

# Euroopan unionin virallinen lehti

# L 278

Suomenkielinen laitos

## Lainsäädäntö

50. vuosikerta

22. lokakuuta 2007

Sisältö I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

### ASETUKSET

- ★ Neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta ..... 1

Hinta: 38 EUR

# FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyyppillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyyppillä ja merkitty tähdellä.

## I

(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

## ASETUKSET

## NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1183/2007,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2007,

**kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta ja ajan tasalle saattamisesta**

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000 <sup>(1)</sup> mukaan kaksikäyttötuotteita (ohjelmistot ja teknologia mukaan luettuina) on valvottava tehokkaasti silloin, kun niitä viedään yhteisöstä.

(2) Jotta jäsenvaltiot ja yhteisö voisivat täyttää kansainväliset sitoumuksensa, asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I esitetään mainitun asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa koskeva yhteinen luettelo, jolla pannaan täytäntöön kansainvälisesti sovitut kaksikäyttötuotteiden valvontajärjestelyt, mukaan luettuina Wassenaarin järjestely, ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR), ydinalan viejämäiden ryhmä (NSG), Australian ryhmä ja kemiallisten aseiden kieltosopimus (CWC).

(3) Asetuksen (EY) N:o 1334/2000 11 artiklassa säädetään, että liitteet I ja IV on ajantasaistettava niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten ja niihin tehtyjen muutosten mukaisesti, joita kukin jäsenvaltio on hyväksynyt kansainvälisten asensulku- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteet I ja IV olisi muutettava niiden muutosten huomioon ottamiseksi, jotka on niiden muutosten jälkeen, jotka näihin liitteisiin tehtiin asetuksella (EY) N:o 394/2006, hyväksytty Wassenaarin järjestelyn, Australian ryhmän, ohjusteknologian valvontajärjestelmän ja ydinalan viejämäiden ryhmän toimesta.

(5) Jotta vientivalvontaviranomaisten ja toimijoiden olisi helppompaa saada säännöksistä selvää, on tarpeen julkaista asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteistä ajantasaistettu ja konsolidoitu toisinto.

(6) Asetus (EY) N:o 1334/2000 olisi siten muutettava tämän mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

*1 artikla*

<sup>(1)</sup> EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 394/2006 (EUVL L 74, 13.3.2006, s. 1).

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteet tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

*2 artikla*

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2007.

*Neuvoston puolesta*  
*Puheenjohtaja*  
R. PEREIRA

LIITE

"LIITE I

**LUETTELO KAKSIKÄYTTÖTUOTTEISTA JA -TEKNOLOGIASTA**

**(asetuksen (EY) N:o 1334/2000 3 artiklassa tarkoitettu)**

Tällä luettelolla pannaan täytäntöön kansainvälisesti sovitut kaksikäyttötuotteiden valvonnat, mukaan lukien Wassenaarin järjestely, ohjusteknologian valvontajärjestely (MTCR), ydinalan viejäm maiden ryhmä (NSG), Australia-ryhmä ja kemiallisten aseiden kieltosopimus. Huomiotta on jätetty kohdat, jotka jäsenvaltiot haluavat asettaa ulkopuolelle jätettävien listalle. Huomiotta on jätetty kansalliset valvonnat (järjestelyihin perustumattomat valvonnat), joita jäsenvaltiot saattavat harjoittaa.

## YLEISET HUOMAUTUKSET LIITTEESEEN I

1. Sotilaskäyttöön suunniteltujen tai muunnettujen tuotteiden valvonnan osalta katso asiaankuuluvaa yksittäisen jäsenmaan ylläpitämää valvontalistaa (-listoja) sotatarvikkeista. Tässä liitteessä viittaukset, jotka toteavat "KATSO MYÖS ASE-TARVIKELUETTELO", viittaavat samoihin listoihin.
2. Tähän liitteeseen sisältyvän valvonnan tarkoitusta ei pidä kumota sellaisten ei-valvonnanalaisien tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun tuo valvonnanalainen komponentti tai ne komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

*Huom.:* Arvioitaessa sitä onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrän, arvon ja sisältyvän teknologisen tietoidon tekijöitä sekä muita erityisolosuhteita, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

3. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

## YDINTEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ydth)

(Sovelletaan 0 ryhmän E osan yhteydessä)

0 ryhmän kaikkiin tuotteisiin suoraan liittyvän "teknologian" siirto on saman tasoisen tarkkailun ja valvonnan alainen kuin tuotteetkin.

"Teknologia" valvonnanalaisien tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Tuotteiden hyväksyminen vientiin oikeuttaa myös tuotteiden käyttöönottoa, toimintaa, ylläpitoa ja korjausta varten tarvittavan vähimmäis"teknologian" viennin samalle loppukäyttäjälle.

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa tai "tieteellistä perustutkimusta".

## YLEINEN TEKNOLOGIAHUOMAUTUS (Ylth)

(Sovelletaan 1–9 ryhmien E osan yhteydessä)

1–9 ryhmässä valvonnanalaisien tuotteiden "kehitystä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten "tarvittavan" "teknologian" vienti on valvonnanalaista 1–9 ryhmien säännösten mukaisesti.

Valvonnanalaisien tuotteiden "kehitystä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten "tarvittava" "teknologia" on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-valvonnanalaisiin tuotteisiin.

Valvonta ei koske sitä vähimmäis"teknologiaa", joka on välttämätön käyttöönottoa, toimintaa, ylläpitoa (tarkastusta) ja korjausta varten tuotteille, jotka eivät ole valvonnanalaisia tai joiden vienti on saatettu luvalliseksi.

*Huom.:* Tämä ei vapauta 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ja 8E002.b kohdassa määriteltyä vastaavaa "teknologiaa".

"Teknologian" siirron valvonta ei koske "julkista" tietoa, "tieteellistä perustutkimusta" tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

## YLEINEN OHJELMISTOHUOMAUTUS (Yloh)

(Tämä huomautus kumoo kaiken 0–9 ryhmien D osan asettaman valvonnanalaisuuden)

Tämän listan 0–9 ryhmät eivät aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka

a. Ovat yleisesti yleisön saatavissa:

1. Myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta:

- a. käsikaupassa;
- b. postimyynissä;
- c. elektronisesti tapahtuvassa myynissä; tai
- d. puhelinmyynissä; ja

2. On suunniteltu käyttäjän käyttöönotettaviksi ilman merkittävää toimittajan tukea; tai

Huom.: Yleisen ohjelmistohuomautuksen a kohta ei vapauta 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedonsuojaus") määriteltyä "ohjelmistoa".

b. Ovat "julkisia".

## TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT

Yksinkertaisissa lainausmerkeissä olevien termien määritelmät on annettu asianmukaisessa teknologiahuomautuksessa.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät ovat seuraavat:

Huom.: Viittaukset ryhmiin ovat suluissa termin määrittelyn jälkeen.

"Aiemmin erotettu" (Previously separated) (0 1) tarkoittaa minkä tahansa sellaisen prosessin käyttöä, jolla halutaan lisätä kontrolloidun isotoopin konsentraatiota.

"Aikavakio" (Time constant) (6) on aika, joka kuluu valoärsytyksen antamisesta siihen kun virran lisäys saavuttaa arvon, joka on  $1-1/e$  kertaa lopullinen arvo (so. 63 % lopullisesta arvosta).

"Aksiaalisiirtymä" (Camming) (2) on pääkaran aksiaalisiirtymä yhden kierroksen aikana, mitattuna karan tasolaikkaa vastaan kohtisuorassa olevassa tasossa, pisteessä, joka on lähinnä tasolaikan kehää (viite ISO 230/1 1986, 5.63 kohta).

"Aktiivinen pikseli" (Active pixel) (6 8) on solid-state-matriisin pienin (yksittäinen) elementti, jolla on valosähköinen siirtokomponentti, kun se altistetaan valolle (sähkömagneettiselle säteilylle).

"Aktiiviset lennonohjausjärjestelmät" (Active flight control systems) (7) ovat järjestelmiä, jotka toimivat "ilma-aluksen" tai ohjuksen ei-toivottujen liikkeiden tai rakenteellisten kuormitusten estämiseksi käsittelemällä itsenäisesti useilta antureilta tulevia tietoja ja antamalla tarvittavia automaatiohjaukseen vaikuttavia ennalta ehkäiseviä komentoja.

"APP" (4) tarkoittaa mukautettua huipputehokkuutta.

"Asettumisaika" (Settling time) (3) tarkoittaa aikaa, joka tarvitaan jotta ulostulo saavuttaa puolen bitin tarkkuudella lopullisen arvon, kun muunnin vaihtaa tilaa minkä tahansa kahden arvon välillä.

"Asiantuntijajärjestelmät" (Expert systems) (7) tarkoittaa järjestelmiä, jotka tuottavat tuloksia soveltamalla käsittelysääntöjä tietoihin, jotka on tallennettu "ohjelmasta" riippumattomasti, ja jotka kykenevät johonkin seuraavista:

- a. muokkaamaan automaattisesti käyttäjän antamaa "lähdekoodia";
- b. tuottamaan johonkin ongelma-alueeseen liittyvää tietoa luonnollista muistuttavalla kielellä; tai
- c. keräämään tietoa itsensä kehittämiseksi (symbolinen harjaannuttaminen).

"Automaattinen maalin seuranta" (Automatic target tracking) (6) tarkoittaa tietojenkäsittelytekniikkaa, joka automaattisesti määrittää ja tulostaa tosiakaisesti maalin todennäköisimmän sijainnin extrapoloidun arvon.

"Avaruusalus" (Spacecraft) (7 9) tarkoittaa aktiivisia ja passiivisia satelliitteja sekä avaruusluotaimia.

"Avaruuskelpoinen" (Space qualified) (3 6) viittaa tuotteisiin, jotka on suunniteltu, valmistettu ja testattu kestäämään avaruuden erityisiä sähköisiä, mekaanisia tai ympäristövaatimuksia, jotta niitä voidaan laukaista ja käyttää satelliiteissa tai 100 km tai sitä korkeammalla toimivissa lentojärjestelmissä.

"Bias" (kiihtyvyyssmittari) (7) tarkoittaa ulostulon arvoa kiihtyvyyssmittarissa, kun siihen ei kohdistu mitään kiihtyvyyttä.

"CE" vastaa "laskentaelementtiä".

"CEP" (yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä) (circle of equal probability) (7) on tarkkuuden mitta; tietyllä etäisyydellä sen ympyrän säde, jonka keskipisteessä on maali ja johon 50 % hyötykuormasta iskeytyy.

"CW-laser" (CW "laser") (6) tarkoittaa "laseria", joka tuottaa nimellisesti vakion lähtöenergian kauemmin kuin 0,25 sekunnin ajan.

"DBRN-järjestelmillä" (Data-Based Referenced Navigation) (7) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa käytetään eri lähteistä saatavaa, ennalta mitattua paikkatietoa, joka on yhdistetty tarkan navigointitiedon tuottamiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tietolähteet voivat olla syvyystietokarttoja, tähtikarttoja, painovoimakarttoja, magneettikarttoja tai kolmiulotteisia numeerisia maastokarttoja.

"Diffuusio-liittäminen" (Diffusion bonding) (1 2 9) tarkoittaa vähintään kahden eri metallin molekyyli-tasoisista jähmeliittämisistä yhdeksi kappaleeksi siten, että liitoslujuus vastaa heikoimman materiaalin lujuutta.

"Digitaalinen kokonaissirtonopeus" (Total digital transfer rate) (5) tarkoittaa toistensa kanssa yhteydessä olevien digitaalisen siirtojärjestelmän laitteiden välillä kulkevien bittien lukumäärää aikayksikössä, mukaan lukien linjan koodaukseen tarvittavat sekä muut lisäbitit.

*Huom.:* Katso myös "digitaalinen siirtonopeus".

"Digitaalinen siirtonopeus" (Digital transfer rate) tarkoittaa minkä tahansa tyyppistä siirtotietä käyttäen suoraan siirretyn informaation kokonaisbittinopeutta.

*Huom.:* Katso myös "digitaalinen kokonaissirtonopeus".

"Digitaalinen tietokone" (Digital computer) (4 5) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkia seuraavia toimintoja yhden tai useamman erillisen muuttujan muodossa:

- a. vastaanottaa tietoa;
- b. tallettaa tietoa tai käskyjä kiinteille tai muutettaville (kirjoitus-) muistilaitteille;
- c. käsitellä tietoa tallennetun käskyjonon avulla, joka on muokattavissa; ja
- d. tulostaa tietoa.

*Huom.:* Tallennetun käskyjonon muokkaus sisältää pysyväismuistiyksiköiden vaihdon, mutta ei langoituksen tai kytkentöjen fyysistä muuttamista.

"Dynaamisesti adaptiivinen reititys" (Dynamic adaptive routing) (5) tarkoittaa automaattista liikenteen uudelleenreititystä, joka perustuu verkon sen hetkisen todellisen tilanteen anturointiin ja analyysiin.

*Huom.:* Tähän eivät sisälly reitityksen päätöstilanteet, jotka tehdään ennalta annetun informaation pohjalta.

"Dynaamiset signaalianalysaattorit" (Dynamic signal analyzers) (3) tarkoittaa "signaalianalysaattoreita", jotka käyttävät digitaalista näytteenotto- ja muunnostekniikkaa muodostaakseen annetulle amplitudi- ja vaiheinformaation sisältävälle aalto-  
muodolle Fourierin spektrinäytön.

*Huom.:* Katso myös "signaalianalysaattorit".

"Ekvivalenttitiheys" (Equivalent density) (6) tarkoittaa optiikan yksikkömassaa optiselle pinnalle projisoitua optisen pinta-  
alan yksikköä kohti.

"Elektroninen kokoonpano" (Electronic assembly) (2 3 4 5) tarkoittaa elektronisten komponenttien (so. 'piirilementtien', 'erilliskomponenttien', integroitujen piirien jne.) joukkoa, joka on kytketty tietyn tehtävän (tai tietyt tehtävät) suorittavaksi kokonaisuudeksi, joka voidaan yksikkönä vaihtaa ja on tavallisesti purettavissa.

*Huom. 1:* 'Piirilementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

*Huom. 2:* 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirilementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

"Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmäantennit" (Electronically steerable phased array antennas) (56) tarkoittaa antennia, joka muodostaa keilan vaihekytkennän avulla, so. keilan suuntausta ohjataan säteilevien elementtien yhdistetyillä virityskertoimilla ja säteen suuntaa voidaan sähköisin signaalein muuttella pysty- tai vaakasuunnassa, tai molemmissa suunnissa, niin lähetyksessä kuin vastaanotossakin.

"Epäsymmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmia, joka käyttää erilaisia matemaattisesti suunniteltuja salaukseen ja salauksen purkuun tarkoitettuja avaimia.

*Huom.:* "Epäsymmetrisen algoritmin" tavanomainen käyttö on avaimen hallinta.

"Eristetyt elävät viljelmat" (Isolated live cultures) (1) tarkoittaa uinuvassa tilassa ja kuivatuissa preparaateissa olevia eläviä viljelmiä.

"Eristystä" (Insulation) (9) käytetään rakettimoottorien osissa, so. rungossa, suuttimessa, läpivienneissä ja rungon väliseinissä, ja se käsittää eristäviä tai tulenkestäviä materiaaleja sisältäviä vulkanoidun tai puoli-vulkanoidun seoskumin levykerroksia. Sitä voidaan käyttää myös rasituksen vaimennustuppeina tai -liuskoina.

"Erityinen halkeamiskelpoinen aine" (Special fissile material) (0) tarkoittaa plutonium-239:ää, uraani-233:a, "isotoopeilla 235 tai 233 rikastettua uraania" ja mitä tahansa edellämainittuja sisältävää ainetta.

"FADEC" vastaa "täyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta".

"Fokusoiva tasojärjestelmä" (Focal plane array) (6) tarkoittaa fokusoivassa tasossa toimivista, lukema-elektronikalla varustetuista tai ilman sitä olevista yksittäisistä ilmaisinelementeistä koostuvaa lineaarista tai kaksiulotteista tasopintaa tai tasopin-tojen yhdistelmää.

Huom.: Tällä ei ole tarkoitus kattaa yksittäisten ilmaisinelementtien pinoa eikä kaksi-, kolme- tai neljäelementtisiä ilmaisimia, edellyttäen että aikaviivästä ja integrointia ei suoriteta elementeissä

"Hajaspektri" (Spread spectrum) (5) tarkoittaa tekniikkaa, jolla suhteellisen kapeakaistaisen tietoliikennekanavan energia levi-tetään huomattavasti laajemman energiaspektrin yli.

"Hajaspektri" tutka (Spread spectrum radar) (6) – katso "Tutkan hajaspektri".

"Henkilökohtainen älykortti" (Personalized smart card) (5) tarkoittaa mikropiirin sisältävää älykorttia, joka on ohjelmoitu eri-tyistä käyttöä varten ja jota käyttäjä ei voi ohjelmoida uudelleen mitään muuta käyttöä varten.

"Hermoverkkotietokone" (Neural computer) (4) tarkoittaa tietokonelaitetta, joka on suunniteltu tai muunnettu jäljittelemään neuronin tai neuroniryhmän käyttäytymistä, so. tietokonetta, jolle on ominaista se, että sen laitteisto kykenee aiemman tie-toon perustuen muuttamaan suurta joukkoa laskennallisten komponenttien välisten kytkentöjen painotusta ja määrää.

"Hetkellinen kaistanleveys" (Instantaneous bandwidth) (3 7) tarkoittaa kaistanleveyttä, jolla lähtöteho pysyy 3 dB:n tarkkuu-della vakiona, ilman että muita toimintaparametreja säädetään.

"Huipputeho" (Peak power) (6) tarkoittaa suurinta tehoa, joka saavutetaan "laserin kestossa".

"Hybridipiiri" (Hybrid integrated circuit) (3) tarkoittaa integroitujen piirien yhdistelmää, joka käsittää integroidun piirin (tai piirejä) tai integroitua piiriä 'piirielementtien' tai 'erilliskomponenttien' yhteydessä, jotka on kytketty toisiinsa tietyn toimin-non (tai toimintojen) suorittamiseksi, ja jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. sisältää vähintään yhden koteloimattoman komponentin;
- b. kytkennät on suoritettu tyypillisiä integroitujen piirien tuotantomenetelmiä käyttäen;
- c. on vaihdettavissa yhtenä kokonaisuutena; ja
- d. ei yleensä ole purettavissa osiinsa.

Huom. 1: 'Piirielementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, tran-sistori, vastus, kondensaattori jne.

Huom. 2: 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen koteloitu 'piirielementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

"Hybriditietokone" (Hybrid computer) (4) tarkoittaa laitetta, joka voi suorittaa kaikkea seuraavaa:

- a. vastaanottaa tietoa;
- b. käsitellä tietoa sekä analogisessa että digitaalisessa muodossa; ja
- c. tulostaa tietoa.

"Ilma-alus" (Aircraft) (1 7 9) tarkoittaa kiinteäsiipistä, kääntyväsiipistä, pyöriväsiipistä (helikopteri) tai kallistuvalla rootto-rilla tai siivillä varustettua ilmakulkuneuvoa.

Huom.: Katso myös "siviili-ilma-alus".

"Ilmaa kevyemmät ilma-alukset" (9) tarkoittavat ilmapalloja ja ilma-aluksia, jotka käyttävät nousemiseen kuumaa ilmaa tai muita ilmaa kevyempiä kaasuja, kuten heliumia tai vetyä.

"Ilmavirran avulla säädely vastamomenttijärjestelmä tai suunnanohjausjärjestelmä" (Circulation controlled anti-torque or cir-culation controlled direction control system) (7) ovat järjestelmiä, jotka käyttävät ilma-aluksen aerodynaamisten pintojen ohi virtaavaa ilmaa lisäämään tai säätämään näiden pintojen synnyttämiä voimia.

"Immunotoksiini" (Immunotoxin) (1) on yhden soluspesifisen monoklonaalisen vasta-aineen ja "toksiinin" tai "toksiinialayk-sikön" muodostama konjugaatti, joka vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin.

"Integroitu kalvopiiri" (Film type integrated circuit) (3) tarkoittaa eristävälle "substraatille" pinnoittamalla muodostettujen ohut- tai paksukalvo "piirielementtien" ja niiden välisten kytkentöjen muodostamaa kokonaisuutta.

*Huom.: 'Piirielementti' on yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa, kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.*

"Integroitu monipalapiiri" (Multichip integrated circuit) (3) tarkoittaa yhteiselle "substraatille" liitettyä kahta tai useampaa "monoliittista integroitua piiriä".

"Isostaattiset puristimet" (Isostatic presses) (2) tarkoittavat laitteita, jotka kykenevät eri väliaineiden avulla (kaasu, neste, kiinteät partikkelit jne.) paineistamaan suljetun tilan, niin että suljetussa tilassa olevaan työkappaleeseen kohdistuu kaikissa suunnissa samansuuruinen paine.

"Isotoopilla 235 tai 233 rikastettu uraani" (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) tarkoittaa uraania, joka sisältää isotooppia 235 tai 233 tai molempia siinä määrin, että näiden isotooppien ylimääräsumman suhde isotooppiin 238 nähden on enemmän kuin luonnossa esiintyvän isotoopin 235 suhde isotooppiin 238 (isotooppisuhde 0,71 %).

"Itsejohtavuuteen perustuva magneettikentän gradiometri" (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) on yksittäinen magneettikentän gradienttia ilmaiseva elementti ja siihen liittyvä elektroniikka, jonka tuloste on magneettikentän gradientin mitta.

*Huom.: Katso myös "magneettikentän gradiometri".*

"ITU:n allokoima" (Allocated by the ITU) (3 5) on taajuuskaistojen allokoimia ITU:n radio-ohjesääntöjen uusimman laitoksen mukaisesti primaari-, sallituille ja sekundaaripalveluille.

*Huom.: Ei sisällä lisä- ja vaihtoehtoisia allokoimia.*

"Jauhaminen" (Comminution) (1) tarkoittaa prosessia, jossa materiaali hajotetaan hiukkasiksi murskaamalla tai jauhamalla.

"Julkinen" (In the public domain) (Ylth Ydth Yloh) tarkoittaa tässä yhteydessä "teknologiaa" ja "ohjelmistoja", jotka ovat saatavilla ilman edelleenlevitystä koskevia rajoituksia (kustannusoikeudelliset rajoitukset eivät estä "teknologiaa" tai "ohjelmistoa" olemasta "julkisia").

"Kaasuatomisointi" (Gas atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa korkeapaineisella kaasuvirtauksella sula metalliseosvirta hajotetaan pisaroiksi, joiden halkaisija on 500 mikrometriä tai vähemmän.

"Kaikki kompensatiot käytettävissä" (All compensations available) (2) tarkoittaa, että otetaan huomioon kaikki valmistajan käytettävissä olevat soveltuvat toimenpiteet yksittäisen työstökoneen kaikkien järjestelmällisten paikannusvirheiden minimoimiseksi.

"Kehitys" (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltäviin vaiheisiin kuten: suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun analysointiin, suunnittelukäsitteisiin, prototyyppien kokoonpanoon ja testaukseen, pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

"Kaikki kompensatiot käytettävissä" (All compensations available) (2) tarkoittaa, että otetaan huomioon kaikki valmistajan käytettävissä olevat soveltuvat toimenpiteet yksittäisen työstökoneen kaikkien järjestelmällisten paikannusvirheiden minimoimiseksi.

"Kehitys" (Development) (Ylth Ydth Kaikki) liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltäviin vaiheisiin kuten: suunnitteluun, suunnittelun tutkimukseen, suunnittelun analysointiin, suunnittelukäsitteisiin, prototyyppien kokoonpanoon ja testaukseen, pilottituotantohankkeisiin, suunnittelutietoihin, suunnittelutietojen muuntamiseen tuotteeksi, konfigurointisuunnitteluun, integrointisuunnitteluun ja piirustuksiin.

"Kemiallinen laser" (Chemical laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa virittymisen aiheuttaa kemiallisen reaktion antama energia.

"Kemiallinen seos" (Chemical mixture) (1) tarkoittaa kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista tuotetta, joka on valmistettu kahdesta tai useammasta aineesta, jotka eivät reagoi keskenään seoksen säilytysolosuhteissa.

"Keskimääräinen lähtöteho" (Average output power) (6) tarkoittaa "laserin" kokonaislähtöenergiaa jouleina jaettuna "laserin kestolla" sekunteina.

"Keskusmuisti" (Main storage) (4) tarkoittaa tietoa tai käskyjä varten tarkoitettua ensisijaista muistia, johon keskusyksiköllä on nopea pääsy. Se koostuu "digitaalisen tietokoneen" sisäisestä muistista ja sen hierarkkisista laajennuksista, kuten väli-muistista tai ei-peräkkäissaantista laajennusmuistista.

"Kieppikara" (Tilting spindle) (2) tarkoittaa työkalunkäsittelykaraa, joka koneistusprosessin aikana muuttaa keskilinjansa kulma-asentoa mihin tahansa muuhun akseliin nähden.

"Kiertymiskulman poikkeama" (Angular position deviation) (2) tarkoittaa kiertymiskulman ja todellisen, erittäin tarkasti mitatun kiertymiskulman välistä maksimiero, kun pöydän työkappaleen alustaa on käännetty alkuperäisestä asennostaan (viite: VDI/VDE 2617, luonnos: "Rotary tables on coordinate measuring machines").

"Kiinteä" (Fixed) (5) tarkoittaa, ettei koodaus- tai pakkausalgoritmi voi ottaa vastaan ulkopuolelta syötettyjä parametrejä (esim. salaus- tai avainmuuttujia) eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.

"Kohdekoodi" (Object code) (9) tarkoittaa yhden tai useamman prosessin tarkoituksenmukaisen esitystavan ("lähdekoodi" (lähdekieli)) laitteessa toteutettavaa muotoa, joka on muunnettu ohjelmointijärjestelmällä.

"Kohinataso" (Noise level) (6) tarkoittaa sähköistä signaalia, joka ilmoitetaan tehon spektritiheytenä. "Kohinatason", joka määriteltynä huipusta-huippuun on  $S_{pp}^2 = 8N_0(f_2-f_1)$ , jossa  $S_{pp}$  on signaalin arvo huipusta-huippuun (esim. nanotesloina),  $N_0$  on tehon spektritiheys (esim. (nanotesla)<sup>2</sup>/Hz) ja  $(f_2-f_1)$  määrittelee tarkasteltavan kaistanleveyden.

"Kokonaisvirtatiheys" (Overall current density) (3) tarkoittaa kelan ampeerikierrosten kokonaismäärää (ts. kierrosten lukumäärä kerrottuna kunkin kierroksen kuljettaman maksimivirran arvolla) jaettuna kelan kokonaispoikkipinnalla (sisältäen suprajohtavat säikeet, metallimatriisin, johon säikeet on upotettu, suojaavan materiaalin, kaikki jäädyttävät elementit jne.).

"Kompensointijärjestelmät" (Compensation systems) (6) koostuvat pääasiallisesta mitta-anturista, yhdestä tai useammasta vertailuanturista (esimerkiksi vektorimagnetometrit) sekä ohjelmistosta, joiden avulla on mahdollista vähentää alustan jäykän rungon pyörimisen melua.

"Komposiitti" (Composite) (1 2 6 8 9) tarkoittaa "matriisia" ja siihen tiettyä tarkoitusta tai tarkoituksia varten lisättyä faasia tai faaseja, jotka koostuvat hiukkasista, whiskerseistä, kuiduista tai mistä tahansa näiden yhdistelmästä.

"Kriittinen lämpötila" (Critical temperature) (1 3 6) (kutsutaan myös joskus transitiolämpötilaksi) tarkoittaa tietyn "suprajohtavan" materiaalin sitä lämpötilaa, jossa materiaali menettää täysin tasavirtavastusarvonsa.

"Kuitu- tai säiemateriaalit" (Fibrous or filamentary materials) (0 1 2 8) sisältävät

- a. jatkuvat monofilamentit;
- b. jatkuvat langat ja rovingit;
- c. teipit, kudokset, matot ja punokset;
- d. katkeet, tapulikuidut ja yhtenäiset kuituhuovat;
- e. erilliskuitukiteet (whiskersit), yksi- tai monikiteisinä ja kaiken pituisina;
- f. aromaattisen polyamidimassan.

"Kuumaisostaattinen puristus" (Hot isostatic densification) (2) tarkoittaa prosessia, jossa valosta paineistetaan yli 375 K (102 °C) asteen lämpötilassa suljetussa tilassa eri väliaineiden avulla (kaasu, neste, kiinteät partikkelit jne.), jotta aikaansaadaan kaikissa suunnissa samansuuruinen voima valoksen sisäisten onteloiden vähentämiseksi tai estämiseksi.

"Kuvan parantaminen" (Image enhancement) (4) tarkoittaa ulkopuolelta saatujen informaatiota sisältävien kuvien käsittelyä algoritmeilla kuten aikakompressio, suodatus, poiminto, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai muunnokset eri tasoihin (kuten nopea Fourier-muunnos tai Walsh-muunnos). Tämä ei sisällä algoritmeja, jotka käyttävät vain yksittäisen kuvan lineaarisia tai toisen asteen muunnoksia kuten kääntäminen, kuvionerotus, kohdistaminen tai vääräväritys.

"Kvanttialaus" (Quantum cryptography) (5) tarkoittaa ryhmää tekniikoita, joilla luodaan jaettu avain "salausta" varten mittaamalla fyysisen järjestelmän kvanttimekaaniset ominaisuudet (mukaan lukien ne fyysiset ominaisuudet, joita määrittävät nimenomaisesti kvanttioptiikka, kvanttikentäteoria tai kvanttisähködynamiikka).

"Käyttäjän ohjelmointimahdollisuus" (User-accessible programmability) (6) tarkoittaa ominaisuutta, joka sallii käyttäjän sisällyttää, muuntaa tai vaihtaa "ohjelmia" muulla tavoin kuin

- a. langoitusta tai kytkentöjä muuttamalla; tai
- b. toimintonäppäimistä asettelemalla, parametrien syöttö mukaan lukien.

"Käyttö" (Use) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa käyttöä, asennusta (paikalla suoritettava asennus mukaan lukien), ylläpitoa (tarkastusta), korjausta, huoltoa ja kunnostusta.

"Köyhdytetty uraani" (Depleted uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka on köyhdytetty alle luonnossa esiintyvän isotooppi 235:n tason.

"Lanka" (Yarn) (1) on kerratuista 'säikeistä' muodostuva kimppu.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaisista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamentista" muodostuva kimppu.

"Laser" (0 2 3 5 6 7 8 9) on komponenttien muodostama kokonaisuus, joka tuottaa sekä avaruudellisesti että ajallisesti koherenttia valoa, jota vahvistetaan stimuloitulla säteilyemissiolla.

Huom.: Katso myös:

"Kemiallinen laser";

"Q-kytkin-laser";

"Suurteholaser";

"Siirtolaser".

"Laserin kesto" (Laser duration) (6) tarkoittaa aikaa, jona "laser" emittoi "laser" säteilyä ja joka "pulssilaserien" osalta vastaa aikaa, jona yksittäinen pulssi tai sarja peräkkäisiä pulsseja emittoidaan.

"Laskentaelementti" ("CE") (Computing element) (4) tarkoittaa pienintä laskentayksikköä, joka tuottaa aritmeettisia tai loogisia tuloksia.

"Lennon kokonaisohjaus" (Total control of flight) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" tilamuuttujien ja lentoradan automaattista ohjausta vastaamalla lentotehtävän tavoitteiden täyttämiseksi tosiaikaisiin muutoksiin tavoitteiden, uhkien tai muiden "ilma-alusten" tiedoissa.

"Lennonohjauksen optinen anturijärjestelmä" (Flight control optical sensor array) (7) on hajautettujen optisten anturien verkko, joka "laser" säteitä käyttäen tuottaa tosiaikaista lennonohjaustietoa ilma-aluksessa tapahtuvaa prosessointia varten.

"Lentoradan optimointi" (Flight path optimization) (7) on proseduri, jolla neljässä ulottuvuudessa (avaruus ja aika) minimoidaan poikkeamia lentotehtävien suorittamiseen tai tehokkuuteen perustuvasta halutusta lentoradasta.

"Lineaarisuus" (Linearity) (2) (mitataan normaalisti epälineaarisuutena) tarkoittaa varsinaisen ominaisuuden (keskimääräisen lukeman) positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa suorasta, joka on asetettu siten, että se tasoittaa tai minimoi maksimipoikkeamat.

"Luonnonuraani" (Natural uranium) (0) tarkoittaa uraania, joka sisältää luonnossa tavattavia isotooppiseosmääriä.

"Lähdekoodi" (tai lähdekieli) (Source code or source language) (4 6 7 9) on sopiva yhden tai useamman prosessin esitystapa, joka voidaan ohjelmointijärjestelmässä muuntaa laitteessa toteutettavaan muotoon ("kohdekoodiksi" tai kohdekielelle).

"Läimäyssammutus" (Splat Quenching) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' jäädytetyn telan päälle sulaa metallivirtaa, joka muodostaa hiutalemaisen tuotteen.

Huom.: 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäähdytysnopeuksilla.

"Maantieteellisesti hajallaan" (Geographically dispersed) (6) tarkoittaa, että jokainen sijainti on missä tahansa suunnassa yli 1 500 m:n päässä kaikista muista. Liikkuvia antureita pidetään aina "maantieteellisesti hajallaan" olevina.

"Magneettikentän gradiometrit" (Magnetic gradiometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten lähteiden magneettikenttien avaruudellista vaihtelua. Ne koostuvat useista "magnetometreistä" ja niihin liittyvästä elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentän gradientin mitta.

Huom.: Katso myös "itseisjohtavuuteen perustuva magneettikentän gradiometri".

"Magnetometrit" (Magnetometers) (6) ovat laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan instrumentin ulkopuolisten lähteiden magneettikenttiä. Ne koostuvat yhdestä magneettikenttää havaitsevasta elementistä ja siihen liittyvästä elektroniikasta, joiden tuloste on magneettikentän mitta.

"Matriisi" (Matrix) (1 2 8 9) tarkoittaa huomattavan jatkuvaa aineen faasia, joka täyttää hiukkasten, whiskersien tai kuitujen välisen tilan.

"Mekaaninen seostaminen" (Mechanical alloying) (1) tarkoittaa seostamisprosessia, jossa alkuaineiden ja perusmetalliseosten jauheet sidostuvat, hajoavat ja sidostuvat uudelleen mekaanisen törmäyksen voimasta. Ei-metallisia hiukkasia voidaan sisällyttää seokseen tarvittavia jauheita lisäämällä.

"Miehittämätön ilma-alus" (Unmanned Aerial Vehicle (UAV)) (9) tarkoittaa ilma-alusta, joka pystyy aloittamaan lennon ja pitämään yllä johdettua lentoa ja lentosuunnistusta ilman, että aluksella on ketään ihmistä.

"Mikro-organismit" (Microorganisms) (1 2) tarkoittaa bakteereita, viruksia, mykoplasmoja, riketsioita, klamydioita tai sieniä, sekä luonnontilaisia, kehitettyjä että muunneltuja, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on tarkoituksella istutettu näitä viljelmiä tai joka on saastutettu niillä.

"Mikroprosessoripiiri" (Microprocessor microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai "monipalapiiriä", joka sisältää ulkoisen muistin yleisluontoisia käskyjä suorittamaan kykenevän aritmetiikkayksikön (ALU).

Huom. 1: "Mikroprosessoripiiri" ei yleensä sisällä sisäistä muistia, johon käyttäjällä olisi pääsy, vaikka se saattaa käyttää samalla lastulla olevaa muistia suorittaessaan loogista toimintaansa.

Huom. 2: Tämä määritelmä sisältää lastuyhdistelmät, jotka on suunniteltu yhdessä toimien huolehtimaan "mikroprosessoripiiri"-toiminnasta.

"Mikrotietokonepiiri" (Microcomputer microcircuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai "monipalapiiriä", joka sisältää sisäisessä muistissa olevia tietoja koskevia sisäisen muistin yleisluontoisten käskyjen sarjoja suorittamaan kykenevän aritmetiikkayksikön (ALU).

Huom.: Sisäistä muistia voidaan laajentaa ulkoisen muistin avulla.

"Mittakerroin" (Scale factor) (gyroskoopissa tai kiihtyvyyssmittarissa) (7) tarkoittaa ulostulon muutoksen suhdetta mitattavaksi aiotun syötteen muutokseen nähden. Mittakerroin ilmaistaan yleisesti sen suoran kaltevuutena, joka voidaan piirtää pienimmän neliösumman menetelmällä syöte- ja tulostearvojen kautta, jotka on saatu vaihtelemalla syötteen arvoa jaksotaisesti syötearvojen alueen yli.

"Mittauksen epävarmuus" (Measurement uncertainty) (2) on ominaisparametri, joka 95 %:n luotettavuustasolla määrittelee, millä alueella saadun tuloksen molemmiin puoliin mitattavan suureen oikea arvo sijaitsee. Se sisältää korjaamattomat systemaattiset poikkeamat, korjaamattoman väljyyden ja satunnaiset poikkeamat (viite ISO 10360–2, tai VDI/VDE 2617).

"Monispektriset kuvannusanturit" (Multispectral imaging sensors) (6) ovat kykeneviä hankkimaan kuvatietoa samanaikaisesti tai peräkkäin kahdesta tai useammasta erillisestä spektrikaistasta. Antureita, joilla on enemmän kuin kaksikymmentä spektrikaistaa, kutsutaan toisinaan hyperspektriseksi kuvannusantureiksi.

"Monitietovirtakäsittely" (Multi-data-stream processing) (4) tarkoittaa 'mikro-ohjelmien' tai laitearkkitehtuurin tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen käsittelyn yhden tai useamman käskyjonon ohjaamana käyttäen sellaisia keinoja kuten

- a. yksi käsky – monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;
- b. monta yksittäistä käskyä – monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;
- c. monta käskyä – monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, läheisesti kytketyt ja väljästi kytketyt mukaan lukien; tai
- d. strukturoidut tiedonkäsittelyelementtien ryhmät, systoliset ryhmät mukaan lukien.

Huom.: 'Mikro-ohjelma' tarkoittaa peruskäskyjen sarjaa, jota säilytetään erillisessä muistissa, ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.

"Monofilamentti" (Monofilament) (1) tai filamentti on säikeen pienin inkrementti, jonka halkaisija on tavallisesti joitakin mikrometrejä.

"Monoliittinen integroitu piiri" (Monolithic integrated circuit) (3) tarkoittaa passiivisten tai aktiivisten "piirilementtien" tai molempien yhdistelmää, joka

- a. on muodostettu diffuusio-, istutus- tai pinnoitusprosesseilla yhden puolijohdepalan (ns. lastun) pintaan tai pinnalle;
- b. voidaan katsoa erottamattomasti yhteen liitetyksi; ja
- c. suorittaa piirin tietyn toiminnon (tai toimintoja).

Huom.: 'Piirilementti' (Circuit element) on yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Mukautettu huipputehokkuus" (Adjusted Peak Performance) (4) tarkoittaa mukautettua huippunopeutta, jolla "digitaaliset tietokoneet" suorittavat 64-bittisten tai sitä suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimituksia, ja joka ilmaistaan painotettuina teraliukulukutoimituksina sekunnissa (WT), yksikköinä, jotka koostuvat 1 012:sta mukautetusta liukulukutoimituksesta sekunnissa.

*Huom.:* Katso ryhmä 4, tekninen huomautus.

"Muotoaan muuttavat peilit" (Deformable mirrors) (6) (joita kutsutaan myös adaptiivisiksi optisiksi peileiksi) tarkoittaa peilejä, joissa

- a. yhtä jatkuvaa optisesti heijastavaa pinnanmuotoa voidaan dynaamisesti muotoilla yksittäisillä momenteilla tai voimilla kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon vääristymiä; tai
- b. useita optisesti heijastavia elementtejä voidaan yksittäin ja dynaamisesti, momenteja tai voimia käyttäen uudelleen asettaa kompensoimaan peilin kohtaavan optisen aaltomuodon vääristymiä.

"Muuttuvan geometrian kantopinnat" (Variable geometry airfoils) (7) tarkoittaa takareunan siivekkeitä tai laippoja, tai johdoreunan solasiivekkeitä tai alaspainuvaa nokkaa, joiden asentoa voidaan lennon aikana ohjata.

"Numeerinen ohjaus" (Numerical control) (2) tarkoittaa prosessin automaattista ohjausta, jossa ohjauslaite käyttää numeerista tietoa, jota se tavallisesti saa toiminnan edetessä (viite: ISO 2382).

"Näyttöalue" (Instrumented range) (6) tarkoittaa tutkan määritelyä, yksikäsitteistä näyttöaluetta.

"Ohjautusjärjestelmä" (Guidance set) (7) tarkoittaa järjestelmiä, jotka yhdistävät kulkuvälineen paikan ja nopeuden mittausta ja laskentaprosessin (so. navigoinnin) kulkuvälineen lennonohjausjärjestelmien lentoradan korjauskomentojen laskenta- ja välitysprosessiin.

"Ohjelma" (Programme) (2) tarkoittaa käskyjonoa, joka voidaan suorittaa tietokoneella tai muuntaa sen suoritettavaksi.

"Ohjelmisto" (Software) (Yloh Kaikki)

Yhden tai useamman ohjelman tai 'mikro-ohjelman' muodostama kokonaisuus missä tahansa käsitettävässä muodossa.

*Huom.:* 'Mikro-ohjelma' tarkoittaa peruskäskyjen sarjaa, jota säilytetään erityisessä muistissa, ja jonka suoritus käynnistyy, kun sen viitekäsky tulee käskyrekisteriin.

"Ohjukset" (Missiles) (1 3 6 7 9) tarkoittaa täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka pysyvät kuljettamaan vähintään 500 kg:n hyötykuorman vähintään 300 km:n etäisyydelle.

"Olennaisin osa" (Principal element) (4) on ryhmää 4 koskien sellainen osa, jonka vaihtoarvo on enemmän kuin 35 % sen järjestelmän kokonaishinnasta, jonka osa se on. Osan arvo on se arvo, jonka järjestelmän valmistaja tai järjestelmän kokoonpanija siitä maksaa. Kokonaisarvo on normaali kansainvälinen myyntihinta vieraille osapuolille valmistuspaikassa tai kuljetuspisteessä.

"Ominaiskimmokerroin" (Specific modulus) (0 1 9) on Youngin kerroin pascaleina ja on yhtä kuin  $N/m^2$  jaettuna ominaispainolla  $N/m^3$ , mitattuna  $(296 \pm 2) K ((23 \pm 2) ^\circ C)$  asteen lämpötilassa sekä  $(50 \pm 5) \%$ :n suhteellisessa kosteudessa.

"Ominaismurtovetolujuus" (Specific tensile strength) (0 1 9) on lopullinen murtovoima pascaleina, joka on yhtä kuin  $N/m^2$  jaettuna ominaispainolla  $N/m^3$ , mitattuna  $(296 \pm 2) K ((23 \pm 2) ^\circ C)$  asteen lämpötilassa sekä  $(50 \pm 5) \%$ :n suhteellisessa kosteudessa.

"Optinen integroitu piiri" (Optical integrated circuit) (3) tarkoittaa "monoliittista integroitua piiriä" tai hybridipiiriä, joka sisältää yhden tai useampia osia, jotka on suunniteltu toimimaan valoanturina tai valolähteenä tai suorittamaan optista tai sähköoptista toimintaa (toimintoja).

"Optinen kytkentä" (Optical switching) (5) tarkoittaa signaalien reititystä tai kytkentää optisessa muodossa muuntamatta niitä sähköisiksi signaaleiksi.

"Optinen tietokone" (Optical computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, joka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään valoa tiedon esittämiseen ja jonka laskenta- tai loogiset tiedonkäsittelyelementit perustuvat suoraan toisiinsa kytkettyihin optisiin komponentteihin.

"Optinen vahvistus" (Optical amplification) (5) tarkoittaa optisen tietoliikenteen vahvistustekniikkaa, jossa erillisen optisen lähteen tuottamia signaaleja vahvistetaan muuntamatta niitä sähköisiksi signaaleiksi, ts. käyttäen optisia puolijohdevahvistimia tai valokuitulumesenssivahvistimia.

"Osallistujavaltio" (Participating state) (7 9) on Wassenaarin järjestelyn jäsenmaa. (Katso [www.wassenaar.org](http://www.wassenaar.org)).

"Paikallisverkko" (Local area network) (4) on tiedonvälitysjärjestelmä, joka

- a. sallii määrittelemättömän määrän yksittäisiä "tietolaitteita" kommunikoida suoraan toistensa kanssa; ja
- b. rajoittuu maantieteellisesti kohtuullisen kokoiselle alueelle (kuten toimistorakennus, tehdas, korkeakoulu, varasto).

*Huom.:* Tietolaite: laite, joka pystyy lähettämään tai vastaanottamaan digitaalista informaatiota sisältäviä sekvenssejä.

"Painelähettimet" (Pressure transducers) (2) ovat laitteita, jotka muuntavat paineen mittaustulokset sähköisiksi signaaleiksi.

"Perusportin etenemisviive" (Basic gate propagation delay time) (3) tarkoittaa etenemisviiveen arvoa, joka vastaa "monoliittisessa integroidussa piirissä" käytetyn perusportin viivettä. Monoliittisten integroitujen piirien 'perheelle' tämä voidaan määrittellä tietyllä joko etenemisviiveenä tyypillistä porttia kohti tietyssä 'perheessä' tai tyypillisenä etenemisviiveenä porttia kohti tietyssä 'perheessä'.

*Huom. 1:* Perusportin etenemisviivettä ei pidä sekoittaa kompleksisen "monoliittisen integroidun piirin" kokonaisviiveeseen sisäänmenon ja ulostulon välillä.

*Huom. 2:* 'Perhe' (Family) tarkoittaa kaikkia integroituja piirejä, joilla on seuraavia valmistusmenetelmiä ja -spesifikaatioita koskevia ominaisuuksia lukuun ottamatta toimintoja, joita ovat

- a. yhteinen laitteisto- ja ohjelmistoarkkitehtuuri;
- b. yhteinen rakenneperiaate ja prosessiteknologia; ja
- c. yhteiset perusominaisuudet.

"Poikkeama" (Run out, out-of-true-running) (2) tarkoittaa pääkaran säteittäistä poikkeamaa yhden kierroksen aikana mitattuna karan akselia vasten suorassa kulmassa olevalla tasolla pisteessä, joka on pyörivän testattavan kappaleen sisä- tai ulkopinnalla (viite ISO 230/1-1986, 5.61 kohta).

"Primäärinen lennon ohjaus" (Primary flight control) (7) tarkoittaa "ilma-aluksen" stabiilisuuden ja liikkeiden ohjausta, joka käyttää voima-/momenttilähteitä, so. aerodynaamisia ohjauspintoja tai propulsiokäyttöistä vektorivastavoimaa.

"Pulssilaserilla" (Pulsed laser) (6) tarkoitetaan "laseria", jonka "pulssin kesto" on 0,25 sekuntia tai vähemmän.

"Pulssin kesto" (Pulse duration) (6) on "laserin" pulssin kesto, FWHI-tasoilla (Full Width Half Intensity) mitattuna.

"Pulssin kompressointi" (Pulse compression) (6) tarkoittaa pitkäaikaisten tutkasignaalien koodausta ja käsittelyä lyhytaikaisina, korkean pulssienergian suomat edut säilyttäen.

"Pyörivä atomisointi" (Rotary atomisation) (1) tarkoittaa prosessia, jossa keskipakovoimalla sulan metallin virrasta tai lähteestä aikaansaadaan läpimitaltaan korkeintaan 500 mikrometrin pisaroita.

"Päätetyövälineet" (End-effectors) (2) tarkoittavat tarraimia, 'aktiivisia työkaluysikköjä' ja kaikkia muita työkaluja, jotka kiinnitetään "robotin" tai manipulaattorin käsivarren kiinnityslaippaan.

*Huom.:* 'Aktiivinen työkaluysikkö' tarkoittaa laitetta, joka kohdistaa työkaluun liikevoimaa tai prosessienergiaa tai anturoi sitä.

"Q-kytkin-laser" (Q-switched laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa energia varastoidaan populaatio inversiossa tai optisessa resonaattorissa ja sitten emittoidaan pulssina.

"Reitit" (System tracks) (6) tarkoittaa käsiteltyjä, korreloituja (kohteen tutkatiedot yhdistelty lentosuunnitelman mukaiseen sijaintiin) ja ajantasalle saatettuja ilma-aluksen sijaintiraportteja, joka on lennonjohtokeskuksen valvojen käytettävissä.

"Resoluutio" (Resolution) (2) tarkoittaa mittalaitteen pienintä inkrementtiä; digitaalisissa mittalaitteissa vähiten merkitsevää bittiä (viite ANSI B-89.1.12).

"Robotti" (Robot) (2 8) tarkoittaa manipulointimekanismia, joka voi olla jatkuvaa rataa tai pisteestä-pisteeseen kulkevaa tyyppeä, voi käyttää antureita ja jolla on seuraavat ominaisuudet:

- a. on monitoiminen;
- b. pystyy muuttuvien liikkeen asemoimaan tai suuntaamaan materiaaleja, osia, työkaluja tai erikoislaitteita kolmessa ulottuvuudessa;

- c. sisältää kolme tai useampia suljetun tai avoimen piirin servolaitteita, jotka voivat sisältää askelmootoreita; ja
- d. on "käyttäjän ohjelmitavissa" opetusajo/toistomenetelmällä tai tietokoneella, joka voi olla ohjelmitava logiikkaohjain, ts. ilman mekaanista väliintuloa.

Huom.: Ylläoleva määritelmä ei sisällä seuraavia laitteita:

1. Manipulaatiomekanismit, jotka ovat ohjattavissa vain manuaalisesti tai kaukokäyttölaitteella;
2. Kiinteän sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteästi ohjelmoiduilla liikkeillä. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteillä pysäyttimillä, kuten tapeilla tai toimikäyrillä. Liikkeiden sarja ja liikeradat tai liikekulmat eivät ole muuttuvia tai muutettavissa mekaanisin, elektronisin tai sähköisin keinoin;
3. Mekaanisesti ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja noudattavat kiinteitä mekaanisesti ohjelmituvia ratoja. Ohjelma on mekaanisesti rajoitettu kiinteillä, mutta aseteltavilla pysäyttimillä, kuten tapeilla tai toimikäyrillä. Liikkeiden sarja ja liikeratojen tai liikekulmien valinta on muutettavissa kiinteän ohjelmamallin rajoissa. Yhden tai useamman akselin ohjelman muutokset (esim. tapeilla tai toimikäyrillä) ovat suoritettavissa vain mekaanisilla operaatioilla;
4. Muut kuin servo-ohjatut muuttuvan sekvenssin manipulaatiomekanismit, jotka ovat automaattisesti liikkuvia laitteita ja toimivat mekaanisesti kiinteiden ohjelmaliikkeiden mukaisesti. Ohjelma on muunneltavissa, mutta liikejako etenee vain mekaanisesti kiinnitettyjen sähköisten binaarilaitteiden tai aseteltavien pysäyttimien antamien binaarisignaalien mukaan;
5. Pinoamislaitteet, joita kutsutaan karteesi-manipulaatiojärjestelmiksi ja jotka on valmistettu korkeavaranon kiinteiksi osiksi ja joiden avulla lokeroiden sisältöä käsitellään (lisätään tai poistetaan).

"Rokote" (Vaccine) on lääkevalmisteena oleva lääke, jolla on joko valmistus- tai käyttömaan sääntelyviranomaisten myöntämä lisenssi tai markkinoille saattamista tai kliinistä tutkimusta koskeva lupa ja jonka tarkoituksena on saada aikaan suojaava immuunivaste sairauden ennaltaehkäisemiseksi niissä ihmisissä tai eläimissä, joille rokote annetaan.

"Roving" (Roving) (1) on suunnilleen samansuuntaista (tavallisesti 12–120) 'säikeistä' muodostuva kimppu.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaista (tavallisesti useammasta kuin 200) "monofilamenteista" muodostuva kimppu.

"Ryömintänopeus" (gyroskooppi) (Drift rate) (7) tarkoittaa gyroskoopin ulostulon komponenttia, joka on toiminnallisesti riippumaton sisääntulon pyörimisestä. Se ilmaistaan kulmapoikkeamana. (IEEE-standardi 528–2001).

"Salaus" (Cryptography) (5) ilmentää periaatteita, välineitä ja menetelmiä, joilla tietoa muunnetaan sen tietosisällön piilottamiseksi, huomaamatta tapahtuvien muutosten estämiseksi tai luvattoman käytön estämiseksi. Salaus rajoittuu tiedon muuntamiseen yhtä tai useampaa 'salaista parametriä' (esim. salausmuuttujia) tai siihen liittyvää avainta käyttäen.

Huom.: 'Salainen parametri': vakio tai avain, jota ei anneta muiden tiedoksi tai pidetään vain tietyn ryhmän tietona.

"Satunnaiskulmapoikkeama" (Angle random walk) (7) tarkoittaa ajan myötä kasaantunutta kulmavirhettä, joka johtuu kulmanopeuden valkoisesta kohinasta. (IEEE-standardi 528–2001).

"Sekoitettu" (Commingled) (1) tarkoittaa termoplastisten kuitujen ja lujitekuitujen filamenttien sekoittamista kokonaan kuitumuodossa olevan lujitekuitu/"matriisi"-sekoituksen tuottamiseksi.

"SHPL" vastaa "suurteholaseria".

"Signaalianalysaattorit" (Signal analysers) (3) tarkoittaa laitteita, jotka kykenevät mittaamaan ja näyttämään monitaajuisten signaalien yksitaajuisten komponenttien perusominaisuuksia.

"Signaalin käsittely" (Signal processing) (3 4 5 6) tarkoittaa ulkoisesta lähteestä tulevien signaalien käsittelyä algoritmeilla kuten kompressio, suodatus, erottelu, valinta, korrelaatio, konvoluutio tai tasomuunnokset (esim. nopea-Fourier- tai Walsh-muunnos).

"Siirtolaser" (Transfer laser) (6) tarkoittaa "laseria", jossa laseroivat aineslajit viritetään siirtämällä energiaa ei-laseroivan atomin tai molekyylin ja laseroivan atomin tai molekyylin aineslajien yhteentörmäyksellä.

"Sisäpinnanvuoraus" (Interior lining) (9) tarkoittaa kiinteän polttoaineen ja rungon tai eristävän vuorauksen välisenä sidoksena käytettävää vuorausta. Tavallisesti se on tulenkestävien tai eristävien materiaalien nestemäiseen polymeeriin, kuten hiihtäytteenä hydroksyyliipäätteinen polybutadieeni (HTPB) tai muu polymeeri, perustuva dispersio, johon on lisätty vulkanoivia aineita ja joka suihkutetaan tai levitetään rungon sisäpinnalle.

"Siviili-ilma-alus" (Civil aircraft) (1 7 9) tarkoittaa "ilma-aluksia", jotka siviili-ilmailuviranomaisten julkaisemien lentokelpoisuuden vahvistavien listojen mukaan on tarkoitettu lentämään kaupallisilla sisäisillä sekä ulkomaan siviililentoreiteillä tai niitä saadaan käyttää lainmukaiseen siviili-, yksityis- tai kaupalliseen käyttöön.

*Huom.:* Katso myös "ilma-alus".

"Sotilaskäyttöön sovitettu" (Adapted for use in war) (1) tarkoittaa mitä tahansa muuntelua tai valintaa (kuten puhtauden, varastointi-ään, myrkyllisyyden, levittämismomenteittien tai UV-säteilyn kestävyysmuuttamista), jolla on tarkoitus lisätä tehokkuutta aiheuttaa tappiota ihmisille tai eläimille, turmella laitteita tai vahingoittaa satoa tai ympäristöä.

"Stabiilisuus" (Stability) (7) tarkoittaa tietyn parametrin variaation (1 sigman) standardipoikkeamaa kalibroidusta arvosta vakio-olosuhteissa mitattuna. Se voidaan esittää ajan funktiona.

"Substraatti" (Substrate) (3) tarkoittaa pohjamateriaalin ohutta levyä, jossa on tai ei ole kytkentäkuviota ja jonka päälle tai sisään voidaan sijoittaa 'erilliskomponentteja' tai integroitua piirejä tai molempia.

*Huom. 1:* 'Erilliskomponentti' (Discrete component): Erikseen kotoitettu 'piirelementti', jolla on omat ulkoiset kytkentäpisteensä.

*Huom. 2:* 'Piirelementti' (Circuit element): Yksittäinen aktiivinen tai passiivinen elektronisen piirin toiminnallinen osa kuten diodi, transistori, vastus, kondensaattori jne.

"Substraattiaihio" (Substrate blanks) (6) tarkoittaa monoliittisiä yhdisteitä, joiden mitat sopivat optisten elementtien (kuten optiset peilit tai ikkunat) tuotantoon.

"Suhteellinen kaistanleveys" (Fractional bandwidth) (3) tarkoittaa "hetkellistä kaistanleveyttä" jaettuna keskitajuudella ja prosenttiosuutena ilmaistuna.

"Sulaerotus" (Melt extraction) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' ja erotetaan nauhamaisia metalliseostuotteita upottamalla pyörivän jäähdetytyn kappaleen lyhyt segmentti sulaan metalliseoskylpyyn.

*Huom.:* 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäähdytysnopeuksilla.

"Sulakehräys" (Melt spinning) (1) tarkoittaa prosessia, jossa 'nopeasti kiinteytetään' sulaa metallivirtaa antamalla sen törmätä pyörivään jäähdetytyn kappaleeseen, niin että muodostuu hiutalemainen, nauhamainen tai saumainen tuote.

*Huom.:* 'Nopea kiinteytys': sulan materiaalin kiinteytys 1 000 K/s ylittävillä jäähdytysnopeuksilla.

"Suoravaikutteinen hydraulipuristus" (Direct-acting hydraulic pressing) (2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa käytetään nesteellä täytettyä joustavaa paljetta suorassa kontaktissa työstettävään kappaleeseen.

"Superplastinen muovaus" (Superplastic forming) (1 2) tarkoittaa muovausprosessia, jossa metalleille, joilla normaalisti huoneen lämpötilassa on alhainen venymä (vähemmän kuin 20 %) tavanomaisessa murtovetolujuuskokeessa, saavutetaan lämpöä käyttämällä prosessin aikana vähintään kaksinkertainen venymä.

"Superseokset" (Superalloys) (2 9) tarkoittaa nikkeli-, koboltti- tai rautapohjaisia seoksia, joiden lujuus yli 922 K (649 °C) asteen lämpötiloissa ja ankarissa ympäristö- ja toimintaolosuhteissa on parempi kuin minkään muun AISI 300 -sarjan metalliseosten.

"Suprajohtava" (Superconductive) (1 3 6 8) tarkoittaa materiaaleja, esim. metallit, metalliseokset tai yhdisteet, jotka voivat menettää kokonaan sähköisen vastusarvonsa, ts., jotka voivat saavuttaa äärettömän suuren sähköisen johtavuuden ja kuljettavat hyvin suuria sähkövirtoja ilman Joule-lämpenemistä.

*Huom.:* Materiaalin "suprajohtavalle" tilalle on yksilöllisesti tunnusomaista "kriittinen lämpötila", kriittinen magneettinen kenttä, joka on lämpötilan funktio, sekä kriittinen virrantiheys, joka on sekä magneettisen kentän että lämpötilan funktio.

"Suurteholaser" (Super High Power Laser) (6) tarkoittaa "laseria", joka pystyy lähettämään lähtöenergiaa, joka (kokonaisuutena tai minä tahansa annoksena) ylittää 1 kJ 50:ssä millisekunnissa tai jonka keskimääräinen tai CW-teho ylittää 20 kW.

"Symmetrinen algoritmi" (5) tarkoittaa salausalgoritmeja, joka käyttää täysin samanlaista avainta sekä salaukseen että salauksen purkuun.

*Huom.:* "Symmetrisen algoritmin" tavanomainen käyttö on avaimen luottamuksellisuus.

"Systolinen matriisitietokone" (Systolic array computer) (4) tarkoittaa tietokonetta, jossa käyttäjä voi ohjata tiedon virtausta ja muuttamista dynaamisesti loogisten porttien tasolla.

"Taajuuden vaihto-aika" (Frequency switching time) (3 5) tarkoittaa maksimiaikaa (so. viivettä), jonka signaali tarvitsee, kun sen valittua lähtötaajuutta vaihdetaan toiselle valitulle lähtötaajuudelle, saavuttaakseen

- a. taajuuden, joka on 100 Hz sisällä lopullisesta halutusta taajuudesta; tai
- b. ulostulon tason, joka on 1 dB sisällä lopullisesta ulostulon tasosta.

"Taajuushyppely" (Frequency hopping) (5) tarkoittaa "hajaspektri" ominaisuuden muotoa, jossa yksittäisen tiedonsiirtokanavan lähetystaajuutta vaihdellaan epäjatkuvasti askelittain satunnaisessa tai puolisuunnaisessa järjestyksessä.

"Taajuussyntesoija" (Frequency synthesiser) (3) tarkoittaa käytettyä tekniikkaa riippumatta mitä tahansa taajuuslähdettä tai signaaligeneraattoria, joka tuottaa yhden tai useamman ulostulon kautta useita samanaikaisia tai vuorottelevia lähtötaajuuksia, joita ohjaavat tai jotka on johdettu tai määrättyvät pienemmästä joukosta normi- (tai perus-)taajuuksia.

"Tarkkuus" (Accuracy) (2 6) tarkoittaa näyttöarvon positiivista tai negatiivista maksimipoikkeamaa standardi- tai tosiarvosta.

"Tarvittava" (Required) (Ylth 1–9) viittaa "teknologian" osalta vain siihen osaan "teknologiaa", joka nimenomaisesti aikaansaa valvottuja suorituksen tasoja, ominaisuuksia tai toimintoja tai lisää niitä. "Tarvittava" "teknologia" voi olla yhteistä eri tuotteille.

"Tehollinen gramma", Erityisen halkeamiskelpoisen aineen (Effective gramme of special fissile material) (0 1) tarkoittaa

- a. plutoniumin isotoopeilla ja uraani-233:lla isotoopin painoa grammoina;
- b. uraanilla, joka on rikastettu yhteen prosenttiin tai enemmän isotoopilla U-235, alkuaineen painoa grammoina kerrottuna sen desimaalisina paino-osina ilmaistun rikastusmäärän neliöllä;
- c. uraanilla, joka on rikastettu alle yhteen prosenttiin isotoopilla U-235, alkuaineen painoa grammoina kerrottuna luvulla 0,0001.

"Tehonhallinta" (Power management) (7) tarkoittaa korkeusmittarin lähettämän signaalin tehon muuttamista siten, että "ilma-aluksen" korkeudella vastaanotettu teho on aina pienin mahdollinen korkeuden määrittämiseen.

"Teippi" (Tape) (1) on punotuista tai yhdensuuntaisista "monofilamenteista", 'säikeistä', "esirovingeista", "touveista" tai "langoista" jne. muodostuva tavallisesti muovillaesikyllästetty materiaali.

Huom.: 'Säie' on suunnilleen samansuuntaisista (tyypillisesti useammasta kuin 200) "monofilamenteista" muodostuva kimppu.

"Teknologia" (Technology) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa erityistä kirjallista tai muussa muodossa olevaa teknistä tietoa, jota tarvitaan tuotteen "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten. Tämä tieto on 'teknisen tiedon' tai 'teknisen avun' muodossa.

Huom. 1: 'Tekninen apu' voi olla muodoltaan ohjeita, taitoja, opetusta, työnsuorustietoutta tai konsultointipalveluja ja saattaa sisältää 'teknisen tiedon' siirtoa.

Huom. 2: 'Tekninen tieto' voi olla muodoltaan piirustuksia, suunnitelmia, kaavioita, malleja, kaavoja, taulukoita, suunnittelukonstruktiota tai määritelmiä, kirjallisia tai muulle medialle tai laitteille, kuten levyille, nauhalle tai lukumuistiin, talletettuja käsikirjoja ja ohjeita.

"Tiedon suojaus" (Information security) (4 5) tarkoittaa kaikkia menetelmiä ja toimintoja, jotka takaavat tiedon tai tiedonvälityksen saatavuuden, luottamuksellisuuden tai eheyden, poislukien menetelmät tai toiminnot, joilla suojaudutaan virheetoiminnoilta. Siihen kuuluu "salaus", 'salauksen analyysi', suojauminen paljastavia vuotoja vastaan ja tietokoneturvallisuus.

Huom.: 'Salauksen analyysi': salausjärjestelmän tai sen syötteiden tai tulosteiden analysointi, jonka tarkoituksena on selvittää luottamuksellisia muuttujia tai sensitiivistä tietoa, selväkielinen teksti mukaan lukien.

"Tieteellinen perustutkimus" (Basic scientific research) (Ylth Ydth) tarkoittaa kokeellista tai teoreettista työtä, jota tehdään pääasiassa uuden tiedon saamiseksi ilmiöiden tai havaittavien faktojen peruseräkkeistä, ja joilla ei ensisijaisesti pyritä mihinkään tiettyyn käytännön päämäärään tai tavoitteeseen.

"Tietoliikennekanavan ohjain" (Communications channel controller) (4) tarkoittaa fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

"Toistuvuus" (Repeatability) (7) tarkoittaa saman muuttujan samoissa toimintaolosuhteissa suoritettujen toistettujen mittausten läheisyyttä toisiinsa, kun mittausten välissä tapahtuu muutoksia olosuhteissa tai muissa kuin toimintajaksossa (Viite: IEEE-standardi 528–2001 (yhden sigman standardipoikkeama)).

"Toksiinialayksiköllä" (Sub-unit toxin) (1) tarkoitetaan kokonaisen "toksiinin" rakenteellisesti ja toiminnallisesti erillistä osaa.

"Toksiinit" (Toxins) (1 2) tarkoittaa valmistustavasta riippumatta tarkoituksellisesti eristettyjen preparaattien tai seosten muodossa olevia myrkyllisiä aineita, lukuun ottamatta toksiineja, joita on saasteina muissa materiaaleissa, kuten patologisissa näytteissä, viljassa, ruokatarvoissa tai "mikro-organismien" kylvöksissä.

"Tosi aikainen kaistanleveys" (Real-time bandwidth) (2 3) on "dynaamisten signaalianalysaattorien" laajin taajuuksien alue, jonka analysaattori voi tulostaa näytölle tai muistiin aiheuttamatta katkoja sisääntulevan tiedon analysoinnissa. Analysaattoreissa, joissa on enemmän kuin yksi kanava, laskelmaa varten tulee käyttää sitä kanavien konfiguraatiota, joka antaa laajimman "tosiaikaisen kaistanleveyden".

"Tosi aikainen käsittely" (Real time processing) (6 7) tarkoittaa tietokonejärjestelmän tiedonkäsittelykykyä, joka käytettävissä olevin resurssein ja järjestelmän kuormituksesta riippumatta turvaa tarvittavan palvelutason taatun vasteajan sisällä, kun ulkoinen tapahtuma käynnistää palvelun.

"Touvi" (Tow) (1) on tavallisesti suunnilleen samansuuntaisten "monofilamenttien" kimppu.

"Tuotanto" (Production) (Ylth Ydth Kaikki) tarkoittaa kaikkia tuotantovaiheita, kuten rakentaminen, tuotanto, suunnittelu, valmistus, integrointi, kokoonpano, asennus, tarkastus, testaus, laadunvalvonta.

"Tuotantolaitteet" (Production equipment) (1 7 9) tarkoittaa "kehitystä" tai yhtä tai useampaa "tuotannon" vaihetta varten erikoisesti suunniteltuja tai muunnettuja työkaluja, mallineita, asettimia, tuurnia, muotteja, suulakkeita, kiinnittimiä, suuntausmekanismeja, testilaitteita sekä muita koneita ja niiden osia.

"Tuotantoympäristö" (Production facilities) (7 9) tarkoittaa laitteita ja niitä varten erityisesti suunniteltuja ohjelmistoja, jotka on yhdistetty kokonaisuudeksi "kehitystä" tai yhtä tai useampaa "tuotannon" vaihetta varten.

"Tutkan hajaspektri" (Radar spread spectrum) (6) tarkoittaa kaikkia modulointitekniikoita, jotka hajauttavat suhteellisen kapean taajuuskaistan signaalien energian laajemman taajuuskaistan yli käyttäen satunnaista tai puolisuatunnaista koodausta.

"Tutkan taajuushyppy" (Radar frequency agility) (6) tarkoittaa kaikkia tekniikoita, jotka vaihtavat puolisuatunnaudessa järjestyksessä pulssitutkan lähettimen kantoaaltoaajuutta pulssien välillä tai pulssiryhmien välillä enemmän kuin mitä on pulssein kaistanleveys.

"Tyhjäatomisointi" (Vacuum atomization) (1) tarkoittaa prosessia, jossa sulasta metallivirrasta aikaansaadaan tyhjässä nopeasti kehittyvän kaasun avulla läpimitaltaan noin 500 mikrometriä tai sitä pienempiä pisaroita.

"Täyden auktoriteetin digitaalinen moottorin ohjaus" ("FADEC") (Full Authority Digital Engine Control) (7 9) tarkoittaa kaasuturbiini- tai yhdistelmätahtimoottorin elektronista ohjausjärjestelmää, joka käyttää digitaalista tietokonetta ohjaamaan moottorin työntövoiman tai akselin lähtötehon säätämiseen tarvittavia muuttujia koko moottorin toiminta-alueella polttoaineen syötön aloittamisesta sen sulkemiseen.

"UF<sub>6</sub>-korroosiota kestäviä aineita" (Materials resistant to corrosion by UF<sub>6</sub>) (0) voivat olla kyseessä olevasta erotusprosessista riippuen kupari, ruostumaton teräs, alumiini, alumiinioksidi, alumiiniseokset, nikkeli tai seos, joka sisältää vähintään 60 painoprosenttia nikkeliä sekä UF<sub>6</sub>-kestävää fluorattua hiilivetypolymeeriä.

"Valtiot, jotka ovat (eivät ole) kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimuspuolia" (States (not) Party to the Chemical Weapons Convention) (1) ovat valtioita, joiden osalta kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä koskeva yleissopimus on (ei ole) tullut voimaan. (Katso [www.opcw.org](http://www.opcw.org)).

"Verkkoliityntäohjain" (Network access controller) (4) tarkoittaa fyysistä liitintä hajautettuun tietoliikenneverkkoon. Se käyttää yhteistä siirtotietä, joka toimii kauttaaltaan samalla "digitaalisella siirtonopeudella" ja jakaa päätteille siirtovuoroja (esim. vuoromerkkien tai kuulostelun avulla). Muista riippumatta se valitsee tietopaketit tai tietoryhmät (esim. IEEE 802), jotka sille on osoitettu. Se on kokoonpano, joka voi olla liitettynä tietokone- tai tietoliikennelaitteeseen viestintäyhteyden luomiseksi.

"Vikasietoisuus" (Fault tolerance) (4) on tietokonejärjestelmän kyky minkä tahansa laitteisto- tai "ohjelmisto"komponentinsa minkä tahansa häiriön jälkeen jatkaa toimintaansa ilman ihmisen väliintuloa tietyllä suoritusasolla, joka takaa toiminnan jatkumisen, tietojen säilymisen ja toiminnan palautumisen ennalleen tietyn ajan kuluessa.

"Viritettävä" (Tunable) (6) tarkoittaa "laserin" kykyä tuottaa jatkuvaa lähtötehoa kaikilla aallonpituuksilla usean "laser" transition alueella. Viiva "laser" tuottaa diskreettejä aallonpituuksia yhdellä "laser" transitiolla eikä sitä katsota "viritettäväksi".

"Ydinreaktori" (Nuclear reactor) (0) tarkoittaa laitteita, jotka ovat reaktoriastian sisällä tai jotka on liitetty suoraan siihen, laitteita, jotka kontrolloivat sydämen tehotasoa sekä komponentteja, jotka normaalisti sisältävät reaktorin sydämen primäärijäähdytettä tai joutuvat suoraan kosketukseen sen kanssa tai ohjaavat sen kulkua.

"Yhdistelmäpyöröpöytä" (Compound rotary table) (2) tarkoittaa pöytää, jolla työkalua voidaan pyörittää tai kallistaa kahden ei-yhdensuuntaisen akselin suhteen, ja joita voidaan ohjata samanaikaisesti "ääri viivaohjausta" varten.

"Yhteen kytketyt tutka-anturit" (Interconnected radar sensors) (6) tarkoittaa, että kaksi tai useampi tutka-anturi on kytketty yhteen, kun ne vaihtavat keskenään tietoa tosiaikaisesti.

"Yhteiskanavamerkinanto" (Common channel signalling) (5) on merkinantomenetelmä, jossa puhelinkeskusten välillä yhdellä kanavalla välitetään tunnuksella varustettujen viestien avulla merkinantotietoa, joka koskee useita piirejä tai puheluja, sekä muuta esim. verkonhallintaan liittyvää tietoa.

"Yksispektriset kuvannusanturit" (Monospectral imaging sensors) (6) ovat kykeneviä hankkimaan kuvatietoa yhdestä erillisestä spektrikaistasta.

"Ääriiviiohjaus" (Contouring control) (2) tarkoittaa kahden tai useamman liikkeen "numeerista ohjausta" käskyillä, jotka määrittävät seuraavan vaadittavan aseman sekä tarvittavat syöttönopeudet tähän asemaan siirtymiseksi. Syöttönopeuksia vaihdellaan toistensa suhteen halutun ääriviivan aikaansaamiseksi (viite ISO/DIS 2806–1980).

## TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETYT AKRONYYMIT JA LYHENTEET

Akronyyimi tai lyhenne, jota käytetään määritellyistä termeistä löytyy "tämän liitteen termien määritelmistä".

Akronyyimi tai lyhenne	Merkitys
ABEC	Annular Bearing Engineers Committee
AGMA	American Gear Manufacturers' Association
AHRS	attitude and heading reference systems (asennon ja suunnan referenssijärjestelmät)
AISI	American Iron and Steel Institute
ALU	arithmetic logic unit (aritmetiikkayksikkö)
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	the American Society for Testing and Materials
ATC	air traffic control (lennonjohto)
AVLIS	Atomic Vapour Laser Isotope Separation (atomihöyryn laserviritykseen perustuva isotooppierotus)
CAD	computer-aided-design (tietokoneavusteinen suunnittelu)
CAS	Chemical Abstracts Service
CCITT	International Telegraph and Telephone Consultative Committee (kansainvälinen neuvoa-antava lennätin- ja puhelinkomitea)
CDU	control and display unit (ohjaus- ja näyttöyksikkö)
CEP	circular error probable (yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä)
CNTD	controlled nucleation thermal deposition (säädeltävä ydintymislämpöhajoaminen)
CRISLA	Chemical Reaction by Isotope Selective Laser Activation (isotooppiselektiivisellä laserilla aktivoitu kemiallinen reaktio)
CVD	chemical vapour deposition (kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
CW	chemical warfare (kemiallinen sodankäynti)
CW (for lasers)	continuous wave (jatkuva aalto (laserit))
DME	distance measuring equipment (etäisyydenmittauslaite)
DS	directionally solidified (suunnatusti kiinteitetty)
EB-PVD	electron beam physical vapour deposition (elektronisuihkun avulla tapahtuva fysikaalinen kaasufaasipinnoitus)
EBU	European Broadcasting Union
ECM	electro-chemical machining (sähkökemiallinen työstö)
ECR	electron cyclotron resonance (elektroni-syklotroni-resonanssi)
EDM	electrical discharge machines (kipinätyöstökoneet)
EEPROMS	electrically erasable programmable read only memory (elektronisesti pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti)
EIA	Electronic Industries Association
EMC	electromagnetic compatibility (sähkömagneettinen mukautuvuus)
ETSI	European Telecommunications Standards Institute (Euroopan telealan standardointilaitos)
FFT	Fast Fourier Transform (Nopea Fourier-muunnos)
GLONASS	global navigation satellite system (globaali navigointisatelliittijärjestelmä)
GPS	global positioning system (globaali paikannusjärjestelmä)
HBT	hetero-bipolar transistors (heterobipolaaritransistori)
HDDR	high density digital recording (suurtiheyksinen digitaalilennus)
HEMT	high electron mobility transistors (korkean elektroniliikkuvuuden transistorit)
ICAO	International Civil Aviation Organisation (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö)
IEC	International Electro-technical Commission (Kansainvälinen sähkötekniikan toimikunta)
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV	instantaneous-field-of-view (hetkellinen näkökenttä)
ILS	instrument landing system (mittarilaskeutumisjärjestelmä)
IRIG	inter-range instrumentation group (monialueinstrumentointiryhmä)
ISAR	inverse synthetic aperture radar (käänteinen synteettinen apertuuritutka)

Akronyymi tai lyhenne	Merkitys
ISO	International Organization for Standardization (Kansainvälinen standardisointijärjestö)
ITU	International Telecommunication Union (Kansainvälinen televiestintäliitto)
JIS	Japanese Industrial Standard
JT	Joule-Thomson
LIDAR	light detecting and ranging (valoon perustuva havainnointi ja etäisyyden mittaaminen)
LRU	line replaceable unit (linjahuollossa vaihdettava yksikkö)
MAC	message authentication code (sanoman autentikointikoodi)
Mach	ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach) (kohteen nopeuden suhde äänen nopeuteen (Ernst Machin mukaan))
MLIS	Molecular laser Isotopic separation (molekyylien laservirtukseen perustuva isotooppien erotus)
MLS	microwave landing systems (mikroaaltoaskeutusjärjestelmät)
MOCVD	metal organic chemical vapour deposition (metalliorgaaninen kemiallinen kaasufaasipinnoitus)
MRI	magnetic resonance imaging (magneettiresonanssikuvaus)
MTBF	mean-time-between-failures (keskimääräinen vikaväli)
Mtops	million theoretical operations per second (miljoonaa teoreettista operaatiota sekunnissa)
MTTF	mean-time-to-failure (keskimääräinen vioittumisaika)
NBC	Nuclear, Biological and Chemical (ydin-, biologinen tai kemiallinen)
NDT	non-destructive test (ainetta rikkomaton testi)
PAR	precision approach radar (tarkkuuslähestymistutka)
PIN	personal identification number (henkilökohtainen tunnusnumero)
ppm	parts per million (miljoonasosa)
PSD	power spectral density (tehon spektritiheys)
QAM	quadrature-amplitude-modulation (kvadratuuri-amplitudi-modulaatio)
RF	radio frequency (radiotaajuus)
SACMA	Suppliers of Advanced Composite Materials Association
SAR	synthetic aperture radar (synteettinen apertuuritutka)
SC	single crystal (yksikide-)
SLAR	sidelooking airborne radar (sivukulmatutka)
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineers (Elokuva- ja televisioalan insinöörien yhdistys)
SRA	shop replaceable assembly (korjaamalla vaihdettava kokoonpano)
SRAM	static random access memory (staattinen luku-/kirjoitusmuisti)
SRM	SACMA Recommended Methods (SACMA:n suosittelemat menetelmät)
SSB	single sideband (yksisivukaista)
SSR	secondary surveillance radar (toisiovalvontatutka)
TCSEC	trusted computer system evaluation criteria (luotettavien tietokonejärjestelmien varmennuskriteerit)
TIR	total indicated reading (koko näyttöalue)
UV	ultraviolet (ultravioletti)
UTS	ultimate tensile strength (murtovetolujuus)
VOR	very high frequency omni-directional range (VHF-monisuuntamajakka)
YAG	yttrium/aluminium garnet (yttrium/alumiinigranaatti)



**RYHMÄ 0**

**YDINAINHEET, LAITTEISTOT JA LAITTEET**



**0A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

0A001 "Ydinreaktorit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut komponentit seuraavasti:

- a. "Ydinreaktorit", jotka voivat ylläpitää säädettävää jatkuvaa ytimien halkeamisketjureaktiota;
- b. Sellaiset metalliset astiat tai niiden merkittävät rakenne-elementit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" sydän, mukaan lukien reaktoripaineastian kansi;
- c. Käsitteilylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineen viemiseksi "ydinreaktoriin" tai polttoaineen poistamiseksi sieltä;
- d. Säätosauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu halkeamisprosessin säätämiseksi "ydinreaktorissa", sauvojen tuki- ja ripustusrakenteet, säätosauvojen käyttökoneistot ja ohjausputket;
- e. Paineputket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään "ydinreaktorin" polttoaine-elementtejä ja primäärijäähdytettä yli 5,1 MPa:n käyttöpaineessa;
- f. Putket tai putkisarjat, jotka on valmistettu zirkoniummetallista tai seoksesta, jossa hafniumin painosuhte zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500, ja jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa";
- g. Jäähdytepumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" primäärijäähdytteen kierrättämiseksi;
- h. "Ydinreaktorin sisäosat", jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorissa", mukaan lukien sydämen tukirakenteet, polttoainekanavat, termiset suojat, verholevyt, sydänritilät ja diffuuserilevyt;

*Huom.:* 0A001.h kohdassa 'ydinreaktorin sisäosat' tarkoittaa mitä tahansa reaktoriastiassa olevaa merkittävää rakennetta, jolla on yksi tai useampi seuraavanlaisista tehtävistä: sydämen tukeminen, polttoaineen paikallaan pitäminen, primäärijäähdytteen virtauksen ohjaus, toimiminen reaktoriastian säteilysuojana ja sydämessä olevien instrumentointilaitteiden ohjaaminen.

- i. Lämmönvaihtimet (höyrytimet), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi "ydinreaktorin" primäärijäähdytyspiirissä;
- j. Neutronien ilmais- ja mittauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorin" sydämessä vallitsevan neutronivuon määrittämiseen.

**OB Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

OB001 Laitokset "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" isotooppien erotusta varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

- a. Laitokset, jotka on erityisesti suunniteltu "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" ja "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" isotooppien erotusta varten, seuraavasti:
1. Kaasusentrifugierotuslaitos
  2. Kaasudiffuusioerotuslaitos
  3. Aerodynaaminen erotuslaitos
  4. Kemialliseen vaihtoon perustuva erotuslaitos
  5. Ionivaihtoon perustuva erotuslaitos
  6. Atomihöyryn "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (AVLIS)
  7. Molekyylien "laser"viritykseen perustuva isotooppierotuslaitos (MLIS)
  8. Plasmaerotuslaitos
  9. Sähkömagneettinen erotuslaitos
- b. Kaasusentrifugit sekä rakenteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi kaasusentrifugierotusprosessissa, seuraavasti:

Huom.: OB001.b kohdassa 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineella' tarkoitetaan jotakin seuraavista:

- a. Maraging-teräs, jonka murtovetolujuus on 2 050 MPa tai suurempi;
  - b. Alumiiniseokset, joiden murtovetolujuus on 460 MPa tai suurempi; tai
  - c. "Kuitu- tai säiemateriaalit", joiden "ominaiskimmomoduuli" on suurempi kuin  $3,18 \times 10^6$  m ja "ominaisvetolujuus" suurempi kuin  $76,2 \times 10^3$  m;
1. Kaasusentrifugit;
  2. Täydelliset roottorikokoonpanot;
  3. Roottoriputkisyliinterit, joiden seinien paksuus on 12 mm tai pienempi ja halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n välillä ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
  4. Renkaat tai palkeet, joiden seinämän paksuus on 3 mm tai pienempi sekä halkaisija 75 mm:n ja 400 mm:n välillä ja jotka on suunniteltu tukemaan paikallisesti roottoriputkea tai liittämään useita putkia yhteen ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
  5. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n välillä olevat ohjauslevyt, jotka on tarkoitettu asennettavaksi roottoriputken sisään ja jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
  6. Halkaisijaltaan 75 mm:n ja 400 mm:n välillä olevat roottoriputken ylä- tai alalaidat, jotka on valmistettu 'korkean lujuus/tiheys -suhteen aineista';
  7. "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" valmistettuun tai sellaisella suojattuun koteloon ripustetut magneettiset ripustuslaakerit, jotka koostuvat rengasmaisesta magneetista ja jotka sisältävät vaimentavan väliaineen ja joissa magneetti kytkeytyy napakappaleeseen tai toiseen roottorin yläkanteen kiinnitettyyn magneettiin;
  8. Erityisvalmisteiset laakerit, jotka koostuvat vaimentimelle asennetusta laakeritappi-kuppi-kokoonpanosta;
  9. Sylintereistä koostuvat molekylaariset pumput, joihin on sisäisesti koneistettu tai puristettu kierrehlausa ja sisäisesti koneistettu porausreikiä;
  10. Monivaiheisten vaihtovirralla toimivien hystereesi- (tai reluktanssi-) moottorien renkaan muotoiset moottoristaattorit tahtikäyttöön tyhjässä taajuusalueella 600–2 000 Hz ja tehoalueella 50–1 000 VA;

- 0B001 b. (jatkoa)
11. Kaasusentrifugin roottoriputkikokoonpanon sentrifugikotelo, joka koostuu jäykästä sylinteristä, jonka seinämän paksuus on enintään 30 mm ja jonka päädyt on tarkkuuskoneistettu ja valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
  12. Sisähalkaisijaltaan enintään 12 mm:n putkista koostuvat kauhakerääjät, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä, UF<sub>6</sub>-kaasun poistamiseksi sentrifugiroottoriputken sisältä Pitot'n putken toimintaperiaatteella;
  13. Taajuusmuuntimet (konvertterit tai invertterit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu syöttämään kaasusentrifugirikastukseen tarkoitettuja moottorin staattoreita ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, ja tällaisia muuntimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
    - a. Monivaiheinen ulostulo 600–2 000 Hz;
    - b. Taajuuden hallinta parempi kuin 0,1 %;
    - c. Harmoninen kokonaissärö pienempi kuin 2 % ja
    - d. Hyötysuhde yli 80 %;
  14. Paljeventtiilit, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 10 mm:n ja 160 mm:n välillä;
- c. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kaasudiffuusioerotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Huokoisista metallisista, polymeerisista tai keraamisista "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut kaasudiffusiosulut, joiden huokosten koko on 10 nm:n ja 100 nm:n välillä ja paksuus 5 mm tai vähemmän sekä putkimaisten muotojen halkaisija 25 mm tai pienempi;
  2. Kaasudiffuusioyksikön kotelot, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
  3. Kompressorit (pakkosyöttö-, keskipakois- ja aksiaalivirtaustyyppiä) tai kaasupuhaltimet, joiden UF<sub>6</sub>-imuteho on 1 m<sup>3</sup>/min tai suurempi ja poistopaine enintään 666,7 kPa ja jotka on tehty "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä;
  4. Pyörivien akselien tiivisteet kompressoreihin ja puhaltimiin, jotka on määritelty 0B001.c.3 kohdassa ja suunniteltu salpakaasun sisäänvuotonopeudelle, joka on pienempi kuin 1 000 cm<sup>3</sup>/min;
  5. Lämmönvaihtimet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, nikkelistä tai yli 60 prosenttia nikkeliä sisältävistä seoksista taikka näiden metallien kombinaatioista verhoiltuina putkina ja jotka on suunniteltu toimimaan normaalin ilmanpaineen alapuolella vuotonopeudella, joka rajoittaa paineen nousun pienemmäksi kuin 10 Pa tunnissa 100 kPa:n paine-eron vallitessa;
  6. Paljettiivisteillä varustetut venttiilit, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n välillä;
- d. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu aerodynaamista erotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Raonmuotoisista kaarevista kanavista tehdyt erotussuuttimet, joiden kaarevuussäde on pienempi kuin 1 mm ja jotka ovat UF<sub>6</sub>-korroosiokestoisia sekä joissa on veitsenterä, joka erottaa suuttimen läpi virtaavan kaasun kahdeksi virraksi;
  2. Tangentiaalisen sisäänmenovirtauksen pyörittämät sylinterimäiset tai kartiomaiset putket (pyörreputket), jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 0,5 cm:n ja 4 cm:n välillä, pituus/halkaisija -suhde pienempi kuin 20:1 ja joilla on yksi tai useampi tangentiaalinen sisäänmenoaukko;
  3. Kompressorit (pakkosyöttö-, keskipakois- ja aksiaalivirtaustyyppiä) tai kaasupuhaltimet, joiden UF<sub>6</sub>-imuteho on vähintään 2 m<sup>3</sup>/min ja jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä, ja niitä varten tarkoitetut pyörimisakselien tiivisteet;
  4. "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut tai niillä suojatut lämmönvaihtimet;
  5. "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" valmistetut tai niillä suojatut aerodynaamisten erotuselementtien kotelot pyörreputkia tai erotussuuttimia varten;

- 0B001 d. (jatkoa)
6. Paljeventtiilit, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojattu niillä ja joiden halkaisija on 40 mm:n ja 1 500 mm:n välillä;
  7. Prosessijärjestelmät UF<sub>6</sub>-kaasun erottamiseksi kantokaasusta (vety tai helium) 1 ppm:n tai alhaisempaan UF<sub>6</sub>-pitoisuuteen, mukaan lukien:
    - a. Kryogeeniset lämmönvaihtimet ja kryoerottimet, jotka kykenevät toimimaan 153 K (– 120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
    - b. Kryogeeniset jäähdytysyksiköt, jotka kykenevät toimimaan 153 K (– 120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
    - c. Erotussuutin- tai pyörreputkiyksiköt UF<sub>6</sub>-kaasun erottamiseksi kantokaasusta;
    - d. UF<sub>6</sub>-kylmäloukut, jotka pystyvät toimimaan 253 K (– 20 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
- e. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kemialliseen vaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Nopeavaihtoiset neste-neste-pulsikolonnit, joiden saosaika vaihetta kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa (esim. sopivista muoviaiaineista kuten fluorihilipolymeereistä tai lasista valmistetut tai niillä vuorattut);
  2. Nopeavaihtoiset neste-neste-keskipakokontaktorit, joiden saosaika vaihetta kohti on 30 sekuntia tai lyhyempi ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa (esim. sopivista muoviaiaineista kuten fluorihilipolymeereistä tai lasista valmistetut tai niillä vuorattut);
  3. Vahvoja suolahappoliuoksia kestävät sähkökemialliset pelkistyskennot, jotka soveltuvat yhden valenssitilan uraanin pelkistämiseen toiseen valenssitilaan;
  4. Sähkökemialliset pelkistyskennojen syöttölaitteet U<sup>+4</sup>-ionien erottamiseksi orgaanisesta virrasta ja ne prosessivirran kanssa kosketuksissa olevat laitteet, jotka on valmistettu sopivista aineista (esim. lasi, fluorihilipolymeerit, polyfenyyliisulfaatti, polyeetterisulfoni ja hartsikyllästetty grafiitti) tai suojattu niillä;
  5. Hyvin puhdistetun uraanikloridiliuoksen tuottamiseen tarkoitettujen syötön valmistelijärjestelmät, jotka koostuvat puhdistukseen tarkoitetuista liuotus-, uutin- ja/tai ioninvaihtolaitteista sekä U<sup>+6</sup>- tai U<sup>+4</sup>-uraanin pelkistämiseen U<sup>+3</sup>-uraaniksi soveltuvista elektrolyttisistä kennoista;
  6. Uraanin hapettamisjärjestelmät U<sup>+3</sup>-uraanin hapettamiseksi U<sup>+4</sup>-uraaniksi;
- f. Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ioninvaihtoon perustuvaa erotusprosessia varten, seuraavasti:
1. Nopeasti reagoivat ioninvaihtohartsit, kalvomaiset tai huokoiset makroverkkomaiset hartsit, joissa aktiiviset kemialliset vaihtoryhmät on rajoitettu ei-aktiivisen huokoisen tukirakenteen pinnotteeksi, ja muut komposiittirakenteet missä tahansa sopivassa muodossa, mukaan lukien partikkelit ja kuidut, joiden halkaisija on 0,2 mm tai pienempi ja suunniteltu vaihtopuoliintumisaika on alle 10 sekuntia ja jotka kestävät vahvaa suolahappoa ja kykenevät toimimaan 373 K–473 K (100 °C–200 °C) asteen lämpötila-alueella;
  2. (Sylinterinmuotoiset) ioninvaihtokolonnit, joiden halkaisija on suurempi kuin 1 000 mm ja jotka on valmistettu vahvaa suolahappoa kestävästä aineista (esim. titaani tai fluorihilimuovit) tai suojattu niillä ja jotka kykenevät toimimaan 373 K–473 K (100 °C–200 °C) asteen lämpötila-alueella ja yli 0,7 MPa:n paineessa;
  3. Ioninvaihtokaisinvirtausjärjestelmät (kemialliset tai sähkökemialliset hapetus- tai pelkistysjärjestelmät) kemiallisten pelkistys- tai hapetusaineiden talteenottamiseksi ioninvaihtoon perustuvissa rikastuskaskadeissa;
- g. Atomihöyryn "laser"-viritykseen perustuvaa isotooppierotusmenetelmää (AVLIS) varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
1. Uraanin höyryttämiseen soveltuvat suuritehoiset kaista- tai pyyhkäisyelektronisuihkutykit, joiden tuottama teho on enemmän kuin 2,5 kW/cm<sup>2</sup>;

0B001 g. (jatkoa)

2. Sulan uraanin tai uraaniseosten käsittelyyn soveltuvat sulan uraanimetallin käsittelyjärjestelmät, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista, muiden harvinaisten maametallien oksideilla päällystetystä grafiitista tai niiden seoksista) valmistetuista tai suojuetuista upokkaista ja upokkaiden jäähdytyslaitteista;

**HUOM.: KATSO MYÖS 2A225 KOHTA.**

3. Tuote- ja jätekerääjäjärjestelmät, jotka on valmistettu uraanimetallihöyryn tai nestemäisen uraanin korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista, kuten yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista tai tantaalista, tai pinnoitettu niillä;
4. Erotusyksikön kotelot (sylinterinmuotoiset tai suorakulmaiset astiat), joihin voidaan sijoittaa uraanimetallin höyrytin, elektronisuihkutykki ja tuote- ja jätekerääjät;
5. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"järjestelmät, joissa oleva taajuusspektirin stabiilaattori mahdollistaa pitkäaikaisen käytön;

**HUOM.: KATSO MYÖS 6A005 JA 6A205 KOHTA.**

h. Molekyylin "laser"viritykseen perustuvaa isotooppien erotusprosessia (MLIS) tai isotooppiselektiivisellä "laserilla" aktivoitua kemiallista reaktiota (CRISLA) varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Ääntä nopeammilla virtauksilla toimivat paisuntasuuttimet, joilla voidaan jäähdyttää  $UF_6$ :n ja kantokaasun seokset 150 K (– 123 °C) asteeseen tai sitä alhaisempaan lämpötilaan ja jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista";
2. Uraanipentafluoridin (UF<sub>5</sub>) kerääjät, jotka koostuvat suodatin-, törmäys-, tai syklonityyppisistä kerääjistä tai niiden yhdistelmistä ja jotka on valmistettu "UF<sub>5</sub>-/UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista";
3. Kompressorit, jotka on valmistettu "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tai suojuetu niillä, ja niihin soveltuvat pyörimisakselien tiivisteet;
4. Laitteet UF<sub>5</sub>:n (kiinteä aine) fluoraamiseksi UF<sub>6</sub>-ksi (kaasu);
5. Prosessijärjestelmät UF<sub>6</sub>:n erottamiseksi kantokaasusta (esim. typestä tai argonista) mukaan lukien:
  - a. Kryogeeniset lämmönvaihtimet ja kryogeeniset erottimet, jotka kykenevät toimimaan 153 K (– 120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
  - b. Kryogeeniset jäähdytysyksiköt, jotka kykenevät toimimaan 153 K (– 120 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
  - c. UF<sub>6</sub>-kylmäloukut, jotka kykenevät toimimaan 253 K (– 20 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa lämpötiloissa;
6. Uraani-isotooppien erottamiseen soveltuvat "laserit" tai "laser"järjestelmät, joissa oleva taajuusspektirin stabiilaattori mahdollistaa pitkäaikaisen käytön;

**HUOM.: KATSO MYÖS 6A005 JA 6A205 KOHTA.**

i. Plasmaerotusmenetelmää varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:

1. Ionien tuottamiseen tai kiihdyttämiseen soveltuvat mikroaaltolähteet ja antennit, joiden lähtötaajuus on enemmän kuin 30 GHz ja keskimääräinen lähtöteho suurempi kuin 50 kW;
2. Radiotaajuusionivirityskelat, jotka toimivat yli 100 kHz:n taajuuksilla ja kykenevät käsittelemään yli 40 kW:n keskimääräisen tehon;
3. Uraaniplasman synnyttämiseen soveltuvat järjestelmät;

- 0B001 i. (jatkoa)
4. Sulan uraanin tai uraaniseosten käsittelyyn soveltuvat sulan metallin käsittelyjärjestelmät, jotka koostuvat sopivista korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista (esim. tantaalista, yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista, muiden harvinaisten maametallien oksideilla päällystetystä grafiitista tai niiden seoksista) valmistetuista tai suojatuista upokkaista ja upokkaiden jäähdytyslaitteista;

**HUOM.: KATSO MYÖS 2A225 KOHTA.**

5. Tuote- ja jätekerääjät, jotka on valmistettu uraanihöyryn korroosiota ja lämpöä kestävästä aineista, kuten yttriumoksidilla päällystetystä grafiitista tai tantaalista, tai suojattu niillä;
6. Erotusyksikön (sylinterimäinen) kotelo, johon voidaan sijoittaa uraaniplasmalähde, radiotaajuinen ajokela ja tuote- ja jätekerääjät, ja joka on tehty sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. ruostumattomasta teräksestä);
- j. Sähkömagneettista isotooppierotusmenetelmää varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
1. Joko yhden tai useita ionisuihkuja synnyttävät ionilähteet, jotka koostuvat höyrylähteestä, ionisaattorista ja suihkun kiihdyttimestä, jotka on valmistettu sopivasta ei-magneettisesta aineesta (esim. grafiitista, ruostumattomasta teräksestä tai kuparista) ja jotka kykenevät tuottamaan 50 mA:n tai suuremman kokonaisionivirran;
2. Rikastetun tai köyhdytetyn uraani-ionisuihkun keräyslevyt, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta raosta ja keräystaskusta ja jotka on valmistettu sopivista ei-magneettisista aineista (esim. grafiitista tai ruostumattomasta teräksestä);
3. Uraanin sähkömagneettisten erotusyksiköiden tyhjökotelot, jotka on valmistettu ei-magneettisista aineista (esim. ruostumattomasta teräksestä) ja suunniteltu toimimaan 0,1 Pa:n tai sitä alhaisemmissa paineissa;
4. Magneettinapakappaleet, joiden läpimitta on suurempi kuin 2 m;
5. Ionilähteisiin tarvittavat suurjänniteteholähteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. Kykenevät toimimaan jatkuvasti;
- b. Ulostulojännite 20 000 V tai suurempi;
- c. Ulostulovirta 1 A tai suurempi ja
- d. Jännitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin jakson aikana;

**HUOM.: KATSO MYÖS 3A227 KOHTA.**

6. Magneettien teholähteet (suuritehoiset, tasavirta-), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. Kykenevät toimimaan jatkuvasti siten, että lähtövirta on 500 A tai suurempi jännitteen ollessa 100 V tai suurempi; ja
- b. Virran tai jännitteen stabiilisuus parempi kuin 0,01 % kahdeksan tunnin jakson aikana.

**HUOM.: KATSO MYÖS 3A226 KOHTA.**

- 0B002 Kohdassa 0B001 määriteltyjä isotooppierotuslaitoksia varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut, "UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävästä aineista" tehdyt tai niillä suojatut apujärjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:
- a. Autoklaavit, uunit tai järjestelmät, joita käytetään UF<sub>6</sub>:n syöttämiseen rikastusprosessiin;
- b. Kiinteyttimet (desublimaattorit) tai kylmäloukut, joita käytetään UF<sub>6</sub>:n poistamiseen rikastusprosessista myöhempää lämmittämällä tapahtuvaa siirtoa varten;
- c. Tuote- ja jäteasemat UF<sub>6</sub>:n siirtämiseksi säilytysastioihin;

- OB002 (jatkoa)
- d. Nesteytys- tai kiinteytysasemat, joita käytetään poistamaan  $UF_6$  väkevöintiprosessista puristamalla ja jäähdyttämällä  $UF_6$  nestemäiseen tai kiinteään olomuotoon;
  - e. Putkisto- ja kokoojajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu  $UF_6$ :n käsittelyyn kaasudiffuusio-, sentrifugi- ja aerodynaamisen erotuslaitoksen kaskadissa;
  - f.
    1. Tyhjöjakoputket tai tyhjökokoojat, joiden imukyky on  $5 \text{ m}^3/\text{min}$  tai suurempi; tai
    2. Tyhjöpumput, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi  $UF_6$ :tta sisältävässä ilmakehässä;
  - g.  $UF_6$ -massaspektrometrit/ionilähteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu ottamaan jatkuvatoimisesti näytteitä  $UF_6$ -kaasun syötteestä, tuotteesta tai jätteestä ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    1. Yhden atomimassayksikön erotuskyky, kun mitattava massa on suurempi kuin 320 atomimassayksikköä;
    2. Ionilähteet, jotka on valmistettu nichrome- tai monel-metallista tai vuorattu niillä taikka päällystetty nikkelillä;
    3. Elektronipommitukseen perustuva ionisointilähde; ja
    4. Isotooppianalyysiin soveltuva kokoojajärjestelmä.
- OB003 Uraanin konversiolaitos ja erityisesti sitä varten suunnitellut tai valmistetut laitteet seuraavasti:
- a. Järjestelmät, joilla uraanimalmikoncentraatit voidaan muuttaa  $UO_3$ :ksi;
  - b. Järjestelmät, joilla  $UO_3$  voidaan muuttaa  $UF_6$ :ksi;
  - c. Järjestelmät, joilla  $UO_3$  voidaan muuttaa  $UO_2$ :ksi;
  - d. Järjestelmät, joilla  $UO_2$  voidaan muuttaa  $UF_4$ :ksi;
  - e. Järjestelmät, joilla  $UF_4$  voidaan muuttaa  $UF_6$ :ksi;
  - f. Järjestelmät, joilla  $UF_4$  voidaan muuttaa uraanimetalliksi;
  - g. Järjestelmät, joilla  $UF_6$  voidaan muuttaa  $UO_2$ :ksi;
  - h. Järjestelmät, joilla  $UF_6$  voidaan muuttaa  $UF_4$ :ksi;
  - i. järjestelmät, joilla  $UO_2$  voidaan muuttaa  $UCl_4$ :ksi.
- OB004 Raskaan veden, deuteriumin ja deuteriumyhdisteen tuotanto- tai konsentrintilaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit seuraavasti:
- a. Raskaan veden, deuteriumin tai deuteriumyhdisteen tuotantolaitos seuraavasti:
    1. Vesi-rikkivety-erotuslaitokset;
    2. Ammoniakki-vety-erotuslaitokset;
  - b. Laitteet ja komponentit seuraavasti:
    1. Hienohiiliteräksistä (esim. ASTM A 516) valmistetut vesi-rikkivety-erotustornit, joiden läpimitta on 6 m:n ja 9 m:n välillä ja jotka voivat toimia 2 MPa:n tai sitä suuremmassa paineessa sekä joiden korroosiovara on 6 mm tai enemmän;
    2. Rikkivetykaasun (yli 70 prosenttia  $H_2S$ :ää sisältävän kaasun) kierrätykseen soveltuvat yksivaiheiset pienipaineiset (0,2 MPa) keskipakopuhaltimet tai kompressorit, joiden tilavuusvirta on  $56 \text{ m}^3/\text{s}$  tai suurempi niiden toimiessa 1,8 MPa:n imua vastaavassa tai suuremmassa paineessa ja jotka on varustettu  $H_2S$ -märkäkäyttöön suunnitelluilla tiivisteillä;

- OB004 b. (jatkoa)
3. Ammoniakki-vety-erotustornit, joiden korkeus on 35 m tai suurempi ja läpimitta 1,5 m:n ja 2,5 m:n välillä ja jotka voivat toimia suuremmissa paineissa kuin 15 MPa;
  4. Tornien sisäiset osat, mukaan lukien kosketuspinnat, ja vaihepumput, mukaan lukien upotettavat pumput, jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
  5. Ammoniakkikrakerit, joiden käyttöpaine on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 MPa ja jotka soveltuvat raskaan veden valmistukseen ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
  6. Infrapuna-absorptioanalysaattorit, jotka kykenevät jatkuvaan vety-deuterium-suhteen mittaamiseen, kun deuteriumpitoisuus on 90 prosenttia tai enemmän;
  7. Katalyyttipolttimet, joilla väkevöity deuterium muutetaan raskaaksi vedeksi ammoniakki-vety-erotusprosessin avulla;
  8. Täydelliset järjestelmät tai niiden kolonnit, joilla parannetaan raskaan veden laatua, raskaan veden deuteriumpitoisuuden konsentroimiseksi reaktoriluokkaan.
- OB005 "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.
- Huom.: "Ydinreaktorin" polttoaine-elementtien valmistukseen erityisesti suunniteltu laitos sisältää laitteet, jotka:
- a. Tavallisesti ovat suoraan yhteydessä ydinaineiden tuotantovirtaan tai suoraan prosessoivat tai valvovat sitä;
  - b. Sulkevat ydinaineet ilmatiiviisti suojakuoren sisään;
  - c. Tarkistavat suojakuoren eheyden tai sulkemisen ilmatiiviiden; tai
  - d. Tarkistavat suljetun polttoaineen viimeistelyn.
- OB006 "Ydinreaktorin" säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet ja komponentit.
- Huom.: OB006 kohtaan kuuluvat:
- a. "Ydinreaktorin" säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitos sekä laitteet ja komponentit, jotka tavallisesti ovat suoraan yhteydessä säteilytettyyn polttoaineeseen ja pääasiallisiin ydinaineiden ja fission tuotteiden prosessivirtoihin ja suoraan ohjaavat niitä;
  - b. Polttoaine-elementtien paloittelu- tai pilkkomiskoneet, ts. kauko-ohjatut laitteet, jotka leikkaavat, paloittavat, pilkkovat tai katkavat "ydinreaktorien" säteilytettyjä polttoainekokoonpanoja, -nipputa tai -sauvoja;
  - c. Liuotinastiat, kriittisyysturvalliset tankit (esim. pieniläpimittaiset tankit, rengasmaiset tai laattatankit), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu "ydinreaktorien" säteilytetyn polttoaineen liuottamiseen ja jotka kykenevät kestämaan kuumia, voimakkaasti syövyttäviä nesteitä ja joita voidaan täyttää ja huoltaa kauko-ohjatusti;
  - d. Vastavirtauuttimet ja ioninvaihtoprosessilaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi säteilytetyn "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" tai "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" jälleenkäsittelylaitoksissa;
  - e. Säilytys- tai varastoastiat, jotka on erityisesti suunniteltu kriittisyysturvalliseksi ja kestämaan typpihapon syövyttäviä vaikutuksia;

OB006 Huom.: e. (jatkoa)

Huom.: Säilytys- tai varastoastioilla voi olla seuraavat ominaisuudet:

1. Seinämien tai sisärankenteiden booriekvivalenttipitoisuus (laskettuna OCO4:ää koskevassa huomautuksessa olevan kaavan mukaisesti kaikkien olennaisten elementtien osalta) vähintään kaksi prosenttia;
  2. Sylinterimäisen astian halkaisija korkeintaan 175 mm; tai
  3. Joko laatta- tai rengasmaisen astian leveys korkeintaan 75 mm.
- f. Prosessin valvontainstrumentointi, joka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu säteilytetyn "luonnonuraanin", "köyhdytetyn uraanin" tai "erityisten halkeamiskelpoisten aineiden" jälleenkäsittelyn valvontaan tai ohjaamiseen.

OB007 Plutoniumin konversiolaitos ja sitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet seuraavasti:

- a. Järjestelmät plutoniumnitraatin muuttamiseksi plutoniumoksidiksi;
- b. Järjestelmät plutoniummetallin tuottamiseksi.

**0C Materiaalit**

0C001 "Luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista;

Huom.: 0C001 kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi seuraavia:

- a. Neljä grammaa tai vähemmän "luonnonuraania" tai "köyhdytettyä uraania", kun se on instrumenttien anturoivassa osassa;
- b. Erityisesti seuraaviin rauhanomaisiin, ei-ydinteknisiin sovellutuksiin käytetty "köyhdytetty uraani":
  1. Suojaus;
  2. Pakkaus;
  3. Painolastit, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
  4. Vastapainot, joiden massa on pienempi kuin 100 kg;
- c. Vähemmän kuin viisi prosenttia toriumia sisältävät seokset;
- d. Toriumia sisältävät keraamiset tuotteet, jotka on valmistettu muuta kuin ydinteknistä käyttöä varten.

0C002 "Erityinen halkeamiskelpoinen aine"

Huom.: 0C002 kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi määrää, joka on neljä "tehollista grammaa" tai vähemmän kyseistä ainetta, kun se on instrumenttien anturoivassa osassa.

0C003 Deuterium, raskas vesi (deuteriumoksidi) ja muut deuteriumyhdisteet sekä deuteriumia sisältävät seokset ja liuokset, joissa deuterium-vety-isotooppisuhte ylittää arvon 1:5 000.

0C004 Reaktoriluokan grafiitti, jonka puhtaustaso on vähemmän kuin 5 miljoonasosaa 'booriekvivalenttia' ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,5 g/cm<sup>3</sup>.

**HUOM.: KATSO MYÖS 1C107 KOHTA.**

Huom. 1: 0C004 kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi:

- a. grafiittivalmisteita, joiden massa on pienempi kuin 1 kg, lukuun ottamatta sellaisia jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäväksi ydinreaktorissa,
- b. grafiittijauhetta.

Huom. 2: 0C004 kohdassa 'booriekvivalentti' (BE) (Boron equivalent) määritellään epäpuhtauksille summuna BE<sub>Z</sub>:ista (lukuun ottamatta BE<sub>hiili</sub>:ia, koska hiiltä ei lasketa epäpuhtaudeksi) mukaan lukien boorin, jolloin

$$BE_Z \text{ (ppm)} = CF \times \text{alkuaineen } Z \text{ konsentraatio ppm-yksiköinä,}$$

$$\text{jossa } CF \text{ on muunnoskerroin} = \frac{\sigma_Z \times A_B}{\sigma_B \times A_Z}$$

$\sigma_B$  ja  $\sigma_Z$  ovat vastaavat boorin ja alkuaineen Z termiset neutronikaappausvaikutusalat (barn-yksiköinä);  $A_B$  ja  $A_Z$  ovat boorin ja alkuaineen Z atomipainot.

0C005 Kaasudiffuusiokalvojen valmistukseen erityisesti valmistetut UF<sub>6</sub>-korroosiota kestävät yhdisteet tai jauheet (esim. nikkeli tai seos, joka sisältää 60 painoprosenttia tai enemmän nikkeliä, alumiinioksidi ja täysin fluoraattut hiilivetyypolymeerit), joiden puhtaus on 99,9 painoprosenttia tai enemmän ja joissa keskimääräinen partikkelikoko on vähemmän kuin 10 mikrometriä mitattuna ASTM (American Society for Testing and Materials) B 330 -standardin mukaisesti ja joissa partikkelit ovat hyvin samankokoisia.

**0D Ohjelmistot**

0D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu tässä ryhmässä määriteltyjen tavaroiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

**0E**      **Teknologia**

0E001      ”Teknologia” ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti tässä ryhmässä määriteltyjen tavaroiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

**RYHMÄ 1**

**MATERIAALIT, KEMIKAALIT, "MIKRO-ORGANISMIT" JA "TOKSIINIT"**



**1A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

1A001 Seuraavat fluoratuista yhdisteistä valmistetut komponentit:

- a. "Ilma-aluksiin" tai avaruuskäyttöön erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat, tiivisteaineet tai polttoainekalvot, joiden valmistuksessa on käytetty yli 50 painoprosenttia 1C009.b tai 1C009.c kohdassa määritettyjä materiaaleja;
- b. Pietsosähköiset polymeerit ja sekapolymeerit, jotka on valmistettu 1C009.a kohdassa määritellyistä vinylideenifluorideista:
  1. Levyn tai kalvon muodossa; ja
  2. Joiden paksuus on yli 200 mikrometriä;
- c. "Ilma-aluksiin", 'ohjuksiin' tai avaruuskäyttöön erityisesti suunnitellut tiivisteet, tiivisterenkaat, venttiilien istukat tai kalvot, jotka on valmistettu fluoroelastomeerista, joka sisältää ainakin yhden vinyylieetteriryhmän ainesosana.

*Huom.:* 1A001.c kohdassa 'ohjus' tarkoittaa täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä.

1A002 Seuraavat "komposiitti"rakenteet tai -laminaatit:

**Huom.:** KATSO MYÖS 1A202, 9A010 ja 9A110 KOHTA.

- a. Jotka koostuvat orgaanisesta "matriisista" ja 1C010.c, 1C010.d tai 1C010.e kohdassa määritellyistä materiaaleista; tai
- b. Jotka koostuvat metalli- tai hiili"matriisista" ja jostain seuraavista:
  1. Hiili"kuitu- tai -säiemateriaaleista", joiden:
    - a. "Ominaiskimmokerroin" ylittää  $10,15 \times 10^6$  m; ja
    - b. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää  $17,7 \times 10^4$  m; tai
  2. 1C010.c kohdassa määritellyistä materiaaleista.

*Huom. 1:* 1A002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi muovilla kyllästetyistä hiili"kuitu- tai -säiemateriaaleista" valmistettuja komposiitti-rakenteita tai -laminaatteja, jotka on tarkoitettu "siviili-ilma-alusten" rakenteiden tai laminoitien korjaukseen edellyttäen, ettei niiden koko ylitä 100 cm × 100 cm.

*Huom. 2:* 1A002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmiita tai puolivalmiita tuotenimikkeitä, jotka on erityisesti suunniteltu seuraaviin puhtaasti siviilitarkoituksiin:

- a. Urheilutarvikkeisiin;
- b. Autoteollisuuteen;
- c. Työstökoneollisuuteen;
- d. Lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin.

1A003 1C008.a.3 kohdassa määritellyistä fluoraamattomista polymeereistä valmistetut kalvot, levyt, teipit tai nauhat:

- a. Joiden paksuus ylittää 0,254 mm; tai
- b. Jotka on pinnoitettu tai laminoitu hiilellä, grafiitilla, metallilla tai magneettisilla aineilla.

*Huom.:* 1A003 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteita, jotka ovat pinnoitettu tai laminoitu kuparilla ja suunniteltu elektronisten piirilevyjen tuotantoon.

1A004 Muut kuin asetarvikelistassa määritellyt suojaus- ja ilmaisulaitteet ja komponentit seuraavasti:

**Huom.:** KATSO MYÖS 2B351 JA 2B352 KOHTA.

- a. Kaasunaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön muunneltuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita vastaan, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;
- b. Suojapuvut, käsineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön muunneltuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita vastaan;

- 1A004 (jatkoa)
- c. Ydinalan, biologisen ja kemian alan (NBC) ilmaisinjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai tunnistamaan biologisia vaikuteaineita tai "sotilaskäyttöön sovitettuja" radioaktiivisia aineita tai kemiallisen sodankäynnin (CW) vaikuteaineita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- Huom.: 1A004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:
- a. Henkilökohtaisia säteilyannoksen valvontamittareita;
- b. Laitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on rajoitettu suojaamaan niitä vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia siviiliteollisuudelle, kuten kaivos-, louhinta-, maatalous-, lääke-, lääkintä-, eläinlääkintä-, ympäristö-, jätteiden käsittelylle tai elintarviketeollisuudelle.
- 1A005 Suojaliivit, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin ne, jotka on valmistettu sotilasstandardien tai -laatuvaatimusten mukaisesti tai vastaavat suoritusarvoiltaan niitä.
- Huom.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.**
- Huom.: Suojaliivien valmistukseen käytettyjen "kuitu- tai säiemateriaalien" osalta katso 1C010 kohta.
- Huom. 1: 1A005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi suojaliivejä tai suojavaatteita, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.
- Huom. 2: 1A005 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi suojaliivejä, jotka on suunniteltu antamaan suojaa vain edestäpäin kohdistuvia, muiden kuin sotilasräjähteiden sirpaleita ja räjähdystä vastaan.
- 1A102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitetut toistokyllästetyt pyrolisoidut hiili-hiilikomponentit.
- 1A202 Muut kuin 1A002 kohdassa määritellyt, komposiittirakenteet putkina, joilla on seuraavat ominaisuudet:
- Huom.: KATSO MYÖS 9A010 JA 9A110 KOHTA.**
- a. niiden sisähalkaisija on 75 ja 400 mm:n välillä; ja
- b. ne on valmistettu 1C010.a tai b tai 1C210.a kohdassa määritellyistä "kuitu- ja säiemateriaaleista" tai 1C210.c kohdassa määritellyistä hiilipregregimateriaaleista.
- 1A225 Platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi.
- 1A226 Erikoisaineet, joita voidaan käyttää raskaan veden erottamiseen tavallisesta vedestä ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- a. ne on tehty fosforipronssiverkosta, joka on käsitelty kemiallisesti vettyvyyden parantamiseksi; ja
- b. ne on suunniteltu käytettäväksi tyhjötislauskolonneissa.
- 1A227 Korkeatiheyksiset (lyijylasista tai muusta aineesta valmistetut) säteilysuojaikkunat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet sekä näitä varten erityisesti suunnitellut puitteet:
- a. 'kylmä (säteilyltä suojattu) ala' on suurempi kuin 0,09 m<sup>2</sup>;
- b. tiheys suurempi kuin 3 g/cm<sup>3</sup>; ja
- c. paksuus 100 mm tai suurempi.
- Tekn. huom.:
- 1A227 kohdassa termillä 'kylmä ala' tarkoitetaan ikkunan läpinäkyvää alaa, joka on altistuneena alhaisimmalle säteilytasolle mallisovelluksessa.

**1B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

1B001 Seuraavat 1A002 tai 1C010 kohdassa määriteltyjen kuitujen, prepregien, preformien tai "komposiittien" tuotantolaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

**Huom.: KATSO MYÖS 1B101 JA 1B201 KOHTA.**

- a. Kuitujen käämintäkoneet, joissa käämittävien kuitujen asettelu-, kiedonta- ja käämintäliikkeit ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiitti"rakenteiden tai -laminaattien valmistukseen "kuitu- tai säiemateriaaleista";
- b. Nauhapäällystys- tai touviasettelukoneet, joissa teipin, touvien tai levyjen asemointi- ja asetteluliikkeit ovat koordinoitavissa ja ohjelmoitavissa kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu "komposiittisten" ilma-aluksen runko- tai 'ohjus'rakenteiden valmistukseen;

*Huom.: 1B001.b kohdassa 'ohjus' tarkoittaa täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä.*

- c. "Komposiitti"rakenteiden valmistukseen tarkoitettujen monisuuntaisten ja monidimensionaalisien kutoma- tai punontakoneiden kuitujen kudontaa, punontaa tai palmikointia varten sekä näiden koneiden adapterit ja muunnossarjat;

Tekn. huom.:

*1B001.c kohdassa punontatekniikkaan sisältyy neulonta.*

*Huom.: 1B001.c kohta ei aseta valvonnanalaisiksi tekstiilikoneita, joita ei ole muunnettu yllä mainittuja loppukäyttöä varten.*

- d. Seuraavat lujitekuitujen tuotantoa varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut laitteet:
  1. Laitteet, joilla polymeerikuituja (kuten polyakryylnitriili, raion, hartsit tai polykarbosilaani) muutetaan hiilikuiduiksi tai piikarbidikuiduiksi, mukaan lukien erikoislaitteet, joilla kuituja jännitetään kuumennuksen aikana;
  2. Laitteistot, joilla valmistetaan piikarbidikuituja pinnoittamalla kuumennettuja kuitusubstraatteja alkuaineilla tai yhdisteillä kemiallista kaasufaasipinnoitusmenetelmää (CVD) käyttäen;
  3. Laitteet, joilla märkäkehrätään tulenkestäviä keraameja (kuten alumiinioksidia);
  4. Laitteet, joilla esikuituja sisältävä alumiini muutetaan lämpökäsittelyllä alumiinioksidikuiduiksi;
- e. Laitteet, joilla tuotetaan kuumasulatusmenetelmällä 1C010.e kohdassa määriteltyjä prepregejä;
- f. Seuraavat ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu "komposiitti" materiaaleja varten:
  1. Röntgentomografiajärjestelmät, joilla voidaan tarkastella valmistusvirheitä kolmessa ulottuvuudessa;
  2. Digitaalisesti ohjatut ultraäänitestauslaitteet, joiden liikkeit lähettimien ja/tai vastaanottimien asettamiseksi koordinoidaan ja ohjelmoidaan yhtäaikaaisesti neljällä tai useammalla akselilla tarkastettavan komponentin kolmiulotteisten äärioviivojen seuraamiseksi.

1B002 Kontaminaation välttämiseen erityisesti suunnitellut, metalliseosten, metalliseosjauheiden tai seostettujen materiaalien tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi jossakin 1C002.c kohdassa määritellyistä prosesseista.

**Huom.: KATSO MYÖS 1B102 KOHTA.**

1B003 Titaanin tai alumiinin tai niiden seosten "superplastista muovausta" tai "diffuusioliittämistä" varten tarkoitettujen työkalujen, suuttimien, muotien tai kiinnikkeiden, jotka on erityisesti suunniteltu:

- a. Ilma-alusten runko- tai avaruusalusten rakenteiden valmistamiseen;
- b. "Ilma-alusten" tai avaruusalusten moottorien valmistamiseen; tai
- c. Näitä rakenteita tai moottoreita varten erityisesti suunniteltujen komponenttien valmistamiseen.

1B101 Seuraavat, muut kuin 1B001 kohdassa määritellyt laitteet rakenteellisten komposiittien "tuotantoa" varten sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet:

**Huom.: KATSO MYÖS 1B201 KOHTA.**

Huom.: 1B101 kohdassa määriteltyihin komponentteihin ja varusteisiin sisältyvät muotit, tuurnat, suukappaleet, kiinnittimet ja työkalut komposiittirakenteiden, -laminaattien ja niiden valmisteiden preformien puristamista, kovettamista, valamista, sintraamista tai liittämistä varten.

- a. Kuidunkäämintäkoneet, joissa kuidun asemointi-, käärintä- ja käämintäliikkeet voidaan koordinoita ja ohjelmoida kolmen tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu valmistamaan komposiittirakenteita tai -laminaatteja kuitu- tai säiemateriaaleista, sekä koordinoinnin ja ohjelmoinnin ohjaukset;
- b. Nauhapäälystyskoneet, joissa nauhan tai levyn asettelu- ja asemointiliikkeet voidaan koordinoita ja ohjelmoida kahden tai useamman akselin suhteen ja jotka on suunniteltu komposiittisten ilma-alusten ja "ohjusten" runkorakenteiden valmistusta varten;
- c. Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalien" "tuotantoa" varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:
  1. Laitteet, joilla muunnetaan polymeerikuituja (esim. polyakryylinitriiliä, raionia tai polykarbosilaa-nia), erityisesti kuitua kuumennuksen aikana jännittäen;
  2. Laitteet, joiden avulla kuumennettuja säiesubstraatteja höyrypinnoitetaan alkuaineilla tai yhdisteillä;
  3. Laitteet, joiden avulla voidaan märkäkehrätä tulenkestäviä keraameja (kuten esim. alumiinioksidia);
- d. Laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu kuitujen erityispintakäsittelyä varten tai 9C110 kohdassa määriteltyjen prepregien ja preformien tuottamista varten.

Huom.: 1B101.d kohtaan sisältyvät valssaimet, venytyslaitteet, päälystyslaitteet, leikkurit ja meistimuotit.

1B102 Muut kuin 1B002 kohdassa määritellyt metallijauheen "tuotantolaitteet" ja komponentit seuraavasti:

**Huom.: KATSO MYÖS 1B115.b KOHTA.**

- a. Metallijauheen "tuotantolaitteet", joita voidaan käyttää 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen pallomaisten tai hivennettyjen materiaalien "tuotantoon" valvotussa ympäristössä.
- b. Erityisesti suunnitellut komponentit 1B002 tai 1B102.a kohdassa määriteltyjä "tuotantolaitteita" varten.

Huom.: 1B102 kohtaan sisältyvät:

- a. Plasmageneraattorit (suuritaajuinen kaarisuihku), joita voidaan käyttää aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, että prosessi tehdään argon-vesiympäristössä;
- b. Sähköpurkauslaitteistot, joita voidaan käyttää aikaansaamaan sputteroituja tai pallomaisia metallijauheita siten, että prosessi tehdään argon-vesiympäristössä;
- c. Laitteet, joita voidaan käyttää pallomaisten alumiinijauheiden "tuotantoon" pulverisoimalla sula suoja-kaasussa (esim. työssä).

1B115 Seuraavat muut kuin 1B002 tai 1B102 kohdassa määritellyt laitteet ajoaineiden ja niiden ainesosien tuotantoa varten ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

- a. "Tuotantolaitteet" 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen neste-mäisten ajoaineiden ja niiden ainesosien "tuotantoa", käsittelyä tai vastaanottotestausta varten;

- 1B115 (jatkoa)
- b. "Tuotantolaitteet" 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen kiinteiden ajoaineiden ja niiden ainesosien "tuotantoa", käsittelyä, sekoittamista, kovettamista, valamista, präsäystä, työstämistä, puristamista tai vastaanottotestausta varten.
- Huom.:* 1B115.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi eräsekoittimia, jatkuvatoimisia sekoittimia tai neste-energiamylyjä. Eräsekoittimien, jatkuvatoimisten sekoittimien ja neste-energiamylyjen valvonnan osalta katso 1B117, 1B118 ja 1B119 kohta.
- Huom. 1:* Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu asetarvikkeiden tuotantoa varten: katso asetarvikeluettelo.
- Huom. 2:* 1B115 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi boorikarbidin "tuotantoon", käsittelyyn ja hyväksymistaukseen tarkoitettuja laitteita.
- 1B116 Erityisesti suunnitellut suuttimet, joilla tuotetaan pyrolyysimenetelmällä muodostuvia aineita muotille, tuurnalle tai muulle substraatille välituotekaasuista, jotka hajoavat 1 573 K (1 300 °C)–3 173 K (2 900 °C) asteen lämpötila-alueella ja 130 Pa:n–20 kPa:n paineessa.
- 1B117 Eräsekoittimet, joiden on pystyttävä sekoittamaan tyhjässä painealueella nolasta 13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion lämpötilaa voidaan säätää ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista, ja tällaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- a. Kokonaistilavuuskapasiteetti 110 litraa tai enemmän; ja
- b. Ainakin yksi keskustasta sivuun asennettu sekoitus/vaivausvarsi.
- 1B118 Jatkuvatoimiset sekoittimet, joiden on pystyttävä sekoittamaan tyhjässä painealueella nolasta 13 326 kPa:iin ja joiden sekoituskammion lämpötilaa voidaan säätää ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja tällaisia sekoittimia varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- a. Kaksi tai useampia sekoitus/vaivausvarsia; tai
- b. Yksi värähtelevä pyörivä varsi sekä vaivaushampaat/piikit varressa ja sekoituskammion vuorauksen sisäpuolella.
- 1B119 Neste-energiamylyt, joita voidaan käyttää 1C011.a, 1C011.b tai 1C111 kohdassa tai asetarvikeluettelossa määriteltyjen aineiden jauhamiseen tai hienontamiseen, ja tällaisia mylyjä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- 1B201 Seuraavat muut kuin 1B001 tai 1B101 kohdassa määritellyt kuidunkäämintäkoneet ja niihin liittyvät laitteet:
- a. Kuidunkäämintäkoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. kuitujen asemointi, käärintä ja käämintä on koordinoitu ja ohjelmoitu kahden tai useamman akselin suhteen;
  2. ne on erityisesti suunniteltu komposiittirakenteiden tai -laminaattien valmistamiseen "kuitu- tai säiemateriaaleista"; ja
  3. ne pystyvät käämimään 75–400 mm:n läpimittaisia ja 600 mm:n pituisia tai suurempia lieriömäisiä roottoreita,
- b. 1B201.a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden koordinointi- ja ohjelmointilaitteet;
- c. 1B201.a kohdassa määriteltyjen kuidunkäämintäkoneiden tarkkuusturnat.
- 1B225 Elektrolyysikennot fluorin tuotantoa varten, joiden tuotantokapasiteetti on suurempi kuin 250 g fluoria tunnissa.
- 1B226 Sähkömagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varustettu yhdellä tai useilla ionilähteillä, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun kokonaisvirta.
- Huom.:* 1B226 kohta sisältää erottimet:
- a. Jotka pystyvät rikastamaan pysyviä isotooppeja;
- b. Joissa ionilähteet ja -kerääjät ovat kummatkin magneettikentässä, sekä ne konfiguraatiot, joissa ne ovat kentän ulkopuolella.
- 1B227 Ammoniakin syntetisointikonverterit tai ammoniakkin syntetisointiyksiköt, joissa synteesikaasu (typpi ja vety) saadaan korkeapaineisesta ammoniakki/vety-vaihtokolonnista ja syntetisoitu ammoniakki palautetaan samaan kolonniin.

- 1B228 Kryogeeniset vetytislauskolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- Ne on suunniteltu toimimaan 35 K (– 238 °C) asteen tai sitä alhaisemmissa sisäisissä lämpötiloissa;
  - Ne on suunniteltu toimimaan 0,5–5 MPa:n sisäisessä paineessa;
  - Ne on valmistettu joko:
    - 300-sarjan vähärikkisestä ruostumattomasta teräksestä, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi; tai
    - Vastaavista kryogeenisistä ja vetyä (H<sub>2</sub>) kestävästä materiaaleista; ja
  - Sisähalkaisija on 1 m tai suurempi ja tehollinen pituus 5 m tai pitempi.
- 1B229 Seuraavat vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit sekä niiden 'sisäkosketuspinnat':
- Huom.:* Erityisesti raskaan veden tuottamista varten suunnitellut tai valmistetut kolonnit: katso OB004 kohta.
- Vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - niiden käyttöpaine on 2 MPa tai suurempi;
    - ne on valmistettu hiiliteräksestä, jonka austeniittinen ASTM:n (tai vastaavan standardin) mukainen raekokoluku on 5 tai suurempi; ja
    - niiden halkaisija on 1,8 m tai suurempi;
  - 1B229.a kohdassa määriteltyjen vesi-rikkivety-erotuspohjakolonnien 'sisäkosketuspinnat'.
- Tekn. huom.:*
- Kolonnien 'sisäkosketuspinnat' ovat segmentoituja pohjia, joiden tehollinen halkaisija koottuna on 1,8 m tai enemmän; ne on suunniteltu helpottamaan vastavirtakosketusta ja ne on valmistettu ruostumattomista teräksistä, joiden hiilipitoisuus on 0,03 prosenttia tai vähemmän. Pohjat voivat olla seula-, venttiili-, kello- ja ritiläpohjia.*
- 1B230 Nesteammoniakkiin liuotetun väkevän tai laimean kaliumamidikatalyytin (KNH<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>) kierrättämiseen kykenevät pumpput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- Ne ovat ilmatiiviitä (so. hermeettisesti suljettuja);
  - Pumppausteho on suurempi kuin 8,5 m<sup>3</sup>/h; ja
  - Jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
    - Ne on tarkoitettu väkevien (1 % tai suurempi pitoisuus) kaliumamidiliuosten kierrättämiseen 1,5–60 MPa:n käyttöpaineella; tai
    - Laimeiden (pitoisuus vähemmän kuin 1 %) kaliumamidiliuosten kierrättämiseen 20–60 MPa:n käyttöpaineella.
- 1B231 Seuraavat tritiumlaitokset tai -tehtaat ja niissä käytettävät laitteet:
- Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia,
  - Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
    - Vedyn tai heliumin jäädytysyksiköt, joissa lämpötila saadaan lasketuksi 23 K (– 250 °C) asteeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lämmönpoistokyky on suurempi kuin 150 W;
    - Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjärjestelmät, joissa varastointiin tai puhdistukseen käytetään metallihydridejä.
- 1B232 Turbohöyrystimet tai turbohöyrystin-kompressoriyhdistelmät, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- Ne on tarkoitettu käytettäväksi siten, että ulostulolämpötila on 35 K (– 238 °C) tai alhaisempi; ja
  - Ne on tarkoitettu tuottamaan vetykaasua 1 000 kg/h tai enemmän.

- 1B233 Litiumisotoppien erotukseen käytettävät laitokset tai tehtaat ja niissä käytettävät laitteet seuraavasti:
- a. Laitokset tai tehtaat litiumisotoppien erottamiseen;
  - b. Laitteet litiumisotoppien erottamiseen seuraavasti:
    1. Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
    2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
    3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
    4. Haihduttimet väkeviä litiumhydroksidiliuoksia varten.

**1C Materiaalit**Tekn. huom.:

Metallit ja metalliseokset:

Ellei toisin säädetä, 1C001–1C012 kohdassa sanat 'metalli' ja 'metalliseos' kattavat seuraavat raat ja puolivalmistemuodot:

Raat muodot:

Anodit, harkot, kanget (mukaan lukien lovetut kanget ja lankaharkot), valanteet, lohkarleet, raakatangot, briketit, kato-dit, kiteet, kuutiot, rouheet, jyväset, valuharkot, kokkarleet, pelletit, raakametalliharkot, pulveri, sulakuoret, valurakeet, valssausaihiot, puristusharkot, sieni, sauvat;

Puolivalmistemuodot (riippumatta siitä ovatko ne pinnoitettuja, päällystettyjä, porattuja tai lävistettyjä):

- a. Taotut tai työstetyt materiaalit, jotka on valmistettu valssamalla, vetämällä, suulakepuristamalla, takomalla, kylmämäpursottamalla, meistäällä, rouhimalla, hiventämällä ja jauhamalla, so.: kulmakiskot, kourut, pyörylät, kiekot, pöly, hiutaleet, foliot ja ohutlevy, taos, levy, pulveri, puristeet ja meistot, nauha, renkaat, tangot (mukaan lukien paljaat hitsauslangat, valssilangat ja valssivanungit), muotometallit, profiilit, levyt ja putket (mukaan lukien putkikehäät, neliökanget ja ontot palkit), vedetyt tai puristetut langat;
- b. Valettu materiaali, joka on tuotettu valamalla hiekka-, suulake-, metalli-, kipsi- tai muun tyyppisellä muotilla, mukaan lukien korkeapainevalokset, sintratut muodot ja pulverimetallurgialla aikaansaadut muodot.

Valvonnan tavoitetta ei tule kumota viemällä muita kuin lueteltuja muotoja, joiden väitetään olevan lopullisia tuotteita, vaikka ne käytännössä ovat raakoja muotoja tai puolivalmistemuotoja.

1C001 Seuraavat sähkömagneettisia aaltoja absorboiviksi erityisesti suunnitellut materiaalit tai itseisjohtavat polymeerit:

**Huom.: KATSO MYÖS 1C101 KOHTA.**

- a. Materiaalit, jotka absorboivat yli  $2 \times 10^8$ , mutta alle  $3 \times 10^{12}$  hertsin taajuuksia;

Huom. 1: 1C001.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

- a. Luonnon- tai synteettisistä kuiduista rakentuvia hiustyyppisiä absorboivia materiaaleja, joiden absorptiokyky on saatu aikaan ei-magneettisella täyteaineella;
- b. Absorboivia materiaaleja, joilla ei ole lainkaan magneettista häviötä, ja joiden kohtauspinta ei ole muodoltaan taso, mukaan lukien pyramidi-, kartio-, kiila- sekä poimuiset pinnat;
- c. Tasopintaisia absorboivia materiaaleja:
  1. Jotka on valmistettu:
    - a. Taipuisista tai jäykistä vaahtomuoveista, joissa täyteaineena on hiili, tai orgaanisista materiaaleista, sideaineet mukaan lukien, jotka antavat metalliin verrattuna yli 5 %:n kaiun kaistalla, joka on yli  $\pm 15$  % kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivät kestä yli 450 K (177 °C) asteen lämpötiloja; tai
    - b. Keraamisista materiaaleista, jotka antavat metalliin verrattuna yli 20 %:n kaiun kaistalla, joka on yli  $\pm 15$  % kohtaavan energian keskitaajuudesta, ja jotka eivät kestä 800 K (527 °C) asteen ylittäviä lämpötiloja;

Tekn. huom.:

1C001.a kohdan 1.c.1 huomautuksessa tarkoitettujen absorptiotestinäytteiden tulee olla nelliötä, joiden sivun pituus on vähintään 5 keskitaajuuden aallonpituutta, ja ne tulee asettaa säteilevän elementin kaukokenttään.

- 1C001
- a. Huom. 1: c. (jatkoa)
2. Joiden vetolujuus on pienempi kuin  $7 \times 10^6$  N/m<sup>2</sup>; ja
  3. Puristuslujuus on pienempi kuin  $14 \times 10^6$  N/m<sup>2</sup>;
- d. Sintratusta ferriitistä valmistetut tasopintaiset absorboivat materiaalit joiden:
1. Ominaispaino ylittää 4,4; ja
  2. Maksimitoimintalämpötila on 548 K (275 °C) astetta.
- Huom. 2: Mikään 1C001.a kohtaa koskevassa huomautuksessa 1 ei vapauta maaliin sisällytettyjä magneettisia materiaaleja, joiden tarkoitus on tehdä se absorptiokykyiseksi.
- b. Materiaalit, jotka absorboivat yli  $1,5 \times 10^{14}$  Hz:n, mutta alle  $3,7 \times 10^{14}$  Hz:n taajuuksia, ja jotka eivät läpäise näkyvää valoa;
- c. Itseisjohtavat polymeerimateriaalit, joiden 'kokonaissähkönjohtokyky' ylittää 10 000 S/m (siemensia metriä kohti) tai 'pintaresistiivisyys' on alle 100 ohmia/m<sup>2</sup>, ja jotka perustuvat johonkin seuraavista polymeereistä:
1. Polyaniliini;
  2. Polypyroli;
  3. Polytiofeeni;
  4. Polyfenyleenivinyleni; tai
  5. Polytienyleenivinyleni.

Tekn. huom.:

'Kokonaissähkönjohtokyky' ja 'pintaresistiivisyys' tulee määritellä ASTM D-257:n tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

- 1C002 Seuraavat metalliseokset, metalliseosjauheet tai seostetut materiaalit:

**Huom.: KATSO MYÖS 1C202 KOHTA.**

Huom.: 1C002 kohta ei aseta valvonnallaiseksi metalliseoksia, metalliseosjauheita tai seostettuja materiaaleja, jotka on tarkoitettu substraattien pinnoitukseen.

Tekn. huom.:

1. Metalliseokset 1C002 kohdassa ovat niitä, joissa mainitun metallin painoprosentti on suurempi kuin minkään muun aineen.
  2. Jännitysmurtumaikä mitataan ASTM-standardin E-139 tai vastaavien standardien mukaisesti.
  3. Väsymisikä mitataan ASTM-standardin E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" mukaisesti tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti. Testauksen tulee olla aksiaalinen, keskimääräisen jännityssuhteen 1 ja jännityksen keskityskertoimen ( $K_t$ ) 1. Keskimääräinen jännityssuhde määritellään maksimijännityksen ja minimijännityksen erotuksen sekä maksimijännityksen osamääränä.
- a. Seuraavat aluminidit:
1. Nikkelialuminidit, jotka sisältävät vähintään 15 painoprosenttia alumiinia, korkeintaan 38 painoprosenttia alumiinia ja vähintään yhden lisäseosalkuaineen;
  2. Titaanialuminidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän alumiinia ja vähintään yhden lisäseosalkuaineen;

1C002 (jatkoa)

- b. Seuraavat metalliseokset, jotka on valmistettu 1C002.c kohdassa määritellyistä materiaaleista:
1. Nikkeliseokset, joiden:
    - a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 923 K (650 °C) asteen lämpötilassa rasiituksen ollessa 676 MPa; tai
    - b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 823 K (550 °C) asteen lämpötilassa maksimirasiituksen ollessa 1 095 MPa;
  2. Niobiumseokset, joiden:
    - a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 1 073 K (800 °C) asteen lämpötilassa rasiituksen ollessa 400 MPa; tai
    - b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 973 K (700 °C) asteen lämpötilassa maksimirasiituksen ollessa 700 MPa;
  3. Titaaniseokset, joiden:
    - a. Jännitysmurtumaikä on 10 000 tuntia tai enemmän 723 K (450 °C) asteen lämpötilassa rasiituksen ollessa 200 MPa; tai
    - b. Low cycle -väsymisikä on 10 000 jaksoa tai enemmän 723 K (450 °C) asteen lämpötilassa maksimirasiituksen ollessa 400 MPa;
  4. Alumiiniseokset, joiden vetolujuus on:
    - a. 240 MPa tai enemmän lämpötilan ollessa 473 K (200 °C) astetta; tai
    - b. 415 MPa tai enemmän lämpötilan ollessa 298 K (25 °C) astetta;
  5. Magnesiumseokset, joiden:
    - a. vetolujuus on 345 MPa tai enemmän; ja
    - b. syöpymisnopeus on vähemmän kuin 1 mm/vuosi 3 %:ssa natriumkloridin vesiliuoksessa mitattuna ASTM-standardin G-31 tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti;
- c. Metalliseosjauhe- tai hiukkasmaiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne on tehty jostakin seuraavista seossysteemeistä:

Tekn. huom.:

Seuraavissa kaavoissa X tarkoittaa yhtä tai useampaa seosalkuainetta.

    - a. Nikkeliseokset (Ni-Al-X, Ni-X-Al), jotka ovat turbiinimoottorien osiksi sopivia, eli joissa on vähemmän kuin 3 (valmistusprosessin aikana lisättyä) kooltaan yli 100 µm olevaa epämetallipartikkeliä 10<sup>9</sup> seospartikkeliä kohti;
    - b. Niobiumseokset (Nb-Al-X tai Nb-X-Al, Nb-Si-X tai Nb-X-Si, Nb-Ti-X tai Nb-X-Ti);
    - c. Titaaniseokset (Ti-Al-X tai Ti-X-Al);
    - d. Alumiiniseokset (Al-Mg-X tai Al-X-Mg, Al-Zn-X tai Al-X-Zn, Al-Fe-X tai Al-X-Fe); tai
    - e. Magnesiumseokset (Mg-Al-X tai Mg-X-Al); ja
  2. Ne on valmistettu kontrolloiduissa olosuhteissa jollakin seuraavista prosesseista:
    - a. "Tyhjäatomisointi";

- 1C002 c. 2. (jatkoa)
- b. "Kaasuatomisointi";
  - c. "Pyörivä atomisointi";
  - d. "Läimäyssammutus";
  - e. "Sulakehräys" ja "jauhatus";
  - f. "Sulaerotus" ja "jauhatus"; tai
  - g. "Mekaaninen seostus"; ja
3. Ne voivat muodostaa 1C002.a tai 1C002.b kohdassa määriteltyjä materiaaleja.
- d. Seostetut materiaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne on tehty 1C002.c.1 kohdassa määritellyistä seossysteemeistä;
  2. Ne ovat hienontamattomia hiutaleina, nauhoina tai ohuina tankoina; ja
  3. Ne on tuotettu kontrolloidussa ympäristössä jollakin seuraavista menetelmistä:
    - a. "läimäyssammutusmenetelmä",
    - b. "sulakehräysmenetelmä", tai
    - c. "sulaerotusmenetelmä".
- 1C003 Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Suhteellinen alkupermeabiliteetti 120 000 tai enemmän ja paksuus 0,05 mm tai vähemmän;  
Tekn. huom.:  
*Alkupermeabiliteetin mittausta on suoritettava täysin hehkutetuilla materiaaleilla.*
  - b. Magnetostriktiiviset metalliseokset, joiden:
    1. Magnetostriktiivinen saturaatio on enemmän kuin  $5 \times 10^{-4}$ ; tai
    2. Magnetomekaaninen kytkentäkerroin (k) on enemmän kuin 0,8; tai
  - c. Amorfiset tai 'nanokiteiset' metalliseosnauhat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    1. Koostumuksesta vähintään 75 painoprosenttia on rautaa, kobolttia tai nikkeliä;
    2. Magneettisen induktion saturaatio ( $B_s$ ) on 1,6 T tai enemmän; ja
    3. Jokin seuraavista:
      - a. Nauhapaksuus on 0,02 mm tai vähemmän; tai
      - b. Ominaisresistanssi on  $2 \times 10^{-4}$  ohmi cm tai enemmän.

Tekn. huom.:

1C003.C kohdassa 'nanokiteiset' materiaalit ovat sellaisia materiaaleja, joiden röntgendiffraktiolla määritelty kide-  
raekoko on 50 nm tai vähemmän.

- 1C004 Uraani-titaaniseokset tai volframiseokset, joilla on rauta-, nikkeli- tai kuparipohjainen "matriisi" ja joiden:
- Tiheys ylittää  $17,5 \text{ g/cm}^3$ ;
  - Elastisuusraja ylittää 880 MPa;
  - Murtolujuus ylittää 1 270 MPa; ja
  - Venymä ylittää 8 %.
- 1C005 Seuraavat yli 100 m pitkät tai yli 100 g:n painoiset "suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet:
- "Suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet, jotka sisältävät yhden tai useamman niobium-titaanikuidun ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Joka on istutettu muuhun "matriisiin" kuin kupari- tai kuparipohjaiseen "matriisiin"; ja
    - Jonka poikkileikkauksen pinta-ala on vähemmän kuin  $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$  (pyöreiden kuitujen halkaisija on vähemmän kuin 6  $\mu\text{m}$ );
  - Yhdestä tai useammasta, muusta kuin niobium-titaanista valmistetusta "suprajohtavasta" kuidusta koostuvat "suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet:
    - Joiden "kriittinen lämpötila" magneettisen induktion nolllapisteessä ylittää 9,85 K ( $-263,31 \text{ }^\circ\text{C}$ ) astetta; ja
    - Jotka pysyvät "suprajohtavassa" tilassa 4,2 K ( $-268,96 \text{ }^\circ\text{C}$ ) asteessa, kun ne asetetaan magneettikenttään, joka on suunnattu mihin tahansa suuntaan kohtisuorassa johtimen pituusakseliin nähden ja jonka magneettinen induktio on 12 T siten, että kriittisen virran tiheys on enemmän kuin  $1 \text{ 750 A/mm}^2$  johtimen kokonaispoikkileikkauksen kohdalla;
  - "Suprajohtavat" "komposiitti"-johtimet, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta "suprajohtavasta" kuidusta ja jotka pysyvät "suprajohtavassa" tilassa yli 115 K ( $-158,16 \text{ }^\circ\text{C}$ ) asteessa.
- Tekn. huom.:
- 1C005 kohdassa kuidut voivat olla langan, sylinterin, kalvon, teipin tai nauhan muodossa.
- 1C006 Seuraavat nesteet ja voiteluaineet:
- Hydraulinesteet, jotka sisältävät perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteistä tai aineista:
    - Synteettiset pii-hiili-vety-öljyt, joiden:  
Tekn. huom.:  
1C006.a.1 kohdassa pii-hiili-vety-öljyt sisältävät pelkästään piitä, vetyä ja hiiltä.
      - Leimahduspiste ylittää 477 K ( $204 \text{ }^\circ\text{C}$ ) astetta;
      - Jähmepiste on 239 K ( $-34 \text{ }^\circ\text{C}$ ) astetta tai alempi;
      - Viskositeetti-indeksi on 75 tai enemmän; ja
      - Terminen stabiliteetti on 616 K ( $343 \text{ }^\circ\text{C}$ ) astetta; tai

- 1C006 a. (jatkoa)
2. Kloori-fluori-hiili-yhdisteet:
- Tekn. huom.:
- 1C006.a.2 kohdassa kloori-fluori-hiili-yhdisteet sisältävät pelkästään klooria, fluoria ja hiiltä.
- a. Joilla ei ole leimahduspistettä;
- b. Joiden itsesyttymislämpötila on yli 977 K (704 °C) astetta;
- c. Joiden jäähmepiste on 219 K (– 54 °C) astetta tai alempi;
- d. Joiden viskositeetti-indeksi on 80 tai enemmän; ja
- e. Joiden kiehumispiste on 473 K (200 °C) astetta tai korkeampi;
- b. Voiteluaineet, jotka sisältävät perusainesosanaan jotain seuraavista yhdisteistä tai aineista:
1. Fenyleeni- tai alkyyli-fenyleenieetterit tai -tioeetterit tai niiden seokset, jotka sisältävät enemmän kuin kaksi eetteri- tai tioeetterifunktiota tai niiden seosta; tai
2. Fluoratut silikoninesteet, joiden kinemaattinen viskositeetti on vähemmän kuin 5 000 mm<sup>2</sup>/s (5 000 senttistokea) 298 K (25 °C) asteen lämpötilassa mitattuna;
- c. Höyrystys- tai vaahdotusnesteet, joiden puhtaus ylittää 99,8 %, jotka sisältävät 100 millilitrassa vähemmän kuin 25 kooltaan 200 µm tai suurempaa partikkelia, ja jotka on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti jostakin seuraavista yhdisteistä tai aineista:
1. Dibromitetrafluorietaani;
2. Polyklooritrifluorietyleni (vain öljyiset tai vahamaiset muunnokset); tai
3. Polybromitrifluorietyleni;
- d. Elektroniikan fluori-hiili-jäähdytysnesteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisältävät 85 painoprosenttia tai enemmän jotakin seuraavista tai niiden seoksista:
- a. Monomeerimuotoisia perfluoripolyalkylieetteri-triatsiineja tai perfluorialifaatti-eettereitä;
- b. Perfluorialkyyliamineita;
- c. Perfluorisykloalkaaneja; tai
- d. Perfluorialkaaneja;
2. Tiheys 298 K (25 °C) asteessa on 1,5 g/ml tai enemmän;
3. Nestemäisessä tilassa 273 K (0 °C) asteessa; ja
4. Sisältävät 60 painoprosenttia tai enemmän fluoria.

Tekn. huom.:

1C006 kohdassa:

- a. Leimahduspiste määritetään ASTM D-92:n kuvaamalla Cleveland Open cup- tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.
- b. Jäähmepiste määritetään ASTM D-97:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.
- c. Viskositeetti-indeksi määritetään ASTM D-2270:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.

1C006 (jatkoa)

d. *Terminen stabiileetti määritetään seuraavalla koemenettelyllä tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä:*

20 ml testattavaa nestettä asetetaan 46 ml:n vetoiseen ruostumattomasta teräksestä (tyyppiä 317) valmistettuun kammioon, joka sisältää yhden työkaluteräksisen (M-10), yhden teräksisen (52 100) ja yhden laivapronssisen (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn) nimellisläpimitaltaan 12,5 mm kuulan.

Kammio tyhjennetään tynen avulla ja suljetaan (yhden) ilmakehän paineeseen, ja lämpötila nostetaan  $644 \pm 6$  K ( $371 \pm 6$  °C) asteeseen kuudeksi tunniksi.

Näytettä pidetään termisesti stabiilina, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1. Kunkin kuulan paino vähenee vähemmän kuin 10 mg kuulan pinnan yhtä mm<sup>2</sup> kohti;
2. Alkuperäisen, 311 K (38 C) asteessa määritetyn viskositeetin muutos on vähemmän kuin 25 %; ja
3. Kokonaishappo- tai -emäsluku on vähemmän kuin 0,40.

e. *Itsesyttymislämpötila määritetään ASTM E-659:n kuvaamalla tai vastaavilla kansallisilla menetelmillä.*

1C007 Seuraavat keraamiset perusmateriaalit, keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, keraamiset "matriisi"- "komposiitti"materiaalit ja väliaineet:

**Huom.: KATSO MYÖS 1C107 KOHTA.**

- a. Yksinkertaisten tai kompleksisten titaaniboridien perusmateriaalit, joiden metallisten epäpuhtauksien kokonaismäärä, tarkoituksellisia lisäaineita lukuunottamatta, on vähemmän kuin 5 000 ppm, keskimääräinen partikkelikoko on 5 mikrometriä tai vähemmän, ja korkeintaan 10 % hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 mikrometriä;
- b. Titaaniborideista koostuvat keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit raaka-aineena tai puolivalmisteina, joiden tiheys on 98 % tai enemmän teoreettisesta tiheydestä;

Huom.: 1C007.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi hioma-aineita.

- c. Keraami-keraami-"komposiitit", joilla on lasi- tai oksidi"matriisi" ja jotka on lujitettu kuiduilla, joilla on kaikki seuraavista:

1. Ne on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:
  - a. Si-N;
  - b. Si-C;
  - c. Si-Al-O-N; tai
  - d. Si-O-N; ja
2. Niiden ominaismurtovetolujuus ylittää  $12,7 \times 10^3$  m;

- d. Keraami-keraami-"komposiitti" materiaalit, joilla on tai ei ole jatkuvaa metallifaasia, ja jotka sisältävät hienojakoisena minkä tahansa kuitumaisen tai whiskers-tyyppisen materiaalin hiukkasista tai faaseja, ja joissa "matriisin" muodostavat piin, zirkoniumin tai boorin karbidit tai nitridit;

- e. Seuraavat väliaineet (erikoispolymeeri- tai metalliorganiset materiaalit), jotka on tarkoitettu 1C007.c kohdassa määriteltyjen materiaalien jonkin faasin tai faasien valmistamiseen:

1. Polydiorganosilaanit (piikarbidin valmistukseen);
2. Polysilatsaanit (piinitridin valmistukseen);
3. Polykarbosilatsaanit (pii-, hiili- ja typpikomponentteja sisältävien keraamisten aineiden valmistukseen).

1C007 (jatkoa)

f. Keraami-keraami "komposiitti" materiaalit, joilla on oksidi- tai lasi"matriisi", joka on lujitettu jonkin seuraavien järjestelmien jatkuvilla kuiduilla:

1.  $Al_2O_3$ ; tai

2. Si-C-N.

Huom.: 1C007.f kohta ei aseta valvonnalaiseksi "komposiitteja", jotka sisältävät näiden järjestelmien kuituja, joiden vetolujuus on vähemmän kuin 700 Mpa 1 273 K (1 000 °C) asteen lämpötilassa tai virumisvastus on enemmän kuin 1 %:n virumisvenymä 100 Mpa:n kuormalla ja 1 273 K (1 000 °C) asteessa 100 tunnin aikana.

1C008 Seuraavat fluoraamattomat polymeeriset aineet:

- a. 1. Bismaleimidit;
2. Aromaattiset polyamidi-imidit;
3. Aromaattiset polyimidit;
4. Aromaattiset polyeetteri-imidit, joiden lasittumislämpötila ( $T_g$ ) ylittää 513 K (240 °C) astetta;

Huom. 1: 1C008.a kohdassa asetetaan valvonnalaiseksi nestemäisessä tai kiinteässä muodossa olevat aineet, mukaan lukien muovi, pulveri, pelletti, kalvo, levy, teippi tai nauha;

Huom. 2: 1C008.a kohta ei aseta valvonnalaiseksi sulamattomia muottipuristusjauheita tai puristeita.

b. Termoplastiset nestekidesekapolymeerit, joilla pehmenemislämpötila ylittää 523 K (250 °C) astetta mitatuna ISO-standardin 75-2 (2004), menetelmän A tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti 1,80 N/mm<sup>2</sup> kuormituksen alaisena, ja jotka koostuvat:

1. Jostakin seuraavista aineista:
- a. Fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; tai
- b. Metyyli-, tertiääri-butyyl- tai fenyyli-substituoitu fenyleeni, bifenyleeni tai naftaleeni; ja
2. Jostakin seuraavista hapoista:
- a. Tereftaalihappo;
- b. 6-hydroksi-2-naftoehappo; tai
- c. 4-hydroksibentsoehappo;

c. Ei käytössä;

d. Polyaryleeniketoni;

e. Polyaryleenisulfidit, joissa aryleeniryhmä on bifenyleeni, trifenyleeni tai jokin niiden yhdistelmistä;

f. Polybifenyleenieetterisulfoni, jonka lasittumislämpötila ( $T_g$ ) ylittää 513 K (240 °C) astetta.

Tekn. huom.:

Lasittumislämpötila ( $T_g$ ) 1C008 kohdan materiaaleille määritetään ISO-standardissa 11357-2 (1999) tai vastaavissa kansallisissa standardeissa kuvatulla tavalla.

1C009 Seuraavat käsittelemättömät fluoratut yhdisteet:

- a. Vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on 75 % tai enemmän betakiderakennetta;
- b. Fluoratut polyimidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;
- c. Fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät 30 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria.

1C010 Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalit", joita voidaan käyttää "komposiitti"rakenteissa tai -laminaateissa, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi" tai hiili"matriisi":

**Huom.: KATSO MYÖS 1C210 JA 9C110 KOHTA.**

a. Orgaaniset "kuitu- tai säiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää  $12,7 \times 10^6$  m; ja
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää  $23,5 \times 10^4$  m;

Huom.: 1C010.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi polyetyleenä.

b. Hiilipohjaiset "kuitu- tai säiemateriaalit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää  $12,7 \times 10^6$  m; ja
2. "Ominaismurtovetolujuus" ylittää  $23,5 \times 10^4$  m;

Huom.: 1C010.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi "siviili-ilma-alusten" rakenteiden tai laminoitien korjaukseen tarkoitettuja kuitu- tai säiemateriaaleista valmistettua kudosta, jonka yksittäisten arkkiäiden koko ei ylitä  $100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$ .

Tekn. huom.:

1C010.b kohdassa mainittujen materiaalien ominaisuudet tulee määrittää SACMA:n (Suppliers of Advanced Composite Materials Association) suosittelemia menetelmiä SRM 12–17 tai vastaavia kansallisia vetokokeita käytäen, kuten japanilaista JIS-R-7601 (Japanese Industrial Standard) 6.6.2 kohta, ja perustua erän keskiarvoon.

c. Epäorgaaniset "kuitu- tai säiemateriaalit", joiden:

1. "Ominaiskimmokerroin" ylittää  $2,54 \times 10^6$  m; ja
2. Sulamis-, hajoamis- tai härmistymispiste on yli  $1\,922 \text{ K}$  ( $1\,649 \text{ °C}$ ) astetta neutraalissa ympäristössä;

Huom.: 1C010.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

1. Epäjatkuvia, monifaasisia, monikiteisiä alumiinioksidikuituja katkeena tai mattona, jotka sisältävät 3 painoprosenttia tai enemmän piitä ja joiden ominaiskimmomoduuli on vähemmän kuin  $10 \times 10^6$  m;
2. Molybdeeni- ja molybdeeniseoskuituja;
3. Boorikuituja;
4. Epäjatkuvia keraamisia kuituja, joiden sulamis-, hajoamis- tai härmistymispiste on alempi kuin  $2\,043 \text{ K}$  ( $1\,770 \text{ °C}$ ) astetta neutraalissa ympäristössä.

d. "Kuitu- tai säiemateriaalit":

1. Jotka koostuvat joistakin seuraavista:

- a. 1C008.a kohdassa määritellyistä polyeetteri-imideistä; tai
- b. 1C008.b–1C008.f kohdassa määritellyistä materiaaleista; tai

2. Jotka koostuvat joistakin 1C010.d.1.a tai b kohdassa määritellyistä materiaaleista ja joihin on "sekoitettu" muita, 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määriteltyjä kuituja;

e. Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai hiilikuitu-preformit:

1. Jotka on valmistettu 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c kohdassa määritellyistä "kuitu- tai säiemateriaaleista";

- 1C010 e. (jatkoa)
2. Jotka on valmistettu orgaanisista tai hiilipohjaisista "kuitu- tai säiemateriaaleista":
- Joiden "ominaismurtovetolujuus" ylittää  $17,7 \times 10^4$  m;
  - Joiden "ominaiskimmokerroin" ylittää  $10,15 \times 10^6$  m;
  - Joita ei ole määritelty 1C010.a tai 1C010.b kohdassa; ja
  - Jotka on kyllästetty 1C008 tai 1C009.b kohdassa määritellyillä materiaaleilla, joiden lasittumislämpötila ( $T_g$ ) ylittää 383 K (110 °C) astetta, tai fenoli- tai epoksihartseilla, joiden lasittumislämpötila ( $T_g$ ) on 418 K (145 °C) tai enemmän.

Huom.: 1C010.e kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

- Epoksihartsi"matriisilla" kyllästettyjä hiili"kuitu- tai -säiemateriaaleja" (prepregejä), jotka on tarkoitettu "siviili-ilma-alusten" rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen, jossa yksittäisten prepegi-arkkien koko ei ylitä  $100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}$ .
- Prepregejä, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksihartseilla ja joiden lasittumislämpötila ( $T_g$ ) on vähemmän kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

Tekn. huom.:

Lasittumislämpötila ( $T_g$ ) 1C010.e kohdan materiaaleille määritetään ASTM D 3418:ssa kuvatulla tavalla kuivamenetelmää käyttäen. Lasittumislämpötila fenoli- ja epoksihartseille määritetään ASTM D 4065:ssä kuvatulla tavalla 1 Hz:n taajuudella ja kuumentamisnopeudella 2 K (°C) minuutissa kuivamenetelmää käyttäen.

- 1C011 Seuraavat metallit ja yhdisteet:

**Huom.:** KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO JA 1C111 KOHTA.

- Metallit, joiden hiukkaskoko on vähemmän kuin 60 µm riippumatta siitä ovatko ne pallomaisia, hivenettyjä, pallomaisia, hiutaloituja tai jauhettuja, jotka on valmistettu materiaalista, joka sisältää 99 % tai enemmän zirkoniumia, magnesiumia ja näiden seoksia;

Tekn. huom.:

Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2–7 prosenttia) lasketaan zirkoniumin kanssa.

Huom.: 1C011.a kohdassa luetellut metallit tai seokset ovat valvonnallaisia riippumatta siitä onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

- Boori tai boorikarbidi, jonka puhtaus on 85 % tai suurempi ja hiukkaskoko 60 mikrometriä tai vähemmän;

Huom.: 1C011.b kohdassa listatut metallit tai seokset ovat valvonnallaisia riippumatta siitä onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

- Guanidiininitraatti.
- Nitroguanidiini (NQ) (CAS 556–88–7).

- 1C012 Seuraavat materiaalit:

Tekn. huom.:

Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti ydinlämpölähteissä.

- Plutonium missä tahansa muodossa, jonka plutonium-238 isotooppipitoisuus on enemmän kuin 50 % painosta;

Huom.: 1C012.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi:

- Toimituksia, joissa plutoniumsisältö on 1 g tai vähemmän;
- Toimituksia, joissa on 3 "tehollista grammaa" tai vähemmän instrumentin anturoivassa osassa.

1C012 (jatkoa)

- b. "Aiemmin erotettu" neptunium-237 missä tahansa muodossa.

Huom.: 1C012.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisältö on 1 g tai vähemmän.

1C101 Muut, kuin 1C001 kohdassa määritellyt, 'ohjuksissa', "ohjusten" alajärjestelmissä tai 9A012 kohdassa määritellyissä miehittämättömissä ilma-aluksissa käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet, jotka pienentävät havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.

Huom. 1: 1C101 kohta sisältää:

- a. Rakennemateriaalit ja pinnoitteet, jotka on erityisesti kehitetty pienentämään tutkaheijastavuutta;
- b. Pinnoitteet, mukaan lukien maalit, jotka on erityisesti kehitetty vähentämään tai muuntamaan säteilyn heijastavuutta tai emissiivisyyttä spektrin mikroaalto-, infrapuna- tai ultraviolettilueella;

Huom. 2: 1C101 kohta ei sisällä pinnoitteita, kun niitä käytetään satelliittien lämmön kontrollointiin.

Tekn. huom.:

1C101 kohdassa 'ohjuksilla' tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.

1C102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitettut toistokyllästytyt pyrolysoidut hiili-hiilimateriaalit.

1C107 Seuraavat, muut kuin 1C007 kohdassa määritellyt grafiitti- ja keraamiset materiaalit:

- a. Hienorakeiset grafiitit, joiden kappaleitiheys on  $1,72 \text{ g/cm}^3$  tai suurempi, 288 K (15 °C) asteen lämpötilassa mitattuna, ja joiden raekoko on 100  $\mu\text{m}$  tai vähemmän ja joita voidaan käyttää rakettien suuttimissa ja ilmakehään palaamaan suunniteltujen alusten kärkikartioissa ja jotka voidaan työstää joksikin seuraavista tuotteista:
1. Sylinterit, joiden halkaisija on 120 mm tai suurempi ja joiden pituus on 50 mm tai enemmän;
  2. Putket, joiden sisähalkaisija on 65 mm tai suurempi ja joiden seinämäpaksuus on 25 mm tai enemmän ja joiden pituus on 50 mm tai enemmän; tai
  3. Lohkot, joiden koko on 120 mm  $\times$  120  $\times$  50 mm tai enemmän.

**Huom.:** KATSO MYÖS 0C004 KOHTA.

- b. Pyrolyttiset tai kuituvahvisteiset grafiitit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa", 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa käytettävissä rakettien suuttimissa ja ilmakehään palaamaan suunniteltujen alusten kärkikartioissa;

**Huom.:** KATSO MYÖS 0C004 KOHTA.

- c. Keraamiset komposiittimateriaalit (dielektrisyydevakio pienempi kuin 6 taajuusalueilla 100 MHz–100 GHz), joita käytetään "ohjuksissa", 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa käytettävissä tutka-antennien suojakuuissa;
- d. Kokonaisina työstettävät piikarbidivahvisteiset polttamattomat keraamit, joita käytetään "ohjuksissa", 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa käytettävissä kärkikartioissa;
- e. Piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiitit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa", 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa käytettävissä kärkikartioissa, ilmakehään palaamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa.

1C111 Seuraavat, muut kuin 1C011 kohdassa määritellyt ajoaineet tai ajoaineiden raaka-aineina käytettävät kemikaalit:

a. Ajoaineet:

1. Muu kuin asetarvikeluettelossa mainittu alumiinipallopöly, jonka tasakokoiset hiukkaset ovat läpimitaltaan alle 200 µm ja alumiinipitoisuus 97 painoprosenttia tai korkeampi, jos vähintään 10 prosenttia kokonaispainosta muodostuu hiukkasista, joiden läpimitta on alle 63 µm, ISO-standardin 2591:1988 tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti;

*Tekn. huom.:*

*Hiukkaskoko 63 µm (ISO R-565) vastaa raekokoa 250 (Tyler) tai 230 (ASTM-Standardi E-11).*

2. Muut kuin asetarvikeluettelossa mainitut metalliset ajoaineet, joiden pallomaisten, hivenettyjen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhettujen hiukkasten koko on alle 60 µm ja jotka sisältävät 97 painoprosenttia tai enemmän seuraavista:

- a. Zirkonium;
- b. Beryllium;
- c. Magnesium; tai
- d. Edellä kohdissa a–c määriteltyjen metallien seokset;

*Tekn. huom.:*

*Hafniumin luontainen pitoisuus zirkoniumissa (tyypillisesti 2–7 prosenttia) lasketaan zirkoniumin kanssa.*

3. Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävissä rakettimoottoreissa käytettävät hapettavat aineet:

- a. Dityppitrioksidi
- b. Typpidioksidi/dityppitetroksiidi
- c. Dityppipentoksidi
- d. Typpioksidisekoitukset (MON);

*Tekn. huom.:*

*Typpioksidisekoitukset (MON) ovat typpioksidin (NO) liuoksia dityppitetroksidissa/typpidioksidissa (N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>/NO<sub>2</sub>), joita voidaan käyttää ohjusjärjestelmissä. On olemassa joukko koostumuksia, jotka voidaan nimetä lyhenteillä MONi tai MONij, joissa i ja j ovat kokonaislukuja, jotka kuvaavat typpioksidin prosenttiosuutta seoksessa (esim. MON3 sisältää 3 prosenttia typpioksidia, MON25 taas 25 prosenttia typpioksidia. Yläraja on MON40 eli 40 painoprosenttia).*

- e. **KATSO ASETARVIKELUETTELO: Inhiboitu punahöyryinen typpihappo (IRFNA);**
- f. **KATSO ASETARVIKELUETTELO JA 1C238: Yhdisteet, jotka muodostuvat fluorista ja yhdestä tai useammasta muusta halogeenista, hapestä tai typestä;**

4. Seuraavat hydratsiinijohdannaiset:

- a. Trimetyylihydratsiini;
- b. Tetrametyylihydratsiini;
- c. N,N-diallyylihydratsiini;

- 1C111 a. 4. *(jatkoa)*
- d. Allylihydratsiini;
  - e. Etyleenidihydratsiini;
  - f. Monometyylihydratsiinidinitraatti;
  - g. Epäsymmetrinen dimetyylihydratsiininitraatti;
  - h. Hydratsiniumatsidi;
  - i. Dimetyylihydratsiniumatsidi;
  - j. **Katso asetarvikeluettelo hydratsiniumnitraatin osalta;**
  - k. Di-imido-oksaalihappodihydratsiini;
  - l. 2-hydroksietyylihydratsiininitraatti (HEHN);
  - m. **Katso asetarvikeluettelo hydratsiniumperklooraatin osalta;**
  - n. Hydratsiniumdiperklooraatti;
  - o. Metyylihydratsiininitraatti (MHN);
  - p. Dietyylihydratsiininitraatti (DEHN);
  - q. 1,4-dihydratsiininitraatti (DHTN);
- b. Polymeeriset aineet:
- 1. Karboksyylipäätteinen polybutadieeni (CTPB);
  - 2. Hydroksyyliipäätteinen polybutadieeni (HTPB), muu kuin asetarvikeluettelossa määritelty;
  - 3. Polybutadieeniakrylihappo (PBAA);
  - 4. Polybutadieeniakrylihappoakrylonitriili (PBAN);
  - 5. Polytetrahydrofuraanipolyetyleeniglykoli (TPEG);
- Tekn. huom.:*
- Polytetrahydrofuraanipolyetyleeniglykoli (TPEG) on poly-1,4-butaanidiolin ja polyetyleeniglykolin (PEG) blokkikopolymeeri.*
- c. Muut ajoaineiden lisä- ja apuaineet:
- 1. **KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA karboraanit, dekaboraanit, pentaboraanit ja niiden johdannaiset;**
  - 2. Trietyleeniglykolidinitraatti (TEGDN);
  - 3. 2-nitrodifenyylamiini (CAS 119-75-5);
  - 4. Trimetylietaanitrinitraatti (TMETN) (CAS 3032-55-1);
  - 5. Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN);
  - 6. Seuraavat ferroseenijohdannaiset:
    - a. **Katso asetarvikeluettelosta katoseeni;**
    - b. Etyyliferroseeni;
    - c. Propyyliferroseeni (CAS 1273-89-8);

- 1C111 c. 6. (jatkoa)
- d. **Katso asetarvikeluettelosta n-butyyliferroseeni;**
  - e. Pentyyyliferroseeni (CAS 1274-00-6);
  - f. Disyklopentyyliferroseeni (CAS 20773-28-8);
  - g. Disykloheksyyyliferroseeni;
  - h. Dietyyliferroseeni;
  - i. Dipropyyliferroseeni;
  - j. Dibutyyliferroseeni (CAS 1274-08-4);
  - k. Diheksyyyliferroseeni (CAS 93894-59-8);
  - l. Asetyyyliferroseenit;
  - m. **Katso asetarvikeluettelosta ferroseenikarboksyylihapot;**
  - n. **Katso asetarvikeluettelosta butaseeni;**
  - o. Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt ferroseenijohdannaiset, joita voidaan käyttää raketien ajoaineiden palamisnopeuden muuttamiseen.

*Huom.:* Muut ajoaineet ja kemialliset ainesosat, joita 1C111 kohdassa ei ole määritelty: katso asetarvikeluettelo.

- 1C116 Maraging-teräkset (teräkset, joille on tunnusomaista korkea nikkelpitoisuus, hyvin alhainen hiilipitoisuus sekä seostusaineiden tai erkaumien käyttö vanhenemis-karckenemisen aikaansaamiseksi), levyinä tai putkina, joiden (seinämän) paksuus on 5 mm tai vähemmän ja joiden murtovetolujuus on 1 500 MPa tai suurempi 293 K (20 °C) asteeseen lämpötilassa mitattuna.

**Huom.:** KATSO MYÖS 1C216 KOHTA.

- 1C117 Wolframi, molybdeeni ja näiden metallien seokset tasakokoisina pallomaisina tai atomisoituina hiukkasina, joiden läpimitta on 500 mikrometriä tai pienempi ja pitoisuus 97 % tai suurempi, joita käytetään "ohjuksissa", 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa käytettävien rakettimoottoreiden komponenttien, esim. lämpösuojusten, suuttimien pohjarakenteiden, suuttimien kurkkujen ja työntövektorin ohjauspintojen valmistukseen.

- 1C118 Titaanistabiloitu ruostumaton dupleksiteräs (Ti-DSS), jolla on:

- a. Kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Sisältää 17,0–23,0 painoprosenttia kromia ja 4,5–7,0 painoprosenttia nikkeliä;
  2. Titaanipitoisuus suurempi kuin 0,10 painoprosenttia; ja
  3. Ferriittis-austeniittinen mikrorakenne (toiselta nimeltään kaksiosainen mikrorakenne), josta vähintään 10 tilavuusprosenttia on austeniittia (ASTM-standardin E-1181-87 tai vastaavien kansallisten standardien mukaan); ja
- b. Jokin seuraavista muodoista:
  1. Harkko tai tanko, jonka mitat ovat joka suunnassa 100 mm tai enemmän;
  2. Levy, jonka leveys on 600 mm tai enemmän ja paksuus 3 mm vai vähemmän; tai
  3. Putki, jonka ulompi halkaisija on 600 mm tai enemmän ja seinämän paksuus 3 mm tai vähemmän.

- 1C202 Seuraavat metalliseokset, joita ei ole määritelty 1C002.b.3 tai b.4 kohdassa:
- a. Alumiiniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
    1. murtovetolujuus voi olla 460 MPa tai enemmän 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa; ja
    2. ne ovat putkina tai täysmetallisina tankoina (myös takeina), joiden ulkohalkaisija on yli 75 mm;
  - b. Titaaniseokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
    1. murtolujuus voi olla 900 MPa tai enemmän 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa; ja
    2. ne ovat putkina tai kiinteinä tankoina (myös takeina), joiden ulkohalkaisija on suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom.:

*Lujuusmääritelmä kattaa seokset sekä lämpökäsittelimättöminä että käsiteltyinä.*

- 1C210 Seuraavat, muut kuin 1C010.a, b tai e kohdassa määritellyt 'kuitu- tai säiemateriaalit' tai prepregit:
- a. Hiili- tai aramidi'kuitu- ja -säiemateriaalit', joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
    1. "ominaiskimmokerroin" on  $12,7 \times 10^6$  m tai suurempi; tai
    2. "ominaismurtovetolujuus" on  $235 \times 10^3$  m tai suurempi;
- Huom.: 1C210.a kohta ei aseta valvonnallaiseksi aramidi 'kuitu- ja -säiemateriaaleja', joissa on 0,25 prosenttia tai enemmän esteripohjaista säiepinnan muuntoainetta;
- b. Lasikuitupitoiset 'kuitu- ja -säiemateriaalit', joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
    1. "ominaiskimmokerroin" on  $3,18 \times 10^6$  m tai suurempi; ja
    2. "ominaismurtovetolujuus" on  $76,2 \times 10^3$  m tai suurempi;
  - c. 1C210.a tai b kohdassa määritellyistä hiili- tai lasi 'kuitu- tai säiemateriaaleista' valmistetut enintään 15 mm:n levyiset (prepregit) kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset "langat", "rovingit", "touvit" tai "teipit".

Tekn. huom.:

*Muovi muodostaa komposiitin matriisin.*

Huom.: 1C210 kohdassa 'kuitu- tai säiemateriaaleilla' tarkoitetaan vain yhtäjaksoisia monofilamentteja, "lankoja", "rovingeja", "touveja" tai "teippejä".

- 1C216 Muu kuin 1C116 kohdassa määritelty maraging-teräs, jonka murtovetolujuus voi 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa ylittää arvon 2 050 Mpa.

Huom.: 1C216 kohta ei aseta valvonnallaiseksi kappaleita, joiden mikään lineaarinen ulottuvuus ei ole suurempi kuin 75 mm.

Tekn. huom.:

*Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräkset sekä lämpökäsittelimättöminä että lämpökäsiteltyinä.*

- 1C225 Boori, joka on rikastettu boori-10-isotoopilla (<sup>10</sup>B) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen, seuraavasti: alkuaineboori, yhdisteet, booria sisältävät seokset, niistä valmistetut tuotteet, kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.

Huom.: 1C225 kohdassa booria sisältäviin seoksiin kuuluvat booripitoiset materiaalit.

Tekn. huom.:

*Boori-10:n luonnollinen isotooppipitoisuus on noin 18,5 painoprosenttia (20 atomiprosenttia).*

- 1C226 Volframi, volframikarbidi ja seokset, joissa on enemmän kuin 90 painoprosenttia volframia, ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- ne ovat sylinterin muotoisia kappaleita, joiden sisäläpimitta on 100–300 mm (sylinterisegmentit mukaan lukien); ja
  - niiden massa on suurempi kuin 20 kg.
- Huom.:* 1C226 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi painoina tai gammasädekollimaattoreina.
- 1C227 Kalsium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- painosta on vähemmän kuin 1 000 miljoonasosaa muita metalliepäpuhtauksia kuin magnesiumia; ja
  - vähemmän kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.
- 1C228 Magnesium, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- painosta on vähemmän kuin 200 miljoonasosaa muita metalliepäpuhtauksia kuin kalsiumia; ja
  - vähemmän kuin 10 miljoonasosaa painosta booria.
- 1C229 Vismutti, jolla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- puhtaus on 99,99 painoprosenttia tai enemmän; ja
  - hopeapitoisuus on pienempi kuin 10 miljoonasosaa.
- 1C230 Berylliummetalli, yli 50 painoprosenttia berylliumia sisältävät seokset, berylliumyhdisteet, niistä tehdyt valmisteet sekä kaikista edellä mainituista syntyvä jäte tai romu.
- Huom.:* 1C230 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:
- Röntgenlaitteiden metalli-ikkunat tai porarei'issä käytettävät sondit;
  - Valmiit tai puolivalmiit oksidiprofiilit, jotka on erityisesti suunniteltu elektronikkakomponenttiosiksi tai elektroniikkapiirien substraateiksi;
  - Berylli (beryllium-alumiinisilikaatti) smaragdina tai akvamariineina.
- 1C231 Hafniummetalli, enemmän kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisältävät seokset, enemmän kuin 60 painoprosenttia hafniumia sisältävät hafniumyhdisteet, näistä tehdyt valmisteet sekä kaikista edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- 1C232 Helium-3 (<sup>3</sup>He), helium-3:a sisältävät seokset ja mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.
- Huom.:* 1C232 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotetta tai laitetta, joissa on vähemmän kuin 1 g helium-3-isotooppia.
- 1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (<sup>6</sup>Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen sekä rikastettua litiumia sisältävät tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisältävät seokset, näistä tehdyt valmisteet, sekä kaikista edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.
- Huom.:* 1C233 ei aseta valvonnanalaiseksi termoluminesenssiannosmittareita.
- Tekn. huom.:*
- Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5 atomiprosenttia).
- 1C234 Zirkonium, jonka hafnium-pitoisuus on vähemmän kuin 1 paino-osa hafniumia per 500 osaa zirkoniumia seuraavasti: metallina, enemmän kuin 50 painoprosenttia zirkoniumia sisältävinä seoksina tai yhdisteinä, näistä tehtyinä valmisteina sekä kaikkina edellä mainitusta syntyvänä jätteenä tai romuna.
- Huom.:* 1C234 ei aseta valvonnanalaiseksi zirkoniumia, joka on enintään 0,10 mm paksuisena folioina.

1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisältävät seokset, joissa tritiumatomien lukumääräsuhte vetyatomeihin ylittää 1:1 000 sekä mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet ja laitteet.

Huom.: 1C235 ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vähemmän kuin  $1,48 \times 10^3$  GBq (40 Ci) tritiumia.

1C236 Alfa-hiukkasia emittoivat radionuklidit, joiden alfa-hiukkasten puoliintumisaika on 10 päivää tai pitempi mutta lyhyempi kuin 200 vuotta, seuraavissa muodoissa:

- a. Alkuaine,
- b. Yhdisteet, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
- c. Seokset, joiden kokonais-alfa-aktiivisuus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) tai suurempi,
- d. Mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C236 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita tai laitteita, jotka sisältävät alle 3,7 GBq (100 millicurietä) alfahiukkasaktiivisuutta.

1C237 Radium-226 ( $^{226}\text{Ra}$ ), radium-226-lejeeringit, radium-226-yhdisteet, radium-226:a sisältävät seokset, mistä ja mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet tai laitteet.

Huom.: 1C237 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. Lääketieteessä käytettävät applikaattorit,
- b. Tuotteet tai laitteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 0,37 GBq (10 millicurietä) radium-226:a.

1C238 Klooritrifluoridi ( $\text{ClF}_3$ ).

1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt voimakkaat räjähteet tai niitä enemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät seokset tai aineet, joiden kideitiheys on suurempi kuin  $1,8 \text{ g/cm}^3$  ja räjähdysnopeus yli 8 000 m/s.

1C240 Muut kuin 0C005 kohdassa määritellyt nikkelijauheet ja huokoinen metallinen nikkeli seuraavasti:

- a. Nikkelijauheet, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
  1. nikkeliipitoisuus on 99,0 painoprosenttia tai suurempi; ja
  2. keskimääräinen hiukkaskoko on pienempi kuin 10 mikrometriä mitattuna American Society for Testing and Materials (ASTM) B330 -standardilla;
- b. 1C240.a kohdassa määritellyistä materiaaleista tuotettu huokoinen metallinen nikkeli.

Huom.: 1C240 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. Säikeiset nikkelijauheet;
- b. Yksinkertaiset huokoiset nikkelilevyt, joiden koko on  $1\ 000 \text{ cm}^2$  tai vähemmän.

Tekn. huom.:

1C240.b kohdassa tarkoitetaan huokoista metallia, joka muodostuu, kun 1C240.a kohdassa tarkoitettuja materiaaleja puristetaan kokoon ja sintrataan siten, että saadaan metallista materiaalia, jossa hienot huokokset jatkuvat koko rakenteen läpi.

1C350 Seuraavat kemikaalit, joita voidaan käyttää myrkyllisten kemiallisten aineiden lähtöaineina, sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät "kemialliset seokset":

**Huom.:** KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

1. Tiodiglykoli (111-48-8)
2. Fosforioksidikloridi (10025-87-3)
3. Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)

1C350 (jatkoa)

4. **Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3): KATSO ASETARVIKELUETTELO**
5. Metyylifosfonodikloridi (676-97-1)
6. Dimetyylifosfiitti (DMP) (868-85-9)
7. Fosforitrikloridi (7719-12-2)
8. Trimetyylifosfiitti (TMP) (121-45-9)
9. Tionyylikloridi (7719-09-7)
10. N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)
11. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etylikloridi (96-79-7)
12. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)
13. 3-kinuklidinoli (1619-34-7)
14. Kaliumfluoridi (7789-23-3)
15. 2-kloorietanoli (107-07-3)
16. Dimetyyliamiini (124-40-3)
17. Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)
18. Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)
19. Dietyylifosfiitti (762-04-9)
20. Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)
21. Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)
22. Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)
23. **Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0): KATSO ASETARVIKELUETTELO**
24. Vetyfluoridi (7664-39-3)
25. Metyylibentsilaatti (76-89-1)
26. Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)
27. 2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)
28. Pinakolyylialkoholi (464-07-3)
29. **O-etyyli-2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti (QL) (57856-11-8): KATSO ASETARVIKELUETTELO**
30. Trietyylifosfiitti (122-52-1)
31. Arseenitrikloridi (7784-34-1)
32. Bentsiilihappo (76-93-7)
33. Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)
34. Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)
35. Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)
36. Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)
37. 3-kinuklidinoni (3731-38-2)

1C350 (jatkoa)

38. Fosforipentakloridi (10026-13-8)
39. Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)
40. Kaliumsyaniidi (151-50-8)
41. Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)
42. Ammoniumvetyfluoridi eli ammoniumbifluoridi (1341-49-7)
43. Natriumfluoridi (7681-49-4)
44. Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)
45. Natriumsyaniidi (143-33-9)
46. Trietanoliamiini (102-71-6)
47. Fosforipentasulfidi (1314-80-3)
48. Di-isopropyliamiini (108-18-9)
49. Dietyyliaminoetanol (100-37-8)
50. Natriumsulfidi (1313-82-2)
51. Dirikkidikloridi (10025-67-9)
52. Rikkidikloridi (10545-99-0)
53. Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)
54. N,N-di-isopropyli-2-aminoetylikloridihydrokloridi (4261-68-1).
55. Metyylifosfonihappo (993-13-5)
56. Dietyylimetyylifosfonaatti (683-08-9)
57. N,N-dimetyyliaminofosorylidikloridi (677-43-0)
58. Tri-isopropyylifosfiitti (116-17-6)
59. Etyyliidietanoliamiini (139-87-7)
60. O,O-dietyylifosforotioaatti (2465-65-8)
61. O,O-dietyylifosforoditioaatti (298-06-6)
62. Natriumheksafluorisilikaatti (16893-85-9)
63. Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-98-2).

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 3: 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 ja 62 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 4: 1C350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

- 1C351 Ihmispatogeinit, zoonoosit ja "toksiinit" seuraavasti:
- a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelmä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
1. Chikungunya-virus;
  2. Krimin verenvuotokuumevirus;
  3. Dengue-virus;
  4. Itäinen hevos-enkefaliittivirus (EEE);
  5. Ebola-virus;
  6. Hantaan-virus;
  7. Junin-virus;
  8. Lassa-kuumevirus;
  9. Lymfocyttäärinen korionmeningiittivirus;
  10. Machupo-virus;
  11. Marburg-virus;
  12. Apinarokkovirus;
  13. Rift Valley -kuumevirus;
  14. Puutiais-enkefaliittivirus;
  15. Isorokkovirus (kaikki alatyypit);
  16. Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);
  17. Läntinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);
  18. White pox -virus;
  19. Keltakuumevirus;
  20. Japanin enkefaliittivirus;
  21. Kyasanur Forest -virus;
  22. Louping ill -virus;
  23. Murray Valley -enkefaliittivirus;
  24. Omsk-verenvuotokuumevirus;
  25. Oropouche-virus;
  26. Powassan-virus;
  27. Rocio-virus;
  28. St. Louis -enkefaliittivirus;
  29. Hendra-virus (Equine morbillivirus);
  30. Etelä-Amerikan verenvuotokuume (Sabia, Flexal, Guanarito);
  31. Keuhko- ja munuaisoireita aiheuttavat verenvuotokuumevirukset (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);
  32. Nipah-virus.

1C351 (jatkoa)

- b. Seuraavat riketsiat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelmäinä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on tarkoituksellisesti istutettu tai joka on saastutettu sellaisilla viljelmillä:
1. Coxiella burnetii;
  2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana; Rickettsia quintana);
  3. Rickettsia prowasecki;
  4. Rickettsia rickettsii.
- c. Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelmäinä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
1. Bacillus anthracis;
  2. Brucella abortus;
  3. Brucella melitensis;
  4. Brucella suis;
  5. Chlamydia psittaci;
  6. Clostridium botulinum;
  7. Francisella tularensis;
  8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
  9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
  10. Salmonella typhi;
  11. Shigella dysenteriae;
  12. Vibrio cholerae;
  13. Yersinia pestis;
  14. Clostridium perfringens epsilon -myrkkyä muodostavat tyypit;
  15. Enterohemorraginen Escherichia coli; serotyyppi O157, ja muut verotoksiinia muodostavat serotyypit.
- d. Seuraavat "toksiinit" ja niiden "toksiinialayksiköt":
1. Botulinus-toksiini;
  2. Clostridium perfringens -toksiini;
  3. Conotoksiini;
  4. Risiini;
  5. Saxitoksiini;
  6. Shigatoksiini;
  7. Staphylococcus aureus -toksiini;
  8. Tetrodotoksiini;
  9. Verotoksiini ja shiga-tyyppiset ribosomien inaktivoitiproteiinit;
  10. Mikrosystiini (Cyanginosiini);
  11. Aflatoksiini;
  12. Abriini;
  13. Koleratoksiini;
  14. Diasetoksiskirpenolitoksiini;

1C351 d. (jatkoa)

15. T-2-toksiini;
16. HT-2-toksiini;
17. Modeksiini;
18. Volkensiini;
19. Viscum album Lectin 1 (Viskumiini).

*Huom.:* 1C351.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteen muodossa olevia botulinus-toksiineja tai conotoksiineja, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne ovat ihmisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita;
2. Ne on pakattu lääkevalmisteina jakelua varten;
3. Valtion viranomainen on antanut luvan niiden markkinointiin lääkevalmisteina.

e. Seuraavat joko luonnossa esiintyvät, parannetut tai muunnetut sienet, jotka esiintyvät joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on tarkoituksellisesti istutettu tällaisia viljelmiä tai joka on saastutettu niillä:

1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.

*Huom.:* 1C351 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita" tai "immunotoksiineja".

1C352 Seuraavat eläinpatogeenit:

a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1. Afrikkalainen sikaruttovirus;
2. Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:
  - a. Lajittelemattomia; tai
  - b. Seuraavat EY:n direktiivissä 92/40/ETY (EYVL N:o L 167, 22.6.1992, s. 1) erittäin patogeenisina määritellyjä:
    1. A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index, patogeenisuusindeksi suonensisäisesti annettuna) on 6 viikkoa vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai
    2. A-tyypin viruksien alatyypit H5 tai H7, joissa on nucleiidisekvenssoinnin avulla osoitettu olevan useita emäksisiä aminohappoja hemagglutiinin katkaisupaikassa;
3. Bluetongue-virus;
4. Suu- ja sorkkatautivirus;
5. Vuohirokkovirus;
6. Valeraivotautivirus (Aujeszkin tauti);
7. Sikaruttovirus;
8. Lyssavirus (rabiesryhmän virukset);
9. Newcastlel tautivirus;
10. Pikkumärehtijärutto-virus (peste des petits ruminants);
11. Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);
12. Nautaruttovirus;
13. Lammasrokkovirus;
14. Teschenin tautivirus;

- 1C352 a. (jatkoa)
15. Suutulehdusvirus (VS-virus);
  16. Lumpy skin -tautivirus;
  17. Afrikkalainen hevusrutto -virus.
- b. Seuraavat mycoplasmat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
1. Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony);
  2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Huom.: 1C352 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "rokotteita".

- 1C353 Seuraavat geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit:
- a. Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 tai 1C354 kohdassa määriteltyjen organismien patogeneisyyteen liittyviä nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali;
  - b. Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.d kohdassa määriteltyjä "toksiineja" tai niiden "toksiini-alayksiköitä" koodaavia nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali.

Tekn. huom.:

1. Geneettinen materiaali sisältää muun muassa joko muunnettuja tai muuntamattomia kromosomeja, genomeja, plasmideja, transposoneja ja vektoreja.
2. 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 tai 1C354 kohdassa määriteltyjen mikro-organismien patogeneisyyteen liittyvillä nukleiinihapposekvensseillä tarkoitetaan mitä tahansa määritellyn mikro-organismin spesifistä sekvenssiä, joka
  - a. itsessään tai transkriptio- tai translaatiotuotteidensa kautta aiheuttaa huomattavan vaaran ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle; tai
  - b. jonka tiedetään lisäävän määritellyn mikro-organismien tai muun organismien, johon kyseistä geneettistä materiaalia on insertiolla tai integraatiolla liitetty, kykyä aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle.

Huom.: 1C353 kohtaa ei sovelleta sellaisiin nukleiinihapposekvensseihin, jotka liittyvät enterohemorragisen *Escherichia coli* serotyypin O157:n ja muiden verotoksiinia muodostavien kantojen patogeneisyyteen, lukuun ottamatta niitä, jotka koodaavat verotoksiinia tai sen alayksiköitä.

- 1C354 Seuraavat kasvipatogeenit:
- a. Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
    1. Andien perunan latentti tymovirus;
    2. Perunan sukkulamukulatauti.
  - b. Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
    1. *Xanthomonas albilineans*;
    2. *Xanthomonas campestris* pv. citri, jotka sisältävät *Xanthomonas campestris* pv. citrin tyypeiksi A, B, C, D, E kutsuttuja lajikkeita tai jotka muuten luokitellaan *Xanthomonas citri*ksi, *Xanthomonas campestris* pv. aurantifoliaksi tai *Xanthomonas campestris* pv. citrumeloksi;
    3. *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae* (*Pseudomonas campestris* pv. *Oryzae*);
    4. *Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus* (*Corynebacterium michiganensis* subsp. *Sepedonicum* tai *Corynebacterium Sepedonicum*);
    5. *Ralstonia solanacearum* rodut 2 ja 3 (*Pseudomonas solanacearum* rodut 2 ja 3 tai *Burkholderia solanacearum* rodut 2 ja 3).

1C354 (jatkoa)

- c. Seuraavat sienet, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko "eristettyinä elävinä viljelminä" tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:
1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
  2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
  3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);
  4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp.tritici);
  5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);
  6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea / Pyricularia oryzae).

1C450 Seuraavat toksiset kemikaalit ja toksisten kemikaalien lähtöaineet sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät "kemialliset seokset":

**Huom.: KATSO MYÖS 1C350, 1C351.d. JA ASETARVIKELUETTELO**

a. toksiset kemikaalit seuraavasti:

1. amiton: O,O-dietyyli-S-2-N,N-dietyyliaminoetyyli-fosforotiolaatti (78-53-5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat,
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometyyli)-1-propeeni (382-21-8),
3. **KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA BZ: 3-kinuklidinylibentsilaatti (6581-06-2),**
4. fosgeeni: karbonyylidikloridi (75-44-5),
5. kloorisyanidi (506-77-4),
6. vetysyanidi (74-90-8),
7. klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2),

Huom. 1: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 1 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 3: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 ja 1C450.a.7 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 4: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajajohdykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

b. toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1. muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka sisältävät fosforiatio-min, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli- tai isopropyyli-ryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja,

Huom.: 1C450.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavaa: Fonofos: O-etyyli-S-fenylietyyli-fosfonotiolionaatti (944-22-9),

1C450 b. (jatkoa)

2. N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-] fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforylidikloridi;

Huom.: Katso 1C350.57 kohta N,N-dimetyyliaminofosforylidikloridin osalta.

3. dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luettelaa kohdassa 1C350,
4. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N-N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi hydrokloridi, jotka luettelaa kohdassa 1C350,
5. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- isopropyyli-]-aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanolit (96–80–0) ja N,N-dietyyliaminoetanolit (100–37–8), jotka luettelaa kohdassa 1C350,

Huom.: 1C450.b.5 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia:

- a. 2-N,N-dimetyyliaminoetanolit (108–01–0) ja vastaavat protonoidut suolat,
- b. 2-N,N-dietyyliaminoetanolit (100–37–8) ja vastaavat protonoidut suolat,
6. 2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaaniolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanioli, joka luettelaa kohdassa 1C350,
7. **etyylidietanoliamiini (139–87–7) osalta katso 1C350 kohta,**
8. metyyliidietanoliamiini (105–59–9).

Huom. 1: Kemiallisia aineita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 2: Kemiallisia aineita koskevaan yleissopimukseen kuuluviin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 3: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "kemiallisia seoksia", jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.8 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30 painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huom. 4: 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajajähydykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

<b>1D</b>	<b>Ohjelmistot</b>
1D001	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B001–1B003 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
1D002	"Ohjelmistot" sellaisten laminaattien tai "komposiittien" "kehittämistä" varten, joilla on orgaaninen "matriisi", metalli"matriisi" tai hiili"matriisi".
1D003	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sitä varten, että laitteet voivat suorittaa 1A004.c kohdassa määriteltyjen laitteiden toiminnot.
1D101	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 tai 1B119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
1D103	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan pienennettyä havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta, ultravioletti-, infrapuna- tai akustista havaittavuutta.
1D201	"Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 1B201 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

**1E Teknologia**

1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A001.b, 1A001.c, 1A002–1A005, 1B tai 1C kohdassa määriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

1E002 Muu teknologia:

- a. "Teknologia" polybentsotiatsoalien tai polybentsoksatsolien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
- b. "Teknologia" vähintään yhden vinyylieetterimonomeerin sisältävien fluoro-elastomeeriyhdisteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
- c. "Teknologia" seuraavien perusmateriaalien tai ei-"komposiittisten" keraamisten materiaalien suunnittelua tai "tuotantoa" varten:

1. Perusmateriaalit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Jokin seuraavista koostumuksista:

1. Yksinkertaiset tai kompleksiset zirkoniumoksidit ja kompleksiset pii- tai alumiinioksidit;
2. Yksinkertaiset boorinitridit (kuutiomaiset kidemuodot);
3. Yksinkertaiset tai kompleksiset pii- tai boorikarbidit; tai
4. Yksinkertaiset tai kompleksiset piinitridit;

b. Metallisten epäpuhtauksien kokonaismäärä, haluttuja lisäaineita lukuun ottamatta, on vähemmän kuin:

1. 1 000 ppm yksinkertaisissa oksideissa tai karbideissa; tai
2. 5 000 ppm kompleksisissa yhdisteissä tai yksinkertaisissa nitrideissä; ja

c. Jotka ovat jokin seuraavista:

1. Zirkoniumoksidi, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on enintään 1 µm ja jonka hiukkasista enintään 10 prosenttia on suurempia kuin 5 µm;
2. Muu perusmateriaali, jonka keskimääräinen hiukkaskoko on 5 µm tai vähemmän ja korkeintaan 10 prosenttia hiukkasista on kooltaan suurempia kuin 10 µm; tai
3. Joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  - a. Hiutaleiden pituuden ja paksuuden suhde ylittää 5;
  - b. Erilliskidekuitujen pituuden ja läpimitan suhde ylittää 10 alle 2 µm:n läpimitoilla; ja
  - c. Jatkuvat tai katkotut kuidut ovat läpimitaltaan alle 10 µm;

2. Keraamiset ei-"komposiitti"materiaalit, jotka koostuvat 1E002.c.1 kohdassa kuvatuista materiaaleista;

Huom.: 1E002.C.2 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "teknologiaa" hioma-aineiden kehitystä ja tuotantoa varten.

d. "Teknologia" aromaattisten polyamidikuitujen "tuotantoa" varten;

e. "Teknologia" 1C001 kohdassa määriteltyjen materiaalien installointia, ylläpitoa tai korjausta varten;

- 1E002 (jatkoa)
- f. "Teknologia" 1A002, 1C007.c tai 1C007.d kohdassa määriteltyjen "komposiitti"rakenteiden, -laminaattien tai -materiaalien korjausta varten;
- Huom.: 1E002.f kohta ei aseta valvonnallaiseksi siviili-ilma-alusten rakenteiden korjaamiseen tarvittavaa "teknologiaa", jossa käytetään hiili"kuitu- tai -säiemateriaaleja" ja hartseja, jotka sisältyvät lentokonevalmistajan käsikirjoihin.
- g. "Kirjastot" (tekniset parametrien tietokannat), jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sitä varten, että laitteet voivat suorittaa 1A004.c kohdassa määriteltyjen laitteiden toiminnot.
- Tekn. huom.:
- 1E002.g kohdassa "kirjastolla" (tekninen parametrien tietokanta) tarkoitetaan teknisten tietojen kokoelmaa, jonka käytöllä voidaan tehostaa asiaankuuluvien laitteiden tai järjestelmien suorituskykyä.
- 1E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 1E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D001, 1D101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
- 1E103 "Teknologia", jonka avulla säädetään lämpötilaa, painetta tai kaasukoostumusta auto- tai hydroklaaveissa silloin kun niitä käytetään "komposiittien" tai osittain käsiteltyjen "komposiittien" valmistukseen".
- 1E104 "Teknologia", jonka avulla tuotetaan pyrolyysimenetelmällä muodostuvia aineita muotille, telineelle tai muulle substraatille välituotekaasuista, jotka hajoavat lämpötilan ollessa 1 573 K (1 300 °C)–3 173 K (2 900 °C) astetta ja paineen 130 Pa–20 kPa.
- Huom.: 1E104 kohta sisältää "teknologian" väliaineita seostamiseksi, virtausnopeudet ja prosessiohjauksen ajoitukset sekä parametrit.
- 1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A002, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B233, 1C002.b.3 tai b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C240 tai 1D201 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 1E202 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A202 tai 1A225–1A227 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 1E203 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D201 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.



**RYHMÄ 2**  
**MATERIAALIN KÄSITTELY**



**2A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

Huom.: Hiljaiset laakerit: katso asetarvikeluettelo.

2A001 Seuraavat kitkaa vähentävät laakerit ja laakerointijärjestelmät ja niiden komponentit:

Huom.: 2A001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuulia, joille valmistajan määrittelemä toleranssi on ISO 3290:n mukaisesti luokkaa 5 tai huonompi.

- a. Kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden kaikki valmistajan määrittelemät toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 4 (tai ANSI/ABMA Std 20:n toleranssiluokka ABEC-7:n tai RBEC-7:n tai muiden vastaavien kansallisten standardien) mukaiset tai niitä paremmat, ja joiden renkaat ja pyörivät osat (ISO 5593) on valmistettu monelmetallista tai berylliumista;

Huom.: 2A001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

- b. Muut kuulalaakerit tai massiivirullalaakerit, joiden kaikki valmistajan määrittelemät toleranssit ovat ISO 492:n toleranssiluokan 2 (tai ANSI/ABMA Std 20:n toleranssiluokan ABEC-9:n tai RBEC-9:n tai muiden vastaavien kansallisten standardien) mukaiset tai niitä paremmat.

Huom.: 2A001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartiorullalaakereita.

- c. Aktiiviset magneettilaakerijärjestelmät, jotka käyttävät jotain seuraavista:

1. Materiaaleja, joiden vuontiheys on 2,0 T tai enemmän ja myötöraja suurempi kuin 414 MPa;
2. Täyssähkömagneettisia 3D yksinapaisia esimagnetointikonstruktioita toimimootoreita varten; tai
3. Korkeita lämpötiloja (430 K (177 °C) tai enemmän) kestäviä asentoantureita.

2A225 Nestemäisiä aktinidimetalleja kestävästä aineista tehdyt upokkaat seuraavasti:

- a. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. vetoisuus  $150 \text{ cm}^3$ – $8\,000 \text{ cm}^3$ ; ja
2. valmistusaineena tai vuorausaineena jokin seuraavista aineista (pitoisuus 98 painoprosenttia tai suurempi):
  - a. Kalsiumfluoridi ( $\text{CaF}_2$ );
  - b. Kalsiumsirkonaatti (metasirkonaatti) ( $\text{CaZrO}_3$ );
  - c. Keriumsulfiidi ( $\text{Ce}_2\text{S}_3$ );
  - d. Erbiumoksidi (erbia) ( $\text{Er}_2\text{O}_3$ );
  - e. Hafniumoksidi (hafnia) ( $\text{HfO}_2$ );
  - f. Magnesiumoksidi ( $\text{MgO}$ );
  - g. Typetty niobi-titaani-volframiseos (noin 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
  - h. Yttriumoksidi (yttria) ( $\text{Y}_2\text{O}_3$ );
  - i. Zirkoniumoksidi (zirkonia) ( $\text{ZrO}_2$ );

- b. Upokkaat, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

1. vetoisuus on  $50 \text{ cm}^3$ – $2\,000 \text{ cm}^3$ ; ja
2. valmistus- tai vuorausaineena on tantaali (pitoisuus 99,9 painoprosenttia tai suurempi);

- c. Upokkaat, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. vetoisuus on  $50 \text{ cm}^3$ – $2\,000 \text{ cm}^3$ ;
2. valmistus- tai vuorausaineena tantaali, jonka pitoisuus on 98 painoprosenttia tai suurempi; ja
3. pinnoitettu tantaalikarbidilla, -nitridillä tai -boridilla tai jollakin näiden yhdisteellä.

- 2A226 Venttiilit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. 'nimelliskoko' 5 mm tai suurempi;
  - b. paljettiiviste; ja
  - c. kokonaisuudessaan valmistettu tai vuorattu alumiinilla, alumiiniseoksella, nikkellillä tai nikkelseoksella, jonka painosta on enemmän kuin 60 % nikkeliä.

Tekn. huom.:

Niiden venttiilien osalta, joiden sisäänmenon ja ulostulon halkaisijat ovat erilaiset, kohdassa 2A226 'nimelliskoolla' tarkoitetaan pienintä halkaisijaa.

**2B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**Tekn. huom.:

1. Ääriviiva-akselien kokonaismäärään ei lasketa yhdensuuntaisia ääriviivasivuakseleita, (esim. vaakakaraisen avaruskoneen w-akselia, tai pyörivää sivuakselia, jonka keskilinja on samansuuntainen pyörivän pääakselin kanssa). Pyörivien akselien ei tarvitse pyörähtää yli 360 astetta. Pyörivää akselia voi käyttää lineaarinen laite (esim. ruuvi tai hammastanko).
2. 2B kohdassa niiden akseleiden määrä, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriviivaohjauksessa", on niiden akseleiden määrä, joita pitkin tai joiden ympäri suoritetaan työkappaleen prosessoinnin aikana samanaikaisia ja toisiinsa liittyviä työkappaleen ja työkalun välisiä liikkeitä. Tähän eivät sisälly muut akselit, joita pitkin tai joiden ympäri suoritetaan muita suhteellisia liikkeitä koneen sisällä, kuten:
  - a. Hiomakoneiden laikan pyöristinjärjestelmät;
  - b. Yhdensuuntaiset pyörivät akselit, jotka on suunniteltu erillisten työkappaleiden asentamiseen;
  - c. Kollineaariset pyörivät akselit, jotka on suunniteltu saman työkappaleen käsittelyyn pitelemällä sitä puristuksessa eri puolilta.
3. Akselien nimeämisen tulee olla ISO 841 standardin (International Standard, Numerical Control Machines – Axis and Motion Nomenclature) mukainen.
4. 2B001–2B009 kohdassa "kieppikara" katsotaan pyöriväksi akseliksi.
5. Taattuina paikannustarkkuustasoja, jotka poikkeavat ISO 230/2:n (1988) <sup>(1)</sup> tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti tehdyistä mittauksista, voidaan käyttää työstökoneille erillisten konetiestien sijasta. Taatulla paikannustarkkuudella tarkoitetaan sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille toimitettua tarkkuusarvoa, johon viejä on sijoittautunut konemallin tarkkuuden edustajana.

## Taattujen arvojen määrittäminen

- a. valitse viisi arvioitavan mallin konetta;
- b. Mittaa ISO 230/2:n (1998) <sup>(1)</sup> mukaisesti lineaarisen akselin tarkkuudet;
- c. Määrittele jokaisen koneen jokaisen akselin A-arvo. A-arvon laskemismenetelmä on kuvattu ISO-standardeissa;
- d. Määrittele jokaisen akselin A-arvon keskiarvo. Tästä keskiarvosta  $\hat{A}$  tulee mallin kunkin akselin mainittu arvo ( $\hat{A}_x \hat{A}_y \dots$ );
- e. Koska 2 ryhmää koskevassa luettelossa viitataan jokaiseen lineaariseen akseliin, mainittuja arvoja on oltava yhtä monta kuin lineaarisia akseleita;
- f. Jos sellaisen työstökoneen mallin, jota ei ole asetettu valvonnanaiseksi 2B001.a–2B001.c tai 2B201 kohdissa, jollekin akselille on määritelty hiomakoneita koskeva 6 mikronin ja jyrsintäkoneita ja sorveja koskeva 8 mikronin tarkkuus  $\hat{A}$  tai tätä parempi tarkkuus, valmistajan olisi vahvistettava tarkkuustaso kerran kahdeksasatoista kuukaudessa.

2B001 Seuraavat työstökoneet ja niiden yhdistelmät, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten eritelmien mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella", ja erityisesti suunnitellut komponentit;

**Huom.: KATSO MYÖS 2B201 KOHTA.**

Huom. 1: 2B001 kohta ei aseta valvonnan alaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu hammaspyörrien valmistukseen. Tällaisten koneiden osalta katso 2B003.

<sup>(1)</sup> Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2B001 (jatkoa)

Huom. 2: 2B001 kohta ei aseta valvonnan alaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu joidenkin seuraavien osien valmistukseen:

- a. Kampiakselit tai nokka-akselit;
- b. Työkalut tai leikkuuterät;
- c. Puristimen syöttöruuvi;
- d. Kaiverretut tai viisteiseksi hiotut korujen osat.

Huom. 3: Työstökone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jyräintää ja hiontaa koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on jyräintäominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B001a, b tai c osalta.

a. Työstökoneet sorvaamista varten, joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensoiteineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
2. Kaksi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa";

Huom.: 2B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kontaktilinssien valmistusta varten suunniteltuja sorveja, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Koneohjain on rajoitettu käyttämään silmätautioppiin perustuvaa ohjelmistoa tuotteen määrittelyyn kuuluvaa tietojen syöttämistä varten; ja
2. Niissä ei ole imua.

b. Työstökoneet jyräintää varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joilla on kaikki seuraavista:
  - a. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensoiteineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
  - b. Kolme lineaarista ja yksi pyörivä akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa";
2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa";
3. Tarkkuusporakoneiden paikannustarkkuus, "kaikkine käytettävissä olevine kompensoiteineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 4 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa akselin suuntaan; ja
4. Nokkateräkoneet, joilla on seuraavat ominaisuudet:
  - a. Karan "poikkeaman" ja "aksiaalisiirtymän" kokonaislukema on vähemmän (parempi) kuin 0,0004 mm TIR; ja
  - b. Luistin liikkeen kulmapoikkeaman (kiertymä pysty-, poikittais- ja pituusakselin ympäri) kokonaislukema on 30 mm:n matkalla vähemmän (parempi) kuin 2 kaarisekuntia TIR.

c. Työstökoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Joilla on kaikki seuraavista:
  - a. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensoiteineen" on saman suuruinen, tai vähemmän (parempi) kuin 4 mikrometriä ISO 230/2:n (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; ja
  - b. Kolme lineaarista ja yksi pyörivä akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa"; tai
2. Viisi tai useampia akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa";

(1) Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

- 2B001 c. (jatkoa)
- Huom.: 2B001.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:
1. Ulkopuolisia, sisäpuolisia tai ulko-sisäpuolisia pyöröhiomakoneita, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - a. Kone on rajoitettu vain pyöröhiontaan; ja
    - b. Hiomakoneen työkappaleen maksimikoko on ulkohalkaisijaltaan tai pituudeltaan 150 mm.
  2. Koneita, jotka on erityisesti suunniteltu mallinehiomakoneeksi, joilla ei ole z-akselia eikä w-akselia ja joiden paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on vähemmän (parempi) kuin  $4 \mu\text{m}$  ISO 230/2:n <sup>(1)</sup> tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.
  3. Pintahiomakoneet.
- d. Langattomat kipinätyöstökoneet (EDM), joilla on kaksi tai useampia pyöriviä akseleita, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "ääriiviivahjauksessa";
- e. Metallin, keraamisten aineiden tai "komposiittien" koneistukseen tarkoitettut koneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne käyttävät materiaalin työstämiseen jotakin seuraavista:
    - a. Vesi- tai muuta nestesuihkua, mukaan lukien ne, jotka käyttävät hiomalisäaineita;
    - b. Elektronisuihkua; tai
    - c. "Laser"sädettä; ja
  2. Niissä on kaksi tai useampia pyöriviä akseleita:
    - a. Joita voidaan samanaikaisesti koordinoida "ääriiviivahjauksessa"; ja
    - b. Joiden paikannustarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 0,003 astetta.
- f. Syväreikäporauskoneet ja sorvit, jotka on muunnettu sopiviksi syväreikäporaukseen, joilla maksimi porausvyvyys ylittää 5 000 mm, sekä niitä varten erityisesti kehitetyt komponentit.
- 2B002 Numeerisesti ohjatut optiset viimeistelytyöstökoneet, jotka on varustettu tuottamaan ei-pallomaisia optisia pintoja ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
- a. Muodon viimeistely alle (paremmaksi kuin)  $1,0 \mu\text{m}$ :iin;
  - b. Karheuden viimeistely alle (paremmaksi kuin) 100 nm rms:iin;
  - c. Kolme tai useampia akseleita, jotka voidaan koordinoida yhtäaikaaisesti "ääriiviivahjausta" varten; ja
  - d. Jotka käyttävät jotain seuraavista prosesseista:
    1. Magnetoreologinen viimeistely ('MRF');
    2. Elektroreologinen viimeistely ('ERF'); tai
    3. Suurenerginen hiukkassuihkuviimeistely.

Tekn. huom.:

2B002 kohdassa tarkoitetaan 'MRF':llä materiaalin poistoprosessia, jossa käytetään hiovaa magneettista nestettä, jonka viskositeetti muuttuu magneettikentässä. 'ERF' on poistoprosessi, jossa käytetään hiovaa nestettä, jonka viskositeettia ohjataan sähkökentällä. 'Suurenergisessä hiukkassuihkuviimeistelyssä' käytetään reaktiivisia atomiplasmoja (RAP) tai ionisuihkuja materiaalin poistamiseksi valikoivasti.

<sup>(1)</sup> Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

2B003 "Numeerisesti ohjatut" tai käsiohjatut työstökoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, ohjaukset ja lisälaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu höyläämään, viimeistelemään, hiomaan tai hoonamaan karkaistuja ( $R_c = 40$  tai yli) lieriöhammaspyöriä, ruuvipyöriä tai kaksoisruuvipyöriä, joiden jakohalkaisija on enemmän kuin 1 250 mm ja hampaan leveys on 15 % jakohalkaisijasta tai enemmän, ja jotka on koneistettu AGMA 14:n laatuiseksi tai paremmiksi (vastaa ISO 1328:n 3 luokkaa).

2B004 Seuraavat kuuma"isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisälaitteet:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B104 ja 2B204 KOHTA.**

- a. Suljetussa tilassaan säädettävä lämpötila, ja kammion tilan sisäläpimita on 406 mm tai enemmän; ja
- b. Jokin seuraavista:
  1. Maksimityöpaine ylittää 207 MPa;
  2. Säädettävä lämpötila ylittää 1 773 K (1 500 °C); astetta; tai
  3. Joissa on edellytykset hiilivetykyllästyksen ja syntyvien kaasumaisten hajoamistuotteiden poistoon.

Tekn. huom.:

*Kammion sisäläpimita tarkoittaa sen tilan kokoa, jossa sekä työlämpötila että työpaine saavutetaan, eikä siihen sisällytetä kiinnittimiä. Tämä mitta on joko painekammion sisähalkaisija tai eristetyn kuumakammion sisähalkaisija ja on se, joka on pienempi, riippuen siitä kumpi kammioista on toisen sisällä.*

Huom.: Erityisesti suunnitellut suulakkeet, muotit ja laitteet: katso kohdat 1B003, 9B009 ja asetarvikeluettelo.

2B005 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet pinnoitusta, prosessointia ja pinnoitteen laadun prosessin aikaista ohjausta varten, joilla aikaansaadaan epäorgaanisia pinnoitteita tai pintamodifikaatioita johtamattomille substraateille käyttäen menetelmiä, jotka on kuvattu 2E003.f kohdan jäljessä olevassa taulukossa ja siihen liittyvissä huomautuksissa, sekä näitä laitteita varten erityisesti suunnitellut automaattiset kuljetus-, sijoitus-, käsittely- ja ohjauskomponentit:

- a. Tuotantolaitteet kemiallista kaasufaasipinnoitusta varten (CVD), joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B105 KOHTA.**

1. Jokin seuraavista prosessin muunnoksista:
  - a. Syke-CVD (pulsating CVD);
  - b. Säädeltävä ydintymis-lämpöhajoaminen (CNTD); tai
  - c. Plasma-CVD; ja
2. Jokin seuraavista:
  - a. Sisältävät pyörivät tyhjiötiivisteet (0,01 pa tai vähemmän); tai
  - b. Sisältävät prosessin aikaisen kerrospaksuuden säädön;
- b. Ioni-istutustuotantolaitteet, joiden ionisuihkun virta on 5 mA tai enemmän;

2B005 (jatkoa)

- c. Tuotantolaitteet elektronisuihkun avulla tapahtuvaa fysikaalista kaasufaasipinnoitusta varten (EB-PVD), joihin sisältyvien tehojärjestelmien nimellisteho ylittää 80 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Nestelähteen pinnan "laser"säätöjärjestelmä, joka tarkasti ohjaa tankojen syöttönopeutta; tai
  2. Tietokoneohjattu nopeuden seuranta, jolla ohjataan kahta tai useampaa elementtiä sisältävän pinnoitteen kasvunopeutta ja joka perustuu höyryvirrassa olevien ionisoitujen atomien fotoluminesenssiin;
- d. Plasmaruiskutustuotantolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Toimivat säädettävässä alennetussa paineessa (10 kPa tai vähemmän, mitattuna 300 mm:n sisältä suuttimen ulostulon yläpuolelta) tyhjökammiossa, joka ennen suihkutusprosessia voidaan tyhjentää 0,01 Pa:iin asti; tai
  2. Sisältävät prosessin aikaisen kerrospaksuuden säädön;
- e. Sputterointituotantolaitteet, joiden virtatiheys voi olla 0,1 mA/mm<sup>2</sup> tai suurempi, kun pinnoitusnopeus on 15 µm tunnissa tai suurempi;
- f. Katodikaaripinnoitustuotantolaitteet, jotka sisältävät sähkömagneeteista koostuvan hilan kaaren pisteen ohjaamiseksi katodilla;
- g. Ionipinnoitustuotantolaitteet, jotka mahdollistavat jonkin seuraavan prosessin aikaisen mittauksen:
1. Kerrospaksuuden mittauksen substraatin päältä ja pinnoitusnopeuden säädön; tai
  2. Optisten ominaisuuksien mittauksen.

Huom.: 2B005 kohta ei aseta valvonnallaiseksi leikkaus- tai työstötyökaluja varten erityisesti suunniteltuja kaasufaasipinnoitus-, katodikaari-, sputterointipinnoitus-, ionipäällystys- tai ioni-istutuslaitteita.

2B006 Seuraavat dimensioiden tarkastus- ja mittausjärjestelmät, -laitteet ja "elektroniset kokoonpanot":

- a. Tietokoneohjatut tai "numeerisesti ohjatut" koordinaattimittauskoneet (KMK), joiden kolmen dimension (tilavuuden) osoituksen suurin sallittu virhe (MPE<sub>E</sub>) koneen toiminta-alueen missä tahansa kohdassa (akselien pituuden puitteissa) on (1,7 + L/1 000) µm tai pienempi (parempi) (L on mitattu pituus millimetreinä) standardin ISO 10360-2 (2001) mukaisesti testattuna;

**Huom.: KATSO MYÖS 2B206 KOHTA.**

- b. Seuraavat lineaarisen ja kulmasiirtymän mittausinstrumentit:
1. Lineaarisen siirtymän mittausinstrumentit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.:

2B006.b.1 kohdassa "lineaarisella siirtymällä" tarkoitetaan mittapään ja mitattavan kohteen välisen etäisyyden muutosta.

- a. Kosketuksettomat mittausjärjestelmät, joiden "resoluutio" on 0,2 µm tai vähemmän (parempi) 0,2 mm:n mittausalueella;
- b. Lineaariset differentiaalimuuntajajärjestelmät, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
  1. "Lineaarisuus" on 0,1 % tai vähemmän (parempi) mittausalueella, joka on 5 mm tai pienempi; ja
  2. Ryömintä on 0,1 % tai vähemmän (parempi) päivässä testaushuoneen vakioilämpötilassa ± 1 K astetta; tai

- 2B006 b. 1. (jatkoa)
- c. Mittausjärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Sisältävät "laserin"; ja
  2. Säilyttävät vähintään 12 tuntia normaalilämpötilan  $\pm 1$  K asteen vaihtelualueella ja normaalipaineessa seuraavat ominaisuudet:
    - a. "Resoluution" 0,1 mikrometriä tai vähemmän (parempi) koko mittausalueella; ja
    - b. "Mittauksen epävarmuuden"  $(0,2 + L/2 000)$  mikrometriä tai vähemmän (parempi) (L on mitattu pituus millimetreinä);
  - d. "Elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan takaisinkyntäkyvyn 2B006.b.1.c kohdassa määritellyissä järjestelmissä;
- Huom.: 2B006.b.1 kohta ei aseta valvonnalaiseksi interferometrimittausjärjestelmiä, joissa on automaattinen valvontajärjestelmä, joka on suunniteltu niin, ettei se käytä takaisinkyntäteknikoita, ja jotka sisältävät "laserin" työstökoneen, mittatarkastuskoneen tai vastaavien laitteiden luistin liikkeen virheitä.
2. Kulmasiirtymän mittausinstrumentit, joiden "kiertymiskulman poikkeama" on 0,00025 astetta tai vähemmän (parempi);
- Huom.: 2B006.b.2 kohta ei aseta valvonnalaiseksi optisia instrumentteja, kuten autokollimaattoreita, jotka käyttävät kollimoitua valoa (esimerkiksi laservaloa) peilin kulmasiirtymän ilmaisemiseen.
- c. Laitteet, joilla mitataan pinnan epätasaisuutta mittaamalla optista sirontaa kulman funktiona ja joiden herkkyys on 0,5 nm tai vähemmän (parempi).
- Huom.: Työstökoneet, joita voidaan käyttää mittausasemina ovat valvonnalaisia, jos niiden ominaisuudet täyttävät tai ylittävät työstökoneille tai mittausasemille määritellyt kriteerit.

2B007 "Robotit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut ohjausyksiköt ja "pääteyövälineet":

**Huom.: KATSO MYÖS 2B207 KOHTA.**

- a. Kykenevät tosiaikaisesti täyteen kolmiulotteiseen kuvan käsittelyyn tai täyteen kolmiulotteiseen 'näkökentän analysointiin' tuottaakseen tai muuntaakseen "ohjelmia" tai numeerista ohjelmatietoa;
- Tekn. huom.:
- 'Näkökentän analysointiin' liittyvä rajoitus ei sisällä kolmannen ulottuvuuden approksimointia annetusta kulmasta eikä rajoitettua harmaasävyjen tulkinnan avulla tapahtuvaa syvyyden tai pintarakenteen havaitsemista ( $2^{1/2} D$ ) hyväksytyjen tehtävien suorittamiseksi.
- b. On erityisesti suunniteltu vastaamaan kansallisia turvallisuusstandardeja, joita sovelletaan räjähtävien sotatarvikkeiden ympäristössä;
- c. On erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämaan säteilyä, jonka kokonaissäteily määrä on enemmän kuin  $5 \times 10^3$  Gy (Pii) ilman, että toimivuus huononee.
- Tekn. huom.:
- Termillä Gy (Pii) tarkoitetaan kilojouleina ilmaistuna energiamäärää, jonka suojaamaton piinäyte imee itseensä, kun se altistetaan ionisoivalle säteilylle.
- d. On erityisesti suunniteltu toimimaan yli 30 000 m:n korkeuksissa.

2B008 Seuraavat erityisesti työstökoneita tai mittojen tarkastus- tai mittausjärjestelmiä tai -laitteita varten suunnitellut kokoonpanot tai yksiköt:

- a. Lineaariset aseman takaisinkyntäyksiköt (esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut asteikot, infrapuna-järjestelmät tai "laser"-järjestelmät), joiden kokonaistarkkuus on vähemmän (parempi) kuin  $(800 + (600 \times L \times 10^{-3}))$  nm (L on tehollinen pituus millimetreinä);

Huom.: "Laser"-järjestelmät: katso myös huomautusta 2B006.b.1 kohdassa.

- 2B008 (jatkoa)
- b. Pyörähdyssaseman takaisinkytkentäyksiköt, esim. induktiiviset laitteet, kalibroidut asteikot, infrapunajärjestelmät tai "laser"järjestelmät, joiden "tarkkuus" on vähemmän (parempi) kuin 0,00025 astetta;
- Huom.:* "Laser" järjestelmät: katso myös huomautusta 2B006.b.1 kohdassa.
- c. "Yhdistelmäpyöröpöydät" ja "kieppikarat", joilla valmistajan spesifikaatioiden mukaan voidaan parantaa työöstökoneiden laatua yli niiden tasojen, jotka on määritelty 2B kohdassa.

- 2B009 Dreijaussorvit ja painesorvit, jotka valmistajan teknisen eritelmän mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjaus"yksiköillä tai tietokoneohjauksella ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B109 JA 2B209 KOHTA.**

- a. Niissä on kaksi tai useampi ohjattava akseli, joista vähintään kahta voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa"; ja
- b. Niiden valssausvoima on suurempi kuin 60 kN.

*Tekn. huom.:*

*Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B009 kohdan tarkoituksessa painesorveiksi.*

- 2B104 Muut kuin 2B004 kohdassa määritellyt "isostaattiset puristimet", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B204 KOHTA.**

- a. Suurin toimintapaine on 69 MPa tai enemmän;
- b. Ne on suunniteltu saavuttamaan ja säilyttämään 873 K (600 °C) asteen kontrolloitu lämpötila tai tätä korkeampi lämpötila; ja
- c. kammion sisähalkaisija 254 mm tai suurempi.

- 2B105 Muut kuin 2B005.a kohdassa määritellyt uunit kemiallista kaasufaasipinnoitusta (CVD) varten, jotka on suunniteltu tai muunnettu hiili-hiilikomposiittien tiivistämiseen.

- 2B109 Seuraavat, muut kuin 2B009 kohdassa määritellyt painesorvit ja erityisesti suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B209 KOHTA.**

- a. Painesorvit, joilla on seuraavat ominaisuudet:
1. Ne voidaan valmistajan teknisen eritelmän mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella" tai tietokoneohjauksella, silloinkin kun niitä ei ole varustettu sellaisilla yksiköillä; ja
  2. Niissä on useampi kuin kaksi akselia, joita voidaan samanaikaisesti koordinoita "ääriiviivaohjauksessa".
- b. 2B009 tai 2B109.a kohdassa määritettyjä painesorveja varten erityisesti suunnitellut komponentit.

*Huom.:* 2B109 kohta ei aseta valvonnallaiseksi koneita, joita ei voida käyttää 9A005, 9A007.a tai 9A105.a kohdissa määriteltyjen työntövoimakomponenttien ja laitteiden (kuten moottorikoppien) tuottamiseen.

*Tekn. huom.:*

*Koneet, joissa yhdistyvät dreijaus- ja painesorvauksen toiminnot, katsotaan 2B109 kohdan tarkoituksessa painesorveiksi.*

- 2B116 Seuraavat tärinäntestausjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:
- Tärinäntestausjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa, joissa on digitaalinen ohjain, jolla koejärjestelmää voidaan täräyttää 10 g:n rms tai suuremmalla kiihdytysarvolla 20 Hz–2 kHz:n taajuusalueella ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia 'paljaalla alustalla' mitattuna;
  - Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tärinäntestausohjelmistot, joiden "tosi-aikainen kais-tanleveys" on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu 2B116.a kohdassa mainittujen tärinäntes-tausjärjestelmien käyttöä varten;
  - Täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi tärinävoima 'paljaalla alustalla' mitattuna ja joita voidaan käyttää 2B116.a kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä;
  - Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita erillisiä täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voi-man 'paljaalla alustalla' mitattuna ja joita voidaan käyttää 2B116.a kohdassa mainituissa tärinäntestausjärjestelmissä.

*Tekn. huom.:*

2B116 kohdassa 'paljaalla alustalla' tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman kiinnittimiä tai sovitteita.

- 2B117 Prosessinohjaus- ja muut laitteet, paitsi 2B004, 2B005.a, 2B104 tai 2B105 kohdassa määritellyt, jotka on suunniteltu tai muunneltu raketien suuttimien ja ilmakehään palaamaan tarkoitettujen alusten karkikartioi-den komposiittirakenteiden tiivistämällä tai pyrolysoimalla tapahtuvaa valmistusta varten.

- 2B119 Tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät laitteet seuraavasti:

**Huom.: KATSO MYÖS 2B219 KOHTA.**

- Tasapainotuskoneet, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
    - Niillä ei voi tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;
    - Niillä on voitava tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat suurempia kuin 12 500 kierrosta minuutissa;
    - Niillä on voitava korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja
    - Niillä on voitava tasapainottaa siten, että jäännösepatasapaino on 0,2 g mm roottorin massan kuta-kin kiloa kohden;
- Huom.: 2B119.a ei aseta valvonnanalaiseksi hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten suun-niteltuja tai muunneltuja tasapainotuskoneita.*
- 2B119.a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ilmaisinpäät.

*Tekn. huom.:*

*Ilmaisinpäät tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.*

- 2B120 Liikesimulaattorit tai pyörityspöydät, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
- Kaksi akselia tai enemmän;
  - Liukurenkaat, joilla voidaan välittää sähkötehoa ja/tai signaalitietoa; ja
  - Joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - Yksittäisen akselin osalta kaikki seuraavista:
      - Kulmanopeus 400 astetta/s tai enemmän taikka 30 astetta/s tai vähemmän; ja
      - Kulmanopeuden erottelukyky 6 astetta/s tai vähemmän ja tarkkuus 0,6 astetta/s tai vähemmän;

- 2B120 c. (jatkoa)
2. Huonoin kulmanopeuden stabiilisuus sama tai parempi (vähemmän) kuin plus tai miinus 0,05 prosenttia keskiarvotettuna 10:lle tai useammalle asteelle; tai
  3. Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.
- Huom.: 2B120 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi työstökoneita tai lääkinnällisiä laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja pyöröpöytiä. Työstökoneiden pyöröpöytien valvonnan osalta katso 2B008 kohta.
- 2B121 Muut kuin 2B120 kohdassa määritellyt asemointipöydät (laitteet täsmälliseen pyöröasemointiin minkä tahansa akselin osalta), joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
- a. Kaksi akselia tai enemmän; ja
  - b. Asemointitarkkuus 5 kaarisekuntia tai parempi.
- Huom.: 2B121 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi työstökoneita tai lääkinnällisiä laitteita varten suunniteltuja tai muunnettuja pyöröpöytiä. Työstökoneiden pyöröpöytien valvonnan osalta katso 2B008 kohta.
- 2B122 Lingot, joilla voidaan saavuttaa yli 100 g:n kiihdytys ja joissa on liukurenkaat, joilla voidaan välittää sähkötehoa ja signaalitietoa.
- 2B201 Seuraavat, muut kuin 2B001 kohdassa määritellyt työstökoneet ja niiden kaikki yhdistelmät, jotka on tarkoitettu työstämään (tai leikkaamaan) metalleja, keraamisia aineita tai "komposiitteja" ja jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa elektronisilla laitteilla kahden tai useamman akselin samanaikaista "ääriiviivoajusta" varten;
- a. Työstökoneet jysintää varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 6 µm ISO 230/2:n (1988) <sup>(1)</sup> tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai
    2. Kaksi tai useampi akseli, joita voidaan samanaikaisesti koordinoida ääriiviivoajauksessa;

Huom.: 2B201.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi jysintäkoneita, joilla on seuraavat ominaisuudet:

    - a. X-akselin liikkuma on suurempi kuin 2 m; ja
    - b. X-akselin kokonaispaikannustarkkuus on enemmän (huonompi) kuin 30 µm.
  - b. Työstökoneet hiontaa varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. Paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on saman suuruinen tai vähemmän (parempi) kuin 4 µm ISO 230/2:n (1988) <sup>(1)</sup> tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti määriteltynä minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan; tai
    2. Kaksi tai useampia pyöriviä ääriviiva-akseleita.

Huom.: 2B001.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavia hiomakoneita:

    - a. Ulkopuoliset, sisäpuoliset tai ulko-sisäpuoliset pyöröhiomakoneet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
      1. Työkappalekapasiteetti on rajoitettu enintään 150 mm:n ulkohalkaisijaan tai pituuteen; ja
      2. Akselit rajoitettu x:ään, z:aan ja c:hen;
    - b. Mallinetyöstökoneet, joissa ei ole z-akselia tai w-akselia ja joiden kokonaispaikannustarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 4 µm ISO 230/2:n (1988) <sup>(1)</sup> tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

<sup>(1)</sup> Valmistajien, jotka laskevat paikannustarkkuustasoja ISO 230/2:n (1997) mukaisesti, olisi neuvoteltava sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, johon ne ovat sijoittautuneet.

- 2B201 b. (jatkoa)
- Huom. 1: 2B201 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi erikoistyöstökoneita, joiden käyttö on rajattu joidenkin seuraavien osien valmistukseen:
- Hammaspyörät;
  - Kampiakselit tai nokka-akselit;
  - Työkalut tai leikkuuterät;
  - Puristimen syöttöruuvit.
- Huom. 2: Työstökone, jolla on ainakin kaksi kaikkiaan kolmesta sorvaamista, jysintää ja hiontaa koskevasta ominaisuudesta (esim. sorvaamiskone, jossa on jysintäominaisuus), on arvioitava kunkin sovellettavan kohdan 2B001.a tai 2B201.a tai b osalta.
- 2B204 Muut kuin 2B004 tai 2B104 kohdassa määritellyt "isostaattiset puristimet" ja niihin liittyvät laitteet seuraavasti:
- "isostaattiset puristimet", joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - kykenevät saavuttamaan 69 MPa:n tai suuremman maksimitoimintapaineen;
    - kammion sisähalkaisija on suurempi kuin 152 mm;
  - 2B204.a kohdassa määriteltyjä "isostaattisia puristimia" varten erityisesti suunnitellut muotit ja ohjauslaitteet.
- Tekn. huom.:
- 2B204 kohdassa kammion sisämitta on sen kammion mitta, jossa saavutetaan sekä toimintalämpötila että toimintapaine, eikä siinä oteta huomioon kiinnittimiä. Ilmoitettu mitta on sisähalkaisijoista pienempi, eli painekammion tai eristetyn uunikammion sisähalkaisija, riippuen siitä, kumpi kammio on toisen sisällä.
- 2B206 Seuraavat, muut kuin 2B006 kohdassa määritellyt, mittatarkastuskoneet, -instrumentit ja järjestelmät:
- Tietokoneohjatut, "numeerisesti ohjatut" tai ohjelmallisesti ohjatut mittatarkastuskoneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - Kaksi tai useampia akseleita; ja
    - Yhden dimension pituuden "mittauksen epävarmuus"  $(1,25 + L/1\ 000)$   $\mu\text{m}$  tai pienempi (parempi) testattuna anturilla, jonka "tarkkuus" on pienempi (parempi) kuin  $0,2 \mu\text{m}$  (L on mitattu pituus millimetreinä); (Viite: VDI/VDE 2617 Osat 1 ja 2);
  - Lineaarisen ja kulmasiirtymän samanaikaiseen tarkasteluun kykenevät järjestelmät, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - "Mittauksen epävarmuus" mitä tahansa lineaarista akselia pitkin on  $3,5 \mu\text{m}$  tai vähemmän (parempi) 5 mm matkalla; ja
    - "Kiertymiskulman poikkeama" on 0,02 astetta tai vähemmän.
- Huom. 1: Työstökoneet, joita voidaan käyttää mittauskoneina ovat valvonnanalaisia, jos niiden ominaisuudet täyttävät tai ylittävät työstökoneille tai mittausasemille määritellyt kriteerit.
- Huom. 2: 2B206 kohdassa määritelty kone on valvonnanalainen, jos se ylittää valvontakynnyksen missä tahansa toiminta-alueellaan.
- Tekn. huom.:
- Mittauksen epävarmuuden määrittämiseen käytetyn anturin tulee olla kuvattu VDI/VDE 2617:n 2, 3 ja 4 osassa.
  - Kaikki 2B206 kohdassa esitetyt mittausarvot tarkoittavat positiivista tai negatiivista poikkeamaa viitearvosta, eivät koko välystä.

- 2B207 Seuraavat muut kuin 2B007 kohdassa määritellyt "robotit", "pääteyövälineet" ja "ohjauksyksiköt":
- "Robotit" ja "pääteyövälineet", jotka on erityisesti suunniteltu täyttämään voimakkaiden räjähteiden käsittelyä koskevat kansalliset turvamääräykset (täyttävät esimerkiksi voimakkaita räjähteitä koskevat sähkösäännökset);
  - ohjauksyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu 2B207.a kohdassa määriteltyjä "robotteja" ja "pääteyövälineitä" varten.
- 2B209 Seuraavat, muut kuin 2B009 ja 2B109 kohdassa määritellyt painesorvit ja dreijaussorvit, jotka kykenevät painesorvin toimintoihin, sekä karat:
- Koneet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - Kolme tai useampia valsseja (aktiivisia tai ohjaavia); ja
    - Jotka valmistajan teknisten spesifikaatioiden mukaan voidaan varustaa "numeerisella ohjauksella" yksiköllä tai tietokoneohjauksella;
  - Roottorin muotoilukarat, jotka on suunniteltu muotoilemaan lieriömäisiä roottoreita, joiden sisäläpimitta on 75 mm:n ja 400 mm:n välillä.
- Huom.: 2B209.a kohta sisältää koneet, joissa on vain yksi metallin muotoiluun suunniteltu valssi ja kaksi lisävalssia, jotka kannattelevat karaa, mutta eivät suoraan osallistu muodonmuutosprosessiin.
- 2B219 Seuraavat kiinteät tai kannettavat, vaaka- tai pystysuuntaiset keskipakovoimaan perustuvat monitasotasapainotuskoneet:
- Joustavien, vähintään 600 mm pitkien roottoreiden tasapainottamiseen tarkoitettujen keskipakovoimaan perustuvien monitasotasapainotuskoneiden, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Pyörähdyshalkaisija tai akselitapin halkaisija suurempi kuin 75 mm;
    - Massankäsittelykyky 0,9–23 kg; ja
    - Kierrosnopeus tasapainotettaessa yli 5 000 kierrosta minuutissa;
  - Onttojen lieriömäisten roottorinosien tasapainottamiseen tarkoitettujen keskipakotasapainotuskoneiden, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Akselitapin halkaisija on suurempi kuin 75 mm;
    - Niiden massankäsittelykyky on 0,9–23 kg;
    - Ne kykenevät tasapainottamaan niin, että jäännösepäätasapaino kussakin tasossa on enintään 0,010 kg × mm/kg; ja
    - Ne ovat hihnakäyttöisiä.
- 2B225 Kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
- Ne pystyvät läpäisemään 0,6 m paksun tai paksumman kuumakammion seinän (seinän läpi työskentely); tai
  - Ne pystyvät kurottamaan 0,6 m paksun tai paksumman kammion seinän yli (seinän yli työskentely).

Tekn. huom.:

Kaukokäsittelylaitteilla välitetään operaattorin liikkeitä käyttövarteen ja päätetyökaluun. Ne voivat olla 'isäntä-orja'-tyyppisiä tai niitä käytetään ohjaimella tai näppäimistöä.

2B226 Kontrolloidun ympäristön (tyhjiö- tai inerttikaasu)induktiouunit ja niiden teholähteet seuraavasti:

**Huom.: KATSO MYÖS 3B KOHTA.**

- a. Uunit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Niitä voidaan käyttää yli 1 123 K (850 °C) asteen lämpötiloissa;
  2. Niiden induktiokelojen halkaisija on 600 mm tai pienempi; ja
  3. Niitä käytetään 5 kW:n tai suuremmalla syöttöteholla;
- b. Erityisesti 2B226.a kohdassa määritetyille uuneille suunnitellut teholähteet, joiden määritelty teho on 5 kW tai suurempi.

Huom.: 2B226.a kohdassa ei tarkoiteta puolijohdekielkojen valmistukseen suunniteltuja uuneja.

2B227 Seuraavat kontrolloidun ympäristön metallurgiset sulatus- ja valu-uunit sekä niihin liittyvät laitteet:

- a. Valokaaritoistosulatus- ja valu-uunit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
  1. Niiden sulavaelektrodkapasiteetti on 1 000 cm<sup>3</sup>–20 000 cm<sup>3</sup>; ja
  2. Ne kykenevät toimimaan yli 1 973 K (1 700 °C) asteen sulatuslämpötiloissa;
- b. Elektronisuihkusulatusuunit sekä plasmasumutus- ja sulatusuunit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
  1. Niiden teho on 50 kW tai suurempi; ja
  2. Ne kykenevät toimimaan yli 1 473 K (1 200 °C) asteen sulatuslämpötiloissa;
- c. 2B227 a. tai b. kohdissa olevia uuneja varten erityisesti konfiguroidut tietokoneohjaus- ja valvontajärjestelmät.

2B228 Seuraavat roottorien valmistus- tai kokoonpanolaitteet, roottorien suoruuden varmistavat laitteet, sekä paljemoivaustuurnat ja muotit:

- a. Roottorien kokoonpanolaitteet, kaasusentrifugien roottorilohkojen, ohjauslevyjen ja päätylaippojen kokoamiseen;

Huom.: 2B228.a kohtaan sisältyvät tarkkuustuurnat, puristimet ja kutistusovituskoneet;

- b. Roottorien suoruuden varmistavat laitteet, joiden avulla kaasusentrifugien roottorien lohkot linjataan yhteiselle akselille;

Tekn. huom.:

2B228.b kohdassa tällaiset laitteet koostuvat yleensä tietokoneeseen kytketyistä tarkkuusmittapäistä, joiden avulla tietokone ohjaa roottoriputkilohkojen linjaukseen käytettävien, esimerkiksi paineilmakäyttöisten, iskumäntien toimintaa.

- c. Paljemoivaustuurnat ja muotit, joiden avulla valmistetaan yksikierteisiä palkeita.

Tekn. huom.:

2B228.c kohdassa tarkoitetuilla palkeilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Sisähalkaisija 75–400 mm;
2. Pituus 12,7 mm tai suurempi;
3. Yhden kierteen syvyys yli 2 mm; ja
4. Valmistusaineina lujat alumiiniseokset, maraging-teräs tai lujat "kuitu- tai säiemateriaalit".

2B230 "Painelähettimet", jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–13 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

- a. Painetta anturoiva elementti on valmistettu tai suojattu alumiinilla tai alumiiniseoksella, nikkelillä tai enemmän kuin 60 % nikkeliä sisältävällä nikkeliseoksella; ja
- b. joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  1. Mitta-alue enintään 13 kPa ja 'tarkkuus' parempi kuin  $\pm 1\%$  täydestä mitta-alueesta; tai
  2. Kokonaismitta-alue 13 kPa tai suurempi ja 'tarkkuus' parempi kuin  $\pm 130$  Pa.

Tekn. huom.:

2B230 kohdassa 'tarkkuuteen' sisältyy epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympäristön lämpötilassa.

2B231 Tyhjäpumput, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Syöttöliitännän sisähalkaisija on 380 mm tai suurempi;
- b. Pumppausnopeus  $15 \text{ m}^3/\text{s}$  tai suurempi; ja
- c. Niiden avulla pystytään saamaan aikaan parempi kuin 13 mPa:n lopullinen tyhjä.

Tekn. huom.:

1. Pumppausnopeus määritetään mittauspisteessä typpikaasulla tai ilmalla.
2. Lopullinen tyhjä määritellään pumpun syötepäässä syöteputken ollessa suljettuna.

2B232 Monivaiheiset kevyet kaasutykit tai muut suurnopeustykkijärjestelmät (käämeihin perustuvat, sähkömagneettiset, ja sähkötermiset tyypit ja muut pitkälle kehitetyt järjestelmät), joiden avulla amukset voidaan kiihdyttää  $2 \text{ km/s}$  tai suurempiin nopeuksiin.

2B350 Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

- a. Sekoittajilla tai ilman niitä varustetut reaktioastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin  $0,1 \text{ m}^3$  (100 l) ja pienempi kuin  $20 \text{ m}^3$  (20 000 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
  1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  6. Titaanista tai titaaniseoksista;
  7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  8. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- b. Sekoittajat, joita käytetään kohdassa 2B350 määritellyissä reaktioastioissa tai reaktoreissa ja tällaisissa sekoittajissa käytettävät juoksupyörät, siivet ja akselit, joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
  1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

- 2B350 b. (*jatkoa*)
5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  6. Titaanista tai titaaniseoksista;
  7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  8. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- c. Varastosäiliöt, säiliöt tai keräysastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m<sup>3</sup> (100 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Metalliseoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  6. Titaanista tai titaaniseoksista;
  7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  8. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- d. Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on suurempi kuin 0,15 m<sup>2</sup> ja pienempi kuin 20 m<sup>2</sup> ja tällaisissa vaihtimissa tai lauhduttimissa käytettävät putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalien (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Grafiitista tai 'grafiitihilestä';
  5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  7. Titaanista tai titaaniseoksista;
  8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista;
  9. Piikarbidista;
  10. Titaanikarbidista; tai
  11. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- e. Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisähalkaisija on suurempi kuin 0,1 m ja tällaisissa tislaus- tai imeytyskolonneissa käytettävät nestejakelijat, höyryjakelijat ja nestekerääjät, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Grafiitista tai 'grafiitihilestä';

- 2B350 e. (jatkoa)
5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  7. Titaanista tai titaaniseoksista;
  8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  9. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- f. Kauko-ohjatut täyttölaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia; tai
  2. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
- g. Venttiilit, joiden nimelliskoko on suurempi kuin 10 mm ja kammiot (venttiilin rungot) tai muotoon puristetut runkotiivisteet tällaisille venttiileille, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  5. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  6. Titaanista tai titaaniseoksista;
  7. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  8. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- h. Moniseinäiset putkistot, joihin sisältyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Fluoripolymeereistä;
  3. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  4. Grafiitista tai 'grafiittihiilestä';
  5. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  6. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  7. Titaanista tai titaaniseoksista;
  8. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  9. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.

2B350 (jatkoa)

- i. Monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin  $0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ , tai vakuumpumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin  $5 \text{ m}^3/\text{h}$  (vakio lämpötilassa ( $0 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $273 \text{ K}$  astetta) ja -ilmanpaineessa ( $101,30 \text{ kPa}$ )), ja tällaisissa pumpuissa käytettävät rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:
1. Seoksista, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;
  2. Keraameista;
  3. Ferropiistä;
  4. Fluoripolymeereistä;
  5. Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);
  6. Grafiitista tai 'grafiitihilestä';
  7. Nikkelistä tai seoksista, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;
  8. Tantaalista tai tantaaliseoksista;
  9. Titaanista tai titaaniseoksista;
  10. Zirkoniumista tai zirkoniumseoksista; tai
  11. Niobiumista (columbiumista) tai niobiumseoksista.
- j. Erityisesti suunnitellut, 1C350 kohdassa määriteltyjen kemikaalien hävittämiseen tarkoitetut polttolaitokset, joissa on erityisesti suunnitellut jätteen syöttöjärjestelmät, erityiset käsittelylaitteet ja keskimääräinen polttokammion lämpötila suurempi kuin  $1\,273 \text{ K}$  ( $1\,000 \text{ }^\circ\text{C}$ ) astetta, joissa kaikki jätteen syöttöjärjestelmän pinnat, jotka tulevat suoraan kosketukseen jätetuotteiden kanssa, on valmistettu tai vuorattu (pinnoitettu) seuraavilla materiaaleilla:
1. Seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 prosenttia kromia;
  2. Keraamit; tai
  3. Nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä.

Tekn. huom.:

'Grafiitihili' on amorfisesta hilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2B351 Myrkyllisten kaasujen valvontajärjestelmät ja niiden erikoisilmaisimet:

- a. Jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita käytetään ilmaisemaan kemiallisia taisteluaineita tai 1C350 kohdassa määriteltyjä kemikaaleja pitoisuuksina, jotka ovat vähemmän kuin  $0,3 \text{ mg}/\text{m}^3$ ; tai
- b. Jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteitä, joilla on koliinisteraasia estävä aktiivisuus.

2B352 Seuraavat biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat laitteet:

- a. Täydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4;

Tekn. huom.:

P3 ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on määritelty WHO:n (World Health Organization) Laboratorion bioturvakäsikirjassa (Laboratory biosafety manual) (toinen painos, Geneve 1993).

- b. Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisia "mikro-organismeja", viruksia tai tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti on vähintään 20 litraa;

Tekn. huom.:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

2B352 (jatkoa)

- c. Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Virtausnopeus ylittää 100 litraa tunnissa;
  2. Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terästä tai titaania;
  3. Niissä on yksi tai useampi tiivistesulku höyrysteriloitavalla alueella; ja
  4. Ne voidaan steriloida höyryllä paikalla ja suljettuna;

Tekn. huom.:

Keskipakoerottimet sisältävät dekanterit.

- d. Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet ja -komponentit seuraavasti:
1. Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet, joilla pystytään erottamaan patogeeniset mikro-organismit, virukset, toksiinit tai soluviljelmät ilman aerosolimuodostusta ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Kokonaissuodatuspinnan koko vähintään 1 m<sup>2</sup>; ja
    - b. Steriloitavissa tai desinfioitavissa paikalla;

Tekn. huom.:

2B352.d.1.b kohdassa tarkoitetaan 'steriloimisella' kaikkien elävien mikrobien poistamista laitteesta käyttämällä joko fysikaalisia (esimerkiksi höyry) tai kemiallisia tekijöitä. 'Desinfiomisella' tarkoitetaan mahdollisen mikrobisen infektiivisyyden tuhoamista laitteesta käyttämällä kemiallisia tekijöitä, joilla on germisidinen vaikutus. Steriloiminen ja desinfiointi ovat eri asioita kuin sanitointi, jolla tarkoitetaan puhdistusmenettelyjä, joiden tarkoituksena on alentaa laitteen mikrobisisältöä poistamatta välttämättä kaikkea mikrobista infektiivisyyttä tai eläviä mikrobeja.

2. Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteiden komponentit (esimerkiksi moduulit, elementit, kasetit, säiliöt, yksiköt tai levyt), joiden suodatuspinta on vähintään 0,2 m<sup>2</sup> kunkin komponentin osalta ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi 2B352.d kohdassa mainituissa risti(tangentiaali) virtaussuodatinlaitteissa;

Huom.: 2B352.d kohta ei aseta valvonnanalaisiksi käänteisosmoosilaitteita sellaisina kuin valmistaja on ne määritellyt.

- e. Höyrysteriloitavat kylmäkuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti ylittää 10 kg jäätä 24 tunnissa ja enintään 1 000 kg jäätä 24 tunnissa;
- f. Seuraavat suoja- ja turvalaitteet:
1. Puoli- ja kokosuojapuvut tai huuvut, jotka ovat riippuvaisia niihin kytketystä ulkoisesta ilmansyötöstä ja jotka toimivat ylipaineella;
 

Huom.: 2B352.f.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pukuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi itsenäisen hengityslaitteen kanssa.
  2. Biologiset suojakaapit tai eristysvarusteet, jotka täyttävät vastaavat suoritusvaatimukset;
 

Huom.: 2B352.f.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat isolaattorit, kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja laminaarivirtaushuuvut (suljettu pystyvirtauksella).
- g. Kammiot, jotka on suunniteltu "mikro-organismeilla", viruksilla tai "toksiineilla" tehtäviä aerosolialtistuskokeita varten ja joiden kammioilavuus on 1 m<sup>3</sup> tai suurempi.

**2C**      **Materiaalit**

Ei ole.

**2D Ohjelmistot**

2D001 Muut kuin 2D002 kohdassa määritetyt "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2A001 tai 2B001–2B009 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

2D002 Elektronisten laitteiden "ohjelmistot", myös pysyvästi elektroniseen laitteeseen tai järjestelmään sijoitetut, jotka mahdollistavat näiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan "numeerisena ohjaus"yksikkönä ja pystyvät koordinoimaan samanaikaisesti useampaa kuin neljää akselia "ääriviivaohjauksessa".

*Huom. 1:* 2D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu työstökoneille, joita ei ole määritelty ryhmässä 2.

*Huom. 2:* 2D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 2B002 kohdassa mainituille tuotteille tarkoitettuja "ohjelmistoja". Katso 2D001 kohta 2B002 kohdassa mainituille tuotteille tarkoitettujen "ohjelmistojen" valvonnan osalta.

2D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 tai 2B119–2B122 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

**Huom.: KATSO MYÖS 9D004 KOHTA.**

2D201 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 tai 2B227 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

2D202 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 2B201 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

**2E Teknologia**

- 2E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A, 2B tai 2D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
- 2E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A tai 2B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
- 2E003 Seuraavat muut "teknologiat":
- a. "Teknologia" "numeerisen ohjaus" yksikön integroituna osana olevan työstöohjelmien laatimiseksi tai muuntamiseksi tarvittavan interaktiivisen grafiikan kehittämistä varten;
  - b. Seuraavat "teknologiat" metalliteollisuuden valmistusprosesseja varten:
    1. Seuraavia prosesseja varten erityisesti suunniteltujen työkalujen, muottien tai kiinnittimien suunnittelu"teknologia":
      - a. "Superplastinen muovaus";
      - b. "Diffuusioliittäminen"; tai
      - c. "Suoravaikutteinen hydraulipuristus";
    2. Tekninen tieto, joka koostuu alla luetelluista prosessimenetelmistä tai niiden parametreista ja jolla ohjataan:
      - a. Alumiiniseosten, titaaniseosten tai "superseosten" "superplastisen muovauksen":
        1. Pinnan valmistelua;
        2. Jännityksen tasoa;
        3. Lämpötilaa;
        4. Painetta;
      - b. "Superseosten" tai titaaniseosten "diffuusioliittämisen":
        1. Pinnan valmistelua;
        2. Lämpötilaa;
        3. Painetta;
      - c. Alumiiniseosten tai titaaniseosten "suoravaikutteista hydraulipuristuksen":
        1. Painetta;
        2. Jakson aikaa;
      - d. Titaaniseosten, alumiiniseosten tai "superseosten" "kuumaisostaattisen puristuksen":
        1. Lämpötilaa;
        2. Painetta;
        3. Jakson aikaa;
  - c. "Teknologia" ilma-alusten runkorakenteiden valmistukseen tarkoitettujen hydraulisten venytysmuovauskoneiden ja niiden muottien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
  - d. "Teknologia" "numeerisessa ohjaus"yksikössä olevasta suunnittelutiedosta tuotettavien työstökonekäskyjen (esim. työstöohjelmien) ohjelmakehittimien "kehittämistä" varten;
  - e. "Teknologia" valmistusosaston toimintojen kehittyneen päätöksenteon tukemiseksi "numeerisiin ohjaus" yksiköihin asiantuntijajärjestelmiä sisällyttävien integrointi"ohjelmistojen" "kehittämistä" varten;

- 2E003 (jatkoa)
- f. "Teknologia", jolla epäorgaanisilla päällystyspinnoitteilla tai epäorgaanisilla pinnanmuunnospinnoitteilla (määritelty seuraavan taulukon 3 sarakkeessa) pinnoitetaan johtamattomia substraatteja (määritelty seuraavan taulukon 2 sarakkeessa) seuraavan taulukon 1 sarakkeessa määritellyillä ja teknisessä huomautuksessa kuvatuilla prosesseilla.
- Huom.:* Taulukko ja tekniset huomautukset on esitetty 2E301 kohdan jälkeen.
- 2E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 tai 2D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" käyttöä varten.
- 2E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B232, 2D201 tai 2D202 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" käyttöä varten.
- 2E301 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B3502–2B352 kohdassa määriteltyjen tuotteiden käyttöä varten.

## Taulukko

## Pinnoitustekniikat

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
A. Kemiallinen kaasu-faasipinnoitus (CVD)	"superseokset"	aluminidit sisäisiin kanaviin
	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	silisidit karbidit dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli-"matriisi"komposiitit"	silisidit karbidit tulenkestävät metallit niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) aluminidit seostetut aluminidit (2) boorinitridi
	Volframikarbidi-kovametalli (16), piikarbidi (18)	karbidit volframi niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantti timantin kaltainen hiili (17)

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
B. Terminen höyrystys-fysikaalinen höyrypinnoitus (TE-PVD)		
B.1. PVD tai EB-PVD	"superseokset"	seostetut silisidit
		seostetut aluminidit (2)
		MCrAlX (5)
		muunnettu zirkoniumoksidi (12)
		silisidit
		aluminidit
		niiden sekoitukset (4)
	keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)	dielektriset kerrokset (15)
	korroosionkestävä teräs (7)	MCrAlX (5)
		muunnettu zirkoniumoksidi (12)
		niiden sekoitukset (4)
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli-"matriisikomposiitit"	silisidit
		karbidit
		tulenkestävät metallit
		niiden sekoitukset (4)
		dielektriset kerrokset (15)
		boorinitridi
	volframikarbidi-kovametalli (16) piikarbidi (18)	karbidit
		volframi
		niiden sekoitukset (4)
		dielektriset kerrokset (15)
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	dielektriset kerrokset (15)
		boridit
		beryllium
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15)
	titaaniseokset (13)	boridit
		nitridit

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
B.2. Ioniavusteinen resistiivinen kuumennus PVD (ioni pinnoitus)	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)  hiili-hiili-, keraamiset ja metalli- "matriisi"komposiitit"  volframikarbidi-kovametalli (16), piikarbidi  molybdeeni ja molybdeeniseokset  beryllium ja berylliumseokset  anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
B.3. "Laser"-PVD	Keraamiset aineet (19) ja vähän laajenevat lasit (14)  hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "mat- riisi"komposiitit"  volframikarbidi-kovametalli (16), piikarbidit  molybdeeni ja molybdeeniseokset  beryllium ja berylliumseokset  anturi-ikkunamateriaalit (9)	silisidit dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15)  dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili
B.4. Katodikaari-Purkaus PVD	"superseokset"  polymeerit (11) ja "komposiitit", joilla on orgaaninen "matriisi"	seostetut silisidit seostetut aluminidit (2) MCrAlX (5)  boridit karbidit nitridit timantin kaltainen hiili (17)
C. Hiilletyslaatikko-karkaisu (katso edellä kohta A. muun kuin laatikko-karkaisun osalta) (10)	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "mat- riisi"komposiitit"  titaaniseokset (13)  tulenkestävät metallit ja niiden seokset (8)	silisidit karbidit niiden sekoitukset (4)  silisidit aluminidit seostetut aluminidit (2)  silisidit oksidit

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
D. Plasmaruiskutus	<p>"superseokset"</p> <p>alumiiniseokset (6)</p> <p>tulenkestävät metallit ja seokset (8)</p> <p>korroosionkestävät teräkset (7)</p> <p>titaaniseokset (13)</p>	<p>MCrAlX (5)</p> <p>muunnettu zirkoniumoksidi (12)</p> <p>niiden sekoitukset (4)</p> <p>muovattava nikkeligrafiitti</p> <p>muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet</p> <p>muovattavat Al-Si-polyesteri seostetut aluminidit (2)</p> <p>MCrAlX (5)</p> <p>muunnettu zirkoniumoksidi (12)</p> <p>silisidit</p> <p>niiden sekoitukset (4)</p> <p>aluminidit</p> <p>silisidit</p> <p>karbidit</p> <p>MCrAlX (5)</p> <p>muunnettu zirkoniumoksidi (12)</p> <p>niiden sekoitukset (4)</p> <p>karbidit</p> <p>aluminidit</p> <p>silisidit</p> <p>seostetut aluminidit (2)</p> <p>muovattava nikkeligrafiitti</p> <p>muovattavat Ni-Cr-Al-pitoiset aineet</p> <p>muovattava Al-Si-polyesteri</p>
E. Lietepinnoitus	<p>tulenkestävät metallit ja seokset (8)</p> <p>hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisi"-komposiitit"</p>	<p>fuusatut silisidit</p> <p>fuusatut aluminidit paitsi lämmitysvastus-elementit</p> <p>silisidit</p> <p>karbidit</p> <p>niiden sekoitukset (4)</p>

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
F. Sputterointi	"superseokset"	seostetut silisidit seostetut aluminidit (2) jalometallimuunnetut aluminidit (3) MCrAlX (5) muunnettu zirkoniumoksidi (12) platina niiden sekoitukset (4)
	keraamiset aineet ja vähän laajenevat lasit (14)	silisidit platina niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
	titaaniseokset (13)	boridit nitridit oksidit silisidit aluminidit seostetut aluminidit (2) karbidit
	hiili-hiili-, keraami- ja metalli- "matriisi"komposiitit"	silisidit karbidit tulenkestävät metallit niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) boorinitridi
	volframikarbidi-kovametalli (16) piikarbidi (18)	karbidit volframi niiden sekoitukset (4) dielektriset kerrokset (15) boorinitridi
	molybdeeni ja molybdeeniseokset	dielektriset kerrokset (15)
	beryllium ja berylliumseokset	boridit dielektriset kerrokset (15) beryllium
	anturi-ikkunamateriaalit (9)	dielektriset kerrokset (15) timantin kaltainen hiili (17)
	tulenkestävät metallit ja seokset (8)	aluminidit silisidit oksidit karbidit

1. Pinnoitusprosessi (1) (*)	2. Substraatti	3. Pinnoitetulos
G. Ioni-istutus	korkean lämpötilan laakeriteräkset	Kromi-, tantaali- tai niobium- (Columbium)lisäaineet
	titaaniseokset (13)	boridit nitridit
	beryllium ja berylliumseokset	boridit
	volframikarbidi-kovametalli (16)	karbidit nitridit

(\*) Suluissa olevat numerot viittaavat tämän taulukon jäljessä oleviin huomautuksiin.

### Pinnoitustekniikkoja kuvaavaan taulukkoon liittyvät huomautukset

- Termi 'pinnoitusprosessi' sisältää, paitsi alkuperäisen pinnoituksen, myös sen korjauksen tai uusimisen.
- Termi 'seostettu aluminidipinnoitus' sisältää yksi- ja monivaiheiset pinnoitukset, joissa substraatti pinnoitetaan ensin tai samanaikaisesti aluminidipinnoituksen kanssa muulla alkuaineella tai -aineilla silloinkin, kun näillä alkuaineilla pinnoitetaan jotain muuta prosessia käyttäen. Se ei kuitenkaan sisällä yksivaiheista hiiletyslaattikkokarkaisuprosessia, jota käytetään useampaan kertaan seostetun aluminidin aikaansaamiseksi substraatin pinnalle.
- Termi 'jalometallimuunnettu aluminidipinnoitus' sisältää monivaiheiset pinnoitukset, joissa jalometallia tai jalometalleja aikaansaadaan substraatin pinnalle jollakin muulla prosessilla ennen aluminidipinnoitusta.
- Termi 'niiden sekoitukset' sisältää suodatettuja aineita, lajiteltuja seoksia sekä lisä- ja monikerrospinnoitteita ja niitä aikaansaadaan yhden tai useamman taulukossa mainitun prosessin avulla.
- 'McrAlX' tarkoittaa metalliseospinnoitetta, jossa M vastaa kobolttia, rautaa, nikkeliä tai niiden yhdistelmiä ja X vastaa hafniumia, yttriumia, piitä, tantaalia missä tahansa määrässä tai muuta tarkoituksellista lisäainetta yli 0,01 painoprosenttia erilaisissa suhteissa ja yhdistelmissä, paitsi:
  - CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 22 painoprosenttia kromia, vähemmän kuin 7 painoprosenttia alumiinia ja vähemmän kuin 2 painoprosenttia yttriumia;
  - CoCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät 22–24 painoprosenttia kromia, 10–12 painoprosenttia alumiinia ja 0,5–0,7 painoprosenttia yttriumia;
  - NiCrAlY-pinnoitteet, jotka sisältävät 21–23 painoprosenttia kromia, 10–12 painoprosenttia alumiinia ja 0,9–1,1 painoprosenttia yttriumia.
- Termi 'alumiiniseos' tarkoittaa metalliseoksia, joiden murtovetolujuus on 190 MPa tai enemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.
- Termi 'korroosionkestävä teräs' tarkoittaa AISI (American Iron and Steel Institute) 300 -sarjaa tai vastaavia kansallisia standarditeräksiä.
- 'Tulenkestävät metallit ja seokset' sisältävät seuraavia metalleja ja niiden seoksia: niobium (Columbium), molybdeeni, volframi ja tantaali.
- 'Anturi-ikkunamateriaaleja' ovat seuraavat: alumiinioksidi, pii, germanium, sinkkisulfidi, sinkkiseneniidi, galliumarseniidi, timantti, galliumfosfidi, safiiri ja seuraavat metallihalidit: zirkoniumfluoridista ja hafniumfluoridista koostuvat anturi-ikkunamateriaalit, joiden läpimitta ylittää 40 mm.
- Kiinteiden turbiininsiipilevyjen yksivaiheinen hiiletyslaattikkokarkaisu "teknologia" ei ole valvonnanalaista 2 ryhmässä.
- Seuraavat 'polymeerit': polyimidi, polyesteri, polysulfidi, polykarbonaatit ja polyuretaanit.

12. 'Muunnettu zirkoniumoksidi' tarkoittaa, että siinä on muiden metallien oksideja lisäaineena, kuten kalsiumoksidi, magnesiumoksidi, yttriumoksidi, hafniumoksidi ja harvinaisten maametallien oksidit jne. zirkoniin asti, joita käytetään stabiloimaan tiettyjä kiteisiä faaseja ja faasikombinaatioita. Lämpöeristyspinnoitukset, jotka on valmistettu zirkoniumoksidista, joka on muunnettu kalsiumoksidia tai magnesiumoksidia sekoittamalla tai fuusamalla, eivät ole valvonnallaisia.
13. 'Titaaniseokset' tarkoittaa vain ilmailu- tai avaruuskäyttöön tarkoitettuja seoksia, joiden murtovetolujuus on 900 MPa tai enemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.
14. 'Vähän laajenevat lasit' tarkoittaa laseja, joiden lämpölaajenemiskerroin on  $1 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$  tai vähemmän mitattuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa.
15. 'Dielektriset kerrokset' ovat pinnoitteita, jotka rakentuvat eristysmateriaalien useista kerroksista, joissa eri taitekertoimen omaavien materiaalien interferenssiominaisuuksia halutulla tavalla käytetään heijastamaan, lähettämään tai absorboimaan eri aallonpituuskaistoja. Dielektriset kerrokset tarkoittavat enemmän kuin neljää dielektristä kerrosta tai dielektristä/metalli"komposiitti" kerrosta.
16. 'Volfraamkarbidikovametalli' ei sisällä lastuamis- ja muovaustyökalumateriaaleja, joilla on seuraava koostumus: volframkarbidi/(koboltti, nikkeli), titaanikarbidi/(koboltti, nikkeli), kromikarbidi/nikkeli-kromi tai kromikarbidi/nikkeli.
17. "Teknologiaa", joka on erityisesti tarkoitettu pinnoittamaan timantin kaltaisella hiilellä seuraavia, ei valvota:

magneettiset levyasemat ja magneettipäät, kertakäyttötuotteiden valmistukseen käytettävät laitteet, hanaventiilit, kaiuttimien akustiset kalvot, moottorien osat autoihin, terätyökälyt, terätyökälyt, lävistyspuristinmatriisit, toimistoautomaatiolaitteet, mikrofonit tai lääkinälliset laitteet tai muovien valamiseen tai muovaamiseen tarkoitettut muotit, jotka on valmistettu alle 5 prosenttia berylliumia sisältävistä seoksista.

18. 'Piikarbidi' ei sisällä terätyökälyihin tai muototeriin käytettäviä aineita.
19. Tässä tarkoitettu 'keraamiset substraatit' eivät sisällä keraamisia aineita, joissa on vähintään 5 painoprosenttia savea tai sementtiä erillisinä ainesosina tai yhdisteinä.

Taulukon 1 sarakkeessa mainitut prosessit määritellään seuraavasti:

- a. Kemiallinen kaasufaasipinnoitus (CVD) on pinnoitus- tai pinnan muunnosprosessi, jossa metallia, metalliseosta, "komposiittia", dielektristä ainetta tai keraamia depositoidaan kuumennetulle substraatille. Kaasumaiset reagoivat aineet hajoavat tai yhdistyvät substraatin välittömässä läheisyydessä, jonka seurauksena haluttu alkuaine, metalliseos tai yhdiste asettuu substraatille. Hajoamisen tai kemiallisen reaktioprosessin tarvitsema energia saadaan substraatin lämmöstä, hohtopurkaus plasmasta tai "laser"-säteilytyksestä.

Huom. 1: CVD sisältää seuraavat prosessit: suunnatun kaasuvirtauksen ei-pakkauspinnoitus, sykkivä CVD, säädettävä ydintymislämpöhoajoaminen (CNTD), plasma- tai plasma-avusteinen CVD.

Huom. 2: Pakkaus tarkoittaa jauheseokseen upotettua substraattia.

Huom. 3: Kaasumaiset, reagoivat aineet, joita käytetään ei-pakkausprosessissa tuotetaan käyttämällä samoja perusreaktioita ja parametreja, kuin pakkauspinnoitusprosessissakin, paitsi että siinä pinnoitettava substraatti ei ole kosketuksissa jauheseokseen.

- b. Terminen höyrystys-fysikaalinen höyrypinnoitus (TE-PVD = Thermal Evaporation-Physical Vapour Deposition) on pinnoitusprosessi, joka suoritetaan tyhjiössä paineen ollessa alle 0,1 Pa, jossa termistä energiaa käytetään höyrystämään pinnoitusmateriaalia. Tässä prosessissa höyrystyneet ainesosat kondensoituvat tai depositoituvat sopivasti asetetun substraatin pinnalle.

Kaasujen lisääminen tyhjäkammioon pinnoitusprosessin aikana on tavallinen prosessin muunnos.

Ioni- tai elektronisäteen tai plasman käyttö aktivoimaan tai avustamaan pinnoitusprosessia on myös tavallinen tämän tekniikan muunnos. Monitorien käyttö mahdollistamaan prosessin aikana optisten ominaisuuksien tai pinnoitteen pakkuuden mittauksen voi olla näiden prosessien lisäpiirre.

Eri TE-PVD prosessit ovat seuraavat:

1. Elektronisuihku-PVD-prosessissa käytetään elektronisuihkuja kuumentamaan ja höyrystämään pinnoitteen muodostavaa materiaalia.
2. Ioniavusteinen resistiivinen-kuumennus-PVD-prosessissa käytetään resistiivisiä kuumennuslähteitä yhdessä iskeytyvän(-vien) ionisäte(id)en kanssa tuottamaan kontrolloidun ja yhtenäisen höyrystyneiden pinnoiteaineksien vuon.
3. "Laser"-höyrystys-(PVD) käyttää joko pulssi- tai jatkuvan aallon "laser"-säteitä höyrystämään pinnoituksen muodostavia materiaaleja;
4. Katodikaaripinnoitus-(PVD) käyttää kuluva katodia, joka on pinnoitteen muodostavaa materiaalia sekä kaaripurkausta, joka aikaansaadaan koskettamalla hetkellisesti sen pintaa maaliipaisimella. Ohjaamalla kaarta erotetaan katodin pinnasta ionisoitua plasmaa. Anodina voi olla joko kartio, joka on kiinnitetty katodin läheisyyteen, eristeen tai kammion läpi. Substraatin (jännite)biassoimintaa käytetään näkymättömissä tapahtuvaan pinnoitukseen.

*Huom.:* Tämä määritelmä ei koske satunnaista katodikaaripinnoitusta biassoimattomia substraatteja käytettäessä.

5. Ioni-pinnoitus (-PVD) on TE-PVD-prosessin muunnos, jossa plasma- tai ionilähdettä käytetään ionisoimaan pinnoitettavia aineksia ja negatiivinen biasjännite johdetaan substraattiin pinnoitusaineksien erottamiseksi plasmasta. Reagoivien aineksien käyttäminen, kiinteiden aineiden höyrystäminen prosessikammiossa ja monitorien käyttö mahdollistamaan prosessin aikaisen, pinnoitteen optisten ominaisuuksien ja paksuuden mittaamiseksi ovat tavalisia prosessin muunnoksia.
- c. Pakkasementointi on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa substraatti upotetaan jauheseokseen (pakkaan), joka koostuu:
1. Depositioitavista metallijauheista (tavallisesti alumiinia, kromia, piitä tai niiden yhdistelmiä);
  2. Aktivaattorista (tavallisesti halidisuola); ja
  3. Reagoimattomasta aineesta, useimmiten alumiinioksidista.

Substraatti ja jauheseos asetetaan retorttiin, joka kuumennetaan 757 °C (1 030 K)–1 102 °C (1 375 K) asteeseen riittävaksi ajaksi pinnoitteen aikaansaamiseksi.

- d. Plasmaruiskutus on pinnoitusprosessi, jossa plasmaa tuottavaan ja ohjaavaan sumuttimeen syötetään pinnoitemateriaalia jauheena tai lankana, ne sulatetaan ja kiihdytetään substraattia kohden. Plasmaruiskutus on joko matalapaineessa tai suurinopeuksista plasmaruiskutusta.

*Huom. 1:* Matalapaineella tarkoitetaan alle ilmakehän painetta.

*Huom. 2:* Suurinopeuksisella tarkoitetaan kaasun lähtönopeutta suuttimesta, kun se ylittää 750 m/s laskettuna 20 °C (293 K) asteen lämpötilassa ja 0,1 MPa paineessa.

- e. Lietepinnoitus on pinnan muunnos- tai pinnoitusprosessi, jossa orgaanisen aineen sitomaa metalli- tai keraamijauhetta riippuu nesteessä ja sumuttamalla, kastamalla tai maalaamalla se aikaansaadaan substraatille, jota seuraa ilmassa tai uunissa tapahtuva kuivaus sekä lämpökäsittely halutun pinnoitteen aikaansaamiseksi.
- f. Sputterointi on pinnoitusprosessi, joka perustuu "liikemäärän siirto" -ilmiöön, jossa positiiviset ionit kiihdytetään sähkökentässä kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on riittävä irrottamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan sopivasti asetettua substraattia.

*Huom. 1:* Taulukko viittaa vain triodi-, magnetroni- tai reaktiiviseen sputterointiin, jota käytetään lisäämään pinnoitteen kiinnittymistä ja depositionsnopeutta ja radiotaajuudella voimistettuun sputterointiin, jota käytetään mahdollistamaan ei-metallisten pinnoitemateriaalien höyrystämisen.

*Huom. 2:* Matalaenergisiä (alle 5 keV) ionisäteitä voidaan käyttää aktivoimaan depositiota.

- g. Ioni-istutus on pinnan muunnospinnoitusprosessi, jossa seostettava elementti ionisoidaan, kiihdytetään potentiaaligradientin läpi ja istutetaan substraatin pinnan tietylle alueelle. Tämä sisältää prosessit, joissa ioni-istutus suoritetaan samanaikaisesti elektronisuihku-PVD:llä tai sputteroinnilla.

**RYHMÄ 3**  
**ELEKTRONIIKKA**



### 3A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

Huom. 1: Sellaisten 3A001 tai 3A002 kohdassa kuvattujen laitteiden, kokoonpanojen ja komponenttien, 3A001.a.3–3A001.a.10 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvattuja lukuun ottamatta, jotka on erityisesti suunniteltu, tai joilla on samat toiminnalliset ominaisuudet kuin jollain muulla laitteella, valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden mukaan.

Huom. 2: 3A001.a.3–3A001.a.9 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvattujen integroitujen piirien, jotka on ohjelmoitu ei-muutettavasti, tai jotka on suunniteltu erityistä toimintoa varten, valvonnanalaisuus määräytyy niiden muiden laitteiden mukaan, joita varten ne on tarkoitettu.

Huom.: Milloin valmistaja tai vientiluvan hakija ei pysty määrittelemään näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuutta, valvonnanalaisuus määräytyy 3A001.a.3–3A001.a.9 tai 3A001.a.12 kohdan mukaan.

Jos integroitu piiri on piipohjainen 3A001.a.3 kohdassa kuvattu "mikrotietokonepiiri" tai mikro-ohjainpiiri, jonka operandin (tiedon) sanan pituus on 8 bittiä tai vähemmän, integroidun piirin valvonnanalaisuus määräytyy 3A001.a.3 kohdan mukaan.

#### 3A001 Elektroniset komponentit seuraavasti:

##### a. Seuraavat yleiskäyttöiset integroidut piirit:

Huom. 1: (Valmiiden tai puolivalmiiden) piikiekkojen, joissa toiminto on määritelty, valvonnanalaisuus arvioidaan 3A001.a kohdan parametrien mukaan.

Huom. 2: Integroidut piirit sisältävät seuraavat tyypit:

"Monoliittiset integroidut piirit";

"Integroidut hybridipiirit";

"Integroidut monipalapiirit";

"Integroidut kalvopiirit", integroidut pii-safiripiirit mukaan lukien;

"Optiset integroidut piirit".

##### 1. Integroidut piirit, jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestävästi jokin seuraavista:

- Säteilyä kokonaisannoksena  $5 \times 10^3$  Gy (Pii) tai enemmän;
- Säteilyä, jonka annosnopeus  $5 \times 10^6$  Gy (Pii)/s tai enemmän; tai
- Neutronien integroitua vuontiheyttä (1 MeV:n vastaavuus), joka on  $5 \times 10^{13}$  n/cm<sup>2</sup> tai enemmän piin osalta tai sitä vastaavan aineen osalta muiden materiaalien ollessa kyseessä.

Huom.: 3A001.a.1.c kohtaa ei sovelleta metallieristepuolijohteisiin (MIS).

##### 2. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit", mikro-ohjainpiirit, integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteesta, analogia-digitaalimuuntimet, digitaali-analogiamuuntimet, sähköoptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkäsittelyä" varten, käyttäjän ohjelmoitavat logiikkapiirit, integroidut hermoverkkopiirit, sellaiset asiakasohjelmoitavat integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on tuntematon, nopea Fourier-muunnos (FFT)-prosessorit, elektronisesti pyyhittävät ohjelmoitavat lukumuistit (EEPROM-Sit), pikamuistipiirit taikka staattiset luku-/kirjoitusmuistit (SRAMit), jotka on joko

- suunniteltu toimimaan yli 398 K (125 °C) lämpötiloissa;
- suunniteltu toimimaan alle 218 K (– 55 °C) lämpötiloissa; tai
- mitoitettu toimimaan koko lämpötila-alueella 218 K (– 55 °C) – 398 K (125 °C);

Huom.: 3A001.a.2 kohta ei koske siviiliautoihin tai juniin tarkoitettuja integroituja piirejä.

3A001 a. (jatkoa)

3. "Mikroprosessoripiirit", "mikrotietokonepiirit" ja mikro-ohjainpiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteesta ja toimivat kellotaajuudella, joka ylittää 40 MHz;

*Huom.:* 3A001.a.3 kohta sisältää digitaaliset signaaliprosessorit, digitaaliset matriisiprosessorit ja digitaaliset apuprosessorit.

4. Integroidut muistipiirit, jotka on valmistettu yhdistepuolijohteista;
5. Seuraavat integroidut analogia-digitaalimuunnin- tai digitaali-analogiamuunninpiirit:

- a. Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

**Huom.: KATSO MYÖS 3A101 KOHTA.**

1. Resoluutio 8 bittiä tai enemmän mutta alle 10 bittiä ja ulostulonopeus suurempi kuin 500 miljoonaa sanaa sekunnissa;
  2. Resoluutio 10 bittiä tai enemmän mutta alle 12 bittiä ja ulostulonopeus suurempi kuin 200 miljoonaa sanaa sekunnissa;
  3. Resoluutio 12 bittiä ja ulostulonopeus suurempi kuin 105 miljoonaa sanaa sekunnissa;
  4. Resoluutio yli 12 bittiä mutta enintään 14 bittiä ja ulostulonopeus suurempi kuin 10 miljoonaa sanaa sekunnissa; tai
  5. Resoluutio yli 14 bittiä ja ulostulonopeus suurempi kuin 2,5 miljoonaa sanaa sekunnissa;
- b. Digitaali-analogiamuuntimet, joiden resoluutio on 12 bittiä tai enemmän ja "asettumisaika" alle 10 ns;

*Tekn. huom.:*

1.  $N:n$  bitin resoluutio vastaa  $2^n:n$  vertailutason kvantisointia.
  2. Ulostulevan sanan bittien lukumäärä on yhtä suuri kuin analogia-digitaalimuuntimen resoluutio.
  3. Ulostulonopeus on muuntimen maksimiulostulonopeus arkkitehtuurista tai ylinäytteistyksestä riippumatta. Myyjä voi kutsua ulostulonopeutta myös näytteenottonopeudeksi, muunnosnopeudeksi tai suoritusnopeudeksi. Se ilmaistaan usein suureilla megahertsi (MHz) tai miljoona näytettä sekunnissa (MSPS).
  4. Ulostulonopeuden mittaamisessa yksi ulostuleva sana sekunnissa vastaa yhtä hertsiä tai yhtä näytettä sekunnissa.
6. Sähköoptiset tai "optiset integroidut piirit" "signaalinkäsittelyä" varten, joilla on kaikki seuraavat:
- a. Yksi tai useampi sisäinen "laser"diodi;
  - b. Yksi tai useampi sisäinen valoa ilmaiseva elementti; ja
  - c. Optisia aaltoputkia;
7. Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joilla on jokin seuraavista:
- a. Ekvivalenttinen käytettävissä oleva porttiluku yli 30 000 (2 sisäänmenoa porttia kohti);
  - b. Tyypillinen perusportin etenemisviive vähemmän kuin 0,1 ns; tai
  - c. Tilanvaihtotaajuus ylittää 133 MHz;

3A001 a. 7. (jatkoa)

Huom.: 3A001.a.7 kohtaan sisältyvät:

- Yksinkertaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (SPLD:t)
- Monimutkaiset ohjelmoitavat logiikkapiirit (CPLD:t)
- Kentällä ohjelmoitavat porttimatriisipiirit (FPGA:t)
- Käyttäjäohjelmoitavat logiikkaverkot (FPLA:t)
- Kentällä ohjelmoitavat yhdyskomponentit (FPIC:t)

Huom.: 'Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit' tunnetaan myös nimellä 'kentällä ohjelmoitavat porttimatriisipiirit' tai 'käyttäjäohjelmoitavat logiikkaverkot'.

8. Ei käytössä;
9. Integroidut hermoverkkopiirit;
10. Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon, tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla on jokin seuraavista:
  - a. Liitospisteiden lukumäärä ylittää 1 000;
  - b. Tyypillinen "perusportin etenemisviive" on vähemmän kuin 0,1 ns; tai
  - c. Toimintataajuus ylittää 3 GHz;
11. Muut digitaaliset integroidut piirit kuin 3A001.a.3–3A001.a.10 tai 3A001.a.12 kohdassa kuvatut, jotka perustuvat yhdistepuolijohteisiin ja joilla on jokin seuraavista:
  - a. Ekvivalenttinen porttiluku on enemmän kuin 3 000 (2 sisäänmenoa porttia kohti); tai
  - b. Kellotaajuus ylittää 1,2 GHz;
12. Nopea-Fourier-muunnos-prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritus aika N:n pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on vähemmän kuin  $(N \log_2 N)/20$  480 ms, jossa N on pisteiden lukumäärä;

Tekn. huom.:

Kun N on yhtä kuin 1 024 pistettä, 3A001.a.12 kohdan kaavan mukainen suoritus aika on 500  $\mu$ s.

b. Mikroaalto- tai millimetriaaltolaitteet:

1. Seuraavat elektroniset tyhjöpaketit ja katodit:

Huom. 1: 3A001.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi putkia, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, joka täyttää kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Joka ei ylitä 31,8 GHz; ja
- b. Jonka "ITU on allokoimut" radioviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.

Huom. 2: 3A001.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi muita kuin "avaruuskelpoisia" putkia, jotka täyttävät kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Keskimääräinen lähtöteho on 50 W tai vähemmän; ja
- b. suunnitellut tai mitoitettut toimimaan taajuuskaistalla, joka täyttää kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Joka ylittää 31,8 GHz mutta ei ylitä 43,5 GHz; ja
  2. Jonka "ITU on allokoimut" radioviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.

- 3A001 b. 1. (jatkoa)
- a. Seuraavat kulkuaaltoputket pulssi- tai jatkuville aalloille:
    1. Jotka toimivat yli 31,8 GHz:n taajuuksilla;
    2. Joiden hehkukatodien käynnistysaika nimelliseen RF-tehoon asti on vähemmän kuin 3 sekuntia;
    3. Kytkeytetyt onteloputket tai niiden muunnokset, joiden "suhteellinen kaistanleveys" on enemmän kuin 7 % tai huipputeho ylittää 2,5 kW;
    4. Kierukkaputket tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
      - a. "Hetkellinen kaistanleveys" on enemmän kuin puoli oktaavia tai enemmän ja nimellisen keskimääräisen lähtötehon (kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden (gigahertseinä) tulo on enemmän kuin 0,5;
      - b. "Hetkellinen kaistanleveys" on yksi oktaavia tai alle ja nimellisen keskimääräisen lähtötehon (kilowatteina) ja maksimitoimintataajuuden (gigahertseinä) tulo on enemmän kuin 1; tai
      - c. Ovat "avaruuskelpoisia";
  - b. Ristikenttävahvistinputket, joiden vahvistus on enemmän kuin 17 dB,
  - c. Elektroniputkien kyllästetyt katodit, jotka tuottavat nimellisissä olosuhteissa jatkuvan emisiovirran tiheyden, joka ylittää 5 A/cm<sup>2</sup>;
2. Monoliittisina integroituna mikroaaltopiireinä (MMIC) toteutetut tehovahvistimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 4 W (36 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 15 prosenttia;
  - b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 16 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
  - c. Ne toimivat yli 16 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,8 W (29 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
  - d. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla;
  - e. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,25 W (24 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia, tai
  - f. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla.
- Huom. 1: 3A001.b.2 kohta ei aseteta valvonnalaiseksi yleisradiolähetysiin tarkoitettujen satelliittien laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan 40,5–42,5 GHz:n taajuusalueella.
- Huom. 2: Niiden MMIC-piirien valvonta-asema, joiden nimelliseen toimintataajuuteen sisältyvät taajuudet, jotka on lueteltu useammalla kuin yhdellä taajuusalueella, sellaisina kuin ne on määritelty 3A001.b.2.a–3A001.b.2.f kohdassa, määrittyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.
- Huom. 3: Ryhmän 3 johdannossa olevat huomautukset 1 ja 2 tarkoittavat sitä, että 3A001.b.2 kohta ei aseteta valvonnalaiseksi MMIC-piirejä, jos ne on erityisesti suunniteltu muita sovelluksia, esimerkiksi televiestintää, tutkia tai autoja, varten.
3. Erillismikroaalto-transistorit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 60 W (47,8 dBm);
  - b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 20 W (43 dBm);

3A001 b. 3. (jatkoa)

- c. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 0,5 W (27 dBm);
- d. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla ja niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm), tai;
- e. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla.

Huom.: Niiden transistorien valvonta-asema, joiden nimelliseen toimintataajuuteen sisältyvät taajuudet, jotka on lueteltu useammalla kuin yhdellä taajuusalueella, sellaisina kuin ne on määritelty 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e kohdassa, määräytyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.

- 4. Puolijohde-mikroaaltovahvistimet ja mikroaaltovahvistimia sisältävät mikroaaltokokoonpanot/moduulit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n ja enintään 6 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 60 W (47,8 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 15 prosenttia;
  - b. Ne toimivat yli 6 GHz:n ja enintään 31,8 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 15 W (42 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
  - c. Ne toimivat yli 31,8 GHz:n ja enintään 37,5 GHz:n taajuuksilla;
  - d. Ne toimivat yli 37,5 GHz:n ja enintään 43,5 GHz:n taajuuksilla, niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 1 W (30 dBm) ja niiden "suhteellinen kaistanleveys" on yli 10 prosenttia;
  - e. Ne toimivat yli 43,5 GHz:n taajuuksilla; tai
  - f. Ne toimivat yli 3,2 GHz:n taajuuksilla ja niillä on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
    - 1. Keskimääräinen lähtöteho (watteina), P, suurempi kuin 150 jaettuna toiseen potenssiin korotetulla suurimmalla toimintataajuudella (GHz:einä) [ $P > 150 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2$ ];
    - 2. Suhteellinen kaistanleveys on 5 prosenttia tai suurempi; ja
    - 3. Minkä tahansa kahden kohtisuorassa toisiaan vasten olevan sivun pituus d (cm:einä) on yhtä suuri tai pienempi kuin 15 jaettuna alimmalla toimintataajuudella (GHz:einä) [ $d = 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / f_{\text{GHz}}$ ].

Tekn. huom

Arvoa 3,2 GHz olisi käytettävä alimpänä toimintataajuutena (fGHz) 3A001.b.4.f.3 kohdan kaavassa niiden vahvistimien osalta, joiden nimellinen toiminta-alue ulottuu alaspäin arvoon 3,2 GHz ja sen alle [ $d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / 3,2 \text{ GHz}$ ].

Huom.: MMIC-tehovahvistimet olisi arvioitava 3A001.b.2 kohdan vaatimuksiin nähden.

Huom. 1: 3A001.b.4 kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi yleisradiolähteyksiin tarkoitettujen satelliittien laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan 40,5–42,5 GHz:n taajuusalueella.

Huom. 2: Niiden tuotteiden valvonta-asema, joiden nimelliseen toimintataajuuteen sisältyvät taajuudet, jotka on lueteltu useammalla kuin yhdellä taajuusalueella, sellaisina kuin ne on määritelty 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e kohdassa, määräytyy alimman keskimääräisen lähtötehon valvontakynnyksen mukaan.

- 5. Elektronisesti tai magneettisesti viritettävät kaistanpäästö- tai kaistanestosuotimet, joissa on enemmän kuin 5 viritettävää resonaattoria, jotka voidaan viritää vähemmässä kuin 10 mikrosekunnissa taajuuskaistalle, jonka  $f_{\text{max}}/f_{\text{min}}$  on 1,5:1, ja joiden:
  - a. Päästökaistan leveys on enemmän kuin 0,5 % keskitaajuudesta; tai
  - b. Estokaistan leveys on vähemmän kuin 0,5 % keskitaajuudesta;

- 3A001 b. (jatkoa)
6. Ei käytössä.
  7. Sekoittajat ja muuntimet, jotka on suunniteltu ulottamaan 3A002.c, 3A002.e tai 3A002.f kohdassa määriteltyjen laitteiden taajuusalueen kohdissa mainittujen rajojen ulkopuolelle;
  8. Mikroaaltotehovahvistimet, jotka sisältävät 3A001.b kohdassa määriteltyjä putkia ja joilla on kaikki seuraavat:
    - a. Toimintataajuudet ovat yli 3 GHz;
    - b. Keskimääräinen ulostulon suhde tiheyteen on 80 W/kg; ja
    - c. Tilavuus on vähemmän kuin 400 cm<sup>3</sup>;

*Huom.:* 3A001.b.8 kohta ei aseta valvonnalliseksi laitteita, jotka on suunniteltu tai mitoitettu toimimaan taajuuskaistalla, jonka "ITU on allokoimut" radioviestintäpalveluille, mutta ei radiomääritykselle.
  9. Mikroaaltotehomoduulit (MPM), jotka koostuvat vähintään kulkuaaltoputkesta, monoliittisesta integroidusta mikroaaltopiiristä ja integroidusta elektronisesta teholähteestä ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Kytkeytymisaika nolla-asennosta täyteen toimintavalmiuteen vähemmän kuin 10 sekuntia;
    - b. Tilavuus vähemmän kuin suurin nimellisteho watteina kerrottuna 10 cm<sup>3</sup>/W:llä; ja
    - c. "Hetkellinen kaistanleveys" enemmän kuin 1 oktaavi (f<sub>max.</sub>>2f<sub>min.</sub>) ja mikä tahansa seuraavista:
      1. Enintään 18 GHz:n taajuuksien osalta RF-lähtöteho on enemmän kuin 100 W; tai
      2. Taajuus on enemmän kuin 18 GHz.

*Tekn. huom.:*

    1. 3A001.b.9.b kohdassa tarkoitetun ohjaustilavuuden laskemiseksi annetaan seuraava esimerkki: 20 W:n suurimmalla nimellisteholla tilavuuden tulisi olla  $20 \text{ W} \times 10 \text{ cm}^3/\text{W} = 200 \text{ cm}^3$ .
    2. 3A001.b.9.a kohdassa tarkoitettu kytkeytymisaika viittaa aikaan, joka kuluu täydestä nolla-asennosta täyteen toimintavalmiuteen eli siihen sisältyy MPM:n lämpenemisaika.
  - c. Seuraavat akustiset aaltolaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
    1. Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet (eli "signaalinkäsittely"laitteet, jotka käytävät hyväkseen materiaalien elastisten aaltojen kulkua), joilla on jokin seuraavista:
      - a. Kantoaallon taajuus ylittää 2,5 GHz;
      - b. Kantoaallon taajuus ylittää 1 GHz, mutta ei 2,5 GHz ja jolla on jokin seuraavista:
        1. Taajuuden sivukeilan vaimennus ylittää 55 dB;
        2. Maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteinä ja kaistanleveys megahertseinä) on enemmän kuin 100;
        3. Kaistanleveys suurempi kuin 250 MHz; tai
        4. Dispersiivinen viive on enemmän kuin 10 mikrosekuntia; tai



- 3A001 e. 2. (jatkoa)
- b. Kondensaattorit, joiden toistotiheys on 10 Hz tai enemmän (toistuvatoimiset kondensaattorit) ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Nimellisjännite 5 kV tai enemmän;
  2. Energiatiheys on 50 J/kg tai enemmän;
  3. Kokonaisenergia on 100J tai enemmän; ja
  4. Lataus-purkuikä on 10 000 tai enemmän;
3. "Suprajohtavat" sähkömagneetit tai solenoidit, jotka on erityisesti suunniteltu täysin ladattaviksi tai purettaviksi alle 1 sekunnissa ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

**Huom.: KATSO MYÖS 3A201.b KOHTA.**

Huom.: 3A001.e.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "suprajohtavia" sähkömagneetteja tai solenoideja, jotka on erityisesti suunniteltu magneettiresonanssikuvausta (MRI) varten lääketieteellisiin laitteisiin.

- a. Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia on enemmän kuin 10 kJ ensimmäisen sekunnin aikana;
  - b. Virtakäämien sisäläpimitta on yli 250 mm; ja
  - c. Magneettisen induktion nimellisarvo on enemmän kuin 8 T tai "kokonaisvirrantiheys" käämissä on yli 300 A/mm<sup>2</sup>;
4. Aurinkokennot, CIC-järjestelmät ja aurinkopaneelit, jotka ovat "avaruuskelpoisia" ja joiden keskimääräinen vähimmäistehokkuus on enemmän kuin 20 prosenttia 301 K:n (28 °C:n) toimintalämpötilassa simuloidussa 'AMO'-valaistuksessa, jonka säteilyvoimakkuus on 1,367 wattia neliometriä kohden (W/m<sup>2</sup>).
- Tekn. huom.:
- 'AMO' tai 'ilmamassan arvo 0' (Air Mass Zero) tarkoittaa auringonvalon spektraalista säteilyvoimakkuutta maapallon uloimmassa ilmakehässä, kun maapallon ja auringon välinen etäisyys on yksi astronominen yksikkö (AU).
- f. Pyöriväsyötteiset akselin absoluuttisen asennon kooderit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Resoluutio on parempi kuin 1 osa 265 000:sta (18 bitin resoluutio) koko alueella; tai
  2. Tarkkuus on parempi kuin  $\pm 2,5$  kaarisekuntia;
- g. Solid state -pulsivirtakytkintyristorilaitteet ja 'tyristorimoduulit', joissa käytetään joko sähköisesti, optisesti ja elektronisäteilyllä ohjattuja kytkentämenetelmiä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 30 000 A/ $\mu$ s ja estojännite on suurempi kuin 1 100 V; tai
  2. Suurin kytkentävirran nousunopeus (di/dt) on suurempi kuin 2 000 A/ $\mu$ s ja kaikki seuraavista:
    - a. Suurin estojännite on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 000 V; ja
    - b. Huippuvirta (syöksyvirta) on yhtä suuri tai suurempi kuin 3 000 A.

Huom. 1: 3A001.g kohtaan sisältyvät:

- Ohjatut piitasasuuntaajat (SCR)
- ETT-tyristorit (Electrical Triggering Thyristors) (ETT)
- LTT-tyristorit (Light Triggering Thyristors) (LTT)
- IGCT-tyristorit (Integrated Gate Commutated Thyristors) (IGCT)
- Hilalta sammutettavat tyristorit (Gate Turn-off Thyristors) (GTO)
- MOS-tyristorit (MOS Controlled Thyristors) (MCT)
- Solidtronit

3A001 g. (jatkoa)

Huom. 2: 3A001.g kohta ei aseta valvonnallaiseksi tyristorilaitteita ja 'tyristorimoduuleja', jotka on sisällytetty laitteisiin, jotka on suunniteltu rautateiden siviilisovelluksia tai "siviili-ilma-alusten" sovelluksia varten.

Tekn. huom.:

3A001.g.a kohdassa 'tyristorimoduuliin' sisältyy yksi tai useampi tyristorilaite.

3A002 Yleiskäyttöiset elektroniset laitteet:

a. Seuraavat nauhoituslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut testinauhat:

1. Analogiset instrumentointinauhurit, mukaan lukien ne, jotka mahdollistavat myös digitaalisten signaalien tallentamisen (esim. käyttämällä suuritiheyksisen digitaalisen tallennuksen (HDDR) mahdollistavaa moduulia), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Kaistanleveys ylittää 4 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla;
- b. Kaistanleveys ylittää 2 MHz kullakin elektronisella kanavalla tai nauhan raidalla ja raitojen määrä ylittää 42; tai
- c. Soveltuvan IRIG:n (International Range Instrumentation Group) tai EIA:n (Electronic Industries Association) suosituksen mukaisesti mitattu aika(taso)siirtymävirhe on alle  $\pm 0,1$  mikrosekuntia;

Huom.: Analogisia nauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu siviilivideotarkoituksiin ei katsota instrumentointinauhureiksi.

2. Digitaaliset videonauhurit, joiden digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus ylittää 360 Mbit/s;

Huom.: 3A002.a.2 kohta ei aseta valvonnallaiseksi digitaalisia videonauhureita, jotka on erityisesti suunniteltu televisionauhoituksiin käyttäen sellaista signaalimuotoa, johon saattaa sisältyä ITU:n (International Telecommunication Unit), IEC:n International Technical Commission), SMPTE:n (Society of Motion Picture and Television Engineers), EBU:n (European Broadcasting Unit), ETSI:n (European Telecommunications Standards Institute) tai IEEE:n (Institute of Electrical and Electronic Engineers) standardien tai suositusten mukainen tiivistetty signaalimuoto siviilitelevisioovelluksissa.

3. Viistopyyhkäisytekniikkaa tai kiinteäpää-tekniikkaa käyttävät digitaaliset instrumentointinauhurit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus ylittää 175 Mbit/s; tai
- b. Ovat "avaruuskelpoisia";

Huom.: 3A002.a.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi analogisia nauhureita, jotka on varustettu HDDR-konversioelektronikalla ja jotka on tarkoitettu vain digitaalisen tiedon nauhoittamiseen.

4. Laitteet, joiden digitaalisen liitännän maksimisiirtonopeus ylittää 175 Mbit/s ja jotka on suunniteltu muuntamaan digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina käytettäviksi;

5. Aaltomuodon digitointilaitteet ja transienttitallentimet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- a. Digitointinopeus on 200 miljoonaa näytteenottoa sekunnissa tai enemmän ja resoluutio 10 bittiä tai enemmän; ja
- b. Jatkuva käsittelykyky 2 Gbit/s tai enemmän;

Tekn. huom.:

Laitteille, joissa on rinnakkaisväyläarkkitehtuuri, jatkuva käsittelykyky on suurin sanansiirtonopeus kerrottuna sanan bittien lukumäärällä.

Jatkuva käsittelykyky tarkoittaa suurinta tiedonsiirtonopeutta, jonka laite voi tulostaa massamuistiin tietoa menettämättä samalla kun se ylläpitää näytteenottonopeutta ja analogia-digitaalimuunnosta.

- 3A002 a. (jatkoa)
6. Digitaaliset instrumentointitietonauhoittimet, joissa käytetään magneettilevymuistitekniikkaa ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Digitointinopeus vähintään 100 miljoonaa näytettä sekunnissa ja resoluutio 8 bittia tai enemmän; ja
    - b. Jatkuva suorituskyky, joka on vähintään 1 Gbit/s;
  - b. Elektroniset "taajuussyntesoija"kokoonpanot, joiden "taajuuden vaihto aika" yhdeltä valitulta taajuudelta toiselle on vähemmän kuin 1 ms;

Huom.: Signaalianalysaattoreiden, signaaligeneraattoreiden, verkkoanalysaattoreiden ja mikroaaltotestivastaanotinten valvonnallisuus erillisinä välineinä määräytyy 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e ja 3A002.f kohdan perusteella.

- c. Seuraavat radiotaajuus"signaalianalysaattorit":
1. "Signaalianalysaattorit", jotka kykenevät analysoimaan yli 31,8 GHz:n mutta enintään 37,5 GHz:n taajuuksia, ja joilla on yli 10 MHz:n resoluutiokaistanleveys (RBW) 3 dB:n teholla;
  2. "Signaalianalysaattorit", jotka kykenevät analysoimaan yli 43,5 GHz:n taajuuksia;
  3. "Dynaamiset signaalianalysaattorit", joiden "tosiaikainen kaistanleveys" ylittää 500 kHz;

Huom.: 3A002.c.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi niitä "dynaamisia signaalianalysaattoreita", jotka käyttävät vain "vakiosuhteisia kaistasuotimia" (kutsutaan myös oktaavi- tai osaoктаavisuotimiksi).

- d. Taajuussyntesoiivat signaaligeneraattorit, joiden tuottamien lähtötaajuuksien tarkkuus ja lyhyen tai pitkän aikavälin stabiilius on sisäisen perusvertailuoskillaattorin ohjaama, siitä johdettu tai sen määräämä, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Syntesoiitu maksimitaajuus ylittää 31,8 GHz mutta ei ylitä 43,5 GHz:ää ja on mitoitettu tuottamaan alle 100 ns:n 'pulsinkesto';
  2. Syntesoiitu maksimitaajuus ylittää 43,5 GHz;
  3. "Taajuuden vaihto aika" yhdeltä valitulta taajuudelta toiselle on jokin seuraavista:
    - a. Vähemmän kuin 10 ns;
    - b. Vähemmän kuin 100 µs kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka ovat enemmän kuin 1,6 GHz syntesoidulla taajuusalueella, joka ylittää 3,2 GHz mutta ei 10,6 GHz;
    - c. Vähemmän kuin 250 µs kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka ovat enemmän kuin 550 MHz syntesoidulla taajuusalueella, joka ylittää 10,6 GHz mutta ei 31,8 GHz;
    - d. Vähemmän kuin 500 µs kaikkien niiden taajuusmuutosten osalta, jotka ovat enemmän kuin 550 MHz syntesoidulla taajuusalueella, joka ylittää 31,8 GHz mutta ei 43,5 GHz; tai
    - e. Vähemmän kuin 1 ms syntesoidulla taajuusalueella, joka ylittää 43,5 GHz; tai
  4. Yksisivukaistan (SSB) vaihekohina on parempi kuin  $-(126 + 20 \log_{10} F - 20 \log_{10} f)$ , dBc/Hz, jossa F on toimintataajuuden poikkeama hertseinä ja f on toimintataajuus megahertseinä;

Huom. 1: 3A002.d kohdassa termiin 'taajuussyntesoiivat signaaligeneraattorit' sisältyvät satunnaisaalto- ja satunnaisfunktiogeneraattorit.

Huom. 2: 3A002.d kohta ei aseta valvonnallaiseksi laitteita, joissa lähtötaajuus aikaansaadaan joko laskeamalla yhteen tai vähentämällä toisistaan kahden tai useamman kideoskillaattorin taajuuksia ja kertomalla siten saatu tulos.

- 3A002 d. (jatkoa)
- Tekn. huom.:
1. Satunnaisaalto- ja satunnaisfunktiogeneraattoreille on normaalisti ominaista näytteenottotaajuus (esim.  $G_{\text{Sample}}/s$ ), joka muunnetaan suurtaajuusalueelle Nyquist-kertoimella 2. Näin ollen  $1 G_{\text{Sample}}/s$ :n satunnaisaallonpituudella on 500 MHz:n suora lähdön virranantokyky. Jos käytetään ylinäytteistystä, suurin suora lähdön virranantokyky on suhteessa alhaisempi.
  2. 3A002.d.1 kohdassa tarkoitetaan 'pulsseinkestolla' aikaa, joka kuluu siitä, kun pulssin etureuna saavuttaa 90 prosenttia huipusta, siihen, kun pulssin takareuna saavuttaa 10 prosenttia huipusta.
- e. Verkkoanalysaattorit, joiden maksimitoimintataajuus ylittää 43,5 GHz;
- f. Mikroaaltotestivastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Maksimitoimintataajuus ylittää 43,5 GHz; ja
  2. Ne kykenevät mittaamaan samanaikaisesti sekä amplitudia että vaihetta;
- g. Atomitaajuusstandardit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Pitkän aikavälin (vanhenemis-)stabiilius on vähemmän (parempi) kuin  $1 \times 10^{-11}$  kuukaudessa; tai
  2. Ne ovat "avaruuskelpoisia".
- Huom.: 3A002.g.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi ei-"avaruuskelpoisia" rubidiumstandardeja.
- 3A003 Suihkujäähdytteiset lämmönsäätelyjärjestelmät, joissa käytetään suljettua nesteenkäsittely- ja uudelleenkäsitelylaitteistoja umpinaisessa rakenteessa ja joissa dielektristä nestettä suihkutetaan elektroniin komponentteihin käyttäen erityisesti suunniteltuja suihkusuuttimia ja jotka on suunniteltu pitämään elektroniset komponentit niiden käyttölämpötilan alueella sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- 3A101 Seuraavat, muut kuin 3A001 kohdassa määritellyt elektroniset laitteet, laitteet ja komponentit:
- a. "Ohjuksissa" käyttökelpoiset analogia-digitaalimuuntimet, jotka on suunniteltu vastaamaan sotilasspesifikaatioiden kovaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden vaatimuksia;
  - b. Kiihdyttimet, joilla pystytään lähettämään sähkömagneettista säteilyä, joka tuotetaan 2 MeV:n energiaan tai sen yli kiihdytettyjen elektronien jarrutus säteilyn (Bremsstrahlung) avulla, sekä näitä kiihdyttämiä sisältävät järjestelmät.
- Huom.: 3A101.b kohdassa ei määritellä laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteellisiin tarkoituksiin.
- 3A102 'Ohjuksia' varten suunnitellut tai muunnetut 'lämpöakut'.
- Tekn. huom.:
1. 3A102 kohdassa 'lämpöakut' ovat kertakäyttöisiä akkuja, jotka sisältävät elektrolyyttinä kiinteän johtamattoman epäorgaanisen suolan. Nämä akut sisältävät pyrolyyttisen materiaalin, joka sytytettyinä sulattaa elektrolyytin ja aktivoi akun.
  2. 3A102 kohdassa 'ohjus' tarkoittaa täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka pystyvät kuljettamaan hyötykuorman vähintään 300 km:n etäisyydelle.
- 3A201 Seuraavat muut kuin 3A001 kohdassa määritellyt elektroniset komponentit:
- a. Kondensaattorit, joilla on joko 1 tai 2 kohdassa luetellut ominaisuudet:
    1. a. Nimellisjännite suurempi kuin 1,4 kV
    - b. Energian varastointikyky suurempi kuin 10J
    - c. Kapasitanssi suurempi kuin 0,5  $\mu\text{F}$  ja
    - d. Sarjainduktanssi vähemmän kuin 50 nH; tai
    2. a. Nimellisjännite suurempi kuin 750 V
    - b. Kapasitanssi suurempi kuin 0,25  $\mu\text{F}$  ja
    - c. Sarjainduktanssi vähemmän kuin 10 nH;

3A201 (jatkoa)

b. "Suprajohtavat" solenoidisähkömagneetit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Pystyvät muodostamaan yli 2 T:n magneettikenttiä;
2. Pituuden suhde sisähalkaisijaan on suurempi kuin 2;
3. Sisähalkaisija yli 300 mm; ja
4. Magneettikenttä poikkeaa vähemmän kuin 1 % tasaisesta kentästä sisätilavuuden keskeisen puoliskon (50 %) alueella;

Huom.: 3A201.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi magneetteja, jotka on erityisesti suunniteltu lääketieteellisten ydinmagneettiseen resonanssiin (NMR) perustuvien kuvanmuodostusjärjestelmien 'osiksi'. Sana 'osiksi' ei välttämättä tarkoita saman toimituksen fyysistä osaa; erilliset toimitukset ovat sallittuja eri lähteistä, mikäli niihin liittyvissä vientiasiakirjoissa selvästi mainitaan, että toimitukset lähetetään kuvanmuodostusjärjestelmän 'osiksi'.

c. Seuraavat välähtävät röntgensalamageneraattorit tai pulssitoimiset elektronikihdyttimet, joilla on joko a tai b kohdassa luetellut ominaisuudet:

1. a. Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 500 keV tai suurempi, mutta pienempi kuin 25 MeV; ja
- b. 'Hyvyyysluku' (K) on 0,25 tai suurempi; tai
2. a. Kiihdyttimen huippuelektronienergia on 25 MeV tai suurempi; ja
- b. 'Huipputeho' on suurempi kuin 50 MW.

Huom.: 3A201.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihdyttimiä, jotka ovat muuhun kuin elektronisuihku- tai röntgensäteilytykseen (esimerkiksi elektronimikroskopiaan) suunniteltujen laitteiden komponentteja eikä niitä, jotka on suunniteltu lääketieteellisiä laitteita varten:

Tekn. huom.:

1. 'Hyvyyysluku' K on määritely seuraavasti:

$$K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$$

V on huippuelektronienergia miljoonina elektronivolteina.

Jos elektronipulssin kesto on pienempi tai yhtä suuri kuin 1 mikrosekunti, Q on kiihdytetty kokonaisvaraus coulombeina. Jos elektronipulssin kesto on suurempi kuin 1 mikrosekunti, Q on 1 mikrosekunnissa kiihdytetty maksimisähkövaraus.

Q on yhtä kuin elektronivirran i integraali ajan t suhteen ( $Q = \int idt$ ), jossa i on säteen virta ampeereina ja t aika sekunneissa.

2. 'Huipputeho' = (huippujännite voltteina)  $\times$  (säteen huippuvirta ampeereina).
3. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa pulssin kesto on pienempi kahdesta seuraavasta: 1  $\mu$ s tai yhden mikroaaltomodulaattorin pulssin tuottaman tiivistetyn pulssipaketin kesto.
4. Mikroaaltokiihdytysonteloihin perustuvissa koneissa säteen huippuvirta on tiivistetyn pulssipaketin keskimääräinen virta sen keston aikana.

3A225 Muut kuin 0B001.c.13 kohdassa määritellyt taajuusmuuntimet tai generaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Monivaiheulostulo kykenee antamaan 40 W:n tai suuremman tehon;
- b. Kykenee toimimaan 600–2 000 Hz:n taajuusalueella;
- c. Harmoninen kokonaissärö on parempi (pienempi) kuin 10 %; ja
- d. Taajuuden säätö on parempi (pienempi) kuin 0,1 %.

Tekn. huom.:

3A225 kohdan taajuusmuuntimia kutsutaan myös konverttereiksi tai inverttereiksi.

- 3A226 Muut kuin 0B001.j.6 kohdassa mainitut tasavirtasuurteholähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- Ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 100 V:n tai korkeamman jännitteen 500 A:n tai suuremmalla virralla; ja
  - Niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.
- 3A227 Muut kuin 0B001.j.5 kohdassa määritellyt tasavirtakorkeajännitelähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- Ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan 20 kV:n tai korkeamman jännitteen 1 A:n tai suuremmalla virralla; ja
  - Niiden jännitteen tai virran stabiilius on parempi kuin 0,1 % 8 tunnin jakson aikana.
- 3A228 Seuraavat kytkinlaitteet:
- Kylmäkatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutäytteisiä tai ei, jotka toimivat kipinävälin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Ne sisältävät kolme tai useampia elektrodeja;
    - Huippuanodijännitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmän;
    - Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmän; ja
    - Anodin viiveaika on 10 µs tai lyhyempi;

*Huom.:* 3A228 kohtaan sisältyvät kaasukryptonputket ja tyhjösprytonputket.
  - Liipaistavat kipinävälit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - Anodiviiveaika on 15 µs tai lyhyempi; ja
    - huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmän;
  - Muut kuin 3A001.g kohdassa määritellyt nopeatoimiset kytkinmodulit tai -kokoonpanot, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Huippuanodijännitteen nimellisarvo on suurempi kuin 2 kV;
    - Huippuanodivirran nimellisarvo on 500 A tai enemmän; ja
    - Kytentäaika on 1 µs tai vähemmän.
- 3A229 Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulsSIGeneraattorit:
- Huom.:** KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.
- Räjähävien syyttimien laukaisulaitteet, jotka on suunniteltu laukaisemaan 3A232 kohdassa määritellyjä valvonnanalaisia monipistesyyttimiä;
  - Moduulirakenteiset sähköpulsSIGeneraattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - Ne on suunniteltu liikkuviksi tai vaativissa olosuhteissa käytettäviksi;
    - Ne on koteloitu pölytiivisti;
    - Pystyvät luovuttamaan energiansa alle 15 µs:ssa;
    - Lähtövirta on suurempi kuin 100 A;
    - 'Nousuaika' on lyhyempi kuin 10 µs alle 40 ohmin kuormituksella.
    - Mikään ulottuvuus ei ole suurempi kuin 254 mm;

- 3A229 b. (jatkoa)
7. Paino on alle 25 kg; ja
8. Ne on määritelty käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella (223 K (– 50 °C) – 373 K (100 °C) astetta) tai sopiviksi "avaruussovelluksiin".
- Huom.: 3A229.b kohtaan sisältyvät ksenonsalamavalon käyttölaitteet.
- Tekn. huom.:
- 3A229.b.5 kohdassa 'nousuaika' on aikaväli, jonka kuluessa virran amplitudi kasvaa 10 prosentista 90 prosenttiin, kun kuorma on resistiivinen.
- 3A230 Erittäin nopeat pulssigeneraattorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- a. Lähtöjännite on yli 6 V alle 55 ohmin resistiivisellä kuormalla; ja
- b. 'Pulssin nousuaika' on lyhyempi kuin 500 ps.
- Tekn. huom.:
- 3A230 kohdassa 'pulssin nousuaika' määritellään ajaksi, jonka kuluessa jännite nousee 10 prosentista 90 prosenttiin jännitteen amplitudista.
- 3A231 Neutronigeneraattorijärjestelmät, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjöjärjestelmää; ja
- b. Hyväksikäyttävät sähköstaattista kiihdytystä tritium-deuteriumydinreaktion synnyttämiseen.
- 3A232 Seuraavat sytyttimet ja monipistesytytinjärjestelmät:
- Huom.:** KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.
- a. Seuraavat sähköisesti ohjattavat räjähtävät sytyttimet:
1. Räjähtävä siltajohdin (EB);
  2. Räjähtävä siltajohdinlanka (EBW);
  3. Iskulaukaisin;
  4. Räjähtävät kalvosytyttimet (EFI);
- b. Järjestelyt, joita käyttäen voidaan yhdellä tai usealla sytyttimellä sytyttää räjähdyspinta yli 5 000 mm<sup>2</sup>:n alalla yhdellä laukaisusignaallilla lähes samanaikaisesti, sytytyksen ajoitus leviää koko pinta-alalle vähemmässä kuin 2,5 µs:ssa.
- Huom.: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sytyttimiä, joissa käytetään vain ensiörajähteitä, esimerkiksi lyijyatsidia.
- Tekn. huom.:
- 3A232 kohdassa kaikki kyseiset sytyttimet käyttävät pientä sähköjohdinta (siltavastusta, siltavastuslankaa tai kalvoa), joka kaasuntuu räjähdysmäisesti, kun nopea, voimakas sähköinen pulssi kulkee sen läpi. Muissa kuin iskulaukaisintyypeissä räjähtävä johdin käynnistää kemiallisen räjähdyskäsien yhteydessä olevassa voimakkaassa räjähteessä, esim. PETN:ssä (pentaerytritoltetraanitratissa). Iskulaukaisimissa sähköjohtimen kaasuntuuminen työntää piikin tai iskurin sytyttimen välin yli ja iskurin törmäys räjähteeseen käynnistää kemiallisen sytytyksen. Joissakin malleissa iskurin käyttövoimana on magneettinen voima. Termiä räjähtävä kalvo voidaan käyttää joko EB- tai iskurityyppisistä sytyttimistä.
- 3A233 Seuraavat, muut kuin 0B002.g kohdassa määritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan atomipainoltaan 230 tai raskaampia ioneja, ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 230:stä ja niiden ionilähteet:
- a. Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers);
- b. Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

3A233 (jatkoa)

- c. Termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = Thermal Ionization Mass Spectrometers);
- d. Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on tehty, vuorattu tai päällystetty UF<sub>6</sub>-kestävillä materiaaleilla;
- e. Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  1. Lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty ruostumattomalla teräksellä tai molybdeenillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K (– 80 °C) asteeseen tai sen alle;  
tai
  2. Lähdekammio on valmistettu, vuorattu tai päällystetty UF<sub>6</sub>-kestävillä materiaaleilla;
- f. Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

**3B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

3B001 Seuraavat puolijohdekomponenttien tai -materiaalien valmistuslaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut osat ja komponentit:

- a. Seuraavat epitaksikasvatusta varten suunnitellut laitteet:
  1. Laitteet, jotka kykenevät tuottamaan vähintään 75 mm:n matkalla kerroksen muuta materiaalia kuin silikonia, jonka kerrospaksuuden vaihtelu on alle + 2,5 %;
  2. Reaktorit, jotka suorittavat metalliorganista kemiallista kaasufaasipinnoitusta (MOCVD) ja jotka on erityisesti suunniteltu yhdistepuolijohdekiteiden kasvatukseen käyttäen kohtien 3C003 tai 3C004 mukaan valvonnanalaisien materiaalien välistä kemiallista reaktiota;
  3. Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet, jotka käyttävät kaasua- tai kiinteitä lähteitä;
- b. Laitteet, jotka on suunniteltu ioni-istutusta varten ja joilla on jokin seuraavista:
  1. Säteen energia (kiihdytysjännite) ylittää 1 MeV;
  2. Ne on erityisesti suunniteltu ja optimoitu toimimaan pienemmällä kuin 2 keV:n säteen energialla (kiihdytysjännitteellä);
  3. Mahdollistavat kuvion suoran istutuksen; tai
  4. Säteen energia vähintään 65 keV ja säteen virta vähintään 45 mA, jotta voidaan suorittaa korkea-energinen happi-istutus kuumennettuun puolijohde "substraattiin";
- c. Seuraavat anisotrooppiset plasmakuivasyövytyslaitteet:
  1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot ja joissa on jokin seuraavista:
    - a. Ne on suunniteltu tai optimoitu tuottamaan minimiviivanleveyden, joka on 180 nm tai vähemmän  $\pm 5\%$  3 sigman tarkkuudella); tai
    - b. Ne on suunniteltu kehittämään  $\text{cm}^2$ :ä kohden vähemmän kuin 0,04 partikkelia, joiden mitattavissa oleva koko on halkaisijaltaan suurempi kuin 0,1  $\mu\text{m}$ ;
  2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia laitteita varten ja joissa on jokin seuraavista:
    - a. Ne on suunniteltu tai optimoitu tuottamaan kriittiset mitat, jotka ovat 180 nm tai vähemmän  $\pm 5\%$  3 sigman tarkkuudella); tai
    - b. Ne on suunniteltu kehittämään  $\text{cm}^2$ :ä kohden vähemmän kuin 0,04 partikkelia, joiden mitattavissa oleva koko on halkaisijaltaan suurempi kuin 0,1  $\mu\text{m}$ ;
- d. Seuraavat plasma-CVD-laitteet:
  1. Laitteet, joissa on kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot ja jotka on suunniteltu valmistajan eritelmien mukaan tai optimoitu käytettäväksi sellaisten puolijohdelaitteiden tuotannossa, joiden kriittiset mitat ovat 180 nm tai vähemmän;
  2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.e kohdan mukaan valvonnanalaisia laitteita varten ja jotka on suunniteltu valmistajan eritelmien mukaan tai optimoitu käytettäväksi sellaisten puolijohdelaitteiden tuotannossa, joiden kriittiset mitat ovat 180 nm tai vähemmän;
- e. Automaattisyöttöiset monikammioiset puolijohdekiekkujen käsittelyjärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat:
  1. Menetelmät kiekkojen syöttöä ja ulosottoa varten ja joihin voidaan liittää enemmän kuin kaksi puolijohdeprosessilaitetta; ja

- 3B001 e. (jatkoa)
2. Suunniteltu muodostamaan tyhjässä toimiva integroitu järjestelmä useiden kiekkojen peräkkäistä prosessointia varten.
- Huom.: 3B001.e kohta ei aseta valvonnanalaiseksi automaattisia kiekkojen robottikäsitteilyjä, joita ei ole suunniteltu toimimaan tyhjässä.
- f. Seuraavat litografialaitteet:
1. Askeltavat kohdistus- ja valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja pyyhkäisy- (skanneri) laitteet kiekkojen prosessointia varten, jotka käyttävät foto-optisia tai röntgenmenetelmiä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Valolähteen aallonpituus lyhyempi kuin 245 nm; tai
- b. Ne pystyvät tuottamaan kuvion, jonka 'pienin erottuva kuvion' koko on 180 nm tai vähemmän;
- Tekn. huom.:
- 'Pienimmän erottuvan kuvion' koko lasketaan seuraavalla kaavalla:
- $$\text{MRF} = \frac{(\text{aallonpituus nanometreinä}) \times (\text{K kerroin})}{\text{numeerinen aukko}}$$
- jossa: K kerroin = 0,45
- MRF on pienin erottuva kuvion koko.
2. Kohokuviointilaitteet, joilla pystytään tuottamaan kuvioita, joiden koko on 180 nm tai vähemmän;
- Huom.: 3B001.f.2 kohtaan sisältyvät:
- Pehmytkuviointivälineet
  - Kuumapakotusvälineet
  - Nanomuokkauskuviointivälineet
  - Step and flash -kuviointi (S-FIL) -välineet
3. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu maskien valmistukseen tai puolijohdekomponenttien prosessointiin käyttäen poikkeutettua ja fokuoitetua elektronisuihkua, ionisuihkua tai "laser"-sädettä, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Suihkun tai säteen pisteen koko on pienempi kuin 0,2 µm;
- b. Kykenevät tuottamaan kuvioita, joiden viivaleveys on vähemmän kuin 1 µm; tai
- c. Kohdistustarkkuus on parempi kuin ± 0,20 µm (3 sigma).
- g. Maskit tai retikkelit, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa määriteltyjä integroituvia piirejä varten;
- h. Monikerrosmaskit, joissa on vaihesiirtokerros.
- Huom.: 3B001.h kohta ei aseta valvonnanalaiseksi monikerrosmaskeja, joissa on vaihesiirtokerros ja jotka on suunniteltu sellaisten muistilaitteiden valmistukseen, joita ei aseteta valvonnanalaiseksi 3A001 kohdassa.
- i. Kohokuviointimallineet, jotka on suunniteltu 3A001 kohdassa määriteltyjä integroituvia piirejä varten.
- 3B002 Seuraavat testauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu valmiiden tai puolivalmiiden puolijohteiden ja erityisesti niitä varten suunniteltujen komponenttien ja tarvikkeiden testaamiseen:
- a. Laitteet transistorien S-parametrien testaukseen yli 31,8 GHz:n alueella;
- b. Ei käytössä;
- c. Laitteet 3A001.b.2 kohdassa määriteltyjen integroitujen mikroaaltopiirien testaukseen.

- 3C Materiaalit**
- 3C001 Hetero-epitaksimateriaalit, jotka koostuvat "substraatista", jonka päälle on epitaksisesti kasvatettu useita kerroksia seuraavia aineita:
- Pii;
  - Germanium;
  - Piikarbidi; tai
  - Galliumin tai indiumin III/V-yhdisteet.
- Tekn. huom.:*
- III/V-yhdisteet ovat monikiteisiä valmisteita tai binaarisia tai kompleksisia yksikiteisiä valmisteita, jotka koostuvat Mendelejevin jaksollisen luokitustaulun ryhmien IIIA ja VA alkuaineista (esim. galliumarsenidi, galliumalumiiniarsenidi, indiumfosfidi).*
- 3C002 Seuraavat estopinnoitemateriaalit ja valvonnanalaisilla estopinnoitemateriaaleilla pinnoitetut "substraatit":
- Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 245 nm:n aallonpituuksille;
  - Kaikki estopinnoitteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi elektroni- tai ionisuihkun kanssa ja joiden herkkyys on 0,01 mikrocoulombia/mm<sup>2</sup> tai parempi;
  - Kaikki röntgenestopinnoitteet, joiden herkkyys on 2,5 mJ/mm<sup>2</sup> tai parempi;
  - Kaikki pintakuvausteknologiaa varten optimoidut estopinnoitteet, 'piitetyt' resistit mukaan lukien.
- Tekn. huom.:*
- 'Piittämis'tekniikka on prosessi, jossa käytetään estopinnoitteen pinnan oksidointia parantamaan sen ominaisuuksia sekä märkä- että kuivakehityksessä.*
- 3C003 Seuraavat orgaanis-epäorgaaniset yhdisteet:
- Metalliorgaaniset alumiini-, gallium- tai indiumyhdisteet, joiden (perusmetallin) puhtaus (metalleista) on parempi kuin 99,999 %;
  - Arseeniorgaaniset, antimoni-orgaaniset ja fosfori-orgaaniset yhdisteet, joiden puhtaus (epäorgaanisista aineista) on parempi kuin 99,999 %.
- Huom.:* 3C003 kohta asettaa valvonnanalaiseksi vain yhdisteet, joiden metallinen, osittain metallinen tai ei-metallinen elementti on suoraan liittynyt hiileen molekyylin orgaanisessa osassa.
- 3C004 Fosfori-, arseeni- tai antimonihydridit, joiden puhtaus on parempi kuin 99,999 %, myös jalokaasuilla tai vedyllä laimennettuina.
- Huom.:* 3C004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi hydridejä, jotka sisältävät 20 mooliprosenttia tai enemmän jalokaasuja tai vetyä.
- 3C005 Piikarbidi (SiC) -kiekot, joiden resistiivisyys on enemmän kuin 10 000 ohmisenttimetriä.

**3D Ohjelmistot**

- 3D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3A001.b–3A002.g tai 3B kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 3D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu jonkin seuraavista "käyttöä" varten:
- a. 3B001.a–f kohdassa tarkoitettut laitteet; tai
  - b. 3B002 kohdassa tarkoitettut laitteet.
- 3D003 Fysiikkapohjaiset simulaatio-"ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten litografia-, syövytys- ja pinnoitusprosessien "kehittämiseen", jotka muuntavat maskin kuviot erityisiksi topografisiksi johtimien, eristeiden ja puolijohdemateriaalien kuvioiksi.
- Tekn. huom.:*
- 'Fysiikkapohjaisella' tarkoitetaan 3D003 kohdassa laskelmien käyttämistä fysikaalisten syy ja seuraus -tapahtumien jakson määrittämiseen fysikaalisten ominaisuuksien perusteella (esimerkiksi lämpötila, paine, diffuusiovakiot ja puolijohdemateriaalien ominaisuudet).
- Huom.:* Kirjastot, suunnitteluparametrit sekä niihin liittyvät tiedot puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua varten käsitetään "teknologiaksi".
- 3D004 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 3A003 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" varten.
- 3D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 3A101.b kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

**3E Teknologia**

3E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A, 3B tai 3C kohdassa määriteltyjen laitteiden ja materiaalien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten.

Huom. 1: 3E001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 3A003 kohdassa valvottujen laitteiden tai komponenttien "tuotantoa" varten tarvittavaa teknologiaa.

Huom. 2: 3E001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi sellaisten 3A001.a.3–3A001.a.12 kohtien mukaan valvonnalaisten integroitujen piirien, "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten tarvittavaa "teknologiaa", joilla on seuraavat ominaisuudet:

1. Perustuvat 0,5:n mikrometrin tai karkeampaan "teknologiaan"; ja
2. Eivät sisällä 'monikerrosrakenteita'.

Tekn. huom.:

Termi 'monikerrosrakenteet' ei sisällä komponentteja, joissa on korkeintaan kolme metallikerrosta ja kolme monikerrosta piikerrosta.

3E002 Muu kuin 3E001 kohdassa määritelty "teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti sellaisen "mikroprosessorimikropiirin", "mikrotietokonemikropiirin" tai mikro-ohjainmikropiiriytimen "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten, jonka aritmeettisloogisen yksikön hakuleveys on 32 bittiä tai enemmän ja jolla on jokin seuraavista piirteistä tai ominaisuuksista:

- a. Vektoriprosessoriyksikkö, joka on suunniteltu suorittamaan enemmän kuin kaksi laskutoimitusta liukulukuvektoreille (32-bittisten tai sitä suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti;

Tekn. huom.:

Vektoriprosessoriyksikkö on prosessorielementti, jossa on sisäänrakennetut käskyt, jotka suorittavat useita laskutoimituksia liukulukuvektoreille (32-bittisten tai sitä suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti, ja jossa on vähintään yhden vektorin aritmeettislooginen yksikkö.

- b. Suunniteltu suorittamaan enemmän kuin kaksi 64-bittistä tai sitä suurempaa liukulukutoimitusta kierrosta kohden; tai
- c. Suunniteltu suorittamaan enemmän kuin neljä 16-bittistä kiintolukutoimitusta kertolaskusummausta käyttäen kierrosta kohden (esimerkiksi sellaisen analogisen tiedon digitaalinen käsittely, joka on aiemmin muunnettu digitaaliseen muotoon eli digitaalinen signaalinkäsittely).

Huom.: 3E002.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi multimedialaajennuksia varten olevaa teknologiaa.

Huom 1: 3E002 ei aseta valvonnanalaiseksi "teknologiaa" yleisen sellaisten mikroprosessoriytimien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten, joilla on kaikki seuraavista:

- a. Ne käyttävät "teknologiaa", jonka koko on 0,130  $\mu\text{m}$  tai enemmän; ja
- b. Niihin sisältyy monikerrosrakenteita, joissa on viisi metallikerrosta tai vähemmän.

Huom. 2: 3E002 kohtaan sisältyy "teknologia" digitaalisia signaalinkäsittelijöitä ja digitaalisia taulukkosuorittimia varten.

3E003 Muu "teknologia" seuraavien komponenttien "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten:

- a. Tyhjä-mikroelektroniset komponentit;
- b. Heterorakenteiset puolijohdekomponentit, kuten korkean elektroniliikkuvuuden transistorit (HEMT), heterobipolaaritransistorit (HBT), kvanttikuoppa- tai superhilakomponentit;

Huom.: 3E003.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi teknologiaa alle 31,8 GHz:n taajuuksilla toimivia HEMT-transistoreja varten ja alle 31,8 GHz:n taajuuksilla toimivia heteroliitosbipolaaritransistoreja (HBT) varten.

- c. "Suprajohtavat" elektroniset komponentit.
- d. Elektronisten komponenttien timanttifilmisubstraatit.
- e. Piieristysubstraatit integroiduille piireille, joissa eristysaineena on piidioksidi.

- 3E003 (jatkoa)
- f. Piikarbidisubstraatit elektronisille komponenteille.
  - g. Elektroniset tyhjöpaketit, jotka toimivat 31,8 GHz:n tai suuremmilla taajuuksilla.
- 3E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.a.1 tai 2, 3A101, 3A102 tai 3D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden ja "ohjelmistojen" "käyttöä" varten.
- 3E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3D101 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
- 3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225–3A233 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.



**RYHMÄ 4**  
**TIETOKONEET**



Huom. 1: Tietokoneet, niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat tietoliikenteen tai "paikallisverkon" toimintoja, tulee arvioida myös 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) toimintaparametreja vasten.

Huom. 2: Ohjauksyksiköitä, jotka yhdistävät suoraan keskusyksikön, "keskusmuistin" tai levyohjaimien väyliä tai kanavia, ei katsota 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) määrittelemiksi tietoliikennelaitteiksi.

Huom.: Pakettikytkentää varten erityisesti suunniteltujen "ohjelmistojen" valvonnanalaisuus: katso 5D001 kohta.

Huom. 3: Tietokoneet, niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", jotka suorittavat salausta, salauksen analysointia tai serifioiduissa olevaa monitasoista turvallisuuden valvontaa tai serifioiduissa olevaa käyttöoikeuden rajoamista tai jotka rajoittavat sähkömagneettista mukautuvuutta (EMC), tulee arvioida myös 5 ryhmän 2 osa ("Tiedon suojaus") toimintaparametreja vasten.

#### 4A Järjestelmät, laitteet ja komponentit

4A001 Seuraavat elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 4A101 KOHTA.**

a. Jotka on erityisesti suunniteltu niin, että niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Mitoitettu toimimaan ympäröivässä lämpötilassa alle 228 K (– 45 °C) astetta tai yli 358 K (85 °C) astetta;

Huom.: 4A001.a.1 kohta ei koske siviilijoneuvo- tai -rautatiesovelluksiin erityisesti suunniteltuja tietokoneita.

2. Kestävät säteilyä yli jonkin seuraavista rajoista:

- a. Kokonaisannos  $5 \times 10^3$  Gy (Pii);
- b. Annosnopeus  $5 \times 10^6$  Gy (Pii)/s; tai
- c. Kertahäiriö  $1 \times 10^{-7}$  virhettä/bit/vrk;

b. Joilla on 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedon suojaus") määritellyt rajat ylittäviä ominaisuuksia tai toimintoja.

Huom.: 4A001.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisia tietokoneita ja niihin liittyviä laitteita, kun käyttäjällä on ne mukanaan henkilökohtaista käyttöä varten.

4A003 Seuraavat "digitaaliset tietokoneet", "elektroniset kokoonpanot" ja niihin liittyvät laitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom. 1: 4A003 kohta sisältää seuraavat:

- a. Vektoriprosessorit;
- b. Matriisiprosessorit;
- c. Digitaaliset signaaliprosessorit;
- d. Logiikkaprosessorit;
- e. Laitteet "kuvan laadun parantamista" varten;
- f. Laitteet "signaalinkäsittelyä" varten.

4A003 (jatkoa)

Huom. 2: Muihin laitteisiin tai järjestelmiin sisältyvien 4A003 kohdassa kuvattujen "digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnallisuus määräytyy näiden muiden laitteiden tai järjestelmien valvonnallisuuden mukaan edellyttäen, että:

- a. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvät laitteet ovat näiden muiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömiä;
- b. "Digitaaliset tietokoneet" tai niihin liittyvät laitteet eivät ole näiden muiden laitteiden tai järjestelmien olennaisin osa; ja

Huom. 1: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen "signaalin käsittely"- tai "kuvan laatua parantavien" laitteiden valvonnallisuuden määrittelee näiden muiden laitteiden valvonnallisuus, vaikka ne ylittäisivätkin olennaisimman osan kriteerin, mikäli ne suorittavat vain näiden muiden laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2: Tietoliikenteessä käytettävien "digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden valvonnallisuus: katso 5 ryhmä 1 osa (Tietoliikenne).

- c. "Digitaalisten tietokoneiden" ja niihin liittyvien laitteiden "teknologia" on määritelty 4E kohdassa.
- a. Jotka on suunniteltu tai muunnettu "vikasietoisiksi";

Huom.: 4A003.a kohdan tarkoituksia varten ei "digitaalisia tietokoneita" tai niihin liittyviä laitteita katsota suunnitelluiksi tai muunnetuiksi "vikasietoisiksi", jos ne käyttävät:

1. "Keskusmuistin" virheenpaljastus- tai virheenkorjausalgoritmeja;
  2. Kahden "digitaalisen tietokoneen" välistä kytkentää siten, että aktiivisen keskusyksikön pettäessä vapaana oleva ja sen toimintaa peilaava keskusyksikkö voi jatkaa järjestelmän toimintaa;
  3. Kahden keskusyksikön välistä tiedonsiirtokytkeä tai yhteistä muistiyksikköä siten, että yksi keskusyksikkö voi suorittaa muita tehtäviä kunnes toinen keskusyksikkö pettää, jolloin ensin mainittu ottaa hoitaakseen järjestelmän toiminnan; tai
  4. Kahden keskusyksikön synkronointia "ohjelmistojen" avulla siten, että yksi keskusyksikkö huomaa milloin toinen pettää ja voi ottaa huolehtiakseen sen tehtävät.
- b. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "mukautettu huipputehokkuus" ("APP") ylittää 0,75 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);
  - c. Seuraavat "elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu nostamaan tehokkuutta yhdistämällä prosessoreja siten, että yhdistelmän "APP" ylittää 4A003.b kohdan rajan;

Huom. 1: 4A003.c kohtaa sovelletaan ainoastaan kokoonpanoihin ja ohjelmitaviin keskinäisiin kytkentöihin, jotka eivät ylitä 4A003.b kohdassa määriteltyä rajaa, kun ne toimitetaan erillisinä "elektronisina kokoonpanoina". Sitä ei sovelleta "elektronisiin kokoonpanoihin", joiden rakenne rajoittaa niiden käytön 4A003.e kohdan määrittelemänä liittyvinä laitteina.

Huom. 2: 4A003.c kohdassa ei aseteta valvonnalliseksi tuotteita tai tuoteperheitä varten erityisesti suunniteltuja elektronisia kokoonpanoja, jotka maksimikokoonpanossaan eivät ylitä 4A003.b kohdan rajaa.

- 4A003 (jatkoa)
- d. Ei käytössä;
  - e. Laitteet, jotka suorittavat analogia-digitaalimuunnoksia tai digitaali-analogiamuunnoksia ja jotka ylittävät 3A001.a.5 kohdassa mainitut rajat;
  - f. Ei käytössä;
  - g. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu "digitaalisten tietokoneiden" tai niihin liittyvien laitteiden välistä ulkoista keskinäisliitännää varten, joka sallii viestiliikenteen tiedonsiirtonopeudella, joka ylittää 1,25 Gbyte/s.
- Huom.: 4A003.g kohdassa ei aseteta valvonnallaisiksi sisäisiä liitännälaitteita (esim. emolevyjä ja väyliä), passiivisia kytkentälaitteita, "verkkoliityntäohjaimia" tai "tietoliikenneohjaimia".
- 4A004 Seuraavat tietokoneet ja niitä varten erityisesti suunnitellut niihin liittyvät laitteet, "elektroniset kokoonpanot" ja komponentit:
- a. "Systoliset matriisitietokoneet";
  - b. "Hermoverkkotietokoneet";
  - c. "Optiset tietokoneet".
- 4A101 Muut kuin 4A001.a.1 kohdassa määritellyt analogiset tietokoneet, "digitaaliset tietokoneet" tai digitaaliset differentiaalianalysaattorit, jotka on suunniteltu kovaan käyttöön ja suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien käyttöä varten.
- 4A102 Hybriditietokoneet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien mallintamista, simulointia tai konstruktioiden integrointia varten.
- Huom.: Tätä valvonnallaisuutta sovelletaan ainoastaan, kun laitteita toimitetaan 7D103 tai 9D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" kanssa.

**4B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

Ei ole.

**4C**      **Materiaalit**

Ei ole.

**4D Ohjelmistot**

*Huom.:* Muissa ryhmissä kuvattujen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten tarkoitettujen "ohjelmistojen" valvonnallaisuutta käsitellään kyseisissä ryhmissä. Tässä ryhmässä kuvattujen laitteiden "ohjelmistojen" valvonnallaisuutta käsitellään tässä kohdassa.

- 4D001 a. 4A001–4A004 tai 4D kohdassa määriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot".
- b. Muut kuin 4D001.a kohdassa määritellyt "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":
1. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "mukautettu huipputehokkuus" ("APP") ylittää 0,04 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT); tai
  2. "Elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä prosessoreja siten, että yhdistelmän "APP" ylittää 4D001.b.1 kohdassa määritellyn rajan;
- 4D002 4E kohdassa määritellyn "teknologian" tukemiseen erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot".
- 4D003 Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
- a. "Lähdekieliset" käyttöjärjestelmä"ohjelmistot", "ohjelmistojen" kehittämistyökalut ja kääntäjät, jotka on erityisesti suunniteltu "monitietovirtakäsittelyä" varten;
  - b. Ei käytössä;
  - c. "Ohjelmistot", joilla on 5 ryhmän 2 osassa ("Tiedon suojaus") määritellyt rajat ylittäviä ominaisuuksia tai toimintoja;

*Huom.:* 4D003.c kohdassa ei aseteta valvonnallaiseksi ohjelmistoa, kun käyttäjällä on se mukanaan henkilökohtaista käyttöä varten.

**4E Teknologia**

- 4E001
- a. Yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti "teknologia", joka on tarkoitettu 4A tai 4D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
  - b. Muu kuin 4E001.a kohdassa määritelty "teknologia", joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":
    1. "Digitaaliset tietokoneet", joiden "mukautettu huipputehokkuus" ("APP") ylittää 0,04 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT); tai
    2. "Elektroniset kokoonpanot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä prosessoreja siten, että yhdistelmän "APP" ylittää 4E001.b.1 kohdassa määritellyn rajan.

### MUKAUTETTUA HUIPPUKUNNOUUTTA ("APP") KOSKEVA TEKNINEN HUOMAUTUS

"APP" on mukautettu huippunopeus, jolla "digitaaliset tietokoneet" suorittavat 64-bittisten tai sitä suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimituksia.

"APP" ilmaistaan painotettuina teraliukulukutoimituksina sekunnissa (WT), yksikköinä, jotka koostuvat 1 012:sta mukautetusta liukulukutoimituksesta sekunnissa.

Tässä teknisessä huomautuksessa käytetyt lyhenteet

n: "digitaalisen tietokoneen" prosessorien lukumäärä

i: prosessorin numero (i, ... n)

ti: prosessorin kierrosaika ( $ti = 1/Fi$ )

Fi: prosessorin taajuus

Ri: liukulukujen laskennan huippunopeus

Wi: arkkitehtuurin mukautustekijä

Yhteenveto "APP":n laskentamenetelmästä

1. Määritetään kunkin prosessorin i osalta 64-bittisten tai sitä suurempien liukulukujen toimitusten huippumäärä FPOi, joka suoritetaan kierrosta kohden "digitaalisen tietokoneen" kunkin prosessorin osalta.

Huom.: FPO:ta määritettäessä otetaan huomioon ainoastaan 64-bittisten tai sitä suurempien liukulukujen yhteenlasku- ja kertolaskutoimitukset. Kaikki liukulukutoimitukset on ilmaistava toimituksina prosessorin kierrosta kohden; useita kierroksia vaativat toimitukset voidaan ilmaista murto-osina kierrosta kohden. Niiden prosessorien, jotka eivät pysty suorittamaan laskuja 64-bittisillä tai sitä suuremmilla liukulukuoperandeilla, todellinen laskentanopeus R on nolla.

2. Lasketaan liukulukunopeus R kunkin prosessorin osalta  $Ri = FPOi/ti$ .

3. Lasketaan "APP" seuraavasti:  $APP = W1 \times R1 + W2 \times R2 + \dots + Wn \times Rn$ .

4. "Vektoriprosessorien" osalta  $Wi = 0,9$ . "Muiden kuin vektoriprosessorien" osalta  $Wi = 0,3$ .

Huom. 1: Jokainen toimitus lasketaan niiden prosessorien osalta, jotka suorittavat yhdistettyjä toimituksia, kuten yhteen- ja kertolaskuja, kierroksen aikana.

Huom. 2: Liukuhihnaprosessorien osalta todellinen laskentanopeus R on liukuhihnanopeudesta (liukuhihnan ollessa täynnä) tai muusta kuin liukuhihnanopeudesta se, kumpi on nopeampi.

Huom. 3: Kunkin osallistuvan prosessorin laskentanopeus R lasketaan sen maksiminopeudessa, joka on teoreettisesti mahdollinen ennen kuin yhdistelmän "APP" johdetaan. Yhtäaikaisten toimitusten oletetaan olevan olemassa, kun tietokoneen valmistaja mainitsee tietokoneen käyttöohjeissa tai esitteessä yhdessä vaikuttavat, rinnakkaiset tai yhtäaikaiset toimitukset tai suoritukset.

Huom. 4: "APP":ta laskettaessa ei oteta huomioon prosessoreja, jotka rajoittuvat syöttö/tulostus- ja oheistoimintoihin (esimerkiksi levyasema, viestintä- ja videonäyttö).

Huom. 5: "APP"-arvoja ei lasketa seuraavien osalta: prosessoriyhdistelmät, jotka on yhdistetty (toisiinsa) "paikallisverkoilla", alueverkoilla, yhteisillä siirräntäyhteyksillä/-laitteilla, siirräntäohjauksjärjestelmillä ja muilla "ohjelmistojen" avulla toteutetuilla tietoliikenneyhteyksillä.

Huom. 6: "APP"-arvot on laskettava seuraavien osalta:

1. Prosessoriyhdistelmät, joihin sisältyy prosessoreja, jotka on erityisesti suunniteltu tehostamaan suorituskykyä toimimalla yhdistelmänä, toimimalla yhtäaikaisesti ja jakamalla muistia; tai
2. Monimuisti-/prosessoriyhdistelmät, jotka toimivat yhtäaikaisesti käyttäen erityisesti suunniteltuja laitteita.

Huom. 7: "Vektoriprosessori" määritellään prosessoriksi, jossa on sisäänrakennetut käskyt, jotka suorittavat useita laskutoimituksia liukulukuvektoreille (64-bittisten tai sitä suurempien lukujen yksiulotteiset matriisit) samanaikaisesti, ja jossa on vähintään kaksi vektoripääyksikköä ja vähintään kahdeksan vektorirekisteriä, joissa on kussakin ainakin 64 elementtiä.

**RYHMÄ 5**

**TIETOLIIKENNE JA "TIEDON SUOJAUS"**



## I OSA

## TIETOLIIKENNE

Huom. 1: Tietoliikennelaitteita tai -järjestelmiä varten erityisesti kehitettyjen komponenttien, "laserien", testaus- ja "tuotanto"laitteiden, materiaalien ja ohjelmien valvonnallaisuus on määritelty 5 ryhmän 1 osassa.

Huom. 2: "Digitaaliset tietokoneet", niihin liittyvät laitteet tai "ohjelmistot", milloin ne ovat olennaisia tässä ryhmässä kuvattujen tietoliikennelaitteiden toiminnalle ja tukevat niitä, katsotaan erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitetyiksi komponenteiksi, edellyttäen, että ne ovat valmistajan tavanomaisesti toimittamia vakiotyyppisiä. Tämä koskee myös tietokonejärjestelmiä toimintaa, hallintoa, ylläpitoa, teknistä suunnittelua tai laskutusta varten.

## 5A1 Järjestelmät, laitteet ja komponentit

- 5A001 a. Tietoliikennelaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:
1. Erityisesti suunniteltu kestämään ydinräjähdyksestä aiheutuvia hetkellisiä elektronisia vaikutuksia tai sähkömagneettista pulssia;
  2. Erityisesti suojattu kestämään gamma-, neutroni- tai ionisäteilyä; tai
  3. Erityisesti suunniteltu toimimaan lämpötila-alueen 218 K (– 55 °C) – 397 K (124 °C) ulkopuolella.

Huom.: 5A001.a.3 kohta koskee vain elektronisia laitteita.

Huom.: 5A001.a.2 ja 5A001.a.3 kohta ei koske satelliiteissa käytettäviksi suunniteltuja tai muutettuja laitteita.

- b. Tietoliikennejärjestelmät ja -laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:
1. Vedenalaiset viestintäjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Akustinen kantoaaltotaajuus, joka on alueen 20–60 kHz ulkopuolella;
    - b. Käyttävät sähkömagneettista kantoaaltotaajuutta alle 30 kHz; tai
    - c. Käyttävät elektronista keilanojaustekniikkaa;
  2. Radiolaitteet, jotka toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Ennakoivat ja valitsevat automaattisesti kanavakohtaisia taajuuksia ja "digitaalisia kokonais-siirtonopeuksia" optimoidakseen lähetystä; ja
    - b. Sisältävät lineaarisen tehovahvistinkonfiguraation, joka kykenee tukemaan useampia signaaleja samanaikaisesti 1 kW:n tai suuremmalla lähtöteholla 1,5–30 MHz:n taajuusalueella tai 250 W:n tai suuremmalla lähtöteholla 30–87,5 MHz:n taajuusalueella, yhden tai useamman oktaavin "hetkellisen taajuuskaistan" yli, siten että ulostulon yliaalto- ja särösisältö on parempi kuin – 80 dB;
  3. Muut kuin 5A001.b.4 kohdassa määritellyt radiolaitteet, jotka käyttävät "hajaspektritekniikkaa", mukaan lukien "taajuushyppy"tekniikka, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. Hajautuskoodit ovat käyttäjän ohjelmoitavissa; tai
    - b. Lähetettävän kaistan kokonaisleveys on vähintään 100 kertaa minkä tahansa informaatiokanavan kaistan leveys ja se ylittää 50 kHz;

Huom.: 5A001.b.3.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi siviilikäytössä olevissa solukkoradiojärjestelmissä.

Huom.: 5A001.b.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi laitteita, jotka on suunniteltu toimiviksi 1,0 Watin tai sitä alemmalla ulostuloteholla.

5A001 b. (jatkoa)

4. Radiolaitteet, jotka käyttävät ultralaajakaistamodulointitekniikoita ja joiden kanavointi-, sekoitus- tai verkkotunnuskoodit ovat käyttäjän ohjelmoitavissa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Kaistanleveys yli 500 MHz; tai
  - b. "Suhteellinen kaistanleveys" 20 prosenttia tai enemmän;
5. Digitaalisesti ohjatut radiovastaanottimet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  - a. Yli 1 000 kanavaa;
  - b. Alle 1 ms:n "taajuuden vaihto aika";
  - c. Tutkivat tai pyyhkivät automaattisesti osaa sähkömagneettisesta spektristä; ja
  - d. Jotka identifioivat vastaanotetut signaalit tai lähettimen tyyppin; tai

*Huom.:* 5A001.b.5 kohta ei aseta valvonnallaiseksi radiolaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi siviilikäytössä olevissa solukkoradiojärjestelmissä.

6. Käyttävät digitaalisia "signaalin käsittely"toimintoja 'puheenkoodauksen' ulostuloon alle 2 400 bit/s nopeuksilla;

*Tekn. huom.:*

1. Nopeudeltaan vaihtelevan puheenkoodauksen osalta sovelletaan 5A001.b.6 kohtaa jatkuvan puheen puheenkoodauksen ulostuloon.
2. 5A001.b.6 kohdassa 'puheenkoodauksella' tarkoitetaan teknikkaa, jossa ihmisen äänestä otetaan näytteitä, minkä jälkeen nämä näytteet muunnetaan digitaaliseksi signaaliksi ottaen huomioon ihmisen puheen erityispiirteet.

c. Seuraavat optiset tiedonsiirtokaapelit, optiset kuidut ja varusteet niitä varten:

1. Yli 500 m pitkät optiset kuidut, jotka valmistajan ilmoituksen mukaan kykenevät kestäämään vetolujuuskokeessa yli  $2 \times 10^9$  N/m<sup>2</sup>:n tai tätä suurempaa vetorasitusta;

*Tekn. huom.:*

Vetolujuuskoe: on-line tai off-line tuotantotesti, jossa kuituun dynaamisesti kohdistetaan ennalta määrätty vetorasitus 0,5–3 metrin matkalla kuidun kulkiessa nopeudella 2–5 m/s kahden n. 150 mm läpimittaisen vetopyörän välillä ympäristön lämpötilan ollessa 293 K (20 °C) ja suhteellisen kosteuden 40 %. Vastaavia kansallisia standardeja voidaan käyttää vetolujuuskoetta suoritettaessa.

2. Optiset kaapelit ja varusteet vedenalaista käyttöä varten;

*Huom.:* 5A001.c.2 kohta ei aseta valvonnallaiseksi norminmukaisia siviilikäyttöön tarkoitettuja tietoliikennekaapeleita ja varusteita.

*Huom. 1:* Veden alla käytettävien yhdyskaapelien ja niiden liittimien osalta katso 8A002.a.3 kohta.

*Huom. 2:* Kuituoptiset aluksen rungon läpiviennit tai liittimet: katso 8A002.c kohta.

d. "Elektronisesti ohjattavat vaiheistetut ryhmäantennit", jotka toimivat yli 31 GHz:n alueella;

*Huom.:* 5A001.d kohta ei aseta valvonnallaiseksi "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmäantenneja" laskeutumisympäristöissä, joissa on ICAO:n mikroaalloilla toimivat laskeutumisympäristöt (MLS) kattavien standardien mukaiset instrumentit.

5A001 (jatkoa)

- e. Radiosuuntimalaitteet, jotka toimivat yli 30 MHz:n taajuuksilla ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekä niitä varten suunnitellut komponentit:
1. "Hetkellinen kaistanleveys" 10 MHz tai enemmän; ja
  2. Pystyvät löytämään suuntimaviivan niiden kanssa toimimattomiin radiolähettimiin, kun signaalin kesto on alle 1 ms.
- f. Häirintälaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu siten, että ne tarkoituksellisesti ja valikoivasti häiritsevät, estävät, ehkäisevät, huonontavat tai johtavat harhaan soluverkon matkaviestinpalveluja ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Simuloivat radioliityntäverkon (Radio Access Network, RAN) laitteiden toimintoja; tai
  2. Havaitsevat ja hyödyntävät käytetyn matkaviestinyhteyksikäytännön (esimerkiksi GSM) erityispiirteitä.

Huom.: GNSS-häirintälaitteiden osalta katso asetarvikeluettelo.

- g. passiiviset koherentit paikantamisjärjestelmät (ns. passiiviset tutkat) tai -laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu havaitsemaan ja jäljittämään liikkuvia esineitä mittaamalla muista lähettimistä kuin tutkista lähtöisin olevien ympäröivien radiotaajuusemissioiden heijastuksia.

Tekn. huom.:

Muut lähettimet kuin tutkat voivat olla kaupallisessa radio-, televisio- tai solukkopohjaisessa televerkkoliikenteessä käytettäviä tukiasemia.

Huom.: 5A001.g. kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

1. Radioastronomisia laitteita;
2. Järjestelmiä tai laitteita, joiden toiminta edellyttää kohteesta peräisin olevia radiolähteyksiä.

5A101 Kaukomittaus- tai kaukohallintalaitteet, mukaan lukien maalaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu 'ohjuksia' varten.

Tekn. huom.:

5A101 kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.

Huom.: 5A101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi

- a. Laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu miehitettyjä ilma-aluksia tai satelliitteja varten;
- b. Maassa sijaitsevia laitteita, jotka on suunniteltu tai muunnettu maa- tai merisovelluksia varten;
- c. Laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviili- tai ihmishenkien turvallisuutta koskevia (esimerkiksi eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja varten.

**5B1 Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

- 5B001 a. Laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A001, 5B001, 5D001 tai 5E001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

*Huom.:* 5B001.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi optisten kuitujen karakterisointilaitteita.

- b. Laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja varusteet, jotka on erityisesti suunniteltu seuraavien tietoliikenteen tai siirtolaitteiden "kehittämiseen":

1. Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan "digitaalisella siirtonopeudella", joka ylittää 15 Gbit/s,

*Tekn. huom.:*

*Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen siirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä.*

2. Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm;
- b. Suorittavat "optista vahvistusta";
- c. Käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myös optiseksi heterodyne- tai homodynetekniikaksi);
- d. Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;

*Huom.:* 5B001.b.2.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämistä" varten erityisesti suunniteltuja laitteita.

3. Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää";
4. Radiolaitteet, jotka käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256; tai
5. Laitteet, jotka käyttävät "yhteiskanavamerkinantoa" ei-liitännäisellä toimintamuodolla.

**5C1**      **Materiaalit**

Ei ole.

**5D1 Ohjelmistot**

- 5D001 a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A001 tai 5B001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai ominaisuuksien "kehittämistä", "valmistusta" tai "käyttöä" varten;
- b. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5E001 kohdassa määritellyn "teknologian" tukemiseen;
- c. Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu toteuttamaan 5A001 tai 5B001 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia, toimintoja tai piirteitä;
- d. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu seuraavien tietoliikenteen siirto- tai kytkentälaitteiden "kehittämistä" varten:
- Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 15 Gbit/s "digitaalilla kokonaissiirtonopeudella";  
*Tekn. huom.:*  
Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen siirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä.
  - Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm; tai
    - Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;*Huom.:* 5D001.d.2.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi "ohjelmistoja", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämistä" varten.
  - Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää"; tai
  - Radiolaitteet, jotka käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256.
- 5D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 5A101 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

**5E1 Teknologia**

- 5E001 a. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu 5A001, 5B001 tai 5D001 kohdassa määriteltyjen laitteiden, toimintojen tai piirteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten (toimintaa lukuun ottamatta);
- b. Seuraavat erityiset "teknologiat":
1. Satelliiteissa käytettäväksi erityisesti suunniteltujen tietoliikennelaitteiden "kehitystä" tai "tuotantoa" varten "tarvittava" "teknologia";
  2. "Kehittämistä" tai "käyttöä" varten tarvittava "teknologia" sellaisia "laser" tietoliikennetekniikoita varten, joilla kyetään automaattisesti seuraamaan signaaleja ja ylläpitämään yhteyttä ilmakehän ulkopuolella tai vedenpinnan alla;
  3. "Teknologia" sellaisten digitaalisen solukkoradiotukiaseman vastaanottolaitteiden kehittämistä varten, joiden monitaajuus-, monikanava-, monimuoto-, monikoodausalgoritmi- tai monikäytäntökäytön mahdollistavaa vastaanottokykyä voidaan muuttaa "ohjelmisto"muutoksilla;
  4. "Teknologia" hajaspektri tekniikoiden, "taajuushyppely" tekniikat mukaan lukien, "kehittämistä" varten.
- c. "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, joka on tarkoitettu seuraavien tietoliikenteen siirto- tai kytkentälaitteiden, -toimintojen tai -ominaisuuksien "kehittämiseen" tai "tuotantoon":
1. Laitteet, jotka käyttävät digitaalitekniikkaa ja jotka on suunniteltu toimimaan yli 15 Gbit/s "digitaalisen kokonaissiirtonopeudella";

*Tekn. huom.:*

*Siirtolaitteiden osalta "digitaalinen kokonaissiirtonopeus" mitataan nopeimmasta portista tai reitistä.*

2. Laitteet, jotka käyttävät "laseria" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Siirrossa käytetty aallonpituus ylittää 1 750 nm;
  - b. Suorittavat "optista vahvistusta" käyttämällä praseodyymikyllästettyjä fluoridikuituvahvistimia (PDFFA);
  - c. Käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (jota kutsutaan myös optiseksi heterodyne- tai homodynetekniikaksi);
  - d. Käyttävät aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa, jossa on enemmän kuin 8 optista kantoaaltoa yksittäisessä optisessa ikkunassa; tai
  - e. Käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 2,5 GHz;

*Huom.:* 5E001.c.2.e kohta ei aseta kaupallisten TV-järjestelmien "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa".

3. Laitteet, jotka käyttävät "optista kytkentää".
4. Radiolaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Käyttävät kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso ylittää 256; tai
  - b. Joiden tulo- tai lähtötaajuus ylittää 31,8 GHz; tai

*Huom.:* 5E001.c.4.b ei aseta valvonnalliseksi ITU:n (International Telecommunication Union) radioviestintäpalvelulle, mutta ei radiomääritykselle allokoimalla taajuuskaistalla toimiviksi suunniteltujen tai muunneltujen laitteiden "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettua "teknologiaa".

  - c. Toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja sisältävät adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman häiriösignaalien vaimennuksen kun 15 dB;

5. Laitteet, jotka käyttävät "yhteiskanavamerkinantoa" ei-liitännäisellä toimintamuodolla.

5E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A101 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä", "tuotantoa" ja "käyttöä" varten.

## 2 OSA

**"TIEDON SUOJAUS"**

Huom. 1: "Tiedonsuojaus"-laitteiden, -"ohjelmistojen", järjestelmien, sovelluskohtaisten "elektronisten kokoonpanojen", moduulien, integroitujen piirien, komponenttien tai toimintojen valvonnanalaisuus määritellään 5 ryhmän 2 osassa, myös siinä tapauksessa, että ne ovat muiden laitteiden komponentteja tai niiden "elektronisia kokoonpanoja".

Huom. 2: 5 ryhmä – 2 osa ei aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka ovat käyttäjän hallussa hänen henkilökohtaista käyttöönsä varten.

Huom. 3: Salausta koskeva huomautus

5A002 ja 5D002 kohdat eivät aseta valvonnanalaiseksi tuotteita, jotka täyttävä kaikki seuraavat edellytykset:

- a. Ovat yleisesti yleisön ostettavissa rajoituksitta vähittäismyymintipisteissä varastosta jollain seuraavista tavoista:
  1. Käsikauppa;
  2. Postimyynti;
  3. Elektronisesti tapahtuva myynti; tai
  4. Puhelinmyynti;
- b. Käyttäjä ei voi helposti muuntaa salauksen toiminnallisuutta;
- c. Tuotteet on suunniteltu käyttäjän käyttöönotettaviksi ilman merkittävää toimittajan tukea; ja
- d. Tuotteita koskevat yksityiskohtaiset tiedot ovat tarvittaessa saatavilla ja pyynnöstä esitetään toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, johon viejä on sijoittautunut, jotta voidaan varmistaa edellä a–c kohdassa kuvattujen ehtojen täyttyminen.

Tekn. huom.:

5 ryhmä – 2 osa, pariteettibittejä ei lasketa avaimen pituuteen.

**5A2 Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

5A002 a. Seuraavat järjestelmät, laitteet, sovelluskohtaiset "elektroniset kokoonpanot", moduulit tai integroidut piirit "tiedon suojausta" varten ja muut niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: Satelliitinavigointijärjestelmien vastaanottolaitteet, jotka sisältävät tai käyttävät salauksen purkua (so. GPS tai GLONASS): katso 7A005 kohta.

1. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään digitaalitekniikkaan perustuvaa "salausta" suorittamaan mitä tahansa muuta salaustoimintaa kuin autentikointia tai digitaalista allekirjoitusta ja jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Tekn. huom.:

1. Autentikointi ja digitaalinen allekirjoitus sisältävät niihin liittyvät avaimenhallintatoiminnot.
2. Autentikointiin sisältyy kaikki sellainen valvonta, jossa ei salata tiedostoja tai tekstiä lukuun ottamatta sitä, mikä liittyy suoraan salasanojen, henkilökohtaisten tunnusnumeroiden tai vastaavan tiedon suojaamiseen luvattoman pääsyn estämiseksi.

5A002 a. 1. (jatkoa)

3. "Salaus" ei sisällä "kiinteitä" tiedon pakkaus- tai koodaustekniikoita.

Huom.: 5A002.a.1 kohtaan sisältyvät laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "salausta", jossa digitaalitekniikan soveltamisessa käytetään analogisia periaatteita.

a. "Symmetrinen algoritmi", joka käyttää yli 56 bitin avaimenpituutta; tai

b. "Epäsymmetrinen algoritmi", jossa algoritmin turvallisuus perustuu johonkin seuraavista:

1. Yli 512 bitin kokonaislukujen tekijöihin jako (esimerkiksi RSA);

2. Diskreettien logaritmien laskenta äärellisen kannan suuremmassa kuin 512 bitin yksikköryhmässä (esim. Diffie-Hellman  $Z/pZ$ :ssä); tai

3. Diskreetit logaritmit muissa kuin 5A002.a.1.b.2 kohdassa mainitussa suuremmassa kuin 112 bitin ryhmässä (esimerkiksi Diffie-Hellman elliptisellä käyrällä);

2. Jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja;

3. Ei käytössä;

4. Jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vähentämään informaatiota kuljettavien signaalien paljastavia vuotoja enemmän kuin on tarpeen terveyden, turvallisuuden tai elektromagneettisia häiriöitä koskevien standardien vuoksi;

5. Muut kuin 5A002.a.6 kohdassa määritellyt, jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään salaustekniikkaa "hajaspektri"järjestelmien hajautuskoodin, mukaan lukien "taajuushyppely"järjestelmän hyppelykoodi, tuottamiseksi;

6. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään salaustekniikkaa kanavointi-, sekoitus- tai verkko-tunnuskoodien tuottamiseksi ultralaajakaistamodulointitekniikoita käyttäviä järjestelmiä varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a. Kaistanleveys yli 500 MHz; tai

b. "Suhteellinen kaistanleveys" 20 prosenttia tai enemmän;

7. Ei käytössä;

8. Tiedonsiirtokaapelijärjestelmät, jotka on suunniteltu tai muunnettu salakuuntelun ilmaisemiseen mekaanista, sähköistä tai elektronista tapaa käyttäen.

9. Jotka on suunniteltu tai muunnettu käyttämään "kvanttisalausta".

Tekn. huom.:

"Kvanttisalaus" tunnetaan myös nimellä kvanttiavaimen jakaminen (QKD).

Huom.: 5A002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. "Henkilökohtaisia älykortteja":

1. Jos salaus on rajoitettu koskemaan niiden käyttöä laitteissa ja järjestelmissä, jotka tämän huomautuksen b-f kohdan mukaan ovat valvonnan ulkopuolella; tai

2. Yleisten julkiseen käyttöön tarkoitettujen sovellusten osalta, jos käyttäjä ei voi vaikuttaa salaukseen ja salaus on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu kortille tallennettujen henkilötietojen suojaamiseen.

Huom.: Jos "henkilökohtainen älykortti" soveltuu useisiin toimintoihin, kunkin toiminnon valvonta arvioidaan erikseen.

- 5A002 a. Huom.: (jatkoa)
- b. Kuluttajille tarkoitettuja yleisradiolähetysten, maksutelevision tai vastaavien rajoitetun yleisön lähetysten vastaanottolaitteita, joissa ei ole digitaalista salausta, lukuun ottamatta niitä, joita käytetään laskutusta koskevia tai ohjelmakohtaisia tietoja takaisin yleisradiolähetysten lähettäjiille;
  - c. Laitteet, joiden salauskykyyn käyttäjä ei voi vaikuttaa ja jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu mahdollistamaan jotain seuraavista:
    - 1. Kopioinnilta suojatun "ohjelmiston" käyttäminen;
    - 2. Pääsy johonkin seuraavista:
      - a. Kopioinnilta suojattuihin, vain luettavissa oleviin välineisiin tallennettuihin sisältöihin; tai
      - b. Salatussa muodossa välineille tallennettuun informaatioon (esimerkiksi tekijänoikeuksien suojaamisen yhteydessä), kun väline tarjotaan myytäväksi yleisölle täysin samassa muodossa;
    - 3. Tekijänoikeudella suojattujen audio/video-tietojen kopioinnin valvonta; tai
    - 4. Salaus ja/tai salauksen purku, jonka tarkoituksena on suojata puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien suunnittelua varten tarkoitettuja kirjastoja, suunnitteluparametrejä sekä niihin liittyviä tietoja;
  - d. Salauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja rajoitettu pankki- tai 'rahaliikenteen' laitteisiin;  
Tekn. huom.:  
'Rahaliikenne' 5A002 kohdan huomautuksessa d sisältää maksujen tai luottojen keräämisen ja suoritukset.
  - e. Siviilikäyttöön tarkoitettuja (esim. kaupallisissa solukkoradiopuhelinjärjestelmissä käytettäviä) salaus-toimintoja sisältäviä kannettavia tai siirrettäviä radiopuhelimia, jotka eivät pysty päästä-päähän-salaukseen;
  - f. Langattomat puhelimet, jotka eivät pysty päästä-päähän-salaukseen ja joiden suurin tehollinen vahvistamaton langaton toimintaetäisyys (eli yksittäinen linkitön hyppy päätteen ja tukiaseman välillä) on valmistajan antamien tietojen mukaan alle 400 metriä.

**5B2****Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

5B002

- a. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu:
  1. 5A002, 5B002, 5D002 tai 5E002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai toimintojen "kehittämistä" varten, mukaan lukien mittaus- tai testauslaitteet;
  2. 5A002, 5B002, 5D002 tai 5E002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai toimintojen "tuotantoa" varten, mukaan lukien mittaus-, testaus-, huolto- tai tuotantolaitteet;
- b. Mittalaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 5A002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen "tiedon suojaus"toimintojen arviointia ja kelpuuttamista varten.

**5C2      Materiaalit**

Ei ole.

**5D2 Ohjelmistot**

- 5D002
- a. 5A002, 5B002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot";
  - b. 5E002 kohdassa määriteltyä "teknologiaa" tukemaan erityisesti suunnitellut tai muunnetut "ohjelmistot";
  - c. Seuraavat erityiset "ohjelmistot":
    1. "Ohjelmistot", joilla on 5A002 tai 5B002 kohdassa määriteltyjen laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat niiden toimintoja;
    2. "Ohjelmistot" 5D002.c.1 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" sertifiointia varten.

Huom.: 5D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. "Ohjelmistoja", joita tarvitaan 5A002 kohdan huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolelle jätettyjen laitteiden "käytössä";
- b. "Ohjelmistoja", jotka mahdollistavat 5A002 huomautuksen mukaan valvonnan ulkopuolella olevien laitteiden toimintoja.

**5E2      Teknologia**

5E002      "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 5A002, 5B002 tai 5D002 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmien" "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

**RYHMÄ 6**  
**ANTURIT JA "LASERIT"**



**6A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

## 6A001 Akustiikka

a. Seuraavat meriakustiset järjestelmät, laitteet tai erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

1. Seuraavat aktiiviset (lähettävät tai lähettävät ja vastaanottavat) järjestelmät, laitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

*Huom.:* 6A001.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a. Vertikaalisesti laitteesta alaspäin toimivia syvyysluotaimia, jotka eivät sisällä  $\pm 20$  astetta ylittävää keilaustoimintoa ja ovat rajoitetut mittaamaan veden syvyyttä tai etäisyyttä uponneisiin tai hautautuneisiin kohteisiin tai paikallistamaan kalaparvia;

b. Seuraavia akustisia majakoita:

1. Akustiset hätämajakat;

2. Äänimajakat, jotka on erityisesti suunniteltu vedenalaisen aseman paikantamista tai siihen palaamista varten.

a. Leveäpeittoiset batymetriset kartoitusjärjestelmät merenpohjan topografian kartoitusta varten, joilla on kaikki seuraavat:

1. Suunniteltu mittaamaan vertikaalisesta suunnasta 20 astetta ylittävässä kulmassa;

2. Suunniteltu mittaamaan syvyyksiä yli 600 metriä vedenpinnan alla; ja

3. Suunniteltu mahdollistamaan jonkin seuraavista:

a. Useiden säteiden yhdistämisen, joista jokin on alle 1,9 astetta; tai

b. Parempia kuin 0,3 %:n veden syvyytiedon tarkkuuksia peittoalueella peiton yksittäisten mittausten keskiarvona laskettuna;

b. Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista:

1. Lähetystaajuus alle 10 kHz;

2. Äänenpaineen taso yli 224 dB (vertailuarvo 1  $\mu\text{Pa}$  1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 10 kHz:n ja 24 kHz:n välisellä taajuusalueella;

3. Äänenpaineen taso ylittää 235 dB (vertailuarvo 1  $\mu\text{Pa}$  1 m:ssä) laitteilla, joiden toimintataajuus on 24 kHz:n ja 30 kHz:n välisellä taajuusalueella;

4. Muodostavat minkä tahansa akselin suunnassa alle 1:n asteen säteitä ja toimintataajuus on vähemmän kuin 100 kHz;

5. Suunniteltu toimimaan 5 120 m ylittävällä selvän näytön etäisyydellä; tai

6. Suunniteltu kestäämään normaalissa käytössä painetta yli 1 000 metrin syvyyksissä ja sisältävät muuntimia, joilla on jokin seuraavista:

a. Dynaaminen kompensointi painetta vastaan; tai

b. Sisältävät muunninelementissä jotain muuta kuin lyijyzirkonaattititanaattia;

c. Akustiset projektorit, mukaan lukien muuntimet, jotka sisältävät yksittäin tai suunnitellussa kombinaatiossa toimivia piezo-sähköisiä, magnetostriktiivisiä, sähköstriktiivisiä, sähködynaamisia tai hydraulisia elementtejä, ja joilla on jokin seuraavista:

*Huom. 1:* Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen akustisten projektorien, muuntimien mukaan lukien, valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

6A001 a. 1. c. (jatkoa)

Huom. 2: 6A001.a.1.c kohta ei aseta valvonnanalaiseksi elektronisia äänilähteitä, jotka suuntaavat ääntä vain pystysuunnassa, tai mekaanisia (esim. ilmatykki tai höyryshokkitykki) tai kemiallisia (esim. räjähdde) äänilähteitä.

1. Hetkellisesti säteilevän 'akustisen tehon tiheys' ylittää 0,01 mW/mm<sup>2</sup>/Hz laitteilla, jotka toimivat alle 10 kHz:n taajuuksilla;
2. Jatkuvasti säteilevän 'akustisen tehon tiheys' ylittää 0,001 mW/mm<sup>2</sup>/Hz laitteilla, jotka toimivat alle 10 kHz:n taajuuksilla; tai

Tekn. huom.:

'Akustisen tehon tiheys' saadaan jakamalla akustinen lähtöteho säteilevän pinnan pinta-alan ja toimintataajuuden tulolla.

3. Sivukeilavaimennus ylittää 22 dB;
- d. Akustiset järjestelmät, laitteet ja erityisesti suunnitellut komponentit pinta-alusten tai vedenalaisten alusten sijainnin määrittämistä varten, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n etäisyydellä paikannustarkkuudella, joka on parempi kuin 10 m rms (tehollisarvo) 1 000 m:n etäisyydellä mitattuna;

Huom.: 6A001.a.1.d kohta sisältää:

- a. Laitteet, jotka käyttävät koherenttia "signaalinkäsittelyä" kahden tai useamman majakan ja pinta-aluksen tai vedenalaisen aluksen kuljettaman hydrofoniyksikön välillä;
- b. Laitteet, jotka kykenevät automaattisesti korjaamaan äänen nopeuden etenemisvirheet jonkin pisteen laskemista varten.

2. Seuraavat passiiviset (vastaanottavat, siitä riippumatta, liittyvätkö ne normaalissa käytössä erillisiin aktiivisiin laitteisiin) järjestelmät, laitteet tai erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

- a. Hydrofonit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huom.: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen hydrofonien valvonnanalaisuus määräytyy kyseisten muiden laitteiden valvonnanalaisuuden mukaan.

1. Sisältävät yhtenäisiä taipuisia anturielementtejä;
2. Sisältävät taipuisia kokoonpanoja erillisistä anturielementeistä, joiden läpimitta tai pituus on vähemmän kuin 20 mm ja etäisyys toisistaan vähemmän kuin 20 mm;
3. Sisältävät jonkin seuraavista anturielementeistä:
  - a. Optisia kuituja;
  - b. 'Pietosähköisiä polymeerikalvoja', lukuun ottamatta polyvinylideenifluoridia (PVDF) ja sen sekapolymeereja (P(VDF-TrFE) ja P(VDF-TFE)); tai
  - c. 'Taipuisia pietosähköisiä komposiitteja';
4. 'Hydrofonin herkkyys' ilman kiihtyvyysskompensointia on parempi kuin - 180 dB missä tahansa syvyydessä;
5. Yli 35 metrin syvyyksissä toimimaan suunnitellussa hydrofonissa, joissa on kiihtyvyysskompensointi; tai
6. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä;

Tekn. huom.:

1. Anturielementti 'pietosähköinen polymeerikalvo' koostuu polaroidusta polymeerikalvosta, joka on venytetty ja kiinnitetty tukikehykseen tai -rullaan (tuurna).
2. Anturielementti 'taipuisa pietosähköinen komposiitti' koostuu pietosähköisistä keraamisista hiukkasista tai kuiduista, jotka on yhdistetty sähköä eristävään ja ääntä läpäisevään kumiin, polymeeriin tai epoksyhdisteeseen, jossa yhdiste on anturielementin kiinteä osa.

6A001 a. 2. a. (jatkoa)

3. 'Hydrofonin herkkyys' määritellään ulostulojännitteen rms-arvon ja 1 V:n rms vertailuarvon suhteen kaksikymmenkertaisena kymmenlogaritmina, kun hydrofonianturi, ilman etuvahvistinta, asetetaan akustiseen tasoaltokenttään, jonka rms paine on 1  $\mu\text{Pa}$ . Esimerkiksi – 160 dB:n hydrofoni (vertailuarvo 1 V mikropascalialta kohti) antaisi sellaisessa kentässä  $10^{-8}$  V:n ulostulojännitteen, kun taas toinen – 180 dB:n herkkyydellä antaisi vain  $10^{-9}$  V:n ulostulojännitteen. Siten – 160 dB on parempi kuin – 180 dB.

b. Hinattavat akustiset hydrofonijärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Hydrofoniryhmien välinen etäisyys on vähemmän kuin 12,5 m tai ne "voidaan muuntaa" siten, että hydrofoniryhmien välinen etäisyys on vähemmän kuin 12,5 m;
2. Suunniteltu tai 'voidaan muuntaa' toimimaan yli 35 metrin syvyyksissä;

Tekn. huom.:

6A001.a.2.b.1 ja 2 kohdassa termi 'voidaan muuntaa' tarkoittaa varautumista mahdollisuuteen muuttaa kaapelointia tai kytkentöjä hydrofoniryhmien välisen etäisyyden tai niiden toimintasyvyyden rajojen muuttamiseksi. Näitä varautumisia ovat: varakaapelointi, joka ylittää 10 % kaapelien lukumäärästä, hydrofoniryhmien välisen etäisyyden sovitushkot tai sisäiset syvyyden rajoituslaitteet, jotka ovat säädettäviä tai jotka ohjaavat useampaa kuin yhtä hydrofoniryhmää.

3. 6A001.a.2.d kohdan mukaan valvonnanalaiset suunta-anturit;
4. Pitkittäissuunnassa lujitetut järjestelmäsukat;
5. Kokoonpantu järjestelmä on läpimitaltaan vähemmän kuin 40 mm;
6. Multipleksoidut hydrofoniryhmien signaalit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 35:n syvyyksissä tai asetettava tai irrotettava syvyyksianturilaitte yli 35 m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten; tai
7. Hydrofoniominaisuudet ovat 6A001.a.2.a kohdassa määriteltyjä;

c. Hinattavia akustisia hydrofonijärjestelmiä varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;

d. Suunta-anturit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Tarkkuus on parempi kuin  $\pm 0,5$  astetta; ja
2. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissä tai joilla on säädettävä tai irrotettava syvyyksianturilaitte yli 35 m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten;

e. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Se sisältää 6A001.a.2.a kohdassa määriteltyjä hydrofoneja; tai
2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Suunniteltu toimimaan yli 35 m:n syvyyksissä tai asetettava tai irrotettava syvyyksianturilaitte yli 35 m:n syvyyksissä tapahtuvaa toimintaa varten; ja
  - b. Voidaan vaihtaa hinattavien akustisten hydrofonijärjestelmämoduulien kanssa toiminnallisesti.

f. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmiä varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;

b. Nopeuskorrelaatiota suorittavat ääniluotainlokot, jotka on suunniteltu mittaamaan niitä kuljettavan aluksen horisontaalista nopeutta merenpohjan suhteen 500 m ylittävällä aluksen ja merenpohjan välisillä etäisyyksillä.

6A002 Optiset anturit

**Huom.: KATSO MYÖS 6A102 KOHTA.**

a. Seuraavat optiset ilmaisimet:

Huom.: 6A002.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi germanium- tai piipohjaisia valoherkkiä komponentteja.

Huom.: Piihin tai muuhun aineeseen pohjautuvien mikrobolometrien ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet” määritellään ainoastaan 6A002.a.3.f kohdassa.

1. Seuraavat ”avaruuskelpoiset” solid-state-ilmaisimet:

a. ”Avaruuskelpoiset” solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:

1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 300 nm; ja
2. Vaste yli 400 nm:n aallonpituuksilla vähemmän kuin 0,1 % vastehuipusta;

b. ”Avaruuskelpoiset” solid-state ilmaisimet, joilla on kaikki seuraavat:

1. Vastehuippu aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm, mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen ”aikavakio” 95 ns tai vähemmän;

c. ”Avaruuskelpoiset” solid-state ilmaisimet, joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

2. Seuraavat kuvanvahvistinputket ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. Kuvanvahvistinputket, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli 1 050 nm;
2. Elektronista kuvanvahvistusta varten mikrokanavalevy, jonka reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on 12  $\mu\text{m}$  tai vähemmän; ja
3. Jokin seuraavista valokatodeista:
  - a. S-20-, S-25- tai monialkaalivalokatodit, joiden valoherkkyys ylittää 350  $\mu\text{A}/\text{lm}$ ;
  - b. GaAs- tai GaInAs-valokatodit; tai
  - c. Muut III–V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;

Huom.: 6A002.a.2.a.3.c kohtaa ei sovelleta yhdistepuolijohteisiin perustuviin valokatodeihin, joiden maksimi säteilyherkkyys on 10  $\text{mA}/\text{W}$  tai vähemmän.

b. Seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:

1. Mikrokanavalevyt, joiden reikätiheys (keskipisteiden välinen etäisyys) on 12  $\mu\text{m}$  tai vähemmän;
2. GaAs- tai GaInAs-valokatodit;
3. Muut III–V yhdistepuolijohteisiin perustuvat valokatodit;

Huom.: 6A002.a.2.b.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yhdistepuolijohteisiin perustuvia valokatodeja, joiden maksimi säteilyherkkyys on 10  $\text{mA}/\text{W}$  tai vähemmän.

6A002 a. (jatkoa)

3. Seuraavat ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet”:

Huom.: Piihin tai muuhun aineeseen pohjautuvien mikrobolometrien ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet” määritellään ainoastaan 64A002.a.3.f kohdassa.

Tekn. huom.:

1. Lineaarisia tai kaksikulotteisia monielementtisiä ilmaisinerakenteita pidetään ”fokusoivina tasorakenteina”;
2. 6A002.a.3 kohdassa ’ristiskannaussuunta’ määritellään ilmaisinelementtien lineaarisen rakenteen suunnaksi akseliksi ja ’skannaussuunta’ ilmaisinelementtien lineaarista rakennetta vasten kohtisuorassa olevaksi akseliksi.

Huom. 1: 6A002.a.3 kohta sisältää valojohtavat ja valosähköiset rakenteet.

Huom. 2: 6A002.a.3 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Monielementtisiä (korkeintaan 16 elementtiä sisältäviä) koteloituja valojohtavia pareja, joissa käytetään joko lyijysulfidia tai lyijyselenidiä;
- b. Pyrosähköisiä ilmaisimia, jotka perustuvat joihinkin seuraavista:
  1. Triglysiinisulfaatti ja sen muunnokset;
  2. Lyijylantaanizirkoniumtitanaatti ja sen muunnokset;
  3. Litiumtantalaaatti;
  4. Polyvinyyliideenifluoridi ja sen muunnokset; tai
  5. Strontiumbariumniobaatti ja sen muunnokset;

a. Ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittäisten elementtien vastehiippu on aallonpituusalueella, joka on yli 900 nm mutta ei yli 1 050 nm; ja
2. Vasteen ”aikavakio” on vähemmän kuin 0,5 ns;

b. Ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet”, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Yksittäisten elementtien vastehiippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 050 nm mutta ei yli 1 200 nm; ja
2. Vasteen ”aikavakio” on 95 ns tai vähemmän;

c. Ei-”avaruuskelpoiset” epälineaariset (kaksikulotteiset) ”fokusoivat tasorakenteet”, joissa yksittäisten elementtien vastehiippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 30 000 nm;

Huom.: Piihin tai muuhun aineeseen pohjautuvien mikrobolometrien ei-”avaruuskelpoiset” ”fokusoivat tasorakenteet” määritellään ainoastaan 64A002.a.3.f kohdassa.

d. Ei-”avaruuskelpoiset” lineaariset (yksikulotteiset) ”fokusoivat tasorakenteet”, joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Yksittäisten elementtien vastehiippu on aallonpituusalueella, joka on yli 1 200 nm, mutta ei yli 3 000 nm; ja
2. Jokin seuraavista ominaisuuksista:
  - a. Ilmaisinelementin skannaussuunnan mitan suhde ilmaisinelementin ristiskannaussuunnan mittaan vähemmän kuin 3,8; tai
  - b. Signaalin prosessointi elementissä (SPRITE);

e. Ei-”avaruuskelpoiset” lineaariset (yksikulotteiset) ”fokusoivat tasorakenteet”, joissa yksittäisten elementtien vastehiippu on aallonpituusalueella, joka on yli 3 000 nm, mutta ei yli 30 000 nm.

- 6A002 a. 3. (jatkoa)
- f. 'Mikrobolometri'-aineeseen pohjautuvat ei-"avaruuskelpoiset" epälineaariset (kaksiulotteiset) "fokusoivat taserakenteet", joissa yksittäisten elementtien suodattamaton vaste on aallonpituusalueella, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin 8 000 nm mutta ei suurempi kuin 14 000 nm.
- Tekn. huom.:
- 6A002.a.3.f kohdassa 'mikrobolometri' määritellään lämpökuvanturiksi, jota infrapunasäteilyn absorptioon aiheuttaman lämpötilamuutoksen vuoksi käytetään tuottamaan mitä tahansa käyttökelpoista signaalia.
- b. Etäishavainnointisovelluksiin suunnitellut "yksispektriset kuvannusanturit" ja "monispektriset kuvannusanturit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Hetkellinen näkökenttä (IFOV) on vähemmän kuin 200  $\mu$ rad (mikroradiaania); tai
  2. Ne on määritelty toimimaan aallonpituusalueella, joka on yli 400 nm, mutta ei yli 30 000 nm, ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - a. Ne antavat kuvatiedon ulostulossaan digitaalisessa muodossa; ja
    - b. Ne ovat jotain seuraavista:
      1. "Avaruuskelpoisia"; tai
      2. Ne on suunniteltu ilmassa tapahtuvaan toimintaan suunniteltuja ja käyttävät muita kuin pii-ilmaisimia, joiden IFOV on vähemmän kuin 2,5 mrad (milliradiaania);
- c. 'Suorakatselu'kuvauslaitteet, jotka toimivat spektrin näkyvällä tai infrapuna-alueella ja jotka sisältävät jonkin seuraavista:
1. 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia; tai
  2. 6A002.a.3 kohdassa määriteltyjä "fokusoivia taserakenteita";
- Tekn. huom.:
- Termi 'suorakatselu' viittaa kuvauslaitteisiin, jotka toimivat spektrin näkyvällä tai infrapuna-alueella ja jotka näyttävät visuaalisen kuvan tarkkailijalle muuttamatta kuvaa sähköiseksi signaaliksi televisionäyttöä varten, ja jotka eivät voi tallettaa kuvaa valokuvana, elektronisesti tai millään muullakaan tavalla.
- Huom.: 6A002.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraavia laitteita, jotka sisältävät muita kuin GaAs- tai GaInAs-valokatodeja:
- a. Teollisuus- tai siviilikäyttöön tarkoitetut murtohälyttimet, liikenteessä tai teollisuudessa käytettävät liikkeen ohjaus- tai laskentajärjestelmät;
  - b. Lääketieteelliset laitteet;
  - c. Teollisuuden laitteet, joita käytetään materiaalien ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;
  - d. Teollisten uunien liekinilmaisimet;
  - e. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokäyttöön.
- d. Seuraavat optisten anturien toimintaa tukevat erikoiskomponentit:
1. "Avaruuskelpoiset" kryojäähdyttimet;
  2. Seuraavat ei-"avaruuskelpoiset" kryojäähdyttimet, joiden kylmälähteen lämpötila on alle 218 K ( $-55^{\circ}\text{C}$ ):
    - a. Suljetulla kierrolla varustetut, joiden määritelty keskimääräinen vioittumisaika (MTTF) tai keskimääräinen vikaväli (MTBF) ylittää 2 500 tuntia;
    - b. Itsesäätävät Joule-Thomson (JT) -minijäähdyttimet, joiden ulkolämpimitta on vähemmän kuin 8 mm;
  3. Optiset anturointikuidut, jotka on erityisesti valmistettu, joko koostumuksellisesti tai rakenteellisesti tai pinnoittamalla, akustisesti, termisesti, inertiaalisesti, sähkömagneettisesti tai ydinsäteilylle herkiksi;
- e. "Avaruuskelpoiset" "fokusoivat taserakenteet", joissa on enemmän kuin 2 048 elementtiä ryhmää kohti ja joiden huippuvaste on aallonpituusalueella, joka on yli 300 nm, mutta ei yli 900 nm.

6A003 Kamerat

**Huom.: KATSO MYÖS 6A203 KOHTA.**

Huom.: Kamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön: katso 8A002.d ja 8A002.e kohta.

a. Seuraavat instrumentointikamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Huom.: 6A003.a.3–6A003.a.5 kohdassa määritellyt moduulirakenteiset instrumentointikamerat on arvioitava niiden suurimman suorituskyvyn mukaan käyttäen saatavilla olevia ohjelmalisäkkeitä kameran valmistajan eritelmien mukaisesti.

1. Suurinopeuksiset elokuvakamerat, jotka käyttävät mitä tahansa filmikokoa välillä 8 mm–16 mm, mukaan lukien ne kamerat, joissa filmiä siirretään jatkuvasti kuvausajanjakson aikana, ja jotka kykenevät ottamaan yli 13 150 kuvaa sekunnissa;

Huom.: 6A003.a.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi siviilikäyttöön tarkoitettuja elokuvakameroita.

2. Mekaaniset suurinopeuksiset kamerat, joissa filmi ei liiku ja jotka kykenevät ottamaan yli 1 000 000 kuvaa sekunnissa täydellä 35 mm:n filmin kuvan korkeudella tai suhteessa suuremmilla nopeuksilla, kun kuvan korkeus on pienempi tai suhteessa pienemmillä nopeuksilla, kun kuvan korkeus on suurempi;

3. Mekaaniset tai elektroniset juovakamerat, joiden piirtonopeus ylittää 10 mm/µs;

4. Elektroniset yksittäiskuvakamerat, joiden nopeus ylittää 1 000 000 kuvaa sekunnissa;

5. Elektroniset kamerat, joilla on kaikki seuraavat:

a. Elektronisen sulkimen nopeus (avainnuskyyky) on vähemmän kuin 1 µs täyttä kuvaa kohti; ja

b. Luettavuusaika sallii yli 125 täyden kuvan nopeuden sekunnissa;

6. Ohjelmalisäkkeet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a. Ne on erityisesti suunniteltu 6A003.a kohdassa määriteltyjä moduulirakenteisia instrumentointikameroita varten; ja

b. Niiden ansiosta nämä kamerat saavuttavat valmistajan eritelmien mukaisesti 6A003.a.3, 6A003.a.4 tai 6A003.a.5 kohdassa määritellyt ominaisuudet.

b. Seuraavat kuvannuskamerat:

Huom.: 6A003.b kohta ei aseta valvonnanalaiseksi televisio- tai videokameroita, jotka on erityisesti suunniteltu televisiolähetystä varten.

1. Solid-state-antureita sisältävät videokamerat, joiden vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 30 000 nm ja joilla on kaikki seuraavista:

a. Jokin seuraavista:

1. Enemmän kuin  $4 \times 10^6$  "aktiivista pikseliä" solid-state-matriisia kohti yksivärikameroissa (mustavalkokameroissa);

2. Enemmän kuin  $4 \times 10^6$  "aktiivista pikseliä" solid-state-matriisia kohti värikameroissa, joissa on kolme solid-state-matriisia; tai

3. Enemmän kuin  $12 \times 10^6$  aktiivista pikseliä solid-state-matriisia kohti värikameroissa, joissa on yksi solid-state-matriisi; ja

b. Jokin seuraavista:

1. 6A004.a kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut optiset peilit;

2. 6A004.d kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut optiikan ohjauslaitteet; tai

3. Mahdollisuus tallentaa sisäisesti tuotettuja kamerapaikannustietoja.

6A003 b. 1. (jatkoa)

Tekn. huom.:

1. Tässä kohdassa digitaaliset videokamerat olisi arvioitava liikkuvan kuvankaappaukseen käytettyjen "aktiivisten pikselien" enimmäismäärän perusteella.
  2. Tässä kohdassa tarkoitetaan 'kamerapaikannustiedoilla' tietoja, joita tarvitaan määrittämään kameran tähtäysviivan suunta maahan nähden. Tähän sisältyy: 1) vaakasuora kulma, jonka kameran tähtäysviiva muodostaa suhteessa maan magneettikentän suuntaan ja 2) pystysuora kulma kameran tähtäysviivan ja maan horisontin välillä.
2. Pyyhkäisevät kamerat ja pyyhkäisevät kamerajärjestelmät, joilla on kaikki seuraavat:
    - a. Vastehuippu on aallonpituusalueella, joka on yli 10 nm, mutta ei yli 30 000 nm;
    - b. Lineaarisia ilmaisinyhmiä, joissa on enemmän kuin 8 192 elementtiä ryhmää kohti; ja
    - c. Yhdessä suunnassa mekaaninen pyyhkäisy;
  3. Kamerat, jotka sisältävät 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia;
  4. 'Kamerat', jotka sisältävät joitakin seuraavista "fokusoivista tasorakenteista":
    - a. "fokusoivia tasorakenteita", jotka 6A002.a.3.a–6A002.a.3.e kohdat asettavat valvonnanalaiseksi; tai
    - b. "fokusoivia tasorakenteita", jotka 6A002.a.3.f kohta asettaa valvonnanalaiseksi.

Huom. 1: 6A003.b.4 kohdassa kuvatut 'kamerat' sisältävät "fokusoivia tasorakenteita", jotka yhdistettyinä näyttöpiiriin lisäksi riittävään signaalinkäsittelyelektroniikkaan mahdollistavat vähimmillään analogisen tai digitaalisen signaalin ulostulon, kun teho on kytketty.

Huom. 2: 6A003.b.4.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraaviin käyttötarkoituksiin suunniteltuja kuvannuskameroita, joissa on sellaisia lineaarisia "fokusoivia tasorakenteita", jotka sisältävät 12 elementtiä tai vähemmän, ja joissa ei käytetä aikaviivästystä ja integrointia elementeissä:

- a. Teollisuus- tai siviilikäyttöön tarkoitetut murtohälyttimet, liikenteessä tai teollisuudessa käytettävät liikkeen ohjaus- tai laskentajärjestelmät;
- b. Teollisuuden laitteet, joita käytetään rakennusten, laitteiden tai teollisuusprosessien lämpövirtojen havaitsemiseen tai seuraamiseen;
- c. Teollisuuden laitteet, joita käytetään materiaalien ominaisuuksien tarkastukseen, lajitteluun tai analysointiin;
- d. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokäyttöön; tai
- e. Lääketieteelliset laitteet.

Huom. 3: 6A003b.4.b ei aseta valvonnanalaiseksi kuvannuskameroita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Enimmäiskuvataajuus yhtä suuri tai pienempi kuin 9 Hz;
- b. Kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Horisontaalinen tai vertikaalinen hetkellinen näkökenttä (IFOV) on vähintään 10 mrad/pixel (millidariaania/pikseli);
  2. Linssi, jonka polttoväli on kiinteä ja jota ei ole suunniteltu poistettavaksi;
  3. Ei 'suorakatselunäyttöä', ja

6A003 b. 4. Huom. 3: b. (jatkoa)

4. Jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Ei mahdollisuutta saada katselukelpoista kuvaa havaitusta näkökentästä; tai
- b. Kamera on suunniteltu vain yhtä sovellusta varten, eikä sitä ole suunniteltu käyttäjän muunnettavaksi; tai
- c. Kamera on erityisesti suunniteltu asennettavaksi vähemmän kuin kolme tonnia (kokonaispaino) painavaan siviilihenkilöitä kuljettavaan maa-ajoneuvoon ja sillä on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Voidaan käyttää ainoastaan, jos se on asennettu johonkin seuraavista:
    - a. Siviilihenkilöitä kuljettavaan maa-ajoneuvoon, johon se on tarkoitettu; tai
    - b. Erityisesti suunniteltuun valtuutettuun huoltotestiympäristöön; ja
  2. Sisältää aktiivisen mekanismin, joka estää kameraa toimimasta, kun se poistetaan ajoneuvosta, johon se on tarkoitettu.

Tekn. huom.:

1. Kohdan 6A003.b.4 huomautuksessa 3.b tarkoitettu hetkellinen näkökenttä (IFOV) on alempi luku horisontaalisen tai vertikaalisen IFOV:n arvoista.

Horisontaalinen IFOV = horisontaalinen näkökenttä (FOV)/horisontaalisten anturielementtien lukumäärä.

Vertikaalinen IFOV = vertikaalinen näkökenttä (FOV)/vertikaalisten anturielementtien lukumäärä.

2. Kohdan 6A003.b.4 huomautuksessa 3.b tarkoitettu 'suorakatselu' tarkoittaa infrapunaspektrillä toimivaa kuvannuskameraa, joka näyttää visuaalisen kuvan inhimilliselle tarkkailijalle minkä tahansa valoturvamekanismin sisältävällä silmikkotyypisellä mikronäytöllä.

6A004 Optiikka

a. Seuraavat optiset peilit (heijastimet):

Huom.: Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen optisten peilien osalta katso 3B001 kohta.

1. "Muotoaan muuttavat peilit", joissa on yhtenäiset tai moni-elementtiset pinnat ja joissa peilipinnan osia voidaan dynaamisesti asetella uudelleen yli 100 Hz:n nopeudella, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut osat;
  2. Kevyet monoliittiset peilit, joiden keskimääräinen "ekvivalenttitiheys" on vähemmän kuin 30 kg/m<sup>2</sup> ja joiden kokonaispaino ylittää 10 kg;
  3. Kevyet "komposiitti"- tai vaahtopeilirakenteet, joiden keskimääräinen "ekvivalenttitiheys" on vähemmän kuin 30 kg/m<sup>2</sup> ja joiden kokonaispaino ylittää 2 kg;
  4. Säteen ohjauspeilit, joiden se läpimitta tai sen pähkäläisajan pituus, jolla latteus on  $\lambda/2$  tai parempi ( $\lambda$  on 623 nm), on yli 100 mm ja joiden ohjauskaistanleveys ylittää 100 Hz;
- b. Sinkkiseleneidistä (ZnSe) tai sinkkisulfidista (ZnS) valmistetut optiset komponentit, joiden lähete on aallonpituusalueella, joka on yli 3 000 nm mutta alle 25 000 nm ja joilla on jokin seuraavista:
1. Tilavuus ylittää 100 cm<sup>3</sup>; tai
  2. Läpimitta tai pääakselin pituus ylittää 80 mm ja paksuus (syvyys) 20 mm;
- c. Seuraavat "avaruuskelpoiset" optisten järjestelmien osat:
1. Jotka on kevennetty alle 20 %:iin sellaisen massiivikappaleen ekvivalenttitiheyteen verrattuna, jolla on sama aukko ja paksuus;
  2. Raakasubstraatit tai (yksi- tai monikerroksisella, metallisella tai dielektrisellä, johtavalla, puolijohdettavalla tai eristävällä) pinnoitteella pinnoitetut tai suojaavalla kalvolla varustetut substraatit;
  3. Peilien segmentit tai kokoonpanot, jotka on suunniteltu koottavaksi avaruudessa optiseksi järjestelmäksi, jonka kokoava aukko on sama tai suurempi kuin yksittäisen läpimitaltaan 1 m:n optiikan;
  4. Jotka on valmistettu "komposiitti"materiaaleista, joiden lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on  $5 \times 10^{-6}$  tai pienempi minkä tahansa koordinaatin suunnassa;

6A004 (jatkoa)

d. Seuraavat optiikan ohjauslaitteet:

1. Jotka on erityisesti suunniteltu 6A004.c.1 tai 6A004.c.3 kohdassa määriteltyjen "avaruuskelpoisten" komponenttien pinnanmuodon tai asennon ylläpitoon;
2. Joilla ohjauksen, seurannan, stabiloinnin tai resonaattorin kohdistuksen kaistanleveydet ovat 100 Hz tai enemmän ja tarkkuus 10  $\mu$ rad (mikroradiaania) tai vähemmän;
3. Kardaanit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  - a. Maksimikäntymä ylittää 5 astetta;
  - b. Kaistanleveys 100 Hz tai enemmän;
  - c. Kulmasuuntausvirhe 200 mikroradiaania tai vähemmän; tai
  - d. joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. Läpimitta tai pääakselin pituus yli 0,15 m, mutta ei yli 1 m ja kykenevät yli 2 radiaanin/s<sup>2</sup> kulmakiihtyvyyksiin; tai
    2. Läpimitta tai pääakselin pituus on yli 1 m ja kykenevät yli 0,5 radiaanin/s<sup>2</sup> kulmakiihtyvyyteen;
4. Jotka on erityisesti suunniteltu ylläpitämään sellaisten vaiheistettujen peiliryhmiä tai segmentti-peilijärjestelmien linjausta, jotka rakentuvat segmentin halkaisijaltaan tai pääakselin pituudeltaan 1 m:n tai suuremmista peileistä;

e. 'Ei- pallomaiset optiset elementit', joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1. Optisen aukon suurin mitta on yli 400 mm;
2. Pinnan epätasaisuus on alle 1 nm (rms) 1 mm:n tai sitä suurempien näytteenottopituuksien osalta; ja
3. Lineaarisen lämpölaajenemiskertoimen absoluuttinen suuruus on alle  $3 \times 10^{-6}/K$  lämpötilassa 25 °C.

Tekn. huom.:

1. 'Ei- pallomainen optinen elementti' on optisessa järjestelmässä käytettävä elementti, jonka kuvapinta- tai pinnat on suunniteltu siten, että ne poikkeavat täydellisen pallomaisesta muodosta.
2. Valmistajia ei veloiteta mittaamaan 6A004.e.2 kohdassa tarkoitettua pinnan epätasaisuutta, ellei optista elementtiä ole suunniteltu tai valmistettu tarkoituksena täyttää tai ylittää valvontaan liittyvä parametri.

Huom.: 6A004.e kohta ei aseta valvonnallaiseksi ei- pallomaisia optisia elementtejä, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. Optisen aukon suurin mitta on alle 1 m ja polttovälin suhde aukkoon on 4,5:1 tai suurempi;
- b. Optisen aukon suurin mitta on 1 m tai suurempi ja polttovälin suhde aukkoon on 7:1 tai suurempi;
- c. Ne on suunniteltu Fresnel-, flyeye-, juova-, prisma- tai diffraktiotyypiksi optisiksi elementeiksi;
- d. Ne on valmistettu borosilikaattilasista, jonka lineaarinen lämpölaajenemiskerroin on suurempi kuin  $2,5 \times 10^{-6}/K$  lämpötilassa 25 °C; tai
- e. Ne ovat röntgenoptisia elementtejä, joilla on sisäisiä peiliominaisuuksia (esim. putkityyppinen peili).

Huom.: Litografialaitteita varten erityisesti suunniteltujen ei- pallomaisten optisten elementtien osalta katso 3B001 kohta.

6A005 Seuraavat muut kuin 0B001.g.5 tai 0B001.h.6 kohdassa määritellyt "laserit", komponentit ja optiset laitteet:

**Huom.: KATSO MYÖS 6A205 KOHTA.**

Huom. 1: Pulssi"lasereihin" kuuluvat ne, jotka toimivat pulssitettuna jatkuva-aaltomoodissa (CW).

Huom. 2: Eksimeeri"laserit", puolijohde"laserit", kemialliset "laserit", hiilimonoksidi"laserit", hiilidioksidi"laserit" ja yksittäisiä pulsseja tuottavat neodymiumlasi"laserit" määritellään ainoastaan 6A005.d kohdassa.

Huom. 3: Kuitu"laserit" sisältyvät 6A005 kohtaan.

Huom. 4: Taajuuden muuttamiseen (eli aallonpituuden muuttamiseen) kykenevien "laserien", muutoin syöttämällä energiaa toisella "laserilla", valvonnallisuus määräytyy sekä taajuusmuunnosta edeltävien että sen jälkeisten valvontaparametrien perusteella.

Huom. 5: 6A005 kohta ei aseta valvonnallaiseksi seuraavia "lasereita":

- a. rubiini"laserit", joiden lähtöenergia on alle 20 J;
- b. typpi"laserit";
- c. krypton"laserit".

Tekn. huom.:

Kohdassa 6A005 käsitteellä 'laserin hyötysuhde' (engl. 'wall-plug efficiency') tarkoitetaan "laserin" lähtötehon (tai "keskimääräisen lähtötehon") suhdetta "laserin" käyttämiseen tarvittavan sähköisen virtalähteen kokonaistehoon, mukaan lukien virtalähteen/virransäädön ja lämmönpoiston/lämmönvaihdon edellyttämä teho.

a. Ei-viritettävät jatkuva valoa tuottavat (engl. CW, continuous wave) "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. lähtöaallonpituus ei ylitä 150 nm ja lähtöteho ylittää 1 W;
2. lähtöaallonpituus ylittää 150 nm, mutta ei ylitä 520 nm ja lähtöteho ylittää 30 W;

Huom.: 6A005.a.2. kohta ei aseta valvonnallaiseksi argon "lasereita", joiden lähtöteho on enintään 50 W.

3. lähtöaallonpituus ylittää 520 nm, mutta ei ylitä 540 nm, ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. yksitransversaalimuodon ulostulon lähtöteho ylittää 50 W; tai
- b. monitransversaalimuodon ulostulon lähtöteho ylittää 150 W;

4. lähtöaallonpituus ylittää 540 nm, mutta ei ylitä 800 nm, ja lähtöteho ylittää 30 W;

5. lähtöaallonpituus ylittää 800 nm, mutta ei ylitä 975 nm, ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. yksitransversaalimuodon ulostulon lähtöteho ylittää 50 W; tai
- b. monitransversaalimuodon ulostulon lähtöteho ylittää 80 W;

6. lähtöaallonpituus ylittää 975 nm, mutta ei ylitä 1 150 nm, ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

- a. yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  1. 'laserin hyötysuhde' ylittää 12 prosenttia ja lähtöteho ylittää 100 W; tai
  2. lähtöteho ylittää 150 W; tai

- 6A005 a. 6. (jatkoa)
- b. monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. 'laserin hyötysuhde' ylittää 18 prosenttia ja lähtöteho ylittää 500 W; tai
  2. lähtöteho ylittää 2 kW;
- Huom.:* 6A005.a.6.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi monitransversaalimuodossa toimivia teollisuus"lasereita", joiden lähtöteho ylittää 2 kW, mutta ei ylitä 6 kW, ja joiden kokonaismassa on yli 1 200 kg. Tässä huomautuksessa kokonaismassalla tarkoitetaan kaikkia "laserin" käyttämiseen tarvittavia komponentteja, mm. "laser", virtalähde, lämmönpoistaja, mutta siihen ei sisälly säteen kunnostukseen tai kuljetukseen tarvittava ulkoinen optiikka.
7. lähtöaallonpituus ylittää 1 150 nm, mutta ei ylitä 1 555 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. yksitransversaalimuodon lähtöteho ylittää 50 W; tai
  - b. monitransversaalimuodon lähtöteho ylittää 80 W; tai
8. lähtöaallonpituus ylittää 1 555 nm ja lähtöteho ylittää 1 W.
- b. Ei-viritettävät pulssitoimiset "lasarit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. lähtöaallonpituus ei ylitä 150 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 1 W; tai
    - b. keskimääräinen lähtöteho ylittää 1 W;
  2. lähtöaallonpituus ylittää 150 nm, mutta ei ylitä 520 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti; ja pulssi"huipputeho" ylittää 30 W; tai
    - b. keskimääräinen lähtöteho ylittää 30 W;
- Huom.:* 6A005.b.2.b kohta ei aseta valvonnallaiseksi argon"lasereita", joiden keskimääräinen lähtöteho on enintään 50 W.
3. lähtöaallonpituus ylittää 520 nm mutta ei 540 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
      1. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 50 W; tai
      2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai
    - b. monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
      1. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 150 W; tai
      2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 150 W;
  4. lähtöaallonpituus ylittää 540 nm, mutta ei ylitä 800 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 30 W; tai
    - b. keskimääräinen lähtöteho ylittää 30 W;
  5. lähtöaallonpituus ylittää 800 nm mutta ei 975 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. pulssin kesto ei ylitä 1 µs ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
      1. lähtöenergia ylittää 0,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 50 W;
      2. yksitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W; tai
      3. monitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai

- 6A005      b. 5. (jatkoa)
- b. pulssin kesto ylittää 1  $\mu$ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. lähtöenergia ylittää 2 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 50 W;
  2. yksitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai
  3. monitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 80 W;
6. lähtöaallonpituus ylittää 975 nm, mutta ei ylitä 1 150 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. pulssin kesto ei ylitä 1 ns ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. ulostulon huipputeho ylittää 5 GW pulssia kohti;
  2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 10 W; tai
  3. lähtöenergia ylittää 0,1 J pulssia kohti;
- b. pulssin kesto ylittää 1 ns, mutta ei ylitä 1  $\mu$ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. huipputeho ylittää 100 MW;
    - b. keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W ja ne on suunniteltu niin, että suurin mahdollinen pulssintoistotaajuus on enintään 1 kHz;
    - c. 'laserin hyötysuhde' ylittää 12 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 100 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella;
    - d. keskimääräinen lähtöteho ylittää 150 W ja ne voivat toimia yli 1 kHz:n pulssintoistotaajuudella; tai
    - e. lähtöenergia ylittää 2 J pulssia kohti; tai
  2. monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. huipputeho ylittää 400 MW;
    - b. 'laserin hyötysuhde' ylittää 18 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 500 W;
    - c. keskimääräinen lähtöteho ylittää 2 kW; tai
    - d. lähtöenergia ylittää 4 J pulssia kohti; tai
- c. pulssin kesto ylittää 1  $\mu$ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. yksitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. huipputeho ylittää 500 kW;
    - b. 'laserin hyötysuhde' ylittää 12 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 100 W; tai
    - c. keskimääräinen lähtöteho ylittää 150 W; tai
  2. monitransversaalimuodon ulostulo, jolla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. huipputeho ylittää 1 MW;
    - b. 'laserin hyötysuhde' ylittää 18 prosenttia ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 500 W; tai
    - c. keskimääräinen lähtöteho ylittää 2 kW;

- 6A005 b. (jatkoa)
7. lähtöaallonpituus ylittää 1 150 nm, mutta ei ylitä 1 555 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- pulssin kesto ei ylitä 1  $\mu$ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - lähtöenergia ylittää 0,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 50 W;
    - yksitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 20 W; tai
    - monitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai
  - pulssin kesto ylittää 1  $\mu$ s ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - lähtöenergia ylittää 0,5 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 50 W;
    - yksitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai
    - monitransversaalimuodon ulostulon keskimääräinen lähtöteho ylittää 80 W; tai
8. lähtöaallonpituus ylittää 1 555 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- lähtöenergia ylittää 100 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 1 W; tai
  - keskimääräinen lähtöteho ylittää 1 W;
- c. "Viritettävät" "laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- Huom.: 6.A005.c kohta sisältää titaani-safiiri- (Ti:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), tulium-YAG- (Tm:YAG), tulium-YSGG- (Tm:YSGG), aleksandriitti- (Cr:BeAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), värikeskus-, väriaine- ja neste"laserit".
- lähtöaallonpituus on vähemmän kuin 600 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 1 W; tai
    - keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;
  - lähtöaallonpituus on 600 nm tai enemmän mutta ei ylitä 1 400 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - lähtöenergia ylittää 1 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 20 W; tai
    - keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 20 W; tai
  - lähtöaallonpituus ylittää 1 400 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    - lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohden ja pulssi"huipputeho" ylittää 1 W; tai
    - keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 1 W;
- d. Muut "laserit", joita ei ole määritelty 6A005.a, 6A005.b tai 6A005.c kohdassa, seuraavasti:
- seuraavat puolijohde"laserit":

Huom. 1: 6A005.d.1 kohta sisältää puolijohde"laserit", joilla on optinen ulostulo (esim. kuituoptiset häntäkaapelit).

Huom. 2: Erityisesti muita laitteita varten suunniteltujen puolijohde"laserien" valvonnallaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden mukaan.

    - erilliset yksitransversaalimoodissa toimivat puolijohde"laserit", joilla on jokin seuraavista:
      - aallonpituus on 1 510 nm tai pienempi ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho on suurempi kuin 1,5 W; tai
      - aallonpituus on suurempi kuin 1 510 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 500 mW; tai

- 6A005 d. 1. (jatkoa)
- b. erilliset, monitransversaalimoodissa toimivat puolijohde"laserit", joilla on jokin seuraavista:
1. aallonpituus on pienempi kuin 1 400 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 10 W;
  2. aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 400 nm ja pienempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 2,5 W; tai
  3. aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 1 W;
- c. erilliset puolijohde"laserien"-ryhmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. aallonpituus pienempi kuin 1 400 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 80 W;
  2. aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 400 nm ja pienempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 25 W; tai
  3. aallonpituus yhtä suuri tai suurempi kuin 1 900 nm ja keskimääräinen tai CW-lähtöteho suurempi kuin 10 W;
- d. puolijohde"laserien" ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden ryhmän, joka on valvonnallinen 6A005.d.1.c kohdan perusteella.

Tekn. huom.:

1. Puolijohde"lasereita" kutsutaan tavallisesti "laser" diodeiksi.
  2. 'Ryhmä' muodostuu useista puolijohde"laser"emittereistä, jotka on valmistettu yhtenä siruna niin, että säteilevien valonsäteiden keskustat ovat yhdensuuntaisilla reiteillä.
  3. 'Ryhmien kerros' on valmistettu kerrostamalla tai muuten kokoamalla 'ryhmät' niin, että säteilevien valonsäteiden keskustat ovat yhdensuuntaisilla reiteillä.
2. Hiilimonoksidi(CO)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. lähtöenergia ylittää 2 J pulssia kohti ja pulssi"huipputeho" ylittää 5 kW; tai
  - b. keskimääräinen tai CW-lähtöteho ylittää 5 kW;
3. Hiilidioksidi(CO<sub>2</sub>)"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. CW-lähtöteho ylittää 15 kW;
  - b. pulssiulostulon pulssin kesto ylittää 10 µs ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. keskimääräinen lähtöteho ylittää 10 kW; tai
    2. pulssi"huipputeho" ylittää 100 kW; tai
  - c. pulssiulostulon pulssin kesto on 10 µs tai lyhyempi ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. pulssin energia ylittää 5 J pulssia kohti; tai
    2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 2,5 kW;
4. Eksimeeri"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. lähtöaallonpituus ei ylitä 150 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. lähtöenergia ylittää 50 mJ pulssia kohti; tai
    2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 1 W;
  - b. lähtöaallonpituus ylittää 150 nm, mutta ei ylitä 190 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti; tai
    2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 120 W;

- 6A005 d. 4. (jatkoa)
- c. lähtöaallonpituus ylittää 190 nm, mutta ei ylitä 360 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. lähtöenergia ylittää 10 J pulssia kohti; tai
  2. keskimääräinen lähtöteho ylittää 500 W; tai
- d. lähtöaallonpituus ylittää 360 nm ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. lähtöenergia ylittää 1,5 J pulssia kohti; tai
  2. keskimääräinen lähtöenergia ylittää 30 W;

Huom.: Erityisesti litografialaitteita varten suunniteltujen eksimeeri"lasereiden" osalta katso 3B001 kohta.

5. Seuraavat "kemialliset laserit":
- a. vetyfluoridi(HF)"laserit";
  - b. deuteriumfluoridi(DF)"laserit";
  - c. seuraavat "siirtolaserit":
    1. happijodi(O<sub>2</sub>-I)"laserit";
    2. deuteriumfluoridihilidioksidi(DF-CO<sub>2</sub>)"laserit";
6. 'Yksittäisiä pulsseja tuottavat' neodyymilasi"laserit", joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. pulssin kesto ei ylitä 1 µs ja lähtöenergia ylittää 50 J pulssia kohti; tai
  - b. pulssin kesto ylittää 1 µs ja lähtöenergia ylittää 100 J pulssia kohti;

Huom.: 'Yksittäisiä pulsseja tuottava' viittaa "laseriin", joka tuottaa joko yhden yksittäisen ulostulopulssin tai jonka tuottamien pulssien aikaväli on yli minuutin.

- e. Seuraavat komponentit:
1. 'Aktiivisella jäädytyksellä' tai lämpöputkijäädytyksellä jäädytetyt peilit;

Tekn. huom.:

'Aktiivinen jäädytys' on optisten osien jäädytystekniikka, jossa käytetään välittömästi optisen komponentin pinnan alla virtaavia nesteitä (nimellisetäisyys optisesta pinnasta vähemmän kuin 1 mm) siirtämään lämpöä optiikasta.

2. Optiset peilit tai läpäisevät tai osittain läpäisevät optiset tai sähköoptiset komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi valvonnalaisten "lasereiden" kanssa;

- f. Seuraavat optiset laitteet:

Huom.: "SHPL"-sovelluksissa toimimaan kykenevät yhteisen aukon optiset elementit: katso asetarvikeluettelo.

1. Dynaamiset aaltorintaman (vaiheen) mittausslaitteet, joilla voidaan rekisteröidä ainakin 50 positiota säteen aaltorintamasta, ja joilla on jokin seuraavista:
  - a. Kuvataajuus on 100 Hz tai enemmän ja vaiheen erottelukyky vähintään 5 % säteen aallonpituudesta; tai
  - b. Kuvanopeus on 1 000 Hz tai enemmän ja vaiheen erottelukyky vähintään 20 % säteen aallonpituudesta;
2. "Laserien" diagnostiikkalaitteet, joilla kyetään mittaamaan "SHPL"-järjestelmän säteen ohjauksen kulmavirheitä, jotka ovat 10 µrad tai pienempiä;

- 6A005 f. (jatkoa)
3. Optiset laitteet, kokoonpanot tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu vaiheistettujen ryhmien koherenttia sädetä kombinoivaa "SHPL"-järjestelmää varten tarkkuudella, joka on seuraavista pienempi:  $\Lambda/10$  suunnitellulla aallonpituudella tai  $0,1 \mu\text{m}$ ;
  4. Erityisesti "SHPL"-järjestelmissä käytettäväksi tarkoitettut projektioteleskoopit.
- 6A006 Seuraavat "magnetometrit", "magneettikentän gradiometrit", "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit", vedenalaiset sähkökenttäanturit ja kompensointijärjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- Huom.: 6A006 kohta ei aseta valvonnallaiseksi instrumentteja, jotka on erityisesti suunniteltu kalastustarkoituksiin tai lääketieteellisen diagnostiikan biomagneettisia mittauksia varten.
- a. Seuraavat "magnetometrit" ja alajärjestelmät:
    1. Jotka käyttävät "suprajohtavaa" (SQUID) "teknologiaa" ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
      - a. Paikallaan käytettäväksi suunniteltuja SQUID-järjestelmiä, joissa ei ole erityisesti suunniteltuja alajärjestelmiä liikkeessä aiheutuvan kohinan vähentämiseksi ja joiden "kohinataso" (herkkyys) on  $50 \text{ fT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti } 1 \text{ Hz:n taajuudella tai alempi (parempi); tai$
      - b. SQUID-järjestelmiä, joiden liikkeessä käytettävien magnetometrien "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $20 \text{ pT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti } 1 \text{ Hz:n taajuudella}$  ja jotka on erityisesti suunniteltu liikkeessä aiheutuvan kohinan vähentämiseksi;
    2. Jotka käyttävät optisesti pumpattua tai ydinpresessio- (protoni/Overhauser-) "teknologiaa", jonka "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $20 \text{ pT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti}$ ;
    3. Jotka käyttävät fluxgate-"teknologiaa", jonka "kohinataso" (herkkyys) on  $10 \text{ pT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti } 1 \text{ Hz:n taajuudella tai alempi (parempi)}$ ;
    4. Induktiokelamagnetometrit, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin:
      - a.  $0,05 \text{ nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti alle } 1 \text{ Hz:n taajuuksilla}$ ;
      - b.  $1 \times 10^{-3} \text{ nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti taajuuksilla } 1 \text{ Hz} - 10 \text{ Hz}$ ; tai
      - c.  $1 \times 10^{-4} \text{ nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti taajuuksilla yli } 10 \text{ Hz}$ ;
    5. Kuituoptiset "magnetometrit", joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $1 \text{ nT (rms) Hz:n neliöjuurta kohti}$ ;
  - b. Vedenalaiset sähkökenttäanturit, joiden "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $8 \text{ nanovoltia metriä kohti } 1 \text{ Hz:n neliöjuurta kohti } 1 \text{ Hz:n taajuudella mitattuna}$ ;
  - c. Seuraavat "magneettikentän gradiometrit":
    1. "Magneettikentän gradiometrit", jotka käyttävät useita 6A006.a kohdassa määriteltyjä "magnetometreja";
    2. Kuituoptiset "itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit", joiden magneettisen gradienttikentän "kohinataso" (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $0,3 \text{ nT/m rms Hz:n neliöjuurta kohti}$ ;
    3. "Itseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit", jotka käyttävät muuta kuin kuituoptista "teknologiaa" ja joiden magneettisen gradienttikentän kohinataso (herkkyys) on alempi (parempi) kuin  $0,015 \text{ nT/m rms Hz:n neliöjuurta kohti}$ ;
  - d. Kompensointijärjestelmät magneettisia antureita tai vedenalaisia sähkökenttäantureita varten, joiden aikaansaama suorituskyky on yhtä suuri tai parempi kuin 6A006.a, 6A006.b tai 6A006.c kohdan vertailuparametrit.

6A007 Seuraavat gravimetrit sekä painovoimagradiometrit:

**Huom.: KATSO MYÖS 6A107 KOHTA.**

- a. Maalla käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut gravimetrit (painovoiman mittarit), joiden staattinen tarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 10 µgal;

*Huom.:* 6A007.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kvartselementtiä käyttäviä (Worden-tyyppisiä) maapohjan gradiometrejä.

- b. Liikkuville alustoille suunnitellut gradiometrit, joiden:

1. Staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,7 mgal; ja
2. Toimintatarkkuus käytössä (toiminnassa) on parempi kuin 0,7 mgal ja vakiintumisaika on vähemmän kuin 2 minuuttia kaikissa läsnä olevien korjaavien kompensointien ja liikkeen vaikutusten kombinaatioissa;

- c. Painovoimagradiometrit.

6A008 Tutkajärjestelmät, -laitteet ja -kokoonpanot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 6A108 KOHTA.**

*Huom.:* 6A008 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Toisiovalvontatutkia (SSR);
- b. Siviilikäyttöön tarkoitettuja liikennetutkia;
- c. Näyttöpäätteitä tai monitoreja, joita käytetään lennonjohdossa (ATC), ja joissa ei ole enempää kuin 12 erottuvaa elementtiä mm kohden;
- d. Ilmatieteellisiä (säähavainto-) tutkia.

- a. Jotka toimivat taajuuksilla 40 GHz–230 GHz ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1. Keskimääräinen lähtöteho on yli 100 mW; tai
2. Paikantamistarkkuus on 1 metri tai vähemmän (tarkempi) ja suuntakulmatarkkuus on 0,2 astetta tai vähemmän (tarkempi)

- b. Joissa on viritettävä kaistanleveys, joka on yli  $\pm 6,25\%$  'keskitoimintataajuudesta';

*Tekn. huom.:*

'Keskitoimintataajuus' on puolet korkeimman ja alhaisimman määritellyn toimintataajuuden summasta.

- c. Jotka kykenevät toimimaan samanaikaisesti useammalla kuin kahdella kantoaaltoaajuudella;
- d. Jotka kykenevät toimimaan synteettisessä apertuuri- (SAR), käänteisessä synteettisessä apertuuritutkamoodissa (ISAR) tai sivukulma-tutkamoodissa (SLAR);
- e. Jotka sisältävät "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmäantenneja";
- f. Jotka kykenevät ei-yhteistoiminnallisten kohteiden korkeuden määrittämiseen;

*Huom.:* 6A008.f kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ICAO:n standardien mukaisia tarkkuuslähestymistutkalaitteita (PAR).

- g. Jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ilmassa (asennettuina ilmapalloon tai lentokoneen rakenteisiin) ja varustettu Doppler-"signaalinkäsittelyllä" liikkuvien kohteiden havaitsemiseksi;

- h. Jotka käsittelevät tutkasignaalia käyttäen:

1. "Tutkan hajaspektri"tekniikkaa; tai
2. "Tutkan taajuushyppely"tekniikkaa;

6A008 (jatkoa)

- i. Jotka takaavat maanpinnalla toimittaessa maksimi"näyttöalueen", joka ylittää 185 km;

Huom.: 6A008.i kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

- a. Kalastusalueiden valvontatutkia;
- b. Maanpinnalla olevia tutkalaitteita, jotka on erikoisesti suunniteltu reittiliikenteen ohjausta varten eikä niiden käyttöön erityisesti suunniteltuja ohjelmia, edellyttäen, että:
  1. Sen maksimi"näyttöalue" on 500 km tai vähemmän;
  2. Se on konfiguroitu siten, että tutkan maalitietoa voidaan lähettää vain yhteen suuntaan tutka-asemalta yhteen tai useampaan siviililennonjohtokeskukseen;
  3. Siinä ei ole varauduttu tutkan pyyhkäisy nopeuden kauko-ohjaukseen reitin varrella olevasta lennonjohtokeskuksesta; ja
  4. Sen on oltava kiinteästi rakennettu.
- c. Säähavaintopallojen seurantatutkia.

- j. "Laser" tutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etäisyysmittauslaitteet (LIDAR), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. Ne ovat "avaruuskelpoisia"; tai
2. Ne käyttävät koherenttia heterodyne- tai homodyneilmatisutekniikkaa ja niiden kulmanerottelukyky on parempi kuin 20 µrad (mikroradiaania);

Huom.: 6A008.j kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kartoitukseen tai ilmatieteellisiin havaintoihin erityisesti suunniteltuja LIDAR-laitteita.

- k. Sisältävät "signaalinkäsittelyä" varten alajärjestelmiä, jotka käyttävät "pulssikompressio" tekniikkaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1. "Pulssikompressio" suhde ylittää 150; tai
2. Pulssin leveys on vähemmän kuin 200 ns; tai

- l. Sisältävät tiedonkäsittelyn alajärjestelmiä, jotka:

1. Suorittavat "automaattista kohteen seuranta", joka kullakin antennin kierroksella ennakoii maalin aseman pidemmälle kuin seuraavan antennin säteen ohimenoajan ajankohtaan;

Huom.: 6A008.l.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi vaaratilanteiden hälytyskykyä lennonjohtojärjestelmissä tai merenkulku- tai satamatutkissa.

2. Laskevat kohteen nopeutta ensiotutkan avulla, jolla on ei-periodinen (vaihtuva) pyyhkäisy nopeus;
3. Suorittavat automaattista kohteiden hahmontunnistusta (piirteiden poimintaa) ja vertaavat kuviota tietokantoihin talletettuihin kohteiden ominaisuuksiin (aaltomuotoihin tai kuviin) kohteiden tunnistamista tai luokittelua varten; tai
4. Suorittavat kahdesta tai useammasta "maantieteellisesti hajallaan" olevasta ja "toisiinsa kytketystä tutka-anturista" saatujen kohteen tietojen superponointia ja korrelaatiota tai yhdistelyä kohteen selvittämiseksi;

Huom.: 6A008.l.4 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi järjestelmiä, laitteita tai kokoonpanoja, joita käytetään meriliikenteen ohjaamiseen.

6A102 Muut kuin 6A002 kohdassa määritellyt säteilyä kestävä 'ilmaisimet', jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan ydinaseiden vaikutuksilta (esim. sähkömagneettiselta pulssilta (EMP = Electromagnetic Pulse), röntgensäteilyltä, yhdistetyiltä paineisku- ja lämpövaikutuksilta) ja voidaan käyttää "ohjuksissa", ja jotka on suunniteltu tai mitoitettu kestävänsä kokonaisannokseltaan  $5 \times 10^5$  radin (Pii) tai sen ylittäviä säteilytasoja.

Tekn. huom.:

6A102 kohdassa 'ilmaisimeksi' määritellään mekaaninen, sähköinen, optinen tai kemiallinen laite, joka automaattisesti tunnistaa ja tallentaa tai rekisteröi ärsyksen, kuten ympäristön paineen tai lämpötilan muutoksen, sähköisen tai sähkömagneettisen signaalin tai radioaktiivisesta aineesta lähtevän säteilyn. Tämä sisältää laitteet, jotka tunnistavat kerta-toimisesti tai vioittumalla/rikkoutumalla.

- 6A107 Seuraavat painovoiman mittarit (gravimetrit) ja gravimetrien ja painovoimagradiometrien komponentit:
- Muut kuin 6A007.b kohdassa määritellyt gravimetrit, jotka on suunniteltu tai muunnettu ilmassa tai merellä tapahtuvaa käyttöä varten ja joiden staattinen tai operationaalinen tarkkuus on  $7 \times 10^{-6}$  m/s<sup>2</sup> (0,7milligalia) tai sitä vähemmän (parempi) ja joiden vakiintumisaika on kaksi minuuttia tai vähemmän.
  - Komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu 6A007.b kohdassa tai 6A107.a kohdassa määriteltyjä gravimetrejä ja 6A007.c kohdassa määriteltyjä painovoimagradiometrejä varten.
- 6A108 Seuraavat muut kuin 6A008 kohdassa määritellyt tutkajärjestelmät ja seurantajärjestelmät:
- Tutka- ja "laser"-tutkajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa;  
Huom.: 6A108.a kohta sisältää seuraavat:
    - Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
    - Kuvausanturilaitteet;
    - Näkymäkartoitus- ja korrelointilaitteet (sekä digitaaliset että analogiset);
    - Doppler-navigointitutkalaitteet.
  - Seuraavat tarkkuusseurantajärjestelmät, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa':
    - Seurantajärjestelmät, jotka käyttävät koodin kääntäjää yhdessä maanpinnalla tai ilmassa olevien vertailupisteiden tai navigointisatelliitti-järjestelmien kanssa tosiaikaiseen lentosijainnin ja -nopeuden mittausten suorittamiseen;
    - Instrumenttietäisyystutkat, mukaanlukien niihin liittyvät optiset/infrapunaseurantalaitteet, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
      - Kulmaresoluutio on parempi kuin 3 milliradiaania;
      - Toimintaetäisyys on 30 km tai suurempi ja etäisyysresoluutio parempi kuin 10 m rms;
      - Nopeusresoluutio on parempi kuin 3 m/s.  
Tekn. huom.:  
*6A108.b kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.*
- 6A202 Valomonistinputket, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
- valokatodipinta on suurempi kuin 20 cm<sup>2</sup>; ja
  - anodipulssin nousuaika on lyhyempi kuin 1 ns.
- 6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa määritellyt kamerat ja komponentit:
- Seuraavat mekaaniset pyöriväpeiliset kamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
    - Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaa/s;
    - Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/μs;  
Huom.: 6A203.a kohdassa näiden kameroiden komponentteihin sisältyvät niiden synkronointielektroniikkayksiköt sekä turbiineista, peileistä ja laakereista koostuvat roottorikokoonpanot.
  - Seuraavat elektroniset juova- ja erilliskuvakamerat, putket ja laitteet:
    - Elektroniset juovakamerat, jotka kykenevät 50 ns:n tai lyhyempään aikaresoluutioon;
    - Juovaputket 6A203.b.1 kohdassa määriteltyjä kameroita varten;
    - Elektroniset (tai elektronisin sulkimin varustetut) erilliskuvakamerat, joiden valotusaika kuvaa kohden on 50 ns tai lyhyempi;

- 6A203 b. (jatkoa)
4. Seuraavat erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joita käytetään 6A203.b.3 kohdassa määriteltyjen kameroiden kanssa:
    - a. Lähitarkenteiset kuvantehostinputket, joissa valokatodi on muodostettu läpinäkyvälle johtavalle pinnoitteelle valokatodin pintavastuksen pienentämiseksi;
    - b. Piitehostinkohtiolevyllä (SIT = Silicon Intensifier Target) varustetut hilakameraputket, joiden nopeatoiminen järjestelmä mahdollistaa valokatodilta tulevien valosähköisten elektronien veräjäinnin ennen niiden iskeytymistä SIT-levylle;
    - c. Kerr- tai Pockel-kennoon perustuva sähköoptinen suljin;
    - d. Muut erilliskuvaputket ja solid-statekuvauslaitteet, joiden pikakuvauksen veräjäointiaika on lyhyempi kuin 50 ns ja jotka on erityisesti suunniteltu 6A203.b.3 kohdassa määriteltyjä kameroita varten;
  - c. Säteilyä kestävä TV-kamerat tai niissä käytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämään yli  $50 \times 10^3$  Gy:n (Pii) ( $5 \times 10^6$  radin (Pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Tekn. huom.:

*Termillä Gy (Pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton silikonitestikapale imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.*

- 6A205 Seuraavat, muut kuin 0B001.g.5, 0B001.h.6 tai 6A005 kohdassa määritellyt "laserit", "laser" vahvistimet ja oskillaattorit:
- a. Argonioni"laserit", joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:
    1. toimivat 400 nm:n ja 515 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla; ja
    2. keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 40 W;
  - b. Viritettävät pulssitoimiset yksimuoto-väriaine"laser"-oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;
    2. 1 W suurempi keskimääräinen lähtöteho;
    3. toistotaajuus on suurempi kuin 1 kHz; ja
    4. pulssin leveys pienempi kuin 100 ns;
  - c. Viritettävät pulssitoimiset väriaine"laser"vahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    1. ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;
    2. keskimääräinen lähtöteho on suurempi kuin 30 W;
    3. toistotaajuus suurempi kuin 1 kHz; ja
    4. pulssin leveys alle 100 ns;

Huom.: 6A205.c kohta ei aseta valvonnallaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita.
  - d. Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    1. ne toimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;
    2. toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz;
    3. keskimääräinen lähtöteho suurempi kuin 500 W; ja
    4. pulssin leveys alle 200 ns;
  - e. Paravetykäyttöiset Raman-muuntimet, jotka on suunniteltu toimimaan 16 mikrometrin lähtöaaltopituudella ja joiden toistotaajuus on suurempi kuin 250 Hz.

- 6A205 (jatkoa)
- f. Neodyymiseostetut "Q-kytkin-laserit" (muut kuin lasi-), joiden lähtöaallonpituus ylittää 1 000 nm, mutta ei ylitä 1 100 nm, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
1. Pulssiviritettävät "Q-kytkin-laserit", joiden pulssinkesto on vähintään 1 ns ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
    - a. yksitransversaalimuodon ulostulo, jonka keskimääräinen lähtöteho ylittää 40 W, tai
    - b. monitransversaalimuodon ulostulo, jonka keskimääräinen lähtöteho ylittää 50 W; tai
  2. Mukana on taajuuden kahdentaminen, jolloin lähtöaallonpituus on 500–550 nm ja keskimääräinen lähtöteho ylittää 40 W.
- 6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmän kuin 10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa
- Huom.: 6A225 kohtaan sisältyvät sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLL:t (doppler"laser"-interferometrit).
- 6A226 Seuraavat paineanturit:
- a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;
  - b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita.

**6B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

6B004 Optiset laitteet seuraavasti:

- a. Laitteet, joilla mitataan absoluuttista heijastumissuhdetta  $\pm 0,1\%$ :n tarkkuudella heijastumissuhteen arvosta;
- b. Muut laitteet kuin optisen pinnan sironnan mittarit, joiden himmentämätön aukko on suurempi kuin 10 cm, ja jotka on erityisesti suunniteltu epätasaisen optisen pinnan kuvan (profiilin) mittaamiseen 2 nm:n tai pienemmällä (paremmalla) "tarkkuudella" tarvittavaa profiilia vasten.

*Huom.:* 6B004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi mikroskooppeja.

6B007 Laitteet, joilla tuotetaan, linjataan ja kalibroidaan maalle asennettavia painovoiman mittareita, joiden staattinen tarkkuus on parempi kuin 0,1 mgal.

6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjärjestelmät, joiden lähetettävien pulssien leveydet ovat 100 ns tai vähemmän, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

**Huom.:** KATSO MYÖS 6B108 KOHTA.

6B108 Muut kuin 6B008 kohdassa määritellyt järjestelmät, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa' ja niiden alajärjestelmissä ja jotka on erityisesti suunniteltu tutkapaikkipintojen mittaamiseen.

*Tekn. huom.*

*Kohdassa 6B108 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilmalusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km.*

**6C Materiaalit**

6C002 Seuraavat optiset anturimateriaalit:

- a. Telluuri (Te) alkuaineena, jonka puhtausaste on 99,9995 % tai korkeampi;
- b. Yksittäiskiteet (mukaan lukien epitaksiekot) joistakin seuraavista:
  1. Kadmiumsinkkitteluidi (CdZnTe), jonka sinkkipitoisuus on alle 6 'mooliosuus'prosenttia;
  2. Kadmiumtelluridi (CdTe) puhtausasteesta riippumatta; tai
  3. Elohopeakadmiumtelluridi (HgCdTe) puhtausasteesta riippumatta.

Tekn. huom.:

'Mooliosuus' määritellään ZnTe-moolien suhteeksi kiteessä olevien CdTe- ja ZnTe-moolien summaan.

6C004 Seuraavat optiset materiaalit:

- a. Sinkkiselenedi (ZnSe)- ja sinkkisulfidi (ZnS)- "substraattiaihiot", jotka on tuotettu kemiallisella kaasufaasi-pinnoitusmenetelmällä ja joilla on jokin seuraavista:
  1. Tilavuus suurempi kuin 100 cm<sup>3</sup>; tai
  2. Läpimitta suurempi kuin 80 mm ja paksuus 20 mm tai enemmän;
- b. Seuraavien sähköoptisten materiaalien synteettiset kiteet:
  1. Kaliumtitanyyliarsenaatti (KTA);
  2. Hopeagalliumselenidi (AgGaSe<sub>2</sub>);
  3. Talliumarseniselenidi (Tl<sub>3</sub>AsSe<sub>3</sub>, tunnetaan myös nimellä TAS);
- c. Epälineaariset optiset materiaalit, joilla on kaikki seuraavat:
  1. Kolmannen tason susceptibiliteetti (khi 3) on 10<sup>-6</sup>m<sup>2</sup>/V<sup>2</sup> tai enemmän; ja
  2. Vasteaika on vähemmän kuin 1 ms;
- d. Piikarbidista tai beryllium-beryllium (Be/Be) -pinnoitetuista materiaaleista valmistetut "substraattiaihiot", joiden läpimitta tai pääakselin pituus on yli 300 mm;
- e. Lasi, mukaan lukien kvartsilasi, fosfaattilasi, fluorofosfaattilasi, zirkoniumfluoridi (ZrF<sub>4</sub>) ja hafniumfluoridi (HfF<sub>4</sub>), joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
  1. Hydroksyyli-ioni(OH-)konsentraatio on vähemmän kuin 5 ppm;
  2. Metallisten epäpuhtauksien kokonaistaso on vähemmän kuin 1 ppm; ja
  3. Korkea homogeisuus (refraktiovarianssin indeksi) on vähemmän kuin 5 × 10<sup>-6</sup>;
- f. Synteettisesti tuotettu timanttimateriaali, jonka absorptio on vähemmän kuin 10<sup>-5</sup> cm<sup>-1</sup> aallonpituuksilla, jotka ylittävät 200 nm mutta ovat alle 14 000 nm.

6C005 Seuraavat kiteiset "laserien" perusmateriaalit käsittelemättömässä muodossa:

- a. Titaaniseostettu safiiri;
- b. Aleksandriitti.

**6D Ohjelmistot**

6D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A004, 6A005, 6A008 tai 6B008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

6D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 6A002.b., 6A008 tai 6B008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

6D003 Seuraavat muut ohjelmistot:

- a.
  1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen säteen muokkaamiseen akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" hinattavia hydrofonijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
  2. "Lähdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" hinattavia hydrofonijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
  3. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu akustisen säteen muokkaamiseen;
  4. "Lähdekoodi" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi" pohja- tai poukamakaapelijärjestelmiä käyttävää passiivista vastaanottoa varten;
- b.
  1. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisia ja sähkökenttien kompensointijärjestelmiä varten magneettisille antureille, jotka on suunniteltu toimimaan liikkuvilla alustoilla;
  2. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu magneettisten ja sähkökenttien poikkeamien ilmaisuun liikkuvilla alustoilla;
- c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu korjaamaan liikkumisen vaikutuksia painovoimamittareihin tai painovoimagradiometreihin;
- d.
  1. Lennonjohto-"ohjelmistojen" sovellus"ohjelmat", jotka toimivat lennonjohtokeskuksiin sijoitetuissa yleiskäyttöisissä tietokoneissa ja kykenevät johonkin seuraavista:
    - a. Käsittelemään ja näyttämään enemmän kuin 150:n samanaikaisen kohteen "reitit"; tai
    - b. Vastaanottamaan kohteiden tutkatietoja useammalta kuin neljältä ensiötutkalta;
  2. "Ohjelmistot" sellaisten suojakupujen suunnittelua tai "tuotantoa" varten, jotka:
    - a. On erityisesti suunniteltu suojaamaan 6A008.e kohdassa määriteltyjä, "elektronisesti ohjattavia vaiheistettuja ryhmä-antenneja"; ja
    - b. Aiheuttavat antennin säteilykuvion, jonka 'keskimääräinen sivukeilatasa' on enemmän kuin 40 dB pääsäteen tason alapuolella.

Tekn. huom.:

'Keskimääräinen sivukeilatasa' 6D003.d.2.b kohdassa mitataan koko ryhmän yli poislukien pääkeilan ja pääkeilan molemmilla puolilla olevien kahden ensimmäisen sivukeilan kulmasuure.

6D102 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 6A108 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

6D103 "Ohjelmistot", jotka lennon jälkeen prosessoivat nauhoitettua tietoa ja jotka mahdollistavat lentolaitteen aseman määrittämisen sen koko lentoradalla ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 'ohjuksia' varten.

Tekn. huom.:

6D103 kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä.

- 6E Teknologia**
- 6E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B, 6C tai 6D kohdassa määriteltyjen laitteiden, materiaalien tai "ohjelmistojen" kehittämistä varten.
- 6E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A, 6B tai 6C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "tuotantoa" varten.
- 6E003 Seuraava muu "teknologia":
- a. 1. Optisen pinnan pinnoitus- ja käsittely"teknologia", jota tarvitaan 99,5 %:n tai paremman tasalaatuisuuden saavuttamiseen optisille pinnoitteille, joiden läpimitta tai pääakselin pituus on 500 mm tai enemmän ja joiden kokonaishäviö (absorptio ja sironta) on vähemmän kuin  $5 \times 10^{-3}$ ;
- Huom.: KATSO MYÖS 2E003.F KOHTA.**
2. Yhden kärjen timanttisorvaustekniikat, joilla tuotetaan parempia pinnan viimeistelytarkkuuksia kuin 10 nm rms yli 0,5 m<sup>2</sup>:n ei-tasomaisille pinnoille;
  - b. "SHPL"-laserien testaamista tai "SHPL"-säteillä säteilytettyjen materiaalien testaamista tai evaluointia varten erityisesti suunniteltujen diagnostiikka-instrumenttien tai maalien "kehittämiseen", "tuotantoon" tai "käyttöön" tarvittava "teknologia";
- 6E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A002, 6A007.b ja c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 tai 6D103 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" käyttöä varten.
- Huom.: 6E101 kohta määrittelee 6A008 kohdassa määriteltyjen laitteiden "teknologian" vain, kun se on suunniteltu ilmailusovelluksiin ja sitä voidaan käyttää "ohjuksissa".
- 6E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 6A003, 6A005.a.1.c, 6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 tai 6A226 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

**RYHMÄ 7**  
**NAVIGOINTI JA ILMAILU**



**7A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

Huom.: Vedänelaisten kulkuneuvojen automaattiohjaukset: katso 8 ryhmä.

Tutkat: katso 6 ryhmä.

7A001 Seuraavanlaiset kiihtyvyyssmittarit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 7A101.**

- a. Lineaariset kiihtyvyyssmittarit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  1. Määritelty toimimaan enintään 15 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla, ja jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
    - a. "Biasstabiilisuus" vuoden aikana on vähemmän (parempi) kuin 130 mikro-g suhteessa kiinteään kalibrointiarvoon;
    - b. "Mittakertoimen" "stabiilisuus" vuoden aikana on vähemmän (parempi) kuin 130 ppm suhteessa kiinteään kalibrointiarvoon;
  2. Määritelty toimimaan yli 15 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla, ja kumpikin seuraavista ominaisuuksista:
    - a. "Biasin" "toistuvuus" on vuoden aikana vähemmän (parempi) kuin 5 000 mikro-g; ja
    - b. "Mittakertoimen" "toistuvuus" on vuoden aikana vähemmän (parempi) kuin 2 500 ppm;
  3. Suunniteltu käytettäväksi inertiasuunnistus- tai ohjausjärjestelmissä ja määritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla;
- b. Kulma- tai kiertokiihtyvyyssmittarit, jotka on määritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla.

7A002 Gyroskoopit sekä kulmakiertymisnopeuden tunnistimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

**Huom.: KATSO MYÖS 7A102 KOHTA.**

Huom.: Kulma- ja kiertokiihtyvyyssmittarit, ks. 7A001.b.

- a. "Ryömintänopeuden" "stabiilisuus", mitattuna 1 g:n olosuhteissa yhden kuukauden aikana ja suhteessa kiinteään kalibrointiarvoon vähemmän (parempi) kuin 0,5 astetta tunnissa, kun ne on määritelty toimimaan enintään 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla;
- b. Satunnaiskulmapoikkeama on 0,0035 astetta tunnin neliöjuurta kohti tai vähemmän (parempi); tai

Huom.: 7A002.b kohdassa ei valvota pyöriä massagyroskooppeja (pyörivät massagyroskoopit ovat gyroskooppeja, joissa käytetään jatkuvasti pyörivää massaa kulmaliikkeen havaitsemiseen).

- c. Kiertonopeus on vähintään 500 astetta sekunnissa, ja jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:
  1. "Ryömintänopeuden" "stabiilisuus", mitattuna 1 g:n olosuhteissa kolmen minuutin aikana ja suhteessa kiinteään kalibrointiarvoon vähemmän (parempi) kuin 40 astetta tunnissa, tai
  2. Satunnaiskulmapoikkeama on 0,2 astetta tunnin neliöjuurta kohti tai vähemmän (parempi); tai
- d. Ne on määritelty toimimaan yli 100 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla.

7A003 Inertiajärjestelmät ja seuraavat erityisesti suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 7A103 KOHTA.**

- a. Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu "ilma-aluksen", maakulkuneuvon, aluksen (pinta- tai vedenalaisen) tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. (Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailin tunnissa 'todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe' tai vähemmän (parempi); tai
  2. Ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyytasoilla.
- b. Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen satelliitinavigointijärjestelmän (-mien) (GNSS) kanssa tai DBRN (*Data-Based Referenced Navigation*) -järjestelmän (-mien) kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai DBRN:n menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin "yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä" (CEP).
- c. Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45 leveysasteessa; tai
  2. Suunniteltu siten, että niillä on 900 g:n tai sitä suurempi iskutaso toimimattomana 1 ms:n tai sitä pidemmän keston ajan.
- d. Inertiamittauslaitteet, joihin sisältyvät inertiamittausyksiköt ja inertiaviitejärjestelmät, jotka muodostuvat 7A001 tai 7A002 kohdassa määritellyistä gyroskoopeista tai kiihtyvyydmittareista ja niitä varten erityisesti suunnitelluista komponenteista.

Huom. 1: 7A003.a ja 7A003.b kohdan parametreja sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

1. Satunnainen syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia kutakin toisiinsa nähden kohtisuoraan olevaa akselia kohti, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:
  - a. Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 g<sup>2</sup>/Hz taajuvälillä 15–1 000 Hz; ja
  - b. PSD vaimenee taajuuden mukana 0,04 g<sup>2</sup>/Hz:stä 0,01 g<sup>2</sup>/Hz:iin taajuvälillä 1 000–2 000 Hz;
2. Kallistus ja kääntymisnopeus on + 2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai
3. Edellä 1 tai 2 kohdan vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

Huom. 2: 7A003 kohta ei aseta valvonnallaiseksi inertiaalisuunnistusjärjestelmiä, jotka "osallistujavaltion" siviiliviranomaiset ovat sertifiineet käytettäväksi "siviili-ilma-aluksissa".

Huom. 3: 7A003.c.1 kohta ei aseta valvonnallaiseksi teodoliittijärjestelmiä, joihin sisältyy erityisesti siviilimittaus-tehtäviin suunniteltuja inertialaitteita.

Tekn. huom.:

1. 7A003-b koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on rakennettu yhdeksi yksiköksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.
2. 'Todennäköinen paikannuksen etäisyysvirhe' (CEP) – Tavanomaisessa ympyräjakelussa, ympyrän säde sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sellaisen ympyrän säde, jossa on 50 prosentin todennäköisyys sijoittua.

- 7A004 Hyrrätähkikompassit ja muut laitteet, jotka määrittävät aseman tai suunnan seuraamalla automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja ja joiden atsimuuttitarkkuus on 5 kaarisekuntia tai vähemmän (parempi).

**Huom.: KATSO MYÖS 7A104 KOHTA.**

- 7A005 Globaalista paikanmäärittysatelliiteista (so. GPS tai GLONASS) vastaanottavat laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 7A105 KOHTA.**

- a. Käyttävät salauksen avausta; tai
- b. Nolla-ohjattavaa antennia.

- 7A006 Ilmassa käytettävät korkeusmittarit, jotka toimivat muilla kuin 4,2–4,4 GHz:n taajuuksilla, ne mukaan lukien, ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

**Huom.: KATSO MYÖS 7A106 KOHTA.**

- a. Suorittavat "tehon hallintaa"; tai
- b. Käyttävät vaihevainnusmodulaatiota.

- 7A008 Vedenalaiset ääniluotainnavigointijärjestelmät, joissa käytetään ohjausmodulilla varustettuja Doppler- tai nopeuskorrelaatiota suorittavia lokeja, joiden paikannustarkkuus on yhtä suuri tai vähemmän (parempi) kuin 3 % kuljetun matkan yhtäläisen todennäköisyyden ympärystä, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Huom.: 7A008 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pinta-aluksiin asennettavaksi määritelyjä järjestelmiä tai järjestelmiä, joissa sijaintia koskevien tietojen antaminen edellyttää akustisia hätämajakoita tai poijuja.

Huom.: Akustisen järjestelmät, ks. 6A001.a, ja nopeuskorrelaatiota suorittavat lokilaitteet, ks. 6A001.b. Muut merenkulun järjestelmät, ks. 8A002.

- 7A101 Seuraavat muut kuin 7A001 kohdassa määritellyt kiihtyvyydsmittarit, sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit,

- a. Lineaariset kiihtyvyydsmittarit, jotka on suunniteltu käytettäväksi inertiasuunnistusjärjestelmissä tai kiihtyvyyssuunnistusjärjestelmissä, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa' ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

1. "Biasin" "toistuvuus" on vähemmän (parempi) kuin 1 250 mikro-g; ja
2. "Mittakertoimen" "toistuvuus" on vähemmän (parempi) kuin 1 250 ppm;

Huom.: 7A101.a kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kiihtyvyydsmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling), joita käytetään porausreikien huoltotoiminnassa.

Tekn. huom.:

1. 7A101.a kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km;
2. 7A101.a kohdassa "biasin" ja "mittakertoimen" mittauksella tarkoitetaan yhden sigman standardipoikkeamaa suhteessa kiinteään kalibrointiin yhden vuoden aikana;

- b. Jatkuvan mittausalueen kiihtyvyydsmittarit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 100 g:n kiihtyvyytasoilla.

- 7A102 Muut kuin 7A002 kohdassa määritellyt kaiken tyyppiset gyroskoopit, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa', ja joiden nimellis "ryömintänopeuden" 'stabiilisuus' on vähemmän kuin 0,5° (1 sigma tai rms) tunnissa 1 g:n olosuhteissa sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

- 7A102 (jatkoa)
- Tekn. huom.:
- 7A102 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä raketinjärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km;
  - 7A102 kohdassa 'stabiilisuus' määritellään parametriksi, jolla mitataan tietyn mekanismin tai suorituskeinojen kykyä säilyä muuttumattomana, kun sitä pidetään jatkuvasti altistettuna kiinteisiin käyttöolosuhteisiin (IEEE-standardi 528-2001, kohta 2.247).
- 7A103 Seuraavat muut kuin 7A003 kohdassa määritellyt instrumentit, navigointilaitteet ja -järjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
- Inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyyssmittareita tai 7A002 tai 7A102 kohdassa määriteltyjä gyroskooppeja, sekä järjestelmät, joihin sisältyy sellaisia laitteita;  
Huom.: 7A103.a kohta ei määrittele 7A001 kohdan määrittelemiä kiihtyvyyssmittareita sisältäviä laitteita, joiden kiihtyvyyssmittarit on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäviksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling).
  - Integroidut lentoinstrumenttijärjestelmät, jotka sisältävät 'ohjuksia' varten suunniteltuja tai muunnettuja hyrrävakauttajia tai automaattiohjauslaitteita;
  - 'Integroidut navigointijärjestelmät', jotka on suunniteltu tai muunnettu 'ohjuksia' varten ja joilla kyetään saamaan aikaan navigaatiotarkkuus, jossa yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä (CEP) on 200 metriä tai vähemmän.  
Tekn. huom.:  
*'Integroituun navigointijärjestelmään' sisältyvät tavallisesti seuraavat komponentit:*
    - Inertiamittauslaite (esim. asento- ja suuntaviitejärjestelmä, inertiaiviiteyksikkö tai inertianavigointijärjestelmä);
    - Yksi tai useampia ulkoisia ilmaisimia, joita käytetään aseman ja/tai nopeuden päivitykseen joko määrääjain tai jatkuvasti lennon aikana (esim. satelliittinavigointivastaanotin, tutkan korkeusmittari ja/tai Dopplertutka); ja
    - Integroidulaitteistot ja -ohjelmistot;
  - Kolmiakseliset suunta-anturit, jotka on määritelty tai muutettu sisällytettäväksi lennonjohto- ja navigaatiojärjestelmiin ja joissa on kaikki seuraavat ominaisuudet, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
    - Sisäinen kallistumankorjaus poikittais- ( $\pm 90$  astetta) ja poikittaisakselin ympäri ( $\pm 180$  astetta),
    - Vaakasunnan tarkkuus parempi (vähemmän) kuin 0,5 astetta rms  $\pm 80$  asteen leveydellä paikalliseen magneettikenttään nähden.  
Huom.: 7A103.d. kohdassa mainittuihin lennonjohto- ja navigointijärjestelmiin kuuluvat gyrovakaimet, autopilotit ja inertianavigointijärjestelmät.  
Tekn. huom.:  
7A103 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä raketinjärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km.
- 7A104 Muut kuin 7A004 kohdassa määritellyt hyrrä-tähtikompassit ja muut laitteet, joiden avulla määritetään asema tai suunta automaattisesti taivaankappaleita tai satelliitteja seuraamalla, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- 7A105 Vastaanottolaitteet maailmanlaajuisia satelliittinavigointijärjestelmiä varten (GNSS; esim. GPS, GLONASS tai Galileo), joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista ja erityisesti suunnitellut komponentit niitä varten:
- Ne on suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä ilma-aluksia tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten; tai

- 7A105 (jatkoa)
- b. Ne on suunniteltu tai muunnettu lentosovelluksia varten ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Ne pystyvät tuottamaan navigointitietoa nopeuksilla, jotka ovat yli 600 m/s;
  2. Ne käyttävät sotilas- tai hallintokäyttöön suunniteltua tai muunnettua salauksenpurkua voidakseen saada pääsyn GNSS-suojattuihin signaaleihin/tietoon; tai
  3. Ne on erityisesti suunniteltu käyttämään häirinnänestoa (esim. nollaohjausantenni tai elektronisesti ohjattava antenni) toimiakseen aktiivisten tai passiivisten vastatoimien ympäristössä.
- Huom.: 7A105.b.2 ja 7A105.b.3 kohta eivät aseta valvonnalliseksi laitteita, jotka on suunniteltu kaupallisia, siviilikäyttöön tarkoitettuja tai ihmishengen turvaavia (esim. tietojen eheys, lentoturvallisuus) GNSS-palveluja varten.
- 7A106 Muut kuin 7A006 kohdassa määritellyt tutka- tai "laser"-tutkatyyppiset korkeusmittarit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 tai 9A104 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa järjestelmissä.
- 7A115 Passiiviset anturit, joiden avulla määritellään suuntima tiettyihin sähkömagneettisiin lähteisiin (suuntimalaitteet) tai maaston ominaisuuksiin, ja jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa.
- Huom.: 7A115 kohta sisältää anturit seuraavia laitteita varten:
- a. Maanpinnan muodon kartoituslaitteet;
  - b. Kuvasanturilaitteet (sekä aktiiviset että passiiviset);
  - c. Passiiviset interferometrilaitteet.
- 7A116 Seuraavat lennon ohjausjärjestelmät ja servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa:
- a. Hydrauliset, mekaaniset, sähköoptiset tai sähkömekaaniset, mukaan lukien fly-by-wire-tyyppiset järjestelmät;
  - b. Lentoasennon säätölaitteet;
  - c. Lennonohjauksen servoventtiilit, jotka on suunniteltu tai muunnettu 7A116.a tai 7A116.b kohdassa määriteltyjä järjestelmiä varten ja suunniteltu tai muunnettu toimimaan ympäristössä, jossa värähtely on yli 10 g rms taajuusalueella 20 Hz–2 kHz.
- 7A117 "Ohjautuslaitteet", joita voidaan käyttää "ohjuksissa", jotka kykenevät 3,33 %:n tai parempaan järjestelmätarkkuuteen toimintaetäisyydellä (esim. "CEP" on 10 km tai vähemmän 300 km:n matkalla).

**7B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet:**

7B001 7A kohdassa määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet;

Huom.: 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ylläpitotasojen I tai II testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteita.

Tekn. huom.:

1. Ylläpitotaso I

Inertiasuunnistusjärjestelmän jonkin yksikön vikaantuminen huomataan lentokoneen ohjaus- ja näyttöyksiköstä (CDU) tai vastaavan alajärjestelmän tilanneviestistä. Noudattaen valmistajan käsikirjan antamia ohjeita vian syy voidaan paikallistaa epäkuntoisen vaihdettavan yksikön tasolle (LRU) ja operaattori voi vaihtaa varayksikön viiallisen tilalle.

2. Ylläpitotaso II

Viallinen linjahuollossa vaihdettava yksikkö (LRU) lähetetään valmistajan (tai tasosta II vastaavan operaattorin) korjauspisteeseen, jossa se testataan erilaisilla soveltuvilla tavoilla ja viallinen kokoonpano (SRA) paikallistetaan. Tämän kokoonpanon (SRA) tilalle vaihdetaan toimiva varaosa ja viallinen kokoonpano (SRA) (tai mahdollisesti koko yksikkö (LRU)) lähetetään valmistajalle.

Huom.: Ylläpitotaso II ei sisällä valvonnalaisten kiihtyvyyksimittarien tai gyroanturien irrottamista kokoonpanosta (SRA).

7B002 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet rengas-”laser”gyroskooppien peilien karakterisointia varten:

**Huom.:** KATSO MYÖS 7B102 KOHTA.

- a. Sironnamittarit, joiden mittaustarkkuus on vähemmän (parempi) kuin 10 ppm
- b. Pinnankarkeusmittarit (profilometrit), joiden mittaustarkkuus on 0,5 nm (5 ångströmiä) tai vähemmän (parempi).

7B003 7A kohdassa määriteltyjen laitteiden ”tuotantoon” erityisesti suunnitellut laitteet.

Huom.: 7B003 kohtaan sisältyy:

- a. Gyroskooppien virityksen testausasemat;
- b. Gyroskooppien dynaamiset tasapainotusasemat;
- c. Gyroskooppien totutuskäyttö/moottorin testausasemat;
- d. Gyroskooppien tyhjennys/täyttöasemat;
- e. Gyroskooppien laakereiden keskipakopitimet;
- f. Kiihtyvyyksimittareiden akselien linjausasema;
- g. Optisten kuitujen käämimiskoneet.

7B102 ”Laser”-gyroskooppien peilien luokitukseen erityisesti suunnitellut heijastusmittarit, joiden mittaustarkkuus on 50 ppm tai vähemmän (parempi).

7B103 ”Tuotantolaitokset” ja ”tuotantolaitteet” seuraavasti:

- a. ”Tuotantolaitokset”, jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa määriteltyjä laitteita varten;
- b. Tuotantolaitteet ja muut kuin 7B001–7B003 kohdassa määritellyt testaus-, kalibrointi- ja linjauslaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi 7A kohdassa määriteltyjen laitteiden kanssa.

**7C      Materiaalit**

Ei ole.

**7D Ohjelmistot**

7D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A tai 7B kohdassa määriteltyjen laitteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten:

7D002 "Lähdekoodi" minkä tahansa tyyppisten inertiasuunnistuslaitteiden "käyttöä" varten, mukaan lukien inertia-laitteet, joita ei ole määritelty 7A003 tai 7A004 kohdassa, tai AHRS-järjestelmät (Attitude Heading Reference Systems).

Huom.: 7D002 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kardaansia AHRS-järjestelmiä.

Tekn. huom.:

AHRS-järjestelmät eroavat yleisesti inertiasuunnistusjärjestelmistä (INS = Inertial Navigation Systems) siinä, että AHRS antaa asento- ja suuntatiedon eikä normaalisti anna INS-järjestelmiin liittyviä kiihtyvyy-, nopeus- tai asematietoja.

7D003 Seuraavat muut "ohjelmistot":

- a. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu parantamaan järjestelmien toimintakykyä tai vähentämään niiden navigointivirhettä 7A003, 7A004 ja 7A008 kohdassa määritellyille tasoille;
- b. Integroitujen hybridijärjestelmien "lähdekoodi", joka parantaa järjestelmien toimintakykyä tai vähentää niiden navigointivirhettä 7A003 ja 7A008 kohdassa määritellylle tasolle yhdistämällä jatkuvasti ohjaustietoa johonkin seuraavista:
  1. Doppler-tutkan tai ääniluotaimen antama nopeustieto;
  2. Globaalien paikannusjärjestelmien (so. GPS tai GLONASS) referenssitieto; tai
  3. Tieto, joka on peräisin DBRN (*Data-based Referenced Navigation*) -suunnistusjärjestelmistä;
- c. "Lähdekoodi" integroituja ilmailu- tai lentotehtäväjärjestelmiä varten, jotka yhdistävät anturitietoa ja käytävät "asiantuntijajärjestelmiä";
- d. "Lähdekoodi" seuraavien laitteiden tai järjestelmien "kehittämistä" varten:
  1. Digitaaliset lennonhallintajärjestelmät "lennon kokonaisohjaukseen";
  2. Integroidut moottori- ja lennonohjausjärjestelmät;
  3. Fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjausjärjestelmät;
  4. Vikasietoiset tai itsetoipuvat "aktiiviset lennonohjausjärjestelmät";
  5. Ilmassa käytettävät automaattiset suuntimislaitteet;
  6. Staattiseen maanpintatietoon perustuvat lentoarvojärjestelmät; tai
  7. Rasterityyppiset tuulilasinäytöt tai kolmiulotteiset näytöt.
- e. Tietokoneavusteiset suunnittelu"ohjelmistot" (CAD), jotka on erityisesti suunniteltu "aktiivisten lennonohjausjärjestelmien", helikopterien moniakseli- fly-by-wire tai fly-by-light ohjausten tai helikopterien "ilmavirran avulla säädellyt vastamomenttijärjestelmät tai ilmavirran avulla säädellyt suunnanohjausjärjestelmät", joiden "teknologia" on määritelty 7E004.b, 7E004.c.1 tai 7E004.c.2 kohdassa.

7D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

7D102 Integrointi"ohjelmistot" seuraavasti:

- a. Integrointi"ohjelmistot" 7A103.b kohdassa määriteltyjä laitteita varten;
- b. 7A003 tai 7A103.a kohdassa määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut integrointi"ohjelmistot".
- c. Integrointi"ohjelmistot", jotka on suunniteltu tai muunnettu 7A103.c kohdassa määriteltyjä laitteita varten.

*Huom.:* Integrointi"ohjelmistojen" tavallisissa muodoissa käytetään Kalman-filteriä.

7D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 7A117 kohdassa määriteltyjen ohjautuslaitteiden mallintamiseen tai simulointiin tai niiden integroinnin suunnitteluun kohdan 9A004, avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit, tai kohdan 9A104, luotainraketit, kanssa.

*Huom.:* 7D103 kohdassa määritellyt "ohjelmistot" jäävät valvonnalaiseksi, kun niitä yhdistetään 4A102 kohdassa määriteltyjen laitteiden kanssa.

**7E Teknologia**

7E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A, 7B tai 7D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä" varten.

7E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A tai 7B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

7E003 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001–7A004 kohdan laitteiden korjaukseen, kunnostukseen tai huoltoon;

Huom.: 7E003 kohta ei aseta valvonnallaiseksi ylläpito"teknologiaa", joka liittyy suoraan "siviili-ilma-alusten" ylläpitystasoa I tai ylläpitystasoa II:ssa kuvattuun viallisten tai ei-huollettavien LRU-yksiköiden ja SRA-kokoonpanojen kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon.

Huom.: Katso tekn. huom. 7B001 kohdassa.

7E004 Seuraava muu "teknologia":

- a. Seuraavien laitteiden tai järjestelmien "kehittämiseen" tai "tuotantoon" tarkoitettu "teknologia":
1. Ilmassa käytettävät automaattiset suuntimalaitteet, jotka toimivat yli 5 MHz:n taajuuksilla;
  2. Lentoarvojärjestelmät, jotka perustuvat vain staattiseen maanpintatietoon, ts. jotka korvaavat konventionaaliset ilmatietosondit;
  3. "Ilma-alusten" rasterityyppiset tuulilasinäytöt tai kolmiulotteiset näytöt;
  4. Inertiasuunnistusjärjestelmät tai hyrrätähtikompassit, jotka sisältävät 7A001 tai 7A002 kohdissa määriteltyjä kiihtyvyyssmittareita tai gyroskooppeja;
  5. Sähköiset toimilaitteet (so. sähkömekaaninen, sähköhydraattinen ja integroitu toimilaittejärjestelmä), jotka on erityisesti suunniteltu "primääristä lennonohjausta" varten;
  6. "Lennonohjauksen optinen anturijärjestelmä", joka on erityisesti suunniteltu "aktiivisten lennonohjausjärjestelmien" toteuttamiseksi.
  7. DBRN-järjestelmät, jotka on tarkoitettu vedenalaiseen navigointiin, jossa käytetään ääni- tai painovoimatietokantoja, joiden paikanmäärittystarkkuus on yhtä suuri tai vähemmän (parempi) kuin 0,4 merimailia.
- b. Seuraava "kehittämis" "teknologia" "aktiivisia lennonohjausjärjestelmiä" varten (mukaanlukien fly-by-wire- tai fly-by-light-järjestelmät):
1. Konfiguraatiosuunnittelu useiden mikroelektronisten prosessointiyksiköiden (on-board-tietokoneiden) yhdistämiseksi suorittamaan tosiaikaista käsittelyä ohjaussäätöjen soveltamiseksi;
  2. Anturien paikan tai lentokonerakenteiden dynaamisen kuormituksen ohjaussäätökompensointi, ts. anturien värinäympäristön tai anturien sijainnin vaihtelun kompensointi painopisteen suhteen;
  3. Elektroninen redundanttien tietojen tai järjestelmien hallinta vian havaitsemista, vian sietoa, vian eristämistä tai uudelleenkonfigurointia varten;

Huom.: 7E004.b.3 kohta ei aseta valvonnallaiseksi "teknologiaa" fyysisen redundanssin suunnittelua varten.

4. Lennonohjausjärjestelmät, jotka sallivat lennon aikaisen voima- ja momenttiohjausten uudelleenkonfiguroinnin ilma-aluksen tosiaikaista autonomista ohjausta varten;

- 7E004 b. (jatkoa)
5. Digitaalisten lennonohjaus-, navigointi- ja moottorinohjaustietojen integrointi digitaalseksi lennonhallintajärjestelmäksi "lennon kokonaisohjausta" varten;
- Huom.: 7E004.b.5 kohta ei aseta valvonnallaiseksi:
- a. "Kehittämis"teknologiaa" digitaalisen lennonohjauksen, navigoinnin ja työntövoiman ohjaustietojen integroimiseksi digitaalseksi lennonhallintajärjestelmäksi "lentoradan optimointia" varten.
- b. Sellaisten "lentokoneen" instrumenttijärjestelmien "kehittämis"teknologiaa", jotka on integroitu ainoastaan seuraavia navigointi- tai laskeutumisjärjestelmiä varten: VOR-, DME, ILS- tai MLS-navigointia tai -lähestymistä varten.
6. "Täyden auktoriteetin digitaaliset lennonohjausjärjestelmät" tai monianturiset lentotehtävän hallintajärjestelmät, jotka sisältävät "asiantuntijajärjestelmiä";
- Huom.: "Teknologia" täyden auktoriteetin digitaalista moottorin ohjausta ("FADEC") varten: katso 9E003.a.9 kohta.
- c. "Teknologia" seuraavien helikopterijärjestelmien "kehittämistä" varten:
1. Moniakseliset fly-by-wire- tai fly-by-light-ohjaukset, jotka yhdistävät toiminnot vähintään kahdesta seuraavasta ohjauksesta yhdeksi ohjaavaksi elementiksi:
- a. Nousu- ja laskuohjaukset;
- b. Vaakatason ohjaukset;
- c. Suuntaoikeaman ohjaukset;
2. "Ilmavirran avulla säädellyt vastamomentti- tai suunnanohjausjärjestelmät";
3. Roottorilavat, jotka sisältävät "muuttuvan geometrian kantopintoja" ja joita käytetään yksittäisiä lappoja ohjaavissa järjestelmissä.
- 7E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115–7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101–7D103 kohdassa määriteltyjen laitteiden käyttöä varten.
- 7E102 Seuraavat "teknologiat" ilmailuelektronikan ja sähköisten alajärjestelmien suojaamiseksi ulkoisista lähteistä aiheutuvaa sähkömagneettisen pulssin (EMP = Electro Magnetic Pulse) sekä sähkömagneettisen häiriön (EMI = Electro Magnetic Interference) uhkaa vastaan:
- a. Suojausjärjestelmien suunnittelu "teknologia";
- b. Suunnittelu "teknologia" vahvennettujen sähköisten piirien ja alajärjestelmien konfigurointia varten;
- c. Suunnittelu "teknologia" 7E102.a ja 7E102.b kohdan vahvennuskriteerien määrittelyä varten.
- 7E104 "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmäksi rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi.



**RYHMÄ 8**

**MERITEKNOLOGIA**



**8A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

8A001 Seuraavat vedenalaiset tai pinta-alukset:

Huom.: Vedenalaisten alusten valvonnallisuuden selvittämiseksi, katso myös:

- 5 ryhmä 2 osa: "Tiedonsuojaus" salattua viestintää suorittavat laitteet;
- 6 ryhmä: anturit;
- 7 ja 8 ryhmä: navigointilaitteet;
- 8A ryhmä: vedenalaiset laitteet.

- a. Miehitetyt kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä;
- b. Miehitetyt kytkemättömät vedenalaiset alukset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
  1. Ne on suunniteltu 'toimimaan itsenäisesti' ja niillä on kaikki seuraavat nostokyvyt:
    - a. 10 % tai enemmän niiden painosta ilmassa; ja
    - b. 15 kN tai enemmän;
  2. Suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä; tai
  3. Niillä on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - a. Ne on suunniteltu 4:n tai useamman hengen miehistöä varten;
    - b. Ne on suunniteltu 'toimimaan itsenäisesti' 10 tuntia tai pidempään;
    - c. 'Toimintasäde' on 25 merimailia tai enemmän; ja
    - d. Pituus on 21 m tai vähemmän;

Tekn. huom.:

1. 8A001.b kohdassa 'toimii itsenäisesti' tarkoittaa toimintaa täysin sukelluksissa, ilman snorkkeliä, kaikki järjestelmät toiminnassa ja kulkemista sillä miniminopeudella, jolla sukelluslaite voi turvallisesti ohjata dynaamisesti syvyyttään käyttämällä vain syvyysohjaimiaan ja tarvitsematta tukialusta tai pinnalla, merenpohjassa tai maalla olevaa tukiasemaa, sekä sukellus- tai pintakäyttöön soveltuvia työntövoimajärjestelmiä.
  2. 8A001.b kohdassa 'toimintasäde' tarkoittaa puolta maksimietäisyydestä, josta sukelluslaite voi suoriutua.
- c. Miehitämättömät, kytketyt vedenalaiset alukset, jotka on suunniteltu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
    1. Ne on suunniteltu itseliikkuviksi 8A002.a.2 kohdassa määriteltyjä työntövoimamoottoreita tai sysäimiä käyttäen; tai
    2. Joilla on kuituoptinen tietoyhteys;
  - d. Miehitämättömät, kytkemättömät vedenalaiset alukset:
    1. Jotka on suunniteltu valitsemaan kurssi minkä tahansa maantieteellisen kohteen suhteen ilman ihmisen tosiaikaista avustusta;
    2. Joilla on akustinen tieto- tai komentoyhteys; tai
    3. Joilla on kuituoptinen tieto- tai komentoyhteys, joka ylittää 1 000 m;

8A001 (jatkoa)

- e. Valtameripelastusjärjestelmät, joiden nostokyky ylittää 5 MN, jotka on tarkoitettu pelastamaan kohteita yli 250 m:n syvyyksistä ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Dynaaminen paikannusjärjestelmä, jolla asema voidaan säilyttää 20 metrin tarkkuudella navigointijärjestelmän antaman pisteen suhteen; tai
  2. Merenpohjanavigoinnin ja navigoinnin integraatiojärjestelmät yli 1 000 m metrin syvyyksille, joiden paikannustarkkuus on alle 10 m ennalta annetusta pisteestä;
- f. (Täysin helmoitetut) ilmatyynyalukset, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 30 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 1,25 m (merenkäyntitila 3) tai enemmän;
  2. Tyynypaine ylittää 3 830 Pa; ja
  3. Tyhjän ja täyteen lastatun aluksen uppomasuhde on alle 0,70;
- g. Sivurungoilla varustetut ilmatyynyalukset, joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 40 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän;
- h. Kantosiipialukset, joissa on aktiiviset järjestelmät kantosiipien automaattiseksi ohjaamiseksi ja joiden maksiminopeus täydessä lastissa on 40 solmua tai enemmän merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän;
- i. 'Pienen vesiviivapinta-alan alukset':
1. Joiden uppouma täydessä lastissa ylittää 500 tonnia ja joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 35 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 3,25 m (merenkäyntitila 5) tai enemmän; tai
  2. Joiden uppouma täydessä lastissa ylittää 1 500 tonnia ja joiden suunniteltu maksiminopeus täydessä lastissa ylittää 25 solmua merkitsevän aallonkorkeuden ollessa 4 m (merenkäyntitila 6) tai enemmän.

Tekn. huom.:

'Pienen vesiviivapinta-alan alus' määritellään seuraavalla kaavalla: vesiviivapinta-ala suunnitellulla toimintasyvyyksellä on vähemmän kuin  $2 \times (\text{uppouman tilavuus suunnitellulla toimintasyvyyksellä})^{2/3}$ .

8A002 Seuraavat järjestelmät ja laitteet ja niiden komponentit:

Huom.: Vedenalaiset viestintälaitteet: katso 5 ryhmä 1 osa – Tietoliikenne.

- a. Seuraavat järjestelmät ja laitteet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisia aluksia varten ja jotka on tarkoitettu toimimaan yli 1 000 m:n syvyyksissä:
1. Painekotelot tai painerungot, joiden sisätilan läpimitta on yli 1,5 m;
  2. Tasavirralla toimivat työntövoimalaitteet;
  3. Yhdyskaapelit ja niiden liittimet, joissa käytetään optisia kuituja ja joissa on synteettisiä vahvikkeita;
  4. 8C001 kohdassa määritellyistä materiaaleista valmistetut komponentit;

Tekn. huom.:

Tässä kohdassa tarkoitettua valvontaa ei saa kiertää viemällä 8C001 kohdassa tarkoitettua syntaktista vaahtoa, kun valmistuksen välivaihe on suoritettu mutta tuote ei ole vielä lopullisen komponentin muodossa.

8A002 (jatkoa)

- b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ohjaamaan automaattisesti 8A001 kohdassa määriteltyjen vedenalaisten alusten liikkeitä käyttäen navigointitietoa ja suljetun säätöpiirin servo-ohjausta ja jotka:
1. Mahdollistavat aluksen liikkumisen 10 m:n sisällä ennalta annetusta vesipatsaan pisteestä;
  2. Säilyttävät aluksen paikan 10 m:n sisällä ennalta määritellystä vesipatsaan pisteestä; tai
  3. Säilyttävät aluksen etäisyyden 10 m:n tarkkuudella, kun seurataan merenpohjalla tai sen alla olevaa kaapelia;
- c. Kuituoptiset runkoläpiviennit ja -liittimet;
- d. Seuraavat vedenalaiset näyttöjärjestelmät:
1. Seuraavat televisiojärjestelmät ja televisiokamerat:
    - a. Televisiojärjestelmät (jotka koostuvat kamerasta, valonlähteistä, monitorointi- ja signaalinvälityslaitteista), joiden rajaerottelu-tarkkuus ilmassa mitattuna ylittää 800 juovaa ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan;
    - b. Vedenalaiset televisiokamerat, joiden rajaerottelutarkkuus ilmassa mitattuna ylittää 1 100 juovaa;
    - c. Heikon valotason televisiokamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön sisältäen kaikki seuraavat:
      1. 6A002.a.2.a kohdassa määriteltyjä kuvanvahvistinputkia; ja
      2. Enemmän kuin 150 000 "aktiivista pikseliä" puolijohdepinta-alamatriisia kohti;
- Tekn. huom.:
- Television rajaerottelutarkkuus on horisontaalisen resoluution mitta, joka tavallisesti ilmaistaan testitaulukosta erottuvana maksimijuovalukuna kuvan korkeutta kohti käyttäen IEEE:n standardia 208/1960 tai jotain vastaavaa standardia.*
2. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen aluksen etäistoimintaan ja jotka käyttävät tekniikkaa, jolla minimoidaan takaisinsironnan vaikutuksia, mukaan lukien etäisyyden mukaan toimivat valonlähteet tai "laser"järjestelmät;
- e. Valokuvauskamerat, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön yli 150 m:n syvyydessä, joiden filmikoko on 35 mm tai suurempi ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Joissa filmiin voidaan sisällyttää tietoa kameran ulkopuolisesta lähteestä;
  2. Joissa on automaattinen polttovälin taustakorjaus; tai
  3. Joissa on automaattinen kompensointiohjaus, joka on erityisesti suunniteltu sallimaan vedenalaisen kameran kotelon käyttö yli 1 000 m:n syvyyksissä;
- f. Elektroniset kuvausjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaiseen käyttöön ja jotka kykenevät tallettamaan digitaalisesti enemmän kuin 50 kuvaa;

Huom.: 8A002.f kohta ei aseta valvonnalaiseksi digitaalisia kameroita, jotka on erityisesti suunniteltu kuluttajien käyttöön, lukuun ottamatta niitä, joissa käytetään elektronisia kuvanmonistustekniikoita.

8A002 (jatkoa)

- g. Seuraavat erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut tai muunnetut valonlähdejärjestelmät:
1. Stroboskooppiset valonlähteet, jotka kykenevät antamaan yli 300 J:n suuruisen valoenergian välähdystä kohti ja joiden välähdysnopeus on enemmän kuin 5 välähdystä sekunnissa;
  2. Argonvalokaarijärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi yli 1 000 m:n syvyyksissä;
- h. Erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut "robotit", joita ohjataan käyttämällä dedikoitua tietokonetta ja jotka:
1. Sisältävät järjestelmiä, jotka ohjaavat "robottia" käyttäen tietoa antureilta, jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia, ulkoisen kohteen etäisyyttä tai "robotin" ja ulkoisen kohteen välistä tuntoaistia; tai
  2. Kykenevät aikaansaamaan 250 N:n tai suuremman voiman tai 250 Nm:n tai suuremman momentin ja joiden rakenne-elimissä on käytetty titaanipohjaisia seoksia tai "kuitu- tai säie"komposiittimateriaaleja;
- i. Etäisohjatut nivelmanipulaattorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi vedenalaisissa aluksissa ja:
1. Joissa on järjestelmiä, jotka ohjaavat manipulaattoreita käyttäen antureiden tietoa, jotka mittaavat ulkoiseen kohteeseen kohdistettua voimaa tai momenttia tai tuntoaistia manipulaattorin ja ulkoisen kohteen välillä; tai
  2. Joita ohjataan isäntä-orja-suhdesäätötekniikalla tai jotka käyttävät dedikoitua tietokonetta ja joilla on 5 tai useampia liikkeen vapausasteita;
- Huom.:* Vain ne toiminnot, joilla on asennon takaisinkytkentää käyttävä suhdesäätö tai jotka käyttävät dedikoitua tietokonetta, otetaan huomioon vapausasteiden lukumäärää määritettäessä.
- j. Seuraavat ilmasta riippumattomat, erityisesti vedenalaiseen käyttöön suunnitellut tehojärjestelmät:
1. Brayton- tai Rankine-moottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on jokin seuraavista:
    - a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja ainehiukkasia kierrätetyistä moottorin pakokaasuista;
    - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käyttämään yksiatomista kaasua;
    - c. Laitteet tai suojuukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; tai
    - d. Erityisesti suunnitellut järjestelmät:
      1. Jotka paineistavat reaktiotuotteita tai puhdistavat polttoainetta (reforming-menetelmällä);
      2. Jotka varastoivat reaktiotuotteita; ja
      3. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;
  2. Dieselmoottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
    - a. Kemialliset pesuri- tai imeytysjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu poistamaan hiilidioksidia, hiilimonoksidia tai ainehiukkasia kierrätetyistä moottorin pakokaasuista;
    - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käyttämään yksiatomista kaasua;

- 8A002 j. 2. (jatkoa)
- c. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; ja
  - d. Erityisesti suunnitellut pakokaasujärjestelmät, jotka eivät poista palamistuloksia jatkuvasti;
3. Polttokennojen ilmasta riippumattomat järjestelmät, joiden teho ylittää 2 kW ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
- a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksien melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; tai
  - b. Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu:
    1. Paineistamaan reaktiotuotteita tai uudistamaan polttoainetta;
    2. Varastoimaan reaktiotuotteita; ja
    3. Poistamaan reaktiotuotteet yli 100 kPa:n painetta vastaan;
4. Stirling-moottorien ilmasta riippumattomat järjestelmät, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- a. Laitteet tai suojukset, jotka on erityisesti suunniteltu vaimentamaan alle 10 kHz:n taajuuksista melua veden alla, tai erityiset iskua vaimentavat kiinnityslaitteet; ja
  - b. Jotka poistavat reaktiotuotteita 100 kPa:n tai suurempaa painetta vastaan;
- k. Helmat, tiivisteet tai liuskat:
1. Jotka on suunniteltu 3 830 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat merkitsevässä 1,25 m:n (merenkäyntitila 3) tai korkeammassa aallokossa ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f kohdassa määriteltyjä kokonaan helmoitettuja ilmatyynyaluksia varten; tai
  2. Jotka on suunniteltu 6 224 Pa:n tai suurempia tyynypaineita varten, jotka toimivat aallokossa, jonka merkitsevä aallonkorkeus on 3,25 metriä (merenkäyntitila 5) tai enemmän, ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.g kohdassa määriteltyjä jäykällä sivuseinillä varustettuja ilmatyynyaluksia varten;
- l. Nostopuhaltimet, jotka on mitoitettu yli 400 kW:lle ja jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f tai 8A001.g kohdassa määriteltyjä ilmatyynyaluksia varten;
- m. Täysin veden alla toimivat kavitoimattomat tai ylikavitoivat kantosiivet, jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.h kohdassa määriteltyjä aluksia varten;
- n. Aktiiviset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu automaattisesti kontrolloimaan aallokon aiheuttamaa liikettä 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa määritellyissä aluksissa;
- o. Seuraavat potkurit, tehonsiirtojärjestelmät, tehontuottojärjestelmät tai melunvaimennusjärjestelmät:
1. Seuraavat potkuri- tai tehonsiirtojärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h tai 8A001.i kohdassa määriteltyjä ilmatyynyaluksia (kokonaan helmoitettuja tai jäykkäsivulaitaisia), kantosiipialuksia tai pienen vesiviivapinta-alan aluksia varten:
    - a. Ylikavitoivat, ylituuletetut, osittain vedenalaiset tai pintaa leikkaavat yli 7,5 MW:lle mitoitettut potkurit;
    - b. Vastakkain pyörivät potkurijärjestelmät, jotka on mitoitettu yli 15 MW:lle;

- 8A002 o. 1. (jatkoa)
- c. Järjestelmät, jotka käyttävät tulopyörre- tai jättöpyörretekniikkaa tasoittamaan potkurivirtausta;
  - d. Erikoiskevyet, korkeakapasiteettiset (K-arvo ylittää 300) alennusvaihteet;
  - e. Tehonsiirron akselijärjestelmät, jotka sisältävät komponentteja komposiittimateriaaleista ja jotka kykenevät siirtämään enemmän kuin 1 MW;
2. Seuraavat aluksissa käytettävät potkurit, tehojärjestelmät tai tehonsiirtojärjestelmät:
- a. Säättösiipipotkurit ja niiden napakoonpanot, jotka on mitoitettu yli 30 MW:lle;
  - b. Sisäisesti nestejäähdytetyt sähkö-työntövoimamoottorit, joiden antoteho ylittää 2,5 MW;
  - c. "Suprajohde"työntövoimamoottorit tai kestopagneetti-työntövoimamoottorit, joiden antoteho ylittää 0,1 MW;
  - d. Tehonsiirron akselijärjestelmät, jotka sisältävät komponentteja "komposiitti"materiaaleista ja jotka kykenevät siirtämään enemmän kuin 2 MW;
  - e. Tuuletetut tai jäähdytetyt potkurijärjestelmät, jotka on mitoitettu yli 2,5 MW:lle;
3. Seuraavat melunvaimennusjärjestelmät, joita käytetään 1 000 tonnin tai suuremman uppouman aluksissa:
- a. Melunvaimennusjärjestelmät, jotka vaimentavat alle 500 Hz:n taajuuksia ja jotka koostuvat akustisista jalustoista dieselmoottoreita, dieselgeneraattoreita, kaasuturbiineita, kaasuturbiinigenaattoreita, työntövoimamoottoreita tai niiden alennusvaihteita varten, ja jotka on erityisesti suunniteltu melun tai tärinän vaimentamiseen, ja joiden oma massa ylittää 30 % asennettavien laitteiden massasta;
  - b. Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät, tai erityisesti tehonsiirtojärjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä, ja jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen;
- p. Vesisuihkutyöntövoimajärjestelmät, joiden ulostuloteho ylittää 2,5 MW ja jotka käyttävät suunnattavaa suutinta ja virtausta säätelevää siipitekniikkaa parantamaan työntötehoa tai vähentämään koneen aiheuttamaa veden alla leviävää melua.
- q. Sukeltamiseen ja vedenalaiseen uintiin soveltuvat itsenäiset, suljetun tai puolisoljetun kierron (rebreathing-) laitteet.

Huom.: 8A002.q kohta ei aseta valvonnalaiseksi henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja yksittäisiä laitteita, jotka ovat käyttäjänsä mukana.

**8B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

- 8B001 Vesitunnelit, joiden taustamelu on vähemmän kuin 100 dB (vertailuarvo 1  $\mu$ Pa, 1 Hz) taajuusalueella 0 Hz–500 Hz ja jotka on suunniteltu mittaamaan veden virtauksen synnyttämää akustista kenttää työntövoimajärjestelmien mallien ympärillä.

**8C**      **Materiaalit**

8C001      'Syntaktiset vaahdot' vedenalaiseen käyttöön:

**Huom.: KATSO MYÖS 8A002.A.4. KOHTA.**

- a.    Jotka on suunniteltu yli 1 000 m:n syvyyksille; ja
- b.    Joiden tiheys on vähemmän kuin  $561 \text{ kg/m}^3$ .

Tekn. huom.:

'Syntaktinen vaahdot' koostuu ontoista muovi- tai lasipalloista, jotka on upotettu hartsimatriisiin.

**8D Ohjelmistot**

- 8D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 8A, 8B tai 8C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.
- 8D002 Erityiset "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu vedenalaisen melun vähentämiseen tarkoitettujen potkurien "kehittämistä", "tuotantoa", korjausta, huoltoa tai uudistamista (uudelleenkonestaamista) varten.

**8E        Teknologia**

8E001        "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 8A, 8B tai 8C kohdassa määriteltyjen laitteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

8E002        Seuraava muu "teknologia":

- a.    "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vähentämiseen suunniteltujen potkurien "kehittämistä", "tuotantoa", korjausta, huoltoa tai uudelleenkonemistamista varten;
- b.    "Teknologia", joka on tarkoitettu 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o tai 8A002.p kohdassa määriteltyjen laitteiden huoltoa tai kunnostamista varten.

**RYHMÄ 9**

**ILMA- JA AVARUUSALUSTEN TYÖNTÖVOIMA**



**9A Järjestelmät, laitteet ja komponentit**

Huom.: Työntövoimajärjestelmät, jotka on suunniteltu tai mitoitettu neutroni- tai lyhytaikaista ionisoivaa säteilyä vastaan: katso asetarvikeluettelo.

9A001 Lentokoneiden kaasuturbiinimoottorit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

**Huom.: KATSO MYÖS 9A101 KOHTA.**

a. Jotka sisältävät jotain 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa"; tai

Huom.: 9A001.a kohdassa ei valvota lentokoneiden kaasuturbiinimoottoreita, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a. Jotka "osallistujavaltion" siviili-ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet; ja

b. Jotka on tarkoitettu voimanlähteeksi ei-sotilaallisissa miehitetyissä ilma-aluksissa, joille "osallistujavaltio" on myöntänyt yhden seuraavista niiden ilma-alusten osalta, joissa on tämä tietty moottorityyppi:

1. Tyyppihyväksyntä siviilikäyttöön; tai

2. Vastaava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) hyväksymä asiakirja.

b. Jotka on suunniteltu voimanlähteeksi ilma-alukseen, joka on suunniteltu lentämään 1 Machin tai suuremmalla matkanopeudella pidempään kuin 30 minuuttia.

9A002 'Laivojen kaasuturbiinimoottorit', joiden määritelty ISO-standardin mukainen jatkuva teho on 24 245 kW tai enemmän ja polttoaineen nimelliskulutus on vähemmän kuin 0,219 kg/kWh 35–100 % tehoalueella, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit.

Huom.: Termi 'laivojen kaasuturbiinimoottorit' sisältää myös sellaiset kaasuturbiinien teolliset tai ilmailuersiot, joita käytetään laivojen työntövoimajärjestelmissä tai sähköntuotantoon aluksilla.

9A003 Erityisesti suunnitellut kokoonpanot ja komponentit, jotka sisältävät mitä tahansa 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa", seuraavia kaasuturbiinityöntövoima-järjestelmiä varten:

a. Jotka on määritelty 9A001 kohdassa;

b. Joiden suunnittelu- tai tuotantoalkuperä ei ole "osallistujavaltiosta" tai on valmistajalle tuntematon.

9A004 Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit tai "avaruusalukset".

**Huom.: KATSO MYÖS 9A104 KOHTA.**

Huom.: 9A004 kohta ei aseta valvonnallaisiksi hyötykuormia.

Huom.: "Avaruusalusten" hyötykuormiin sisältyvien tuotteiden valvonnallaisuuden määrittämiseksi, katso soveltuvat ryhmät.

9A005 Nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9A006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja.

**Huom.: KATSO MYÖS 9A105 JA 9A119 KOHTA.**

9A006 Seuraavat järjestelmät tai komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu nestemäistä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiin:

**Huom.: KATSO MYÖS 9A106, 9A108 JA 9A120 KOHTA.**

a. Kryogeeniset jäähdyttimet, lentokeveät dewar-säiliöt, kryogeeniset lämpöputket tai kryogeeniset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi avaruusaluksissa ja jotka kykenevät rajoittamaan kryogeenisen nesteen hukan vähempään kuin 30 % vuodessa;

b. Kryogeeniset säiliöt tai suljetun kierron jäähdytysjärjestelmät, jotka kykenevät tuottamaan 100 K (– 173 °C) astetta tai alempia lämpötiloja, yli 3 Machin lentonopeutta ylläpitämään tarkoitettuja lentokoneita, kantoraketteja tai "avaruusaluksia" varten;

c. Nestemäisen vedyn varastointi- tai siirtojärjestelmät;

d. Korkeapaineiset (yli 17,5 MPa) turbopumpit, pumppujen komponentit tai niihin liittyvät kaasugeneraattorit tai laajenemissyklin turbiinimoottorijärjestelmät;

- 9A006 (jatkoa)
- e. Korkeapaineiset (yli 10,6 MPa) työntökammiot ja niiden suuttimet;
  - f. Polttoaineen varastointijärjestelmät, jotka käyttävät kapillaarista säilytystä tai positiivista (esim. joustavilla palkeilla aikaansaatu) poistoperiaatetta;
  - g. Erityisesti nestemäistä polttoainetta käyttäville rakettimeoottoreille suunnitellut nestemäisen polttoaineen injektorit, joiden yksittäiset suuttimet ovat läpimitaltaan 0,381 mm tai pienemmät (ei-pyöreiden aukkojen ala  $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$  tai pienempi);
  - h. Yksiosaiset hiili-hiili palokammiot tai yksiosaiset hiili-hiili poistokartiot, joiden tiheydet ylittävät  $1,4 \text{ g/cm}^3$  ja murtovetolujuus ylittää 48 MPa.

9A007 Kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joilla on jokin seuraavista:

**Huom.: KATSO MYÖS 9A107 JA 9A119 KOHTA**

- a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs;
- b. Ominaisimpulssi on 2,4 kNs/kg tai enemmän kun suutinvirtausta laajennetaan siten, että kammion paine on 7 MPa (suhteutettuna merenpinnan tasolle);
- c. Vaiheiden massaosamäärät ylittävät 88 % ja kiinteän polttoaineen täyttösuhde ylittää 86 %;
- d. Jonkin 9A008 kohdassa määritellyistä komponenteista; tai
- e. Eristeen ja polttoaineen välillä on sidosjärjestelmät, joissa käytetään suoraanliitettyä moottorirakennetta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinteän polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin välille.

Tekn. huom.:

9A007.e kohdassa tarkoitetaan 'vahvalla mekaanisella sidoksella' vähintään polttoaineen vahvuista sidosta.

9A008 Seuraavat erityisesti kiinteätä polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:

**Huom.: KATSO MYÖS 9A108 KOHTA.**

- a. Eristeen ja polttoaineen väliset sidosjärjestelmät, joissa käytetään vuorausta muodostamaan 'vahva mekaaninen sidos' tai este kemialliselle kulkeutumiselle kiinteän polttoaineen ja kotelon eristysmateriaalin välille;

Tekn. huom.:

9A008.a kohdassa tarkoitetaan 'vahvalla mekaanisella sidoksella' vähintään polttoaineen vahvuista sidosta.

- b. Kuidusta kiedotusta "komposiitti"materiaalista valmistetut moottorikotelot, joiden läpimitta ylittää 0,61 m tai joiden 'rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)' ylittää 25 km;

Tekn. huom.:

'Rakenteellinen tehokkuussuhde (PV/W)' on puhkeamispaineen (P) ja astian tilavuuden (V) tulo jaettuna paineastian kokonaispainolla (W).

- c. Suuttimet, joiden työntövoimataso ylittää 45 kN tai joiden kaulan kulumisnopeus on vähemmän kuin 0,075 mm/s;
- d. Liikkuvan suuttimen tai sekundäärisen polttoaineen ruiskutuksen työntövektorin ohjausjärjestelmät:
  - 1. Jotka kykenevät yli  $\pm 5$  asteen liikkeeseen akselinsa ympäri;
  - 2. Joiden kulmavektoria voidaan kääntää 20 astetta sekunnissa tai enemmän; tai
  - 3. Joiden kulmavektoriikihtyvyyden on 40 astetta/s<sup>2</sup> tai enemmän.

- 9A009 Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden:
- Huom.: KATSO MYÖS 9A109 JA 9A119 KOHTA.**
- Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs; tai
  - työntövoima ylittää tyhjöolosuhteissa 220 kN.
- 9A010 Seuraavat kantoraketteja tai kantorakettien työntövoimalaitteita tai "avaruusaluksia" varten erityisesti suunnitellut komponentit, järjestelmät ja rakenteet:
- Huom.: KATSO MYÖS 1A002 JA 9A110 KOHTA.**
- Kaikki 10 kg ylittävät komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 1C007 tai 1C010 kohdassa määriteltyjä metalli"matriiseja", "komposiitteja", orgaanisia "komposiitteja", keraamisia "matriiseja" tai metallivahvistettuja materiaaleja käyttäen valmistettuja laukaisulaitteita varten;
- Huom.: Painorajoitus ei ole olennainen kärkikartioille.*
- Komponentit ja rakenteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A005–9A009 kohdassa määriteltyihin laukaisulaitteiden työntövoima-järjestelmiin, ja jotka on valmistettu 1C007 tai 1C010 kohdassa määriteltyjä metallimatriiseja, komposiitteja, orgaanisia komposiitteja, keraamisia komposiitteja tai metallivahvistettuja materiaaleja käyttäen;
  - Rakenteellisia komponentteja ja eristäviä järjestelmiä, jotka on erityisesti suunniteltu aktiivisesti ohjaamaan "avaruusaluksen" rakenteiden dynaamisia reaktioita tai muodonmuutoksia;
  - Nestemäistä polttoainetta käyttävät sykäysrakettimoottorit, joiden työntö/paino suhde on 1 kN/kg tai enemmän ja vasteaika (aika, joka tarvitaan saavuttamaan 90 % mitoitetusta työntövoimasta käynnistyksestä) on vähemmän kuin 30 ms.
- 9A011 Patoputki- (ramjet), ahtoputki- (scramjet) tai yhdistelmätahtimoottorit ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- Huom.: KATSO MYÖS 9A111 JA 9A118 KOHTA.**
- 9A012 "Miehittämättömät ilma-alukset" ("UAV":t), niihin liittyvät järjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:
- "UAV":t, joissa on jokin seuraavista:
    - Riippumaton lennonhallinta- ja suunnistuskkyky (esim. inertiasuunnistusjärjestelmällä varustettu automaattiohjain); tai
    - Kyky suorittaa johdettu lento suoran näköetäisyyden ulkopuolelle operaattorin avustuksella (esim. televisuaalinen kauko-ohjaus).
  - Niihin liittyvät järjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:
    - Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A012.a kohdassa määriteltyjen UAV:iden kauko-ohjaukseen;
    - Muut kuin 7A kohdassa määritellyt ohjaus- tai hallintajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu sisällytettäväksi 9A012.a kohdassa määriteltyihin UAV:ihin;
    - Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu muuntamaan miehitetty "ilma-alus" 9A012.a kohdassa määriteltyksi "UAV":ksi.
- 9A101 Seuraavat muut kuin 9A001 kohdassa määritellyt suihkuturbiini- ja ohivirtausmoottorit (mukaan lukien yhdistelmäturbiinimoottorit):
- Moottorit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
    - Maksimi (asentamattomana saavutettu) työntövoiman arvo on suurempi kuin 400 N lukuun ottamatta hyväksytyjä siviilimoottoreita, joiden maksimi (asentamattomana saavutettu) työntövoiman arvo on suurempi kuin 8 890 N; ja
    - Ominaispolttoaineen kulutus (jatkuvalla maksimiteholla merenpinnan tasolla vakio- ja normaaliolosuhteissa) on 0,15 kg/N/h tai vähemmän;
  - Moottorit, jotka on suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi "ohjuksissa".

- 9A104 Luotainraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkaan.
- Huom.: KATSO MYÖS 9A004 KOHTA.**
- 9A105 Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit:
- Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.**
- a. Muut kuin 9A005 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 1,1 MNs tai suurempi;
- b. Muut kuin 9A005 tai 9A105.a kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.
- 9A106 Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttäviin raketteihin erityisesti suunnitellut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan käyttää ohjuksissa:
- a. Työntövoima- ja palokammioiden kuluvat vuoraukset;
- b. Rakettien suuttimet;
- c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät;
- Tekn. huom.:*
- Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A106.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:*
1. *Taipuisa suutin;*
  2. *Neste- tai toisiokaasusuihkutus;*
  3. *Liikkuva moottori tai suutin;*
  4. *Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai*
  5. *Työntövoimalaipat.*
- d. Nestemäisen ja lietemäisen ajoaineen (myös hapettimien) ohjausjärjestelmät sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu tai muunnettu toimimaan yli 10 g:n rms ja 20 Hz–2 kHz:n värinäolosuhteissa.
- Huom.:* *Ainoat servoventtiilit ja pumput, jotka on määritelty 9A106.d kohdassa ovat seuraavat:*
- a. *Servoventtiilit, jotka on suunniteltu 24 litran minuutissa tai suuremmille virtausnopeuksille, 7 MPa tai suuremmalle absoluuttipaineelle ja joiden toimilaitteen vasteaika on vähemmän kuin 100 ms;*
  - b. *Pumput nestemäisiä polttoaineita varten, joiden akselinopeudet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 8 000 rpm tai joiden poistumisaineet ovat yhtäsuuria tai suurempia kuin 7 MPa.*
- 9A107 Muut kuin 9A007 kohdassa määritellyt kiinteää polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä rakettijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 0,841 MNs tai suurempi.
- Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.**
- 9A108 Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa määritellyt komponentit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmiä varten:
- a. Rakettimoottorien kotelot ja niiden "eristys"komponentit;
  - b. Rakettien suuttimet;
  - c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät.

- 9A108 c. (jatkoa)
- Tekn. huom.:*
- Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A108.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:
1. Taipuisa suutin;
  2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
  3. Liikkuva moottori tai suutin;
  4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
  5. Työntövoimalaivat.
- 9A109 Muut kuin 9A009 kohdassa määritellyt hybridirakettimeoottorit, joita voidaan käyttää 'ohjuksissa', ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.
- Huom.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.**
- Tekn. huom.:*
- 9A109 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km.
- 9A110 Muut kuin 9A010 kohdassa määritellyt komposiittirakenteet, -laminaatit ja niistä tehdyt valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi 9A004 kohdassa määritellyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määritellyissä luotainraketeissa tai 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106–9A108, 9A116 tai 9A119 kohdassa määritellyissä alajärjestelmissä.
- Huom.: KATSO MYÖS 1A002 KOHTA.**
- 9A111 Pulssisuihkumoottorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" tai 9A012 kohdassa tarkoitetuissa miehittämättömissä ilma-aluksissa, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.
- Huom.: KATSO MYÖS 9A011 JA 9A118 KOHTA.**
- 9A115 Seuraavat laukaisuapulaitteet:
- a. Kojeet ja laitteet käsittelyä, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja, 9A012 kohdassa määriteltyjä miehittämättömiä ilma-aluksia tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten;
  - b. Ajoneuvot kuljetusta, käsittelyä, hallintaa, aktivointia tai laukaisua varten suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja tai 9A104 kohdassa määriteltyjä luotainraketteja varten.
- 9A116 Seuraavat "ohjuksissa" käyttökelpoiset ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset sekä niitä varten suunnitellut tai muunnetut laitteet:
- a. Ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset;
  - b. Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut lämpösuojukset ja niiden osat;
  - c. Kevyistä, suuren ominaislämmön omaavista aineista valmistetut jäähdytyslevyt ja niiden osat;
  - d. Ilmakehään palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.
- 9A117 "Ohjuksissa" käyttökelpoiset raketien vaiheistuskonstruktiot, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet.
- 9A118 9A011 tai 9A111 kohdassa määritellyissä "ohjuksissa" tai 9A012 kohdassa tarkoitetuissa miehittämättömissä ilma-aluksissa käyttökelpoisten moottorien palonsäätelulaitteet.
- 9A119 Muut kuin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ja 9A109 kohdassa määritellyt yksittäiset raketien vaiheet, joita voidaan käyttää kantomatkaltaan 300 km:n täydellisissä raketijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa.

9A120 Muut kuin 9A006 kohdassa määritellyt nestemäisen polttoaineen säiliöt, jotka on erityisesti suunniteltu 1C111 kohdassa määritellyille polttoaineille tai 'muille nestemäisille polttoaineille' ja joita käytetään raketti-järjestelmissä, jotka pystyvät kuljettamaan vähintään 500 kg:n hyötykuorman vähintään 300 km:n etäisyydelle.

Huom.: 9A120 kohdassa 'muut nestemäiset polttoaineet' sisältävät asetarvikeluettelossa määritellyt polttoaineet rajoittumatta niihin.

9A350 Seuraavat suihkutus- tai sumutusjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu asennettavaksi lentokoneisiin, ilmaa kevyempiin tai miehittämättömiin ilma-aluksiin, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

- a. Täydelliset suihkutus- tai sumutusjärjestelmät, jotka pystyvät tuottamaan emulsiosta alkupisaran, jonka 'VMD' (volyymin mediaanihalkaisija) on alle 50 µm virtausnopeudella, joka on suurempi kuin kaksi litraa minuutissa;
- b. Suihkutuspuomit tai aerosolia tuottavien yksiköiden järjestelmät, jotka pystyvät tuottamaan emulsiosta alkupisaran, jonka 'VMD' on alle 50 µm virtausnopeudella, joka on suurempi kuin kaksi litraa minuutissa;
- c. Aerosolia tuottavat yksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi 9A350.a ja b kohdassa mainittuihin järjestelmiin.

Huom.: Aerosolia tuottavat yksiköt ovat laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu asennettavaksi ilma-aluksiin. Niitä ovat esimerkiksi suuttimet, pyörivät lieriösumuttimet ja vastaavat laitteet.

Huom.: 9A350 kohta ei aseta valvonnallaiseksi suihkutus- tai sumutusjärjestelmiä ja komponentteja, joiden on osoitettu olevan kyvyttömiä tuottamaan tartuntoja aiheuttavien aerosolien muodossa olevia biologisia agensseja.

Tekn. huom.:

1. Ilma-aluksissa, ilmaa kevyemmissä aluksissa tai miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettäväksi suunniteltujen suihkutuslaitteiden tai suuttimien pisarakoko on mitattava jommallakummalla seuraavista tavoista:
  - a. Doppler-"laser" menetelmä;
  - b. Forward "laser" -diffraktiomenetelmä.
2. 9A350 kohdassa 'VMD' tarkoittaa volyymin mediaanihalkaisijaa, ja vesipohjaisten järjestelmien osalta tämä vastaa massan mediaanihalkaisijaa (MMD).

**9B Testaus-, tarkastus- ja tuotantolaitteet**

- 9B001 Seuraavat erityisesti suunnitellut laitteet, työkalut tai kiinnittimet kaasuturbiinien lapojen, siipien tai kärkivai-pan valujen valmistamiseen:
- Laitteet suunnattua kiinteystystä tai yksikidevalua varten;
  - Keraamiset ytimet tai kuoret;
- 9B002 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjärjestelmät, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai automaattiset tiedonkeruu- ja -käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9E003.a kohdassa määriteltyä "teknologiaa" sisältävien kaasuturbiinimoottorien, niiden kokoonpanojen tai komponenttien "kehittämiseen".
- 9B003 Valmistus- ja testauslaitteet sellaisten kaasuturbiinien harjatiivisteiden tuotantoon, jotka on suunniteltu toimimaan 335 m/s ylittävillä kärkien nopeuksilla ja yli 773 K (500 °C) asteen lämpötiloissa, sekä näiden laitteiden erityisesti suunnitellut osat ja varusteet.
- 9B004 Työkalut, suulakkeet, tai kiinnittimet "superseoksen", titaanin tai 9E003.a.3 tai 9E003.a.6 kohdassa määriteltyjen metalliyhdisteiden airfoil-to-disk-yhdistelmien mekaaniseen liittämiseen kaasuturbiineita varten.
- 9B005 On-line (tosiaikaiset) -ohjausjärjestelmät, instrumentointi (anturit mukaan lukien) tai automaattiset tiedonkeruu- ja -käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi seuraavissa tuulitunneleissa tai laitteissa:

**Huom.: KATSO MYÖS 9B105 KOHTA.**

- Tuulitunnelit, jotka on suunniteltu 1,2 Machin tai suuremmille nopeuksille; paitsi: Sellaiset, jotka on erityisesti suunniteltu koulutustarkoituksiin, ja joiden 'testauslohkon koko' (lateraalisesti mitattuna) on vähemmän kuin 250 mm;

*Tekn. huom.:*

9B005.a kohdassa 'testauslohkon koko' tarkoittaa ympyrän läpimittaa, neliön sivua tai suorakaiteen pisintä sivua testauslohkon laajimmalla kohdalla mitattuna.

- Laitteet, joilla simuloidaan virtausympäristöjä yli 5 Machin nopeuksilla, mukaanlukien hot-shot-tunnelit, plasmakaaritunnelit, paineiskuputket, paineiskutunnelit, kaasutunnelit ja kevyet kaasutykit; tai
- Tuulitunnelit ja laitteet, muut kuin kaksidimensioiset lohkot, joilla voidaan simuloida virtauksia, joiden Reynoldsin luku on yli  $25 \times 10^6$ .

- 9B006 Erityisesti suunnitellut akustisen värähtelyn testauslaitteet, joilla voidaan tuottaa 160 dB:n tai suurempia äänenpainetasoja (verrattuna 20 TPa:iin), ja joiden nimellinen ulostuloteho on 4 kW tai enemmän testikammion lämpötilan ollessa yli 1 273 K (1 000 °C), astetta, sekä erityisesti niitä varten suunnitellut kvartsikuumentimet.

**Huom.: KATSO MYÖS 9B106 KOHTA.**

- 9B007 Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu rakettimoottorien eheyden tutkimiseen käyttäen muita ainetta rikkomattomia testimenetelmiä (NDT) kuin tasoröntgeniä tai fysikaalisia tai kemiallisia perusanalyysijä.
- 9B008 Muuntimet, jotka on erityisesti suunniteltu seinämän pintakitkan suoraan mittaamiseen testausvirtauksella, jonka stagnaatiolämpötila ylittää 833 K (560 °C) astetta.
- 9B009 Työkalut, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisten turbiinimoottorin jauhemetallurgisten roottoriosien tuotantoon, jotka kykenevät toimimaan rasiustasolla, joka on 60 % tai enemmän niiden murtovetolujuudesta (UTS) ja 873 K (600 °C) asteen tai korkeammassa metallin lämpötiloissa.
- 9B010 Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A102 kohdassa määriteltyjen "miehittämättömien ilma-alusten" ("UAV":t) ja niihin liittyvien järjestelmien, laitteiden ja komponenttien valmistamiseksi.

9B105 Mach 0,9 tai suuremmille nopeuksille tarkoitetut tuulitunnelit, joita voidaan käyttää 'ohjuksia' tai niiden alajärjestelmiä varten.

**Huom.: KATSO MYÖS 9B005 KOHTA.**

Tekn. huom.:

*9B105 kohdassa tarkoitetaan 'ohjuksella' täydellisiä raketijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 kilometriä*

9B106 Seuraavat ympäristöolosuhdekammiot tai kaiuttomat huoneet:

a. Ympäristöolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:

1. 10 g:n rms tai suurempia värinäolosuhteita 'paljaalla alustalla' mitattuna 20 Hz:n ja 2 kHz:n välillä ja 5 kN:n tai suuremmalla värinävoimalla; ja
2. 15 km:n tai suurempaa korkeutta; tai
3. Vähintään 223 K (– 50 °C) – 398 K (+ 125 °C) asteen lämpötila-aluetta;

Tekn. huom.:

1. 9B106.a kohdassa kuvataan järjestelmiä, joilla voidaan synnyttää yhden aallon (esim. siniaalto) värinäolosuhteita, ja järjestelmiä, joilla voidaan synnyttää laajan aaltoalueen satunnaista värinää (eli tehospektri);
2. 9B106.a.1 kohdassa tarkoitetaan 'paljaalla alustalla' tasaista alustaa tai sellaista pintaa, johon ei ole kiinnitetty mitään.

b. Ympäristöolosuhdekammiot, joilla voidaan simuloida seuraavia lento-olosuhteita:

1. 140 dB:n (verrattuna 20 µPa:iin) tai suurempia yleisäänepainetasoja tai 4 kW:n tai suurempaa mitoitettua akustista kokonaistehoa; ja
2. 15 km:n tai suurempaa korkeutta; tai
3. Vähintään 223 K (– 50 °C) – 398 K (+ 125 °C) asteen lämpötila-aluetta.

9B115 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A105–9A109, 9A111, 9A116 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.

9B116 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja varten tai 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A104–9A109, 9A111 tai 9A116–9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.

9B117 Kiinteää tai nestemäistä polttoainetta käyttäviä raketteja tai rakettimootoreita varten tarkoitetut testauspenkit ja testustelineet, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- a. Ne kestävät yli 68 kN työntövoimia; tai
- b. Niillä voidaan samanaikaisesti mitata kaikkien kolmen akselin työntövoimakomponentteja.

**9C Materiaalit**

9C108 Muu kuin 9A008 kohdassa määritelty "eristys"materiaali irtotavarana ja "sisäpinnanvuoraus" rakettimootorien koteloihin, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" tai jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi "ohjuksissa".

Tekn. huom.:

9C108 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka ylittää 300 km.

9C110 9A110 kohdassa määriteltyjä komposiittirakenteita, -laminaatteja ja niistä tehtyjä valmisteita varten tarkoitettua hartseilla kyllästettyä kuitupregiä ja metallipinnoitettua kuitupreformaattia varten, jotka on valmistettu joko orgaanisesta tai metallimatriisista käyttäen kuitu- tai säievahvisteita, joiden "ominaisvetolujuus" on suurempi kuin  $7,62 \times 10^4$  m ja "ominaiskimmomoduuli" suurempi kuin  $3,18 \times 10^6$  m.

**Huom.: KATSO MYÖS 1C010 ja 1C210 KOHTA.**

Huom.: Ainoat hartseilla kyllästetyt kuitupregit, jotka on määritelty 9C110 kohdassa ovat ne, joissa käytetään hartseja, joiden lasittumislämpötila ( $T_g$ ) vulkanoinnin jälkeen ylittää 418 K (145 C) astetta ASTM D4065 tai vastaavan standardin mukaan määriteltynä.

**9D Ohjelmistot**

9D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A001–9A119, 9B tai 9E003 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "teknologian" kehittämistä varten.

9D002 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A001–9A119 tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

9D003 Seuraavat "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A kohdassa määriteltyjen työntövoimajärjestelmien "täyden auktoriteetin digitaalisten moottorin ohjausten" ("FADEC") tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten:

- a. "Ohjelmistot" työntövoimajärjestelmien, avaruustestauslaitteistojen, tai ilmaa-hengittävien lentokone-moottorien testauslaitteistojen digitaalielektronisia ohjausjärjestelmiä varten;
- b. Vikasietoiset "ohjelmistot", joita käytetään työntövoimajärjestelmien "FADEC"-ohjauksissa ja niihin liittyvissä testauslaitteistoissa.

9D004 Seuraavat muut "ohjelmistot":

- a. 2D- tai 3D-viskoosiset "ohjelmistot", jotka on varmennettu tuulitunneli- tai lentotestitiedoilla, joita tarvitaan moottorivirtauksen yksityiskohtaiseen mallintamiseen;
- b. Lentokaasuturbiinimoottoreiden, niiden kokoonpanojen tai komponenttien testaamiseen tarkoitettut "ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu keräämään, rajaamaan ja analysoimaan tietoja tosiasjassa, ja jotka pystyvät takaisinkytkettyyn säätöön, mukaan lukien testauskohteiden ja testiolosuhteiden dynaaminen muuttaminen testauksen kuluessa;
- c. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu ohjaamaan suunnattua kiinteystystä tai yksikidevalua;
- d. "Lähdekoodilla", "kohdekoodilla" tai konekieliselä koodilla toimivat "ohjelmistot", joita tarvitaan roottori- ja kärkeä varten ohjauksen aktiivisten kompensointijärjestelmien "käyttöä";

*Huom.: 9D004.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "ohjelmistoja", jotka on asennettu valvonnan ulkopuolisiin laitteisiin tai joita tarvitaan ylläpitotehtävissä, jotka liittyvät aktiivisesti kompensoivien välyksen ohjausjärjestelmien kalibrointiin, huoltoon tai ajanmukaistamiseen.*

- e. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A102 kohdassa määriteltyjen "miehittämättömien ilma-alusten" ("UAV":t) ja niihin liittyvien järjestelmien, laitteiden ja komponenttien "käyttöön";
- f. "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu lentokoneiden kaasuturbiinin juoksuosien, johtosiipien ja kärkeä suojusten sisäisten jäähdytyskanavien suunnittelua varten;
- g. "Ohjelmistot", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1. Ne on erityisesti suunniteltu lentokoneiden kaasuturbiinimoottoreiden aerotermaalisten, aeromekaanisten ja palamisolosuhteiden ennustamiseksi; ja
2. Niissä on aerotermaalisten, aeromekaanisten ja palamisolosuhteiden teoreettisen mallintamisen ennusteet, jotka on validoitu todellisilla lentokoneen kaasuturbiinimoottorin (kokeellista tai tuotannollista) suorituskykyä koskevilla tiedoilla.

9D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9B105, 9B106, 9B116 tai 9B117 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.

9D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettyjen kantorakettien tai 9A104 kohdassa määriteltyjen luotainrakettien tai kohdissa 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 tai 9A119 määriteltyjen alajärjestelmien suunnittelun integrointiin.

9D103 (jatkoa)

Huom.: 9D103 kohdassa määritellyt ohjelmat ovat valvonnanalaisia myös yhdistettynä 4A102 kohdassa määriteltyihin laitteisiin.

9D104 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 tai 9A118 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

9D105 "Ohjelmistot", joissa sovitetaan yhteen useamman kuin yhden alajärjestelmän toiminta ja jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A004 kohdassa määriteltyissä avaruuteen laukaisussa käytettävissä kantoraketeissa tai 9A104 kohdassa määriteltyissä luotainraketeissa tapahtuvaa "käyttöä" varten.

**9E Teknologia**

Huom.: 9E001–9E003 kohdassa määritelty kaasuturbiinimoottorien "kehittämis"- tai "tuotantoteknologia" on valvonnanaista myös silloin, kun sitä käytetään korjauksen, uudistamisen tai huollon yhteydessä. Valvonnan ulkopuolella ovat tekninen tieto, piirustukset tai dokumentaatio sellaisia ylläpitotoimenpiteitä varten, jotka liittyvät suoraan viallisten tai ei-korjattaviksi tarkoitettujen vaihdettavien yksiköiden kalibrointiin, poistoon tai vaihtoon, kokonaiset moottorit tai niiden moduulit mukaan lukien.

9E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan" 9A001.b, 9A004–9A012, 9A350, 9B tai 9D kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" kehittämistä varten.

9E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti, jota "tarvitaan" 9A001.b, 9A004–9A011, 9A350 tai 9B kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.

Huom.: Valvonnanaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen tarvittava "teknologia": katso 1E002.f kohta.

9E003 Seuraava muu "teknologia":

a. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien kaasuturbiinimoottorikomponenttien tai järjestelmien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten:

1. Suunnatusti kiinteytyistä (DS) tai yksikideseoksista (SC) valmistetut kaasuturbiinien lavat, siivet tai kärkivaipat, jotka on mitoitettu (001 Millerin indeksin suunnassa) vähintään 400 tuntia 1 273 K (1 000 °C) asteen lämpötiloissa ja 200 MPa:n paineessa keskimääräisten ominaisarvojen perusteella;
2. Monikupuiset polttokammiot, joiden polttimen poistoaukon keskimääräinen lämpötila on yli 1 813 K (1 540 °C) astetta tai polttokammiot, joissa on termisesti erotetut vaipat, ei-metalliset vaipat tai ei-metalliset kuoret;
3. Komponentit, jotka on valmistettu jostakin seuraavista:
  - a. Orgaanisista "komposiitti"-materiaaleista, jotka on suunniteltu toimimaan yli 588 K (315 °C) asteen lämpötiloissa;
  - b. 1C007 kohdassa määritellyistä metalli"matriisi"-komposiiteista, materiaaleista, joilla on keraaminen "matriisi", metalliyhdisteistä tai lujitetuista metalliyhdisteistä; tai
  - c. "Komposiitti"-materiaaleista, jotka on määritelty 1C010 kohdassa ja valmistettu 1C008 kohdassa määritellyistä hartseista.
4. Jäähdyttämättömät turbiinien lavat, siivet, kärkien vaipat tai muut komponentit, jotka on suunniteltu toimimaan 1 323 K (1 050 °C) asteen tai korkeammassa kaasuvirran lämpötiloissa;
5. Jäähdytetyt turbiinien lavat, siivet tai kärkien vaipat, muut kuin 9E003.a.1 kohdassa kuvatut, jotka joutuvat alttiiksi 1 643 K (1 370 °C) tai korkeammille kaasuvirran lämpötiloille;
6. Lapojen liitokset, joissa kantopinta on yhdistetty roottorin kehään mekaanista liittämistä käyttäen;
7. Kaasuturbiinimoottorien komponentit, joissa on käytetty 2E003.b kohdassa määriteltyä "diffuusioliittämistä" teknologiaa;
8. Vauriosietoiset kaasuturbiinimoottorin pyörivät komponentit, joissa on käytetty 1C002.b kohdassa määriteltyjä jauhemetallurgisia materiaaleja;
9. "FADEC"-kaasuturbiini- ja yhdistelmätahtimoottoreita varten sekä siihen liittyvät diagnostiikkakomponentit, anturit ja erityisesti suunnitellut komponentit;

- 9E003 a. (jatkoa)
10. Säädettävä virtaustien geometria ja siihen liittyvät ohjausjärjestelmät:
- Kaasugeneraattoriturbiineja varten;
  - Puhallin- tai käyttöturbiineja varten;
  - Suihkusuuttimia varten;
- Huom. 1:* Aseteltavaan virtaustien geometriaan ja siihen liittyviin ohjausjärjestelmiin ei 9E003.a.10 kohdassa lueta tuloaukon johdesiipiä, säädettäviäsiipiä puhaltimia, säädettäviä staattoreita eikä ahtimen puhallus-venttiilejä.
- Huom. 2:* 9E003.a.10 kohta ei aseta valvonnallaiseksi jarrutustyöntövoiman säädettävän virtaustien geometrian "kehittämistä" tai "tuotanto" teknologiaa".
11. Ontot puhaltimien siivet;
- b. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien laitteiden "kehittämistä" ja "tuotantoa" varten:
- Tuulitunneissa käytettävät mallit, jotka on varustettu pinta-antureilla ja jotka kykenevät lähettämään tietoa antureilta tiedonkeruujärjestelmälle; tai
  - Komposiiteista valmistetut potkurien lavat tai potkurituulettimet, jotka kestävät yli 2 000 kW yli 0,55 Machin lentonopeuksilla;
- c. "Teknologia", jota "tarvitaan" kaasuturbiinimoottorin komponenttien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten käyttäen "laser"-, vesisuihku- tai ECM/EDM-reiänporausprosesseja, joilla aikaansaadaan reikiä, joilla on jokin seuraavista ominaisuusryhmistä:
- Kaikki seuraavat:
    - Syvyys enemmän kuin neljä kertaa niiden läpimitta;
    - Läpimitta vähemmän kuin 0,76 mm; ja
    - Kohtauskulma 25 astetta tai vähemmän; tai
  - Kaikki seuraavat:
    - Syvyys enemmän kuin viisi kertaa niiden läpimitta;
    - Läpimitta vähemmän kuin 0,4 mm; ja
    - Kohtauskulma enemmän kuin 25 astetta;
- Tekn. huom.:*
- 9E003.c kohdassa kohtauskulma mitataan tasosta, joka sivuaa kantopintaa pisteessä, jossa reiän keskiviiva lävistää kantopinnan.
- d. "Teknologia", jota "tarvitaan" helikopterien tehonsiirtojärjestelmien tai kääntöväroottorien tai kääntöväsiipisten "ilma-alusten" tehonsiirtojärjestelmien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten;
- e. "Teknologia", jota "tarvitaan" maakulkuneuvojen työntövoimajärjestelmien sellaisten diesel(mäntä) moottorien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
- 'Kotelotilavuus' on 1,2 m<sup>3</sup> tai vähemmän;
  - Kokonaisantoteho on enemmän kuin 750 kW 80/1269/EEC:n, ISO 2534:n tai vastaavan kansallisen standardin mukaisesti määritettynä; ja
  - Tehon tiheys on enemmän kuin 700 kW 'kotelotilavuuden' m<sup>3</sup>:ää kohti;

9E003 e. (jatkoa)

Tekn. huom.:

'Kotelotilavuus' 9E003.e kohdassa on kolmen toisiaan vastaan kohtisuorassa olevan, seuraavalla tavalla mitatun dimension tulo:

Pituus: Kampiakselin pituus etulaipasta vauhtipyörän etusivuun;

Leveys: Suurin seuraavista:

- a. Ulkomitta venttiilin kannesta toiseen venttiilin kanteen;
- b. Sylinterinkansien ulkoreunojen mitat; tai
- c. Vauhtipyörän kotelon läpimitta;

Korkeus: Suurin seuraavista:

- a. Kampiakselin keskiviivasta venttiilin kannen päällimmäiseen tasoon (tai sylinterinkanteen) otettu mitta laskettuna yhteen kaksinkertaisen iskunpituuden kanssa; tai
- b. Vauhtipyörän kotelon läpimitta.

f. "Teknologia", jota "tarvitaan" seuraavien, erityisesti korkeatehoisia dieselmootoreita varten suunniteltujen komponenttien "tuotantoa" varten:

1. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten moottorijärjestelmien "tuotantoa" varten, joiden kaikki seuraavat osat on valmistettu käyttäen 1C007 kohdassa määriteltyjä valvonnanalaisia keraamisia materiaaleja:

- a. Sylinteriputket;
- b. Männät;
- c. Sylinterinkannet; ja
- d. Yksi tai useampia muita komponentteja (mukaan lukien pakoaukot, turboahtimet, venttiilien ohjaimet, venttiilikokoonpanot tai eristetyt polttoaineen suihkuttimet;

2. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten turboahdinjärjestelmien tuotantoon, joissa on yksivaiheiset kompressorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

- a. Toimivat 4:1 tai suuremmilla painesuhteilla;
- b. Massavirtaus on 30–130 kg minuutissa; ja
- c. Kompressori- tai turbiiniosan virtausläpimittaa voidaan muuttaa;

3. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten polttoaineen suihkutusjärjestelmien tuotantoon, jotka on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan useiden polttoaineiden (esim. diesel- tai suihkumootoripolttoaineet) käyttö viskositeettialueella, joka ulottuu dieselpolttoaineesta (2,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) asteessa) bensiiniin (0,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) asteessa), ja joilla on molemmat seuraavista:

- a. Suihkutusmäärä ylittää 230 mm<sup>3</sup> suihkutusta ja sylinteriä kohti; ja
- b. Erityisesti suunnitellut elektroniset ohjaustoiminnot, jotka käyttämällä sopivia antureita vaihtavat polttoaineen ominaisuuksista riippuen automaattisesti säätimen arvoja niin että vääntömomenttiominaisuudet pysyvät samoina;

g. "Teknologia", jota "tarvitaan" sellaisten korkeatehoisten dieselmootorien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten, joissa käytetään sylinteriseinämän kiinteää, kaasumaista tai nestekalvovoitelua (tai näiden yhdistelmää), joka sallii toiminnan yli 723 K (450 °C) asteen lämpötiloissa (mitattuna männän ylärenkaan liikkeen ylärajalta sylinterin seinämään).

9E003 g. (jatkoa)

Tekn. huom.:

*Korkeatehoisia dieselmootoreita ovat dieselmootorit, joiden keskimääräiseksi teholliseksi jarrutuspaineksi on määritely 1,8 MPa tai enemmän 2 300 rpm:n kierrosnopeudella, edellyttäen että nimellinen kierrosnopeus on 2 300 rpm tai enemmän.*

9E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A101, 9A104–9A111 tai 9A115–9A119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

9E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A004 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien tai 9A005–9A011, 9A101, 9A104–9A111, 9A115–9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 tai 9D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

---

## LIITE II

## YHTEISÖN YLEINEN VIENTILUPA N:o EU001

(asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklassa tarkoitettu)

## Myöntävä viranomainen: Euroopan yhteisö

## Osa 1

Tämä vientilupa koskee seuraavia tuotteita:

Kaikki tämän asetuksen liitteen I missä tahansa kohdassa mainitut kaksikäyttötuotteet, lukuun ottamatta jäljempänä osassa 2 lueteltuja tuotteita

## Osa 2

- Kaikki liitteessä IV tarkoitettut tuotteet
- 0C001 "Luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.
- 0C002 Muut kuin liitteessä IV mainitut "erityiset halkeamiskelpoiset materiaalit".
- 0D001 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten *siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.*
- 0E001 "Teknologia" ydinteknologiahuomautuksen mukaisesti ryhmässä 0 määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten *siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.*
- 1A102 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin tarkoitettut toistokyllästetyt pyrolysoidut hiili-hiilikomponentit.
- 1C351 Ihmispatogeenit, zoonoosit ja "toksiinit".
- 1C352 Eläinpatogeenit.
- 1C353 Geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit.
- 1C354 Kasvipatogeenit.
- 7E104 "Teknologia" lennon ohjaus-, ohjautus- ja työntövoimatietojen integrointiin lennonhallintajärjestelmäksi rakettijärjestelmän lentoradan optimoimiseksi.
- 9A009.a. Hybridipolttoainetta käyttävien rakettien työntövoimajärjestelmät, joiden kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MN
- 9A117 "Ohjuksissa" käyttökelpoiset rakettien vaiheistusmekanismit, irrotusmekanismit ja vaiheiden väliset laitteet.

## Osa 3

Tämä vientilupa on voimassa kaikkialla yhteisössä seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä:

- Australia
- Kanada
- Japani
- Uusi-Seelanti
- Norja
- Sveitsi
- Amerikan yhdysvallat

Huom: Osia 2 ja 3 voidaan muuttaa vain niiden asiaa koskevien velvoitteiden ja sitoumusten mukaisesti, joita kukin jäsenvaltio on hyväksynyt kansainvälisten asetus- ja vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä, ja kunkin jäsenvaltion yleisten turvallisuusasetusten mukaisesti sellaisina kuin ne ilmenevät sen vastuussa päättää kaksikäyttötuotteiden vientilupahakemuksista tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

#### **Tämän luvan käytön edellytykset ja vaatimukset**

- 1) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, jos viejä on saanut tiedon sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuna käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden tai muiden ydinräjähdeiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen tai tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin tai jos viejä tietää, että kyseiset tuotteet ovat tarkoitettuna tällaiseen käyttöön.
- 2) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, jos viejä on saanut tiedon sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla tarkoitettuna tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun sotilaskäyttöön maassa, johon kohdistuu Euroopan unionin, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tai Yhdistyneiden Kansakuntien aseasto, tai jos viejä on tietoinen, että kyseiset tuotteet on tarkoitettu mainitunlaiseen käyttöön.
- 3) Tätä yleislupaa ei saa käyttää, kun kyseiset tuotteet viedään tullivapaalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, joka sijaitsee luvan kattamassa määräpaikassa.
- 4) Jäsenvaltiot määrittelevät tämän yleisluvan käyttöön liittyvät rekisteröinti- ja ilmoitusvaatimukset sekä lisätiedot, jotka jäsenvaltio, josta vienti tapahtuu, saattaa vaatia luvan perusteella viedyistä tuotteista. Näiden vaatimusten on perustuttava niihin vaatimuksiin, jotka koskevat niiden jäsenvaltioiden myöntämien yleisten vientilupien käyttöä, joissa säädetään kyseisistä luvista.

## LIITE IIIa

## (lomakemalli)

## (10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu)

EUROOPAN YHTEISÖ

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTI (Asetus (EY) N:o ...)

LUPA	1	1. Viejä N:o	2. Tunnistenumero	3. Viimeinen voimassaolopäivä ( <i>tarvittaessa</i> )		
			4. Yhteystiedot			
		5. Vastaanottaja	6. Myöntävä viranomainen			
		7. Asiamies/edustaja (jos toinen kuin viejä) N:o	8. Alkuperämaa ( <i>tarvittaessa</i> )		Koodi (1)	
			9. Vastaanottava maa ( <i>tarvittaessa</i> )		Koodi (1)	
		10. Loppukäyttäjä (jos toinen kuin vastaanottaja)	11. Tuotteiden nykyinen tai tuleva sijaintijäsenvaltio		Koodi (1)	
			12. Jäsenvaltio, jossa tavara aiotaan asettaa vientimenettelyyn		Koodi (1)	
			13. Lopullinen määrämaa		Koodi (1)	
	1	14. Tavarankuvaus (2)		15. Tavarankoodi ( <i>tarvittaessa</i> )	16. Tarkastusluetelo N:o	
			17. Valuutta ja arvo	18. Tuotteiden määrä ( <i>tarvittaessa</i> )		
	19. Loppukäyttö	20. Sopimuksen päivä- määrä ( <i>tarvittaessa</i> )	21. Vientimenettely			
	22. Kansallisen lainsäädännön vaatimia lisätietoja (tarkennettava lomakkeessa)					
	<p>Jäsenvaltioiden käytettävissä esipainettuja tietoja varten</p> <p>Myöntävä viranomainen täyttää</p> <p>Allekirjoitus <span style="float: right;">Leima</span></p> <p>Myöntävä viranomainen</p> <p>Päiväys</p>					

(1) Katso asetus (EY) N:o 1172/95 (EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10), sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna.

(2) Tarvittaessa kuvaus voidaan esittää yhdellä tai useammalla tämän lomakkeen liitteellä (1 a). Tällöin on tässä kohdassa mainittava liitteiden tarkka lukumäärä.





## LIITE IIIb

## YLEISVIENTILUPIA JULKAISTAESSA ANNETTAVAT TIEDOT JA KÄYTETTÄVÄT ILMAISUT

(10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu)

- 1) Yleisen vientiluvan otsake
- 2) Luvan myöntävä viranomainen
- 3) Voimassaolo EY:n alueella. Seuraavaa tekstiä on käytettävä:

”Tämä on asetuksen (EY) N:o 1334/2000 6 artiklan 2 kohdan mukainen yleisvientilupa. Tämä lupa on kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti voimassa kaikissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa.”

- 4) Tuotteet, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on käytettävä:

”Tämä vientilupa kattaa seuraavat tuotteet”

- 5) Määräpaikat, joita lupa koskee: seuraavaa johdantoa on käytettävä:

”Tämä vientilupa on voimassa seuraaviin määräpaikkoihin suuntautuvassa viennissä”

- 6) Edellytykset ja vaatimukset

---

## LIITE IV

## (asetuksen (EY) N:o 1334/2000 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo)

Luettelon kohdissa ei aina ole tuotteen täydellistä kuvausta ja siihen liittyviä, liitteessä I olevia huomautuksia <sup>(1)</sup>. Tuotteiden täydellinen kuvaus on vain liitteessä I.

Tuotteen mainitseminen tässä liitteessä ei vaikuta liitteessä I olevia massatuotantotuotteita koskevien säännösten soveltamiseen.

## Osa I

(mahdollisuus myöntää kansallinen yleisvientilupa yhteisön sisäistä kauppaa varten)

## Häive (Stealth-) tekniikka

1C001 Materiaalit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi sähkömagneettista säteilyä absorboivina aineina, tai itseisjohtavat polymeerit.

**HUOM.: KATSO MYÖS 1C101 KOHTA**

1C101 Muut kuin 1C001 kohdassa määritellyt, 'ohjuksissa', "ohjusten" alajärjestelmissä tai 9A012 kohdassa määritellyissä miehittämättömissä ilma-aluksissa käyttökelpoiset materiaalit ja laitteet, jotka pienentävät havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta tai ultravioletti-, infrapuna- ja akustista havaittavuutta.

*Huom:* 1C101 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi materiaaleja, jos kyseessä olevat tuotteet on suunniteltu ainoastaan siviilisovelluksia varten.

*Tekn. huom.:*

1C101 kohdassa 'ohjuksella' tarkoitetaan tarkoitetaan täydellisiä rakettijärjestelmiä ja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.

1D103 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu analysoimaan vähennettyä havaittavuutta, kuten tutkaheijastavuutta tai ultravioletti/infrapuna- ja akustista havaittavuutta.

1E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C101 tai 1D103 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

1E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1D103 kohdassa määriteltyjen "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.

6B008 Tutkan kaikupinnan pulssimittausjärjestelmät, joiden pulssinpituus on 100 ns tai vähemmän, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

**HUOM.: KATSO MYÖS 6B108 KOHTA.**

6B108 Järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tutkapaokkipintojen mittaamiseen ja joita voidaan käyttää "ohjuksissa", ja niiden alajärjestelmät.

## Yhteisön strateginen valvonta

1C239 Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt voimakkaat räjähteet tai niitä enemmän kuin 2 painoprosenttia sisältävät seokset tai aineet, joiden kideitiheys on suurempi kuin 1,8 g/cm<sup>3</sup> ja räjähdysnopeus yli 8 000 m/s.

1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C239 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.

(<sup>1</sup>) Liitteiden I ja IV sanamuotojen ja soveltamisalojen väliset erot on tekstissä lihavoitu ja kursivoitu.

- 3A229 Seuraavat laukaisulaitteet ja vastaavat suurvirtapulssigeneraattorit ...  
**HUOM.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.**
- 3A232 Seuraavat syyttimet ja monipistesyyttinjärjestelmät ...  
**HUOM.: KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO.**
- 3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A229 tai 3A232 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 6A001 Akustiikka seuraavasti:
- 6A001.a.1.b. Kohteen havaitsemis- tai paikantamisjärjestelmät, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Lähetystaajuus **alle 5 kHz**;
  6. Suunniteltu kestämaan;
- 6A001.a.2.a.2. Hydrofonit ... Sisältävät ...
- 6A001.a.2.a.3. Hydrofonit ... joilla on ...
- 6A001.a.2.a.6. Hydrofonit ... Suunniteltu ...
- 6A001.a.2.b. Hinattavat akustiset hydrofonijärjestelmät ...
- 6A001.a.2.c. Hinattavia akustisia hydrofonijärjestelmiä käytettäessä **reaaliaikaisia sovelluksia** varten erityisesti suunnitellut akustiset hydrofonijärjestelmät, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- ja taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
- 6A001.a.2.e. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmä, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:
1. Se sisältää hydrofoneja ..., tai
  2. Multipleksoituja hydrofoniryhmien signaalimoduleja ...
- 6A001.a.2.f. Pohja- tai poukamakaapelijärjestelmien **reaaliaikaisia sovelluksia** varten erityisesti suunnitellut (signaalien) käsittelylaitteet, jotka ovat "käyttäjän ohjelmoitavissa" ja joissa on aika- tai taajuusalueen käsittely ja korrelaatio, mukaan lukien spektrianalyysi, digitaalinen suodatus ja säteen muotoilu käyttäen nopeaa Fourier-muunnosta tai muita muunnoksia tai käsittelyjä;
- 6D003.a. "Ohjelmistot" akustisen tiedon "tosiaikaiseksi käsittelemiseksi";
- 8A002.o.3. Seuraavat melunvaimennusjärjestelmät, joita käytetään 1 000 tonnin tai suuremman uppouman aluksissa:
- b) Aktiiviset äänen vaimennus- tai kumoamisjärjestelmät, tai erityisesti tehonsiirtojärjestelmiin suunnitellut magneettiset laakerit, jotka sisältävät elektronisia ohjausjärjestelmiä, ja jotka kykenevät aktiivisesti vähentämään laitteiden tärinää tuottamalla melun tai tärinän vastasignaaleja suoraan melun tai tärinän lähteeseen;
- 8E002.a. "Teknologia", joka on tarkoitettu erityisesti vedenalaisen melun vähentämiseen suunniteltujen potkurien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.

#### Yhteisön strateginen valvonta – Salaus – ryhmä 5 – 2 osa

- 5A002.a.2. laitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suorittamaan salauksen analysointitoimintoja.
- 5D002.c.1. ainoastaan ohjelmistot, joilla on kyseisten laitteiden ominaisuuksia tai jotka suorittavat tai simuloivat kohdassa 5A002.a.2. mainittujen laitteiden toimintoja.
- 5E002. ainoastaan teknologia edellä kohdassa 5A002.a.2. tai 5D002.c.1. mainittujen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä", "tuotantoa" tai "käyttöä" varten.

## MTCR-tekniikka

- 7A117 "Ohjautuslaitteet", joita voidaan käyttää "ohjuksissa", jotka kykenevät 3,33 %:n tai sitä parempaan järjestelmätarkkuuteen toimintaetäisyydellä (esim. "CEP" on 10 km tai vähemmän 300 km:n matkalla) **lukuun ottamatta "ohjautuslaitteita", jotka on tarkoitettu ohjuksiin, joiden kantamatka on alle 300 km, tai miehitettyihin ilma-aluksiin.**
- 7B001 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteet.  
*Huom:* 7B001 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi ylläpitotasojen I tai II testaus-, kalibrointi- tai linjauslaitteita.
- 7B003 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjen laitteiden "tuotantoon" erityisesti suunnitellut laitteet.
- 7B103 **edellä 7A117 kohdassa** määriteltyjä laitteita varten erityisesti suunnitellut "tuotantolaitokset".
- 7D101 "Ohjelmistot", jotka on erityisesti suunniteltu **edellä** 7B003 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 7E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "kehittämistä" varten.
- 7E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003 tai 7B103 kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
- 7E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 7A117, 7B003, 7B103 tai 7D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ohjelmien "käyttöä" varten.
- 9A004 Avaruuteen laukaisussa käytettävät kantoraketit **jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**  
**HUOM.: KATSO MYÖS 9A104 KOHTA.**  
*Huom. 1:* 9A004 kohta ei aseta valvonnanalaisiksi hyötykuormia.
- 9A005 Nestemäistä polttoainetta käyttävien raketien työntövoimajärjestelmät, jotka sisältävät mitä tahansa 9A006 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai komponentteja, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.**  
**HUOM.: KATSO MYÖS 9A105 JA 9A119 KOHTA.**
- 9A007.a. Kiinteää polttoainetta käyttävien raketien työntövoimajärjestelmät, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin**, joilla on jokin seuraavista:  
**HUOM.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.**  
a. Kokonaisimpulssikapasiteetti ylittää 1,1 MNs;
- 9A008.d. Seuraavat erityisesti kiinteätä polttoainetta käyttävien raketien työntövoimajärjestelmiä varten suunnitellut komponentit:  
**HUOM.: KATSO MYÖS 9A108.c. KOHTA.**  
d. Liikkuvan suuttimen tai sekundäärisen polttoaineen ruiskutuksen työntövektorin ohjausjärjestelmät, **joita voidaan käyttää edellä 9A004 kohdassa määriteltyihin avaruuteen laukaisussa käytettäviin kantoraketteihin tai jäljempänä 9A104 kohdassa määriteltyihin luotainraketteihin.**  
1. Jotka kykenevät yli  $\pm 5$  asteen liikkeeseen akselinsa ympäri;  
2. Joiden kulmavektoria voidaan kääntää 20 astetta sekunnissa tai enemmän; tai  
3. Joiden kulmavektoriikihtyvyys on 40 astetta/s<sup>2</sup> tai enemmän.

9A104 Luotainraketit, jotka kykenevät vähintään 300 km:n kantomatkkaan **vähintään 500 kg:n hyötykuormalla.**

**HUOM.: KATSO MYÖS 9A004 KOHTA.**

9A105.a. Seuraavat nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit:

**HUOM.: KATSO MYÖS 9A119 KOHTA.**

a. Muut kuin 9A005 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja joiden kokonaisimpulssikapasiteetti on 1,1 MNs tai suurempi **lukuun ottamatta nestemäistä polttoainetta käyttäviä huippurakettimoottoreita, jotka on suunniteltu tai muunnettu satelliittisovelluksiin ja joilla on:**

1. **Suuttimen halkaisija 20 mm tai vähemmän;**
2. **Palokammionpaine 15 bar tai vähemmän.**

9A106.c. Seuraavat muut kuin 9A006 kohdassa määritellyt nestemäistä polttoainetta käyttäviin raketteihin erityisesti suunnitellut järjestelmät ja komponentit, joita voidaan käyttää ohjuksissa:

c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät **lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu raket-tijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyöty-kuormalla.**

Tekn. huom.:

Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A106.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:

1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.

9A108.c. Seuraavat muut kuin 9A008 kohdassa määritellyt komponentit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteää polttoainetta käyttävien raketien työntövoimajärjestelmiä varten:

c. Työntövoimavektorin ohjauksen alajärjestelmät **lukuun ottamatta niitä, jotka on suunniteltu raket-tijärjestelmille, jotka eivät kykene vähintään 300 km:n kantomatkkaan vähintään 500 kg:n hyöty-kuormalla.**

Tekn. huom.:

Esimerkkejä tavoista, joilla saavutetaan 9A108.c kohdassa määritelty työntövoimavektorin ohjaus:

1. Taipuisa suutin;
2. Neste- tai toisiokaasusuihkutus;
3. Liikkuva moottori tai suutin;
4. Poistokaasuvirtauksen poikkeutus (suihkusiivekkeet tai -tangot); tai
5. Työntövoimalaipat.

9A116 Seuraavat "ohjuksissa" käyttökelpoiset ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset sekä niitä varten suunnitellut tai muunnetut laitteet, **paitsi aseistamattomia hyötykuormia varten suunnitellut:**

- a. Ilmakehään palaamaan suunnitellut alukset;
- b. Keraamisista tai sulamalla kuluvista aineista valmistetut lämpösuojukset ja niiden osat;
- c. Kevyistä, suuren ominaislämmön omaavista aineista valmistetut jäähdytyslevyt ja niiden osat;
- d. Ilmakehään palaaviin aluksiin erityisesti suunnitellut elektroniset laitteet.

- 9A119 Muut kuin **edellä** 9A005 tai 9A007.a kohdassa määritellyt yksittäiset rakettien vaiheet, joita voidaan käyttää **vähintään 500 kg:n hyötykuormalla** 300 km:n kantomatkaan täydellisissä raketijärjestelmissä tai miehittämättömissä ilma-aluksissa.
- 9B115 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" **edellä** 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9B116 Erityisesti suunnitellut "tuotantolaitteet" 9A004 kohdassa määriteltyjä avaruuteen laukaisussa käytettäviä kantoraketteja varten tai **edellä** 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjä järjestelmiä, alajärjestelmiä ja komponentteja varten.
- 9D101 Ohjelmistot, jotka on erityisesti suunniteltu **edellä** 9B116 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 9E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai "ohjelmistojen" "kehittämistä" varten.
- 9E002 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 tai 9B116 kohdassa määriteltyjen laitteiden "tuotantoa" varten.
- Huom.: Valvonnalaisten rakenteiden, laminaattien ja materiaalien korjaukseen tarvittava teknologia: katso 1E002.f kohta.
- 9E101 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 tai 9A119 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 9E102 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti **edellä** 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 tai 9D101 kohdassa määriteltyjen avaruuteen laukaisussa käytettävien kantorakettien "käyttöä" varten.

— Poikkeukset:

Liitteen IV mukaan seuraava MTCR-tekniikka ei ole valvonnan alaista:

- 1) tuotteet, jotka siirretään Euroopan avaruusjärjestön (ESA) sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka ESA siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi,
- 2) tuotteet, jotka siirretään jäsenvaltion kansallisen avaruusjärjestön sopimussuhteen mukaisesta määräyksestä tai jotka se siirtää virallisten tehtäviensä hoitamiseksi,
- 3) tuotteet, jotka siirretään kahden tai useamman eurooppalaisen hallituksen allekirjoittaman yhteisön avaruuteen laukaisua koskevan kehittämis- ja tuotanto-ohjelman yhteydessä annetun sopimussuhteen mukaisen määräyksen perusteella,
- 4) tuotteet, jotka siirretään valtion valvomalle avaruuteenlaukaisupaikalle jäsenvaltion alueella, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio valvoo kyseisiä siirtoja tämän asetuksen ehtojen mukaisesti.

## Osa II

(ei kansallista yleisvientilupaa yhteisön sisäistä kauppaa varten)

### Kemiallisten aseiden kieltosopimus

- 1C351.d.4 Risiini  
1C351.d.5 Saxitoksiini

### NSG-tekniikka

Liitteen I **ryhmä 0 kokonaisuudessaan** sisältyy liitteeseen IV, **lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja:**

- 0C001: tämä kohta **ei** sisälly liitteeseen IV;
- 0C002: 0C002 kohta sisältyy liitteeseen IV **ainoastaan** seuraavien erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien osalta:
  - a. erotettu plutonium;
  - b. isotoopeilla 233 tai 235 yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani.

- OD001: (ohjelmistot) **sisältyvät** liitteeseen IV, **paitsi siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**
- OE001: (teknologia) **sisältyy** liitteeseen IV, **paitsi siltä osin kuin se liittyy 0C001 kohtaan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV.**

**Huom:** Kohdat **0C003** ja **0C004** ainoastaan "ydinreaktorissa" käyttöä varten (0A001.a kohdan puitteissa).

1B226 Sähkömagneettiset isotooppierottimet, jotka on suunniteltu toimimaan tai varusteltu yhdellä tai useilla ionilähteillä, joilla voidaan saada aikaan 50 mA:n tai suurempi ionisuihkun kokonaisvirta.

Huom: 1B226 kohta sisältää erottimet:

- a. Jotka pystyvät rikastamaan pysyviä isotooppeja;
- b. Joissa ionilähteet ja -kerääjät ovat kummatkin magneettikentässä, sekä ne konfiguraatiot, joissa ne ovat kentän ulkopuolella.

1C012 Seuraavat materiaalit:

Tekn. huom.:

Näitä materiaaleja käytetään tyypillisesti ydinlämpölähteissä

- b. "Aiemmin erotettu" neptunium-237 missä tahansa muodossa.

Huom: 1C012.b kohta ei aseta valvonnalliseksi toimituksia, joissa neptunium-237 sisältö on 1 g tai vähemmän.

1B231 Seuraavat tritiumlaitokset ja -tehtaat ja niissä käytettävät laitteet:

- a. Laitokset tai tehtaat, joissa tuotetaan, otetaan talteen, uutetaan, rikastetaan tai käsitellään tritiumia,
- b. Tritiumlaitosten tai -tehtaiden laitteet seuraavasti:
  1. Vedyn tai heliumin jäähdytysyksiköt, joissa lämpötila saadaan lasketuksi 23 K (– 250 °C) asteeeseen tai alhaisemmaksi ja joiden lämmönpoistokyky on suurempi kuin 150 W;
  2. Vetyisotooppien varastointi- ja puhdistusjärjestelmät, joissa varastointiin tai puhdistukseen käytetään metallihydridejä.

1B233 Litiumisotooppien erotukseen käytettävät laitokset tai tehtaan ja niissä käytettävät laitteet seuraavasti:

- a. Laitokset tai tehtaat litiumisotooppien erottamiseen;
- b. Laitteet litiumisotooppien erottamiseen seuraavasti:
  1. Erityisesti litiumamalgaameja varten suunnitellut pakatut neste-neste erotuskolonnit,
  2. Elohopea- tai litiumamalgaamipumput,
  3. Litiumamalgaamielektrolyysikennot,
  4. Haihduttimet väkeviä litiumhydroksiliuoksia varten.

1C233 Litium, joka on rikastettu 6-isotoopilla (<sup>6</sup>Li) suurempaan kuin luonnolliseen isotooppipitoisuuteen sekä rikastettua litiumia sisältävät tuotteet tai laitteet, seuraavasti: seokset (lejeeringit), yhdisteet, litiumia sisältävät seokset, näistä tehdyt valmisteet, sekä kaikesta edellä mainitusta syntyvä jäte tai romu.

Huom: 1C233 ei aseta valvonnalliseksi termoluminesenssiannosmittareita.

Tekn. huom.:

Litiumin 6-isotoopin pitoisuus luonnossa on noin 6,5 painoprosenttia (7,5 atomiprosenttia).

- 1C235 Tritium, tritiumyhdisteet ja tritiumia sisältävät seokset, joissa tritiumatomien lukumääräsuhte vetyatomeihin ylittää 1:1 000 sekä mitä tahansa edellä mainittua ainetta sisältävät tuotteet ja laitteet.
- Huom.: 1C235 ei aseta valvonnallaiseksi tuotteita ja laitteita, joissa on vähemmän kuin  $1,48 \times 10^3$  GBq (40 Ci) tritiumia.*
- 1E001 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1C012 b kohdassa määriteltyjen tuotteiden tai materiaalien "kehittämistä" tai "tuotantoa" varten.
- 1E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 tai 1C235 kohdassa määriteltyjen tuotteiden "käyttöä" varten.
- 3A228 Seuraavat kytkinlaitteet:
- a. Kylmäkatodiputket, olivatpa ne sitten kaasutäytteisiä tai ei, jotka toimivat kipinävälin tavoin ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:
1. Ne sisältävät kolme tai useampia elektrodeja;
  2. Huippuanodijännitteen nimellisarvo on 2,5 kV tai enemmän;
  3. Huippuanodivirran nimellisarvo on 100 A tai enemmän; ja
  4. Anodin viiveaika on 10  $\mu$ s tai lyhyempi;
- Huom.: 3A228 kohtaan sisältyvät kaasukryptonputket ja tyhjöspryttonputket.*
- b. Liipaistavat kipinävälit, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
1. Anodiviiveaika on 15  $\mu$ s tai lyhyempi; ja
  2. Huippuvirran nimellisarvo 500 A tai enemmän;
- 3A231 Neutronigeneraattorijärjestelmät, mukaan lukien putket, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:
- a. Ne on suunniteltu toimimaan ilman ulkoista tyhjöjärjestelmää; ja
- b. Hyväksikäyttävät sähköstaattista kiihdytystä tritium-deuteriumydinreaktion synnyttämiseen.
- 3E201 "Teknologia" yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 3A228.a, 3A228.b tai 3A231 kohdassa määriteltyjen laitteiden "käyttöä" varten.
- 6A203 Seuraavat muut kuin 6A003 kohdassa määritellyt kamerat ja komponentit:
- a. Seuraavat mekaaniset pyöriväpeiliset kamerat ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:
1. Erilliskuvia ottavat kamerat, joiden tallennusnopeus on suurempi kuin 225 000 kuvaa/s;
  2. Juovakamerat, joiden piirtonopeus on suurempi kuin 0,5 mm/s;
- Huom.: 6A203.a kohdassa näiden kameroiden komponentteihin sisältyvät niiden synkronointielektroniikkayksiköt sekä turbiineista, peileistä ja laakereista koostuvat roottorikokoonpanot.*
- 6A225 Nopeusinterferometrit yli 1 km/s nopeuksien mittaamiseksi lyhyemmän kuin 10 mikrosekunnin aikajakson kuluessa
- Huom.: 6A225 kohtaan sisältyvät sellaiset nopeusinterferometrit kuten VISAR:it ja DLI:t (dopplerlaserinterferometrit).*
- 6A226 Seuraavat paineanturit:
- a. Manganiini-anturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita;
- b. Kvartsipaineanturit, joilla mitataan yli 10 GPa:n paineita."